Automation PC 810

Anwenderhandbuch

Version: 1.48 (Mai 2013)

Best. Nr.: MAAPC800-GER

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Drucklegung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Kapitel 1: Allgemeines	
Kapitel 2: Technische Daten	
Kapitel 3: Inbetriebnahme	
Kapitel 4: Software	
Kapitel 5: Normen und Zulassungen	
Kapitel 6: Zubehör	
Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung	
Anhang A	

Kapitel 1 Allgemeines	
1 Handbuchhistorie	14
2 Sicherheitshinweise	19
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	19
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen	19
2.2.1 Verpackung	19
2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung	19
2.3 Vorschriften und Maßnahmen	19
2.4 Transport und Lagerung	
2.5 Montage	
2.6 Betrieb	
2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile	
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase	
2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme	
2.7 Umweltgerechte Entsorgung	
2.7.1 Werkstofftrennung	
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen	
4 Richtlinien	
5 Übersicht	23
Kapitel 2 Technische Daten	27
1 Einleitung	
1.1 Features	28
1.2 Aufbau / Konfiguration	28
1.3 Konfiguration - Grundsystem	29
1.4 Konfiguration - optionale Komponenten	
2 Gesamtgerät	
2.1 Temperaturangaben	
2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur	32
2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur	37
2.1.3 Temperaturüberwachung	
2.1.4 Temperatursensorpositionen	
2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben	
2.3 Leistungshaushalt	
2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung	
2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= D0	
2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < D0	
2.3.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= D0	
2.3.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < D0	
2.3.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00	
2.3.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00	
2.4 Serialnummernaufkleber	
2.5 Blockschaltbilder	
2.5.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00	
2.5.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01	
2.5.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00	
2.5.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01	
2.5.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00	
2.5.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00	
2.5.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01	
2.5.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02	
2.6 Geräteschnittstellen	
2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC	
2.6.2 Serielle Schnittstelle COM1	
2.6.3 Serielle Schnittstelle COM2	
2.6.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)	
2.6.5 Ethernet 1 (ETH1)	61

2.6.6 Ethernet 2 (ETH2)	
2.6.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)	63
2.6.8 MIC, Line IN, Line OUT	64
2.6.9 Add-on Schnittstellensteckplatz	64
2.6.10 Add-on USV Steckplatz	65
2.6.11 AP Link Steckplatz	65
2.6.12 Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)	66
2.6.13 Status LEDs	68
2.6.14 CMOS Profile Schalter	68
2.6.15 Power Taster	69
2.6.16 Reset Taster	69
2.6.17 Batterie	70
2.6.18 Hardware Security Key (Dongle)	71
2.6.19 CompactFlash Slot 1	72
2.6.20 CompactFlash Slot 2	72
2.6.21 Slide-in Slot 1	73
2.6.22 Slide-in Slot 2	73
2.6.23 Slide-in compact Slot	
3 Einzelkomponenten	
3.1 Systemeinheiten	
3.1.1 5PC810.SX01-00	75
3.1.2 5PC810.SX02-00	82
3.1.3 5PC810.SX03-00	89
3.1.4 5PC810.SX05-00	96
3.2 Buseinheiten	103
3.2.1 Allgemeines	103
3.2.2 Bestelldaten	104
3.2.3 Technische Daten	104
3.3 CPU Boards 945GME	106
3.3.1 Allgemeines	106
3.3.2 Bestelldaten	106
3.3.3 Technische Daten 5PC800.B945-0x	107
3.3.4 Technische Daten 5PC800.B945-1x	
3.4 Kühlkörper	109
3.4.1 Bestelldaten	109
3.4.2 Technische Daten	109
3.5 Hauptspeicher	111
3.5.1 Allgemeines	
3.5.2 Bestelldaten	
3.5.3 Technische Daten	
3.6 Laufwerke	
3.6.1 5AC801.HDDI-00	
3.6.2 5AC801.HDDI-01	
3.6.3 5AC801.HDDI-02	
3.6.4 5AC801.HDDI-03	
3.6.5 5AC801.HDDI-04	
3.6.6 5AC801.SSDI-00	
3.6.7 5AC801.SSDI-01	
3.6.8 5AC801.SSDI-02	
3.6.9 5AC801.SSDI-03	
3.6.10 5MMSSD.0060-00	
3.6.11 5MMSSD.0060-01	
3.6.12 5MMSSD.0180-00	
3.6.13 5AC801.ADAS-00	
3.6.14 5AC801.HDDS-00	
3.6.15 5AC801.DVDS-00	
3.6.16 5AC801.DVRS-00	

3.6.17 5ACPCI.RAIC-01	
3.6.18 5ACPCI.RAIC-02	
3.6.19 5ACPCI.RAIC-03	151
3.6.20 5ACPCI.RAIC-04	154
3.6.21 5ACPCI.RAIC-05	156
3.6.22 5ACPCI.RAIC-06	159
3.6.23 5MMHDD.0250-00	162
3.6.24 5MMHDD.0500-00	164
3.7 Lüfter Kit	
3.7.1 5PC810.FA01-00	166
3.7.2 5PC810.FA02-01	
3.7.3 5PC810.FA03-00	168
3.7.4 5PC810.FA05-00	169
3.8 AP Link Steckkarten	
3.8.1 5AC801.SDL0-00	
3.8.2 5AC801.RDYR-00	
3.9 Ready Relais	
3.9.1 5AC801.RDYR-01	
3.9.2 Allgemeines	
3.9.3 Bestelldaten	
3.9.4 Pinbelegung	
3.9.5 Lieferumfang	
3.10 Schnittstellenoptionen (IF Option)	
3.10.1 Allgemeines	
3.10.2 5AC600.CANI-00	
3.10.3 5AC600.485I-00.	
3.10.0 3A0000. 1 031-00	170
Kapitel 3 Inbetriebnahme	182
•	
1 Montage	187
1 Montage	
1.1 Vorgehensweise	182
1.1 Vorgehensweise	182 182
1.1 Vorgehensweise	182 182 183
1.1 Vorgehensweise	
1.1 Vorgehensweise	
1.1 Vorgehensweise	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln	
1.1 Vorgehensweise	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests	
1.1 Vorgehensweise	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen	
1.1 Vorgehensweise	
1.1 Vorgehensweise	
1.1 Vorgehensweise	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem Burnln Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse 5 Anschlussbeispiele	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen	
1.1 Vorgehensweise. 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse 5 Anschlussbeispiele 5.1 Auswahl der Displayeinheiten 5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard 5.2.1 Voraussetzung Grundsystem 5.2.2 Linkbaugruppe	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse 5 Anschlussbeispiele 5.1 Auswahl der Displayeinheiten 5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard 5.2.1 Voraussetzung Grundsystem 5.2.2 Linkbaugruppe 5.2.3 Kabel	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse 5 Anschlussbeispiele 5.1 Auswahl der Displayeinheiten 5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard 5.2.1 Voraussetzung Grundsystem 5.2.2 Linkbaugruppe 5.2.3 Kabel 5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse 5 Anschlussbeispiele 5.1 Auswahl der Displayeinheiten 5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard 5.2.1 Voraussetzung Grundsystem 5.2.2 Linkbaugruppe 5.2.3 Kabel 5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen 5.2.5 BIOS Einstellungen	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse 5 Anschlussbeispiele 5.1 Auswahl der Displayeinheiten 5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard 5.2.1 Voraussetzung Grundsystem 5.2.2 Linkbaugruppe 5.2.3 Kabel 5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen 5.2.5 BIOS Einstellungen 5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse 5 Anschlussbeispiele 5.1 Auswahl der Displayeinheiten 5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard 5.2.1 Voraussetzung Grundsystem 5.2.3 Kabel 5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen 5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard 5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse 5 Anschlussbeispiele 5.1 Auswahl der Displayeinheiten 5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard 5.2.1 Voraussetzung Grundsystem 5.2.3 Kabel 5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen 5.2.5 BIOS Einstellungen 5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard 5.3.1 Voraussetzung Grundsystem 5.3.2 Linkbaugruppe 5.3.2 Linkbaugruppe	
1.1 Vorgehensweise 1.2 Wichtige Informationen zur Montage 1.3 Einbaulagen 1.3.1 Einbaulage - senkrecht 1.3.2 Einbaulage - waagrecht 1.4 Luftzirkulationsabstände 2 Anschluss von Kabeln 3 Erdungskonzept 4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests 4.1 Vorgehensweise 4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen 4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center 4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark 4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen 4.4 Auswertung der Messergebnisse 5 Anschlussbeispiele 5.1 Auswahl der Displayeinheiten 5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard 5.2.1 Voraussetzung Grundsystem 5.2.3 Kabel 5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen 5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard 5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard	182 183 183 183 184 185 186 187 187 187 188 190 190 191 191 192 192 192 192 193 193 194 194

5.4 Ein Automation Panel 800 über SDL onboard	196
5.4.1 Voraussetzung Grundsystem	196
5.4.2 Kabel	
5.4.3 BIOS Einstellungen	
5.5 Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard	
5.5.1 Voraussetzung Grundsystem	
5.5.2 Linkbaugruppe	198
5.5.3 Kabel	
5.5.4 BIOS Einstellungen	
5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard	200
5.6.1 Voraussetzung Grundsystem	
5.6.2 Linkbaugruppen	
5.6.3 Kabel	201
5.6.4 BIOS Einstellungen	
5.7 Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link	
5.7.1 Voraussetzung Grundsystem	
5.7.2 Linkbaugruppe	
5.7.3 Kabel	
5.7.4 BIOS Einstellungen	
5.8 Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link	
5.8.1 Voraussetzung Grundsystem	
5.8.2 Linkbaugruppe	
5.8.3 Kabel	
5.8.4 BIOS Einstellungen	207
5.9 Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link	
5.9.1 Voraussetzung Grundsystem	208
5.9.2 Linkbaugruppe	
5.9.3 Kabel	
5.9.4 BIOS Einstellungen	
5.10 Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link	211
5.10.1 Voraussetzung Grundsystem	211
5.10.2 Linkbaugruppe	212
5.10.3 Kabel	
5.10.4 BIOS Einstellungen	
5.11 Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link	214
5.11.1 Voraussetzung Grundsystem	214
5.11.2 Linkbaugruppe	215
5.11.3 Kabel	215
5.11.4 BIOS Einstellungen	
6 Anschluss von USB Peripheriegeräten	
6.1 Lokal am APC810	
6.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI	218
6.3 Remote am Automation Panel 800 / 900 über SDL	218
7 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes	219
7.1 Create RAID Set	220
7.2 Create RAID Set - Striped	
7.3 Create RAID Set - Mirrored	221
7.4 Delete RAID Set	
7.5 Rebuild Mirrored Set	222
7.6 Resolve Conflicts	222
7.7 Low Level Format	
8 Bekannte Probleme / Eigenheiten	224
Kapitel 4 Software	225
1 BIOS Optionen	225
1.1 Allgemeines	225
1.2 RIOS Setup and Startyorgang	225

1.2.1 BIOS Setup Tasten	227
1.3 Main	228
1.4 Advanced	229
1.4.1 ACPI Configuration	230
1.4.2 PCI Configuration	231
1.4.3 PCI Express Configuration	234
1.4.4 Graphics Configuration	
1.4.5 CPU Configuration	
1.4.6 Chipset Configuration	239
1.4.7 I/O Interface Configuration	240
1.4.8 Clock Configuration	241
1.4.9 IDE Configuration	241
1.4.10 USB Configuration	247
1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration	248
1.4.12 Remote Access Configuration	
1.4.13 CPU Board Monitor	
1.4.14 Baseboard/Panel Features	252
1.5 Boot	256
1.6 Security	258
1.6.1 Hard Disk Security User Password	259
1.6.2 Hard Disk Security Master Password	
1.7 Power	
1.8 Exit	261
1.9 BIOS Defaulteinstellungen	262
1.9.1 Main	
1.9.2 Advanced	262
1.9.3 Boot	267
1.9.4 Security	267
1.9.5 Power	267
1.10 BIOS Fehlersignale (Beep Codes)	268
1.11 Ressourcenaufteilung	
1.11.1 RAM-Adressbelegung	269
1.11.2 I/O-Adressbelegung	
1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode	269
1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode	270
2 Upgradeinformationen	274
2.1 BIOS Upgrade	
2.1.1 Was muss ich wissen?	274
2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS	275
2.2 Firmwareupgrade	277
2.2.1 Vorgangsweise	277
2.2.2 Mögliche Upgradeprobleme und Softwareabhängigkeiten (für V1.00)	278
2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP	280
2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files	282
2.4.1 Was wird benötigt	282
2.4.2 Vorgangsweise	282
2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?	282
2.5 So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files	283
2.5.1 Was wird benötigt?	283
2.5.2 Vorgangsweise	283
2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?	283
2.6 Upgradeprobleme	283
3 Microsoft DOS	
3.1 Bestelldaten	284
3.2 Bekannte Probleme	284
3.3 Auflösungen und Farbtiefe	284
4 Windows XP Professional	285

4.1 Bestelldaten	285
4.2 Übersicht	285
4.3 Installation	
4.3.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.R	AIC-06. 286
4.3.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante	
4.4 Treiber	
5 Windows 7	
5.1 Allgemeines	
5.2 Bestelldaten	
5.3 Übersicht	
5.4 Installation	
5.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.R	
5.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante	
5.5 Eigenheiten, Einschränkungen	
5.6 Treiber	
6 Windows XP Embedded	
6.1 Allgemeines	
6.2 Bestelldaten	
6.3 Übersicht	
6.4 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007)	
6.5 Installation	
6.6 Treiber	
6.6.1 Touchscreentreiber	
7 Windows Embedded Standard 2009	
7.1 Allgemeines	
7.2 Bestelldaten	
7.3 Übersicht	
7.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)	
7.5 Installation	
7.6 Treiber	
7.6.1 Touch Screen Treiber	
8 Windows Embedded Standard 7	
8.1 Allgemeines	
8.2 Bestelldaten	
8.3 Übersicht	
8.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)	
8.5 Installation	
8.6 Treiber	
8.6.1 Touch Screen Treiber	
9 Windows CE	296
9.1 Allgemeines	296
9.2 Bestelldaten	296
9.3 Übersicht	296
9.4 Features Windows CE 6.0	296
9.5 Was wird benötigt	297
9.6 Installation	
9.7 B&R Embedded OS Installer	297
10 Automation Runtime	298
10.1 Allgemeines	298
10.2 Bestelldaten	298
10.3 Automation Runtime Windows (ARwin)	298
10.4 Automation Runtime Embedded (ARemb)	
11 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center	
11.1 Funktionen	
11.2 Installation	
11.3 SDL Equalizer Einstellung	
11.4 USV Parametrierung	

11.4.1 Installation des USV Dienstes für die B&R Add-on USV	
11.4.2 Statuswerte der USV anzeigen	
11.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten	
11.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren	304
11.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern	
11.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren	305
11.4.7 Weitere USV Einstellungen ändern	306
11.4.8 Ablauf bei einem Powerfail	308
12 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit	309
13 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK	311
14 B&R Key Editor	313
Kapitel 5 Normen und Zulassungen	315
1 Richtlinien und Erklärungen	315
1.1 CE- Kennzeichnung	
1.2 EMV-Richtlinie	315
1.3 Niederspannungsrichtlinie	315
2 Zulassungen	
2.1 UL Zulassung	
2.2 Zulassungen für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	
2.2.1 UL Haz. Loc. Zulassung	
2.2.2 ATEX Zulassung	
2.2.3 Anforderungen zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	
2.3 GL Zulassung (Germanischer Lloyd)	
Kapitel 6 Zubehör	321
1 Ersatz CMOS Batterien	
1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000	
1.1.1 Allgemeines	
1.1.2 Bestelldaten	
1.1.3 Technische Daten	
2 Spannungsversorgungsstecker	
2.1 0TB103.9x	
2.1.1 Allgemeines	
2.1.2 Bestelldaten	
2.1.3 Technische Daten	
3 Ersatz Lüfterfilter	
3.1 Allgemeines	
4 DVI - Monitor Adapter	
4.1 5AC900.1000-00	
4.2 Allgemeines	
4.3 Bestelldaten	
5 CompactFlash Karten	
5.1 Allgemeines	
5.2 Grundlagen	
5.2.1 Flashtechnologie	
5.2.2 Wear Leveling	
5.2.3 Fehlerkorrektur ECC	
5.2.4 S.M.A.R.TSupport	
5.2.5 Maximale Zuverlässigkeit	
5.3 5CFCRD.xxxx-06	
5.3.1 Allgemeines	
5.3.2 Bestelldaten	
5.3.3 Technische Daten	
5.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	
5.3.5 Abmessungen	330

5.3.6 Benchmark	221
5.4 5CFCRD.xxxx-04	
5.4.1 Allgemeines	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.4.2 Bestelldaten	
5.4.3 Technische Daten	
5.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	
5.4.5 Abmessungen	
5.4.6 Benchmark	
5.5 5CFCRD.xxxx-03	
5.5.1 Allgemeines	
5.5.2 Bestelldaten	
5.5.3 Technische Daten	
5.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	
5.5.5 Abmessungen	
5.6 Bekannte Probleme / Eigenheiten	
6 USB Media Drive	
6.1 5MD900.USB2-01	340
6.1.1 Allgemeines	340
6.1.2 Bestelldaten	340
6.1.3 Schnittstellen	340
6.1.4 Technische Daten	341
6.1.5 Abmessungen	342
6.1.6 Abmessungen mit Frontklappe	
6.1.7 Einbau in Wanddurchbrüche	
6.1.8 Lieferumfang	
6.1.9 Montage	
6.2 5MD900.USB2-02	
6.2.1 Allgemeines.	
6.2.2 Bestelldaten	
6.2.3 Schnittstellen	
6.2.4 Technische Daten	
6.2.5 Abmessungen	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6.2.6 Abmessungen mit Frontklappe	
6.2.7 Einbau in Wanddurchbrüche	
6.2.8 Lieferumfang	
6.2.9 Montage	
6.3 5A5003.03	
6.3.1 Allgemeines	
6.3.2 Bestelldaten	
6.3.3 Technische Daten	
6.3.4 Abmessungen	
6.3.5 Lieferumfang	
6.3.6 Montage	
7 USB Memory Sticks	351
7.1 5MMUSB.2048-00	351
7.1.1 Allgemeines	351
7.1.2 Bestelldaten	351
7.1.3 Technische Daten	351
7.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	352
7.2 5MMUSB.2048-01	
7.2.1 Allgemeines	
7.2.2 Bestelldaten	
7.2.3 Technische Daten	
7.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	
8 HMI Drivers & Utilities DVD	
8.1 5SWHMI.0000-00	
8.1.1 Allgemeines.	

8.1.2 Bestelldaten	355
8.1.3 Inhalt (V2.10)	355
9 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	358
9.1 Features	358
9.2 Was wird benötigt	358
9.3 5AC600.UPSI-00	359
9.3.1 Allgemeines	359
9.3.2 Bestelldaten	359
9.3.3 Technische Daten	359
9.3.4 Montage	359
9.4 5AC600.UPSB-00	360
9.4.1 Allgemeines	360
9.4.2 Bestelldaten	360
9.4.3 Technische Daten	360
9.4.4 Temperatur Lebensdauerdiagramm bis 20% Batteriekapazität	361
9.4.5 Tiefentladezyklen	
9.4.6 Abmessungen	362
9.4.7 Bohrschablone	362
9.4.8 Montagevorschriften	362
9.5 5CAUPS.00xx-00	
9.5.1 Allgemeines	
9.5.2 Bestelldaten	
9.5.3 Technische Daten	363
9.6 5AC600.UPSF-00	
9.6.1 Allgemeines	364
9.6.2 Bestelldaten	
9.7 5AC600.UPSF-01	
9.7.1 Allgemeines	
9.7.2 Bestelldaten	
10 Netzfilter	
10.1 5AC804.MFLT-00	365
10.1.1 Allgemeines	365
10.1.2 Bestelldaten	365
10.1.3 Technische Daten	
10.1.4 Abmessungen	
10.1.5 Bohrschablone	366
10.1.6 Anschluss an das Endgerät	
11 PCI Einsteckkarten	
11.1 5ACPCI.ETH1-01	
11.1.1 Allgemeines	367
11.1.2 Bestelldaten	367
11.1.3 Technische Daten	367
11.1.4 Treibersupport	368
11.1.5 Abmessungen	
11.2 5ACPCI.ETH3-01	
11.2.1 Allgemeines	
11.2.2 Bestelldaten	
11.2.3 Technische Daten	370
11.2.4 Treibersupport	
11.2.5 Abmessungen	
12 Kabel	
12.1 DVI Kabel	
12.1.1 5CADVI.0xxx-00	
12.2 SDL Kabel	
12.2.1 5CASDL.0xxx-00	
12.3 SDL Kabel mit 45° Stecker	
12.3.1 5CASDL.0xxx-01	

12.4 SDL Kabel flex	382
12.4.1 5CASDL.0xxx-03	382
12.5 SDL Kabel flex mit Extender	385
12.5.1 5CASDL.0xx0-13	385
12.6 USB Kabel	389
12.6.1 5CAUSB.00xx-00	389
12.7 RS232 Kabel	390
12.7.1 9A0014.xx	390
12.8 Versorgungskabel intern	392
12.8.1 5CAMSC.0001-00	392
13 HDD Ersatzdiskablage	393
13.1 5AC801.FRAM-00	393
13.1.1 Allgemeines	393
13.1.2 Bestelldaten	393
13.1.3 Technische Daten	393
13.1.4 Abmessungen	394
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung	395
1 Batteriewechsel	
1.1 Batteriestatusermittlung	
1.2 Vorgangsweise	
2 CompactFlash Tausch	
3 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch	
3.1 Vorgangsweise	
4 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch	
4.1 Vorgangsweise	
5 Slide-in compact Adapter Montage	
5.1 Vorgangsweise	400
6 Lüfter Kit Einbau / Tausch	402
6.1 Vorgangsweise	402
7 Montage des USV Moduls	404
7.1 Montage ohne montiertem Add-on Schnittstellenmodul	
7.1.1 APC810 1 Card Slot	404
7.1.2 APC810 2 und 3 Card Slot	
7.1.3 APC810 5 Card Slot	
7.2 Montage mit montiertem Add-on Schnittstellenmodul	
7.2.1 APC810 1 Card Slot	
7.2.2 APC810 2 und 3 Card Slot	
7.2.3 APC810 5 Card Slot	
8 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit	
8.1 Vorgangsweise	
9 Seitendeckeldemontage	
9.1 APC810 mit 1 Card Slot	
9.2 APC810 mit 2 und 3 Card Slot	
9.3 APC810 mit 5 Card Slot	
10 AP Link Montage	
10.1 Vorgangsweise	
11 Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1	
11.1 Vorgangsweise	
12 Montage der HDD Ersatzdiskablage	
12.1 Vorgangsweise	
13 Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz	
13.1 Vorgangsweise	424
Anhang A	
1 Maintenance Controller Extended (MTCX)	
1.1 Temperaturüberwachung Lüfterregelung	426

Kapitel 1 • Allgemeines

1 Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
0.10 Preliminary	20.11.2007	Erste Version
0.20 Preliminary	11.01.2008	Textänderung beim Systemeinheitenkurztext Textänderung auf 945GME (statt 945GM) 256 MB Hauptspeicher entfernt. 5AC801.ADAS-00 und 5AC801.HDDS-00 ergänzt. Zubehör ergänzt. Ready Relais 5AC801.RDYR-00, SATA RAID Controller, Lüfter Kit, IF Optionen, Ersatz Luftfilter ergänzt. BIOS Beschreibung ergänzt.
0.30 Preliminary	31.01.2008	 Fehler bei der Konfiguration behoben. BIOS Defaultprofile ergänzt. Namensänderung von APC810 auf APC800 und Best. Nr. Änderung. Technische Daten des Gesamtgerätes ergänzt. Anschlussbeispiele ergänzt. Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses ergänzt.
0.40 Preliminary	11.04.2008	 Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses überarbeitet. Abschnitt "Temperatursensorpositionen" in "Anhang A" ergänzt. Abschnitt "Temperaturangaben" auf Seite 31 ergänzt. Systemeinheit mit 1 Card Slot ergänzt. Inhaltliche Änderungen (speziell im Kapitel Wartung / Instandhaltung). BIOS Beschreibung für die Version 1.10 überarbeitet.
0.41 Preliminary	09.05.2008	 Grafikkorrekturen bei "Umgebungstemperaturen mit und ohne Lüfter Kit". Maßangaben des 1 und 2 Card Slot Gesamtgerätes um den Kühlkörper 5AC801.HS00-01 erweitert. Abschnitt Leistungshaushalt ergänzt. Serialnummernaufkleberinformationen ergänzt. Abschnitt Automation PC 810 mit Windows XP Professional und Windows XP Embedded ergänzt. Abschnitt Automation Device Interface (ADI) erweitert. 5 Card Slot Variante ergänzt. Bohrschablonen um 5 Card Slot Variante erweitert. Abschnitt "Anschluss von USB Peripheriegeräten" auf Seite 217 ergänzt. Indexerweiterung
0.42 Preliminary	29.05.2008	 Informationen zur Einbaulage (senkrecht, waagrecht) in Kapitel 3 "Inbetriebnahme". Umgebungstemperaturangaben mit und ohne Lüfter Kit bzgl. Einbaulage (senkrecht, waagrecht) erweitert. Fehlerkorrektur (Bestellnummern Lüfter Kits) in Abbildung "Abb. 2: Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 30. Fehlerkorrektur (Pinbelegung) in Tabelle "Tab. 18: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC" auf Seite 57. Slide-in Slot 2 Beschreibung überarbeitet. Slide-in DVD Brenner 5AC801.DVRS-00 ergänzt. Lüfter Kit für die 5 Card Slot Variante (5PC810.FA05-00) ergänzt. Echtzeituhr (RTC) Angaben ergänzt.
1.00	10.07.2008	 Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler. Blockschaltbilder aller Systemeinheiten in Abhängigkeit der Buseinheit ergänzt ("Blockschaltbilder" auf Seite 49). Beschreibung des Add-on Schnittstellenmoduls 5AC600.485I-00 erweitert.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	ım Änderung				
1.10	12.09.2008	Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler.				
		Werte des Einschaltstroms geändert (wegen neuem Netzteil).				
		PCI Ethernetkarten 5ACPCI.ETH1-01und 5ACPCI.ETH3-01 ergänzt.				
		Stromaufnahme von bisher 15A auf 16A geändert.				
		Manual auf den maximalen Wert von 130W angepasst.				
		Neues Kapitel "Normen und Zulassungen" hinzugefügt.				
		 Luftfeuchtigkeitsangaben ergänzt "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 39. 				
		User ID näher beschrieben.				
		Best.Nr. für Windows XP mit SP3 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL er-				
		gänzt				
		Minimale Umgebungstemperaturangaben hinzugefügt.				
		Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00 (für externen Verbraucher am PCI Steckplatz) ergänzt.				
		Konfiguration eines SATA RAID Controllers von Kapitel Software nach Kapitel Inbetriebnahme verscho-				
		ben.				
		Fehlerkorrektur bei 5PC810.FA05-00 (siehe "5PC810.FA05-00" auf Seite 169).				
		BIOS Einstellungen geändert (neue BIOS Version).				
		Information zur Erstellung einer MS-DOS Startdiskette ergänzt.				
		Information zur Erstellung eines bootbaren USB Memory Sticks ergänzt.				
		Beschreibung B&R Key Editor ergänzt.				
		Ergänzung HMI Treiber & Utilities DVD.				
		Beschreibung für den Betrieb als RS485 Schnittstelle des Add-on RS232/422/485 Interface Moduls über-				
		arbeitet.				
		Ergänzung ADI Control Center.				
		Ergänzung Glossar.				
		Ergänzung Seitendeckeldemonatge 5PC810.SX01-00 und 5PC810.SX05-00.				
		Ergänzung zur Montage des USV Moduls (mit und ohne Add-on Schnittstellenmodul).				
		Fehlerkorrektur des 3-phasigen Netzteils 40A (0PS340.1) bei den Bestellnummern.				
		Ergänzung 5 Card Slot Buseinheit.				
		Korrektur einiger Temperatur-Luftfeuchtediagramme.				
		Ergänzung Add-on Schnittstellensteckplatz.				
		Beschreibung "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 428 ergänzt.				
		Beschreibung "AP Link Montage" auf Seite 420 ergänzt.				
		Korrektur der Sicherung der Versorgungsspannung von 10A auf 15A auf Seite "Spannungsversorgung				
		+24 VDC" auf Seite 57.				
		Ergänzung der CMOS Profil Schalterstellung 2 auf Seite "CMOS Profile Schalter" auf Seite 68.				
		Korrektur der Lebensdauer und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Lüfter Kits 5PC810.FA01-00.				
		Ergänzung Temperaturüberwachung Lüfterregelung siehe "Temperaturüberwachung Lüfterregelung" auf				
		Seite 426.				

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Allgemeines • Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.20	14.10.2009	Topologiegrafik ergänzt.
		Korrektur der maximalen Umgebungstemperatur der Systemeinheit 5AC800.B945-02 in der Abbildung
		auf Seite .
		Beschreibung des CMOS Battery Status in Tabelle "Tab. 207: 945GME Baseboard Monitor Einstellmög-
		lichkeiten" auf Seite 254 geändert.
		HDD Ersatzablage zum Zubehör auf Seite "5AC801.FRAM-00" auf Seite 393 sowie deren Montage
		zum Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" ergänzt.
		Fehler in Abbildungs- und Tabellenverzeichnis behoben. Fehler in Tabellenverzeichnis behoben. Fehler in Tabellenverzeichnis behoben.
		Fehler im Temperatur Luftfeuchtediagramm von SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-03 und SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC 04 habeted RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC 04 habeted RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-03 und SATA RAID HARD BIRD BIRD BIRD BIRD BIRD BIRD BIRD BI
		RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-04 behoben. • ADI Development Kit geändert.
		 ADI Development Kit geändert. Tabelle für die maximale Umgebungstemperatur für die Kühlkörper 5AC801.HS00-00 > Rev. D0 und
		5AC801.HS00-01 > Rev. D0 hinzugefügt.
		PCIE Port (ETH2) und PCIE Port (ETH1) BIOS-Beschreibung ergänzt.
		9S0000.08-010, 9S0000.08-020, 9S0000.09-090 abgekündigt.
		Informationen zum Firmwareupgrade aktualisiert.
		CMOS-Profil 3 (5PC820.SX01-00) hinzugefügt - nähere Informationen zum CMOS-Profil sind im APC820
		Anwenderhandbuch nachzulesen.
		Abschnitt "Umweltgerechte Entsorgung" in Kapitel 1 "Allgemeines" ergänzt.
		Neuen Lüfter Kit 5PC810.FA02-01 APC810 2 Slot hinzugefügt.
		PCI Bus Typ bei den Buseinheiten hinzugefügt.
		BIOS Defaulteinstellungen für FDC/LPT/COM Ports ergänzt.
		Lieferumfang des USB Memory Sticks entfernt.
		Bild der Silicon Systems CompactFlash aktualisiert.
		L2 Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache
		B&R CompactFlash Karten ergänzt. Tack inches Bake and Cities
		Technische Daten der Silicon Systems CFs überarbeitet. Absolutiet 4.44 IP Programmen unt silven II auf Caite 200 aus auch der Silven II auch de
		Abschnitt 1.11 "Ressourcenaufteilung" auf Seite 269 ergänzt. Abschnitt 4.3.1 "Installation auf DOL SATA BAID Controller 5ACDOL BAIC 03 5ACDOL BAIC 05. Abschnitt 4.3.1 "Installation auf DOL SATA BAID Controller 5ACDOL BAIC 03. FACDOL BAIC 05.
		 Abschnitt 4.3.1 "Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05 5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 286 ergänzt.
		Neue "5AC801.SSDI-00" auf Seite 122 ergänzt.
		BIOS-Einstellungen auf Version V1.14 aktualisiert.
		Die Tabellen "CPU Board Softwarestände" und "Automation Panel Link Softwarestände" aus dem Ab-
		schnitt "BIOS Upgrade" wurden entfernt.
		Abmessungen der Slide-in und Slide-in compact Geräte geändert - jetztige Abmessungen beziehen sich
		auf die gesamte Mechanik der Geräte.
		Mechanische Eigenschaften zu den Produkten 5AC801.DVDS-00 und 5AC801.DVRS-00 ergänzt.
		Betriebssyteme 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-ENG und 5SWWXP.0500-MUL ergänzt.
		 Abschnitt 9.4 "Erzeugung eines bootbaren (bootable) USB Memory Sticks" entfernt.
		 Im Kapitel 4 "Software" die Abschnitte "BIOS Upgrade", "Firmwareupgrade" und "MS-DOS Bootdiskette
		erstellen unter Windows XP" in den Abschnitt 2 "Upgradeinformationen" verschoben und aktualisiert.
		Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&F Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "Software
		Upgrade Files" auf Seite 282 ergänzt.
		Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt 2.5 "So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&F Lagrada Files" auf Seite 202 ersänst. Lagrada Files " auf Seite 202 ersänst. Lagrada Files" auf Seite 202 ersänst.
		Upgrade Files" auf Seite 283 ergänzt.
		 Angaben zu den möglichen Auflösungen in den Technischen Daten der CPU Boards ergänzt. Abschnitt 1.10 "BIOS Fehlersignale (Beep Codes)" auf Seite 268 im Kapitel 4 "Software" ergänzt.
		 Asscribit 1.10 Biod Fernelsignale (beep codes) and seite 200 lift Rapiter 4. Software erganzt. Installationstext von Windows XP Professional geändert.
		Abschnitt "Temperatursensorpositionen" geändert.
		Informationen zu B&R Key Editor aktualisiert.
		Abschnitt 3 "Microsoft DOS" auf Seite 284 ergänzt.
		Chipset der Technischen Daten des CPU Board im Abschnitt "CPU Boards 945GME" auf Seite 106
		korrigiert.
		Tabelle "Tab. 88: 5AC801.ADAS-00 - Technische Daten" auf Seite 138 korrigiert.
		Information auf Seite "Buslänge und Kabeltyp RS422" auf Seite 180 ergänzt.
		Tabelle "Tab. 179: Linkbaugruppen" auf Seite 215 korrigiert.
		Hex-Bereich in der Tabelle "Tab. 235: RAM-Adressbelegung" auf Seite 269 ergänzt.
		Ersatz CMOS Batterien 0AC201.9 durch 0AC201.91 ersetzt.
		CPU Board 5PC800.B945-05 ergänzt.
		Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 39 überarbeitet.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.30	12.07.2010	 Die Systemeinheit 5PC810.SX03-00, die Buseinheit 5PC810.BX03-00, den Lüfter Kit 5PC810.FA03-00 und den Ersatzlüfter 5AC801.FA03-00 ergänzt. Abschnitt 7 "Windows Embedded Standard 2009" auf Seite 291 ergänzt. Abschnitt 11 "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 299 aktualisiert. Kapitel 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 315 überarbeitet. B&R CompactFlash 16 GByte (5CFCRD.016G-04) ergänzt. Abschnitt "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 224 wurde um einen Punkt erweitert. Abschnitt "Kabel" auf Seite 373 im Kapitel 6 "Zubehör" ergänzt. B&R ID Codes der Systemeinheiten ergänzt. Anschnitt 9 "Windows CE" auf Seite 296 ergänzt. B&R USB Memory Stick im Kapitel 6 "Zubehör" auf Seite 321 ergänzt. CPU Boards 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 wurden ergänzt. Technisches Datum "Remanente Variablen für AR (Automation Runtime) im Power Fail Mode" bei den APC810 Systemeinheiten ergänzt.
1.31	14.11.2010	 Ready Relais 5AC801.RDYR-01 im Kapitel 6 "Zubehör" ergänzt. Abschnitt 13 "Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz" auf Seite 424 im Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" ergänzt.
1.32	02.11.2010	 "5AC801.HDDI-03" auf Seite 118 ergänzt. "5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 156 ergänzt. "5MMHDD.0250-00" auf Seite 162 ergänzt. Abbildung "Abb. 2: Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 30 überarbeitet. 5AC801.HDDI-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5MMHDD.0250-00 im Abschnitt 2.1 "Temperaturangaben" und in Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 39 ergänzt.
1.33	20.05.2011	 Abschnitte "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 293, "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 311, "Automation Runtime" auf Seite 298 und "B&R Automation Runtime Dongle" ergänzt. BIOS Version aktualisiert (1.14 -> 1.17). Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 299, "B&R Key Editor" auf Seite 313, "HMI Drivers & Utilities DVD" auf Seite 355 und "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 309 überarbeitet. Buseinheit 5PC810.BX05-02 ergänzt. Chipset Information "CPU Boards 945GME" auf Seite 106 korrigiert. Abbildung "Abb. 2: Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 30 überarbeitet.
1.34	11.07.2011	 USB 5 in Überschrift ergänzt ("USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)" auf Seite 63). 5AC801.HDDI-03 in Tabelle "Tab. 44: Slide-in compact Slot" auf Seite 74 ergänzt. Tabelleneintrag "Ladedauer bei Low Battery" in Tabelle "Tab. 283: 5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten" auf Seite 360 ergänzt. Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 299, "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 311 überarbeitet. Information zu "Besonderheiten 5PCI Slot Variante" bei "Windows XP Professional" auf Seite 285 und "Windows 7" auf Seite 287 ergänzt. Information zu "Windows XP Mode" in Abschnitt "Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)" auf Seite 294 korrigiert. Verweis auf die externe USV 24 VDC in Abschnitt "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" auf Seite 358 überarbeitet.
1.40	23.01.2012	 Abschnitt "CompactFlash Karten" wurde überarbeitet. Abschnitt "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" in Kapitel 4 "Software" verschoben. Abschnitt "Temperatursensorpositionen" in Kapitel 2 "Technische Daten" verschoben. Der Anschitt Bohrschablonen im Kapitel Inbetriebnahme wurde entfernt und die Bohrschablonen im Kapitel 2 "Technische Daten", Abschnitt 2 "Gesamtgerät" auf Seite 31 bei den Systemeinheiten ergänzt. Abschnitt "Anschlussbeispiele" auf Seite 191 wurde überarbeitet. "Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung" aus Abschnitt "AP Link Steckkarten" auf Seite 171 entfernt. Neue CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden im Kapitel 6 "Zubehör" ergänzt - die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 wurden abgekündigt. Abschnitt "B&R Automation Runtime Dongle" entfernt, die Bestelldaten wurden im Abschnitt "Automation Runtime" auf Seite 298 ergänzt. BIOS Version aktualisiert (1.17 -> 1.18). Gesamtes Handbuch gemäß den aktuellen Formatierungsvorgaben überarbeitet.
1.41	25.06.2012	 Die Informationen zum Automation Device Interface und Key Editor wurden aktualisiert. Im Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)" auf Seite 66 wurden Informationen zur Verwendung mit 64-Bit PCI Karten ergänzt. Der Abschnitt "Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung" auf Seite 59 wurde ergänzt. Informationen zu der "PCI to PCI Bridge" wurden in 3.2.3 "Technische Daten" der Buseinheiten ergänzt. Informationen zu der "PCIe to SATA Bridge" wurde im Abschnitt "Slide-in Slot 2" auf Seite 73 ergänzt. Das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 wurde auf Seite Ready Relais verschoben.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Allgemeines • Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.45	01.10.2012	 Der Abschnitt "Gestaltung von Sicherheitshinweisen" auf Seite 22 wurde geändert - der Beschreibungstext für "Vorsicht" und "Warnung" wurde ausgetauscht. SSD Laufwerke "5AC801.SSDI-01" auf Seite 126 und "5AC801.SSDI-02" auf Seite 128 wurden ergänzt. Der Abschnitt "Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests" auf Seite 187 wurde ergänzt. Windows 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows 7" auf Seite 287). Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 293). Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 299 wurde aktualisiert. Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 309 wurde auf Version 3.40 aktualisiert. Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 311 wurde auf Version 1.80 aktualisiert. Der "B&R Key Editor" auf Seite 313 wurde auf Version 3.30 aktualisiert. Die Technischen Daten der CPU Boards wurden aktualisiert - siehe "CPU Boards 945GME" auf Seite 106.
1.46	21.11.2012	 Die B&R CompactFlash Karte 5CFCRD.032G-06 wurde ergänzt, siehe "5CFCRD.xxxx-06" auf Seite 328. Die Technischen Daten der USV Kabel wurden überarbeitet, siehe "5CAUPS.00xx-00" auf Seite 363.
1.47	14.03.2013	 Folgende Laufwerke wurden ergänzt: "5AC801.HDDI-04" auf Seite 120, "5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 159,"5MMHDD.0500-00" auf Seite 164. Die Bestelldaten der Systemeinheiten "5PC810.SX01-00" auf Seite 75, "5PC810.SX02-00" auf Seite 82, "5PC810.SX03-00" auf Seite 89 und "5PC810.SX05-00" auf Seite 96 wurden überarbeitet. Die allgemeinen Informationen der Laufwerke "5ACPCI.RAIC-01" auf Seite 146, "5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 156 sowie "5MMHDD.0250-00" auf Seite 162 wurden überarbeitet. Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler
1.48	15.05.2013	 Kapitel 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 315 wurde überarbeitet. Bei den technischen Daten der Einzelkomponenten wurden die Zertifizierungen überarbeitet. Der Netzfilter "5AC804.MFLT-00" auf Seite 365 wurde ergänzt. Das Add-on Sicherungs Kit "5AC600.UPSF-00" auf Seite 364 und die Ersatz Sicherungen "5AC600.UPSF-01" auf Seite 364 für die USV Batterieeinheit wurden ergänzt. Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-03" auf Seite 130 wurde ergänzt. Die Ersatz SSDs "5MMSSD.0060-00" auf Seite 132, "5MMSSD.0060-01" auf Seite 134 und "5MMSSD.0180-00" auf Seite 136 wurden ergänzt.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

- Elektrische Baugruppen mit Gehäuse
 - ... benötigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- · Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse
 - ... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschützt.

2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- · Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen. Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!
- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

- ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).
- Die erhöhten ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Allgemeines • Sicherheitshinweise

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder
vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus
etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für
alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

2.5 Montage

- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedienund Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmäßigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten Zeitabständen zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder über Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgeräte und die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Bedien- und Beobachtungsgeräte Unterbrechungsfreie Stromversorgung Batterien & Akkumulatoren Kabel	Elektronik Recycling
Karton/Papier Verpackung	Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial	Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

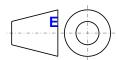
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis	Beschreibung	
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.	
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sacschäden.	
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.	
Information:	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.	

Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise

4 Richtlinien



Für alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europäischen Bemaßungsnormen gültig.

Alle Abmessungen in mm.

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel		
bis 6 mm	± 0,1 mm		
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm		
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm		
über 120 bis 400 mm	± 0,5 mm		
über 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm		

Tabelle 4: Nennmaßbereiche

5 Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite		
1A4601.06	Automation PC / Panel PC B&R Automation Runtime ARemb, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	298		
1A+001.00	Automation Panel Link Steckkarten	230		
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	173		
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	171		
JAC601.3DL0-00	Automation Runtime	171		
144600 10 2		200		
1A4600.10-2	B&R Automation Runtime ARwin, ARNC0	298		
1A4600.10-3	B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	298		
1A4600.10-4	B&R Automation Runtime ARwin+ARNC0+PVIControls	298		
	Batterien	321		
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as "partly regulated". Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27			
44,0006,00,000		204		
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	321		
	Buseinheiten			
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	104		
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	104		
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	104		
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	104		
5PC810.BX03-00	APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)	104		
5PC810.BX05-00	APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)	104		
5PC810.BX05-01	APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)	104		
5PC810.BX05-02	APC810 Bus, 5 PCI	104		
	CPU Boards			
5PC800.B945-00	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	106		
5PC800.B945-01	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	106		
5PC800.B945-02	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	106		
5PC800.B945-03	Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B			
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B			
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C			
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL81110			
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	106		
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	106		
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	106		
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	106		
	CompactFlash			
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	336		
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	336		
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	332		
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	328		
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	336		
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	328		
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	336		
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	332		
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	328		
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	336		
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	332		
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	328		
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	336		
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	332		
5CFCRD.2048-06	Compact lash 2 GByte B&R (SLC)	328		
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	336		
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	332		
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	328		
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	336		
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	332		
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) DVI Kabel	328		
5CADVI 0019 00		373		
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.			
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	373		
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m. Feldklemmen	373		
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	323		

Allgemeines • Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	323
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	111
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	111
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	111
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	109
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	109
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	109
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	138
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	141
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	143
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	112
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis:	116
0/10001.11DD1 02	Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	110
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	118
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	120
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie	139
	das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	•
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	122
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	126
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	128
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	130
5ACPCI.RAIC-03	PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	151
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz	154
	der Harddisk.	
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	156
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	159
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das	162
51.41.41.DD 0500.00	Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	164
5MMSSD.0060-00	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD für 5PP5IO.GMAC-00;	132
	Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00;	134
EMMCCD 0490 00	Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD. 180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD für	106
5MMSSD.0180-00	5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	136
	Lüfter Kit	
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	166
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	167
5PC810.FA03-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.	168
5PC810.FA05-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX05-00.	169
31 30 10:17100 00	MS-DOS	100
9S0000.01-010	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	284
9S0000.01-020	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	284
000000.01 020	RS232 Kabel	201
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	390
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	390
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	390
	SDL Kabel	
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	376
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	376
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	376
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	376
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	376
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	376
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	376
	SDL Kabel 45° Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	379
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	379
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	379
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	379
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	382
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	382
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	382
	SDL Kabel flex, 15 m.	382
5CASDL.0150-03		
5CASDL.0150-03 5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	382
	SDL Kabel flex, 20 m. SDL Kabel flex, 25 m.	382 382
5CASDL.0200-03		

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite		
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	385		
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	385		
	Serialadapter			
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	179		
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	176		
54.0000 4000 00	Sonstiges			
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.	325		
5SWHMI.0000-00	HMI Drivers & Utilities DVD	355		
FD0040 0V04 00	Systemeinheiten	7.5		
5PC810.SX01-00	APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	75		
5PC810.SX02-00	APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)			
5PC810.SX03-00	APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	89		
5PC810.SX05-00	APC810 Systemeinheit 5 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 2 Slide-in Steckplätze; Smart Display Link/DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	96		
	USB Kabel			
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	389		
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	389		
	USB Zubehör			
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.	349		
5MD900.USB2-01	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)			
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)			
5MMUSB.2048-00	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte	351		
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R Undefined	353		
1A4601.06-2	B&R Automation Runtime ARemb, ARNC0	298		
5AC801.HDDI-01	80 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	114		
5ACPCI.RAIC-01	PCI RAID System SATA 2x 60 GByte Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	146		
5ACPCI.RAIC-02	60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-01 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	149		
5PC810.FA02-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00	167		
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung			
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	360		
5AC600.UPSF-00	USV Sicherungs Kit für Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 bis Revision D0.	364		
5AC600.UPSF-01	USV Sicherung, 5 Stück	364		
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	359		
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	363		
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	363		
	Windows 7 Professional/Ultimate			
5SWWI7.1100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	287		
5SWWI7.1100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	287		
5SWWI7.1200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	287		
5SWWI7.1200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	287		
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	287		
5SWWI7.1400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	287		
	Windows Based Runtime			
1A4600.10	B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz Windows CE 6.0	298		
5SWWCE.0826-ENG	Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MByte).	296		
	Windows Embedded Standard 2009			
5SWWXP.0726-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; Compact-	291		
	Flash separat bestellen (mind. 1 GByte).			

Allgemeines • Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite	
	Windows Embedded Standard 7		
5SWWI7.1526-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	293	
5SWWI7.1626-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	293	
5SWWI7.1726-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	293	
5SWWI7.1826-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	293	
	Windows XP Embedded		
5SWWXP.0426-ENG	Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 512 MByte).	289	
	Windows XP Professional		
5SWWXP.0500-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	285	
5SWWXP.0500-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.		
5SWWXP.0500-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.		
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.		
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.		
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	285	
	Zubehör		
5AC801.FA01-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX01-00; 5 Stk.	324	
5AC801.FA02-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk.	324	
5AC801.FA03-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk.	324	
5AC801.FA05-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX05-00; 5 Stk.	324	
5AC801.FRAM-00	APC810 SATA Hard Disk Ersatzablage	393	
5AC801.RDYR-01	Ready Relais für APC810 für die Montage an einem Add-on USV Steckplatz	174	
5AC804.MFLT-00	Netzfilter	365	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	367	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	370	
5CAMSC.0001-00	Versorgungskabel intern	392	

Kapitel 2 • Technische Daten

1 Einleitung

Der APC810 ist die konsequente Weiterentwicklung der APC620 Produktreihe. Basierend auf neuester Intel® Core™2 Duo Technologie bietet der APC810 höchste Performance für alle Anwendungen, bei denen es auf maximale Rechenleistung ankommt.

Der APC810 spart Platz im Schaltschrank. Frontseitig verbergen sich geschützt hinter einer Klappe Einschübe für Laufwerke (DVD, Hard Disk) sowie zwei CompactFlash Slots. Durch die modulare Einschubtechnik können die Laufwerke sehr einfach vom Anwender getauscht werden. Alle Anschlüsse und Schnittstellen sind auf der Gehäuseoberseite angeordnet. Die Bautiefe wird nicht durch hervorstehende Stecker vergrößert. Der APC810 bietet mit den unterschiedlichen Baugrößen mit einem, zwei, drei oder fünf Card Slots (für PCI bzw. PCI Express Steckkarten) die optimale Bauform für jede Einbausituation - passgenau und ohne kostbaren Platz im Schaltschrank zu verschwenden.



1.1 Features

- Neueste Prozessortechnologien Core Duo, Core 2 Duo, Celeron M und Atom N270
- Bis zu 3 GB Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)
- 2 CompactFlash Steckplätze (Typ I)
- 1, 2, 3 oder 5 Card Slot Steckplätze (für PCI / PCI Express (PCIe) Karten)
- SATA Laufwerke (Slide-in bzw. Slide-in compact Steckplätze)
- 5x USB 2.0
- 2x Ethernet 10/100/1000 MBit Schnittstellen
- 2x RS232 Schnittstelle, modemfähig
- · 24 VDC Versorgungsspannung
- Lüfterloser Betrieb1)
- BIOS (AMI)
- · Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)
- SRAM 512 kByte (batteriegepuffert)
- Anschluss verschiedenster Anzeigegeräte am "Monitor/Panel" Videoausgang (Unterstützung von RGB, DVI und SDL - Smart Display Link - Signalen)
- · 2'ter Grafikstrang mit Einbau der optionalen AP Link Steckkarte
- Einfacher Slide-in Laufwerkstausch (SATA Hot Plug fähig)
- · Optionaler Einbau des Add-on USV Modules
- · Optionale CAN Schnittstelle
- Optionale RS232/422/485 Schnittstelle
- · Optionaler RAID Controller (benötigt einen freien PCI Slot)

1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist möglich das APC810 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustellen.

Für den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

- Systemeinheit
- Buseinheit
- · CPU Board
- Kühlkörper
- Hauptspeicher
- Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte oder Hard Disk) für das Betriebssystem
- Software

1.3 Konfiguration - Grundsystem

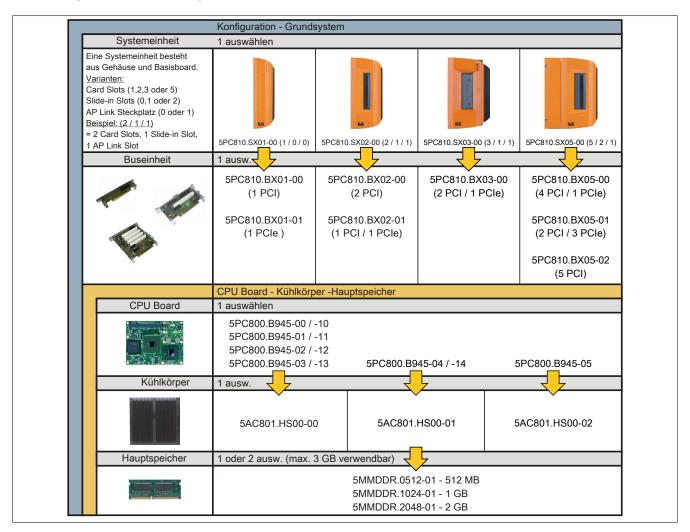


Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem

1.4 Konfiguration - optionale Komponenten

Systemeinheit Eine Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Basisboard. Varianten: Card Slots (1,2,3 oder 5) Slide-in Slots (0,1 oder 2) AP Link Steckplatz (0 oder 1) Beispiel: (2 / 1 / 1) = 2 Card Slots, 1 Slide-in Slot, 1 AP Link Slot Lüfter Kit	1 auswählen			***
aus Gehäuse und Basisboard. Varianten: Card Slots (1,2,3 oder 5) Slide-in Slots (0,1 oder 2) AP Link Steckplatz (0 oder 1) Beispiel: (2 / 1 / 1) = 2 Card Slots, 1 Slide-in Slot, 1 AP Link Slot	555			
1 AP Link Slot		6.0	65	
Luiter Kit	5PC810.SX01-00 (1 / 0 / 0)	5PC810.SX02-00 (2 / 1 / 1)	5PC810.SX03-00 (3 / 1 / 1)	5PC810.SX05-00 (5 / 2
	1 auswählen	I		I
	5PC810.FA01-00	5PC810.FA02-01	5PC810.FA03-00	5PC810.FA05-0
Slide-in compact Laufwerk	1 auswählen			
	5AC801.HI	DDI-00 (40 GByte) DDI-04 (500 GByte) SDI-00 (32 GByte)	5AC801.SSDI-01 (5AC801.SSDI-02 (5AC801.SSDI-03 (180 GByte)
CompactFlash	1 oder 2 auswählen			
Page Succes	5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.032G-06		5CFCRD.0256-03 5CFCRD.1024-03	, 5CFCRD.0128-03 , 5CFCRD.0512-03 , 5CFCRD.2048-03 , 5CFCRD.8192-03
Slide-in Laufwerk	nicht möglich	1 möglich		2 möglich
100		5AC801.HDDS-00 (40 GByte) 5AC801.DVDS-00 (DVD Laufwerk) 5AC801.ADAS-00 (Adapter) 5AC801.DVRS-00 (DVD Brenner)		
AP Link Steckkarte	1 auswählen			
		5AC801.SDL0-00 (für 2'ten Grafikstrang) 5AC801.RDYR-00 (Ready Relais)		
RAID System	1 auswählen			
	5ACPCI.RAIC-06 (2x 500 GByte, belegt 1 PCI Slot) 5MMHDD.0500-00 (Ersatz SATA-HDD 500 GByte)			
Schnittstellenoption	1 auswählen			
		C600.CANI-00 (CAN) C600.485I-00 (kombinie	erte RS232/RS422/RS4	185)
USV Modul + Batterie	1 auswählen			
	Verbindungskabe	(Add-on USV Modul) + I: 5CAUPS.0005-00 (0,		
Feldklemmen	1 auswählen			
		0TB103.9 (Sch 0TB103.91 (Fe	raubklemme) derzugklemme)	
Software	1 auswählen			
Windows ^{xp} Windows ^{xp}	Windows XP 5SWWXP.0500-EN 5SWWXP.0500-GE 5SWWXP.0500-MU 5SWWXP.0600-EN	NG 5SWWXP.0726-E ER Windows Embe JL 5SWWI7.1526-EI	ENG dded Standard 7 NG	Automation Runti 1A4601.06 1A4601.06-2 1A4600.10 1A4600.10-2
Windows*P Embedded	5SWWXP.0600-GE 5SWWXP.0600-MU	ER 5SWWI7.1726-M	UL	1A4600.10-3
Windows Embedded Standard 2009 Windows Embedded	Windows CE 5SWWCE.0826-EN	Windows XP Em	bedded	1A4600.10-4
Standard 7 Windows CE Automation Runtime	Windows 7 5SWWI7.1200-EN0 5SWWI7.1200-GEI			Microsoft DOS 9S0000.01-010 9S0000.01-020

Abbildung 2: Konfiguration - optionale Komponenten

2 Gesamtgerät

2.1 Temperaturangaben

Aufgrund der Möglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke, Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. in Abhängigkeit von Systemeinheit und Lüfter Kit zu kombinieren, bieten die nachfolgenden Tabellen bedingt durch diese Komponenten, einen Überblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resultierenden, maximal möglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen für den Betrieb mit und ohne Lüfter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen unter z.B. Microsoft Windows höhere Umgebungstemperaturen erzielt werden können. Die diesbezügliche Prüfung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Temperaturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

- Thermal Analysis Tool (TAT V2.02) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung
- BurnIn Testtool (BurnIn V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenauslastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Add-on und Slide-in Laufwerke, USB Schnittstellen, Audioausgänge)
- · Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

Was muss bei der Ermittlung der maximalen Umgebungstemperatur beachtet werden?

- Betrieb der Ethernetschnittstellen (ETH1/ETH2) im 10/100 MBit oder 1 GBit Modus
- · Betrieb des Gesamtgerätes mit oder ohne Lüfter Kit
- Revision des verwendeten Kühlkörpers

2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur

Maximale Umgebungstemperatur ohne Lüfter Kit

- Unterscheidung der ETH2 Schnittstelle in bis 100 MBit bzw. bis 1 GBit Betrieb
- Betrieb ohne Lüfter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite 183).
- Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur für Systemeinheiten mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 < Rev. D0 und 5AC801.HS00-01 < Rev. D0.

		ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 100 MBit Betrieb					ı								
		L2400	L7400	U7500	M 423	T7400		L2400	L7400	U7500	M 423	T7400			
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maxi- malen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	5PC800.B945-00	5PC800.B945-01	5PC800.B945-02	5PC800.B945-03	5PC800.B945-04		5PC800.B945-00	5PC800.B945-01	5PC800.B945-02	5PC800.B945-03	5PC800.B945-04			
	Maximale Umgebungstemperatur	35	35	35	45	-		30	30	30	40	-		_	eich
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?													Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich
	On-Board CompactFlash ¹⁾	1	1	1	1			1	1	1	1			80	
	5AC801.HDDI-00	1	✓	✓	✓			✓	1	1	✓			80	
	5AC801.HDDI-01	✓	✓	✓	✓			✓	✓	1	✓			80	
	5AC801.HDDI-02	✓	✓	✓	1			✓	✓	1	✓			80 60	
Slide-in com-	5AC801.HDDI-03	✓	✓	✓	1			✓	✓	1	✓				
pact Laufwerke	5AC801.HDDI-04	1	1	1	1	ļ		1	1	1	1			60	. 0
	5AC801.SSDI-00	1	1	1	1			1	1	1	1			70 70 70 70	
	5AC801.SSDI-01	1	1	1	1			✓	1	1	1				
	5AC801.SSDI-02	1	1	1	1			1	1	1	1				1
	5AC801.SSDI-03	1	1	1	1			✓	1	1	1				
	5AC801.HDDS-00	1	1	1	1			1	1	1	1			80	ᆫ논
Slide-in Laufwerke	5AC801.DVDS-00	1	1	1	40		***************************************	✓	1	1	1			50	Slide-in Laufwerk
	5AC801.DVRS-00	1	1	1	40	ļ		✓	1	1	1			50	E Si
	5MMDDR.0512-01	1	1	1	1			1	1	1	1			-	
Hauptspeicher	5MMDDR.1024-01	1	1	1	1		***************************************	✓	1	1	1			-	.
	5MMDDR.2048-01	1	1	1	1			✓	1	1	1			-	ĺ
	5PC810.SX01-00	1	1	1	1			1	1	1	1			80	
0	5PC810.SX02-00	1	1	1	1		***************************************	✓	1	1	1			80	Netzteil
Systemeinheiten	5PC810.SX03-00	1	✓	1	1			1	1	1	✓			80	Vetz
	5PC810.SX05-00	1	✓	1	1			✓	1	1	✓			80	1 -
	5AC600.CANI-00	1	1	1	1			1	1	1	1			-	
	5AC600.485I-00	1	1	1	1			1	1	1	1			-	
	5AC801.SDL0-00	1	1	1	1			1	1	1	1			-	
Zusatzsteckkarten	5AC801.RDYR-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓			-	1
Schnittstel- len / AP Link	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/	30/	30/	30/ 40			1	1	1	30/ ✓			-	'
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1			-	1
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	1	✓	✓	1	1		1	1	1	✓			-	1
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			-	

¹⁾ Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 5: Umgebungstemperatur ohne Lüfter

- Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
- Betrieb ohne Lüfter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite 183).
- Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur für Systemeinheiten mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 ≥ Rev. D0 und 5AC801.HS00-01 ≥ Rev. D0.

-		ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 100 MBit Betrieb				ETH1: ETH2								
		L2400	L7400	U7500	M 423	T7400	L2400	L7400	U7500	M 423	T7400			
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN.	3945-00	3945-01	3945-02	3945-03	3945-04	3945-00	3945-01	3945-02	3945-03	3945-04			
	Herabsenkung (Derating) der maxi- malen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	5PC800.B945-00	5PC800.B945-01	5PC800.B945-02	5PC800.B945-03	5PC800.B945-04	5PC800.B945-00	5PC800.B945-01	5PC800.B945-02	5PC800.B945-03	5PC800.B945-04			
	Maximale Umgebungstemperatur	35	35	45	45	-	30	30	40	40	-		<u> </u>	eich
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?												Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich
	On-Board CompactFlash ¹⁾	✓	1	1	✓		✓	1	✓	✓			80	
	5AC801.HDDI-00	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			80	1
	5AC801.HDDI-01	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			80	1
Slide-in com- pact Laufwerke	5AC801.HDDI-02	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			80	1
	5AC801.HDDI-03	1	1	1	1		 ✓	1	1	✓			60	
	5AC801.HDDI-04	1	1	1	1		 ✓	1	1	✓			60	2
	5AC801.SSDI-00	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			70 70 70 70	1
	5AC801.SSDI-01	1	1	1	1		 ✓	1	1	1				1
	5AC801.SSDI-02	1	1	1	1		 ✓	1	1	1				1
	5AC801.SSDI-03	1	1	1	1		 ✓	1	1	1				1
	5AC801.HDDS-00	1	1	1	1		√	1	1	1			80	ᆫᆂ
Slide-in Laufwerke	5AC801.DVDS-00	1	1	40	40		 ✓	1	1	1			50	Slide-in Laufwerk
	5AC801.DVRS-00	1	1	40	40		 ✓	1	1	1			50	Ea Si
	5MMDDR.0512-01	1	1	1	1		√	1	1	1			-	
Hauptspeicher	5MMDDR.1024-01	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			-	١.
	5MMDDR.2048-01	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			-	İ
	5PC810.SX01-00	1	1	1	1		√	1	1	1			80	
	5PC810.SX02-00	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			80	重
Systemeinheiten	5PC810.SX03-00	1	1	1	1		 ✓	1	1	✓			80	Netzteil
	5PC810.SX05-00	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			80	_
	5AC600.CANI-00	1	1	1	1		√	1	1	1			-	
	5AC600.485I-00	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			-	İ
	5AC801.SDL0-00	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			-	1
Zusatzsteckkarten	5AC801.RDYR-00	1	1	1	1		 ✓	1	1	✓	1	[-	1
Schnittstel- len / AP Link	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/	30/	30/ ✓	30/ 40		 ✓	1	1	30/			-	'
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			-	1
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			-	1
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1		 ✓	1	1	1			-	1

¹⁾ Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 6: Umgebungstemperatur ohne Lüfter

- KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
- Betrieb ohne Lüfter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (1.3 "Einbaulagen" auf Seite 183).
- Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur für Systemeinheiten mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 ≥ Rev. D0 und 5AC801.HS00-01 ≥ Rev. D0 und das CPU Board 5PC800.B945-05 mit Kühlkörper 5AC801.HS00-02.

		L2400	L7400	U7500	M 423	T7400	N270]				
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN.	5PC800.B945-10	5PC800.B945-11	5PC800.B945-12	5PC800.B945-13	5PC800.B945-14	5PC800.B945-05					
	Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800					
	Maximale Umgebungstemperatur	35	35	45	45	-	50	_	eich			
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?							Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich			
	On-Board CompactFlash ¹⁾	✓	✓	✓	✓		✓	80				
	5AC801.HDDI-00	✓	✓	1	✓		✓	80				
	5AC801.HDDI-01	✓	✓	✓	✓		✓	80				
	5AC801.HDDI-02	✓	✓	✓	✓		✓	80				
Slide-in compact Laufwerke	5AC801.HDDI-03	✓	✓	✓	✓		45	60	. 0			
Silue-iii Compact Laurwerke	5AC801.HDDI-04	✓	✓	✓	✓		45	60	<u> </u>			
	5AC801.SSDI-00	✓	✓	✓	✓		✓	70				
	5AC801.SSDI-01	✓	✓	✓	✓		✓	70				
	5AC801.SSDI-02	✓	✓	1	1		✓	70				
	5AC801.SSDI-03	✓	√	1	√		1	70				
	5AC801.HDDS-00	✓	1	1	1		1	80	ᆫ논			
Slide-in Laufwerke	5AC801.DVDS-00	✓	✓	40	40		40	50	Slide-in Laufwerk			
	5AC801.DVRS-00	✓	1	40	40		40	50	Sii			
	5MMDDR.0512-01	1	√	1	1		1	-				
Hauptspeicher	5MMDDR.1024-01	√	✓	1	1		✓	-				
	5MMDDR.2048-01	√	1	1	1		1	-				
	5PC810.SX01-00	1	1	1	1		1	80				
	5PC810.SX02-00	√	1	1	1		1	80	Ē.			
Systemeinheiten	5PC810.SX03-00	1	1	1	1		1	80	Netzteil			
	5PC810.SX05-00	√	√	1	1		1	80				
	5AC600.CANI-00	1	1	1	1		1	-				
	5AC600.485I-00	1	√	1	1		1	-				
	5AC801.SDL0-00	1	√	1	1	1	1	-				
	5AC801.RDYR-00	1	· ✓	1	1		1	-				
Zusatzsteckkarten Schnittstellen / AP Link	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/✓	30/✔	30/✔	30/ 40		30/ 40	-	'			
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	✓	√	1	1		1	-	-			
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	√	√	1	1		45	-	-			
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	1	√	1	1		45	-	"			

¹⁾ Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 7: Umgebungstemperatur ohne Lüfter

Maximale Umgebungstemperatur mit Lüfter Kit

- Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
- Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite 183).

_		ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 100 MBit Betrieb			ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb										
		L2400	L7400	U7500	M 423	T7400		L2400	L7400	U7500	M 423	T7400			
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN.	3945-00	3945-01		1			3945-00	3945-01	1	1	1			
	Herabsenkung (Derating) der maxi- malen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	5PC800.B945-00	5PC800.B945-01	5PC800.B945-02	5PC800.B945-03	5PC800.B945-04		5PC800.B945-00	5PC800.B945-01	5PC800.B945-02	5PC800.B945-03	5PC800.B945-04			
	Maximale Umgebungstemperatur	55	55	55	55	55		50	50	50	50	45		E .	reich
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?													Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich
	On-Board CompactFlash ¹⁾	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		80	
	5AC801.HDDI-00	1	1	1	1	1		✓	1	1	✓	1		80	1
	5AC801.HDDI-01	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		80 80 60 60 70 70 70 70	1
Slide-in com- pact Laufwerke	5AC801.HDDI-02	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1			1
	5AC801.HDDI-03	50	50	50	50	50		✓	1	1	✓	✓			
	5AC801.HDDI-04	50	50	50	50	50		✓	1	1	✓	1			
	5AC801.SSDI-00	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1			1
	5AC801.SSDI-01	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1			1
	5AC801.SSDI-02	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1			1
	5AC801.SSDI-03	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1			1
	5AC801.HDDS-00	1	1	1	1	1		√	1	1	1	1		80	_ ¥
Slide-in Laufwerke	5AC801.DVDS-00	50	50	50	50	50		✓	1	1	✓	1		50	de-ii
	5AC801.DVRS-00	50	50	50	50	50		✓	1	1	1	1		50	Slide-in Laufwerk
	5MMDDR.0512-01	1	1	1	1	1		√	1	1	1	1		-	
Hauptspeicher	5MMDDR.1024-01	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		-	
	5MMDDR.2048-01	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		-	1
	5PC810.SX01-00	1	1	1	1	1		√	1	1	1	1		80	
	5PC810.SX02-00	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		80	i ≡
Systemeinheiten	5PC810.SX03-00	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		80	Netzteil
	5PC810.SX05-00	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		80	_
	5AC600.CANI-00	1	1	1	1	1		√	1	1	1	1		-	
	5AC600.485I-00	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		-	1
	5AC801.SDL0-00	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		-	1
Zusatzsteckkarten	5AC801.RDYR-00	1	1	1	1	1		√	1	1	1	1		-	1
Schnittstel- len / AP Link	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40		30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40		-	'
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1	1		✓	1	1	1	1		-	1
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	50	50	50	50	50		✓	1	1	✓	1		-	1
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	50	50	50	50	50		✓	1	1	1	1		-	1

¹⁾ Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 8: Umgebungstemperatur mit Lüfter

- KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
- Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite 183).
- Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur für Systemeinheiten mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 ≥ Rev. D0 und 5AC801.HS00-01 ≥ Rev. D0 und das CPU Board 5PC800.B945-05 mit Kühlkörper 5AC801.HS00-02.

		L2400	L7400	U7500	M 423	T7400	N270						
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN.	5PC800.B945-10	5PC800.B945-11	5PC800.B945-12	5PC800.B945-13	5PC800.B945-14	5PC800.B945-05						
	Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800						
	Maximale Umgebungstemperatur	55	55	55	55	55	60	_	eich				
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?							Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich				
	On-Board CompactFlash ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	1	80					
	5AC801.HDDI-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80					
	5AC801.HDDI-01	✓	1	1	1	✓	✓	80					
	5AC801.HDDI-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80					
Slide-in compact Laufwerke	5AC801.HDDI-03	50	50	50	50	50	50	60	<u> </u>				
	5AC801.HDDI-04	50	50	50	50	50	50	60	≤				
	5AC801.SSDI-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70					
	5AC801.SSDI-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70					
	5AC801.SSDI-02	✓	✓	1	1	✓	✓	70					
	5AC801.SSDI-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70					
	5AC801.HDDS-00	1	1	1	1	1	✓	80	ㄷ높				
Slide-in Laufwerke	5AC801.DVDS-00	50	50	50	50	50	50	50	Slide-in Laufwerk				
	5AC801.DVRS-00	50	50	50	50	50	50	50	S B				
	5MMDDR.0512-01	✓	✓	1	1	1	1	-					
Hauptspeicher	5MMDDR.1024-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-					
	5MMDDR.2048-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-					
	5PC810.SX01-00	✓	✓	1	1	1	1	80					
0	5PC810.SX02-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	ig i				
Systemeinheiten	5PC810.SX03-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	Netzteil				
	5PC810.SX05-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80					
	5AC600.CANI-00	1	✓	1	1	1	√	-					
	5AC600.485I-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-					
	5AC801.SDL0-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-					
Zusatzsteckkarten	5AC801.RDYR-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-					
Schnittstellen / AP Link	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard)	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	30/ 40	_					
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-					
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	50	50	50	50	50	50	-					
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	50	50	50	50	50	50	-					

¹⁾ Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 9: Umgebungstemperatur mit Lüfter

Wie bestimmt man die maximale Umgebungstemperatur?

- 1. Auswahl des CPU Boards (Verwendung mit oder ohne Lüfter Kit).
- 2. Die Zeile "Maximale Umgebungstemperatur" zeigt die maximale Umgebungstemperatur des Gesamtsystems in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern ü. NN.

3. Sind im APC810 System zusätzlich Laufwerke (Add-on, Slide-in), Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. eingebaut, kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n) eine Temperatureinschränkung besteht.

Ist bei der verbauten Komponente ein "✓" (Häkchen), so kann diese bei der maximalen Umgebungstemperatur des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. "35", so darf die Umgebungstemperatur des gesamten APC810 Systems diese nicht überschreiten.

2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur

Die minimale Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit einer der folgenden Komponenten bei +5°C: 5AC801.DVDS-00, 5AC801.DVRS-00, 5ACPCI.RAIC-01, 5ACPCI.RAIC-02. Wird keine der genannten Komponenten verwendet so liegt die minimale Umgebungstemperatur bei 0°C.

2.1.3 Temperaturüberwachung

Sensoren überwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board, Board I/O, Board ETH2, Board Netzteil, ETH2 Controller, Netzteil und Slide-in Laufwerke 1/2) im APC810. Die Position der Temperatursensoren ist der Abbildung "Abb. 3: Temperatursensorpositionen" auf Seite 38 zu entnehmen. Der angegebene Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle²) dar. Beim Überschreiten der Temperatur wird kein Alarm ausgelöst. Die Temperaturen können im BIOS (Menüpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhältlichen Hard Disks für APC810 Systeme mit der S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es können verschiedene Parameter, wie z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer - Freeware) unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen (außer Windows CE) ausgelesen werden.

Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

2.1.4 Temperatursensorpositionen

Sensoren zeigen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board I/O, Slide-in Laufwerk, usw.) im APC810 an. Die Temperaturen³⁾ können im BIOS (Menüpunkt Advanced - CPU Monitor) oder unter Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center⁴⁾ ausgelesen werden.

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.

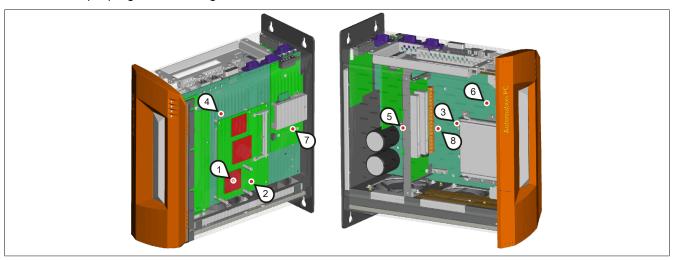


Abbildung 3: Temperatursensorpositionen

Position	Messpunkt für	Messung	max. spezifiziert
1	CPU	Temperatur des Prozessors (Sensor integriert im Prozessor).	100°C
2	Board	Temperatur des CPU Boards (Sensor integriert im CPU Board).	85°C
3	Board I/O	Temperatur des Board I/O Bereiches (Sensor auf dem Baseboard).	85°C
4	Board ETH2	Temperatur des Baseboards im Bereich des ETH2 Controllers (Sensor am Baseboard).	80°C
5	Board Netzteil	Temperatur des Board Netzteils (Sensor am Baseboard).	80°C
6	ETH2 Controller	Temperatur des ETH2 Controllers (Sensor im ETH2 Controller).	125°C
7	Netzteil	Temperatur des Netzteils (Sensor am Netzteil).	80°C
8	Slide-in Laufwerk 1	Temperatur eines Slide-in Laufwerks 1 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert).	laufwerkabhängig
8	Slide-in Laufwerk 2	Temperatur eines Slide-in Laufwerks 2 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert).	laufwerkabhängig

Tabelle 10: Temperatursensorpositionen

Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

⁴⁾ Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladenwerden.

2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten, die für die Einschränkung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerätes von Bedeutung sind. Für die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste, wie auch größte Wert zu verwenden.

Komponente		Betrieb	Lagerung / Transport
CPU Boards 945GME COM Expre	ess	10 bis 90%	5 bis 95%
Systemeinheiten (alle Varianten)		5 bis 90%	5 bis 95%
Hauptspeicher für CPU Boards		10 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-01	5 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-02	8 bis 80%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-03	5 bis 95%	5 bis 95%
Slide-in compact Laufwerke	5AC801.HDDI-04	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-00	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-01	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-02	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-03	8 bis 95%	8 bis 95%
	5AC801.HDDS-00	5 bis 90%	5 bis 90%
Slide-in Laufwerke	5AC801.DVDS-00	8 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.DVRS-00	8 bis 90%	5 bis 95%
	5AC600.CANI-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5AC600.485I-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.SDL0-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.RDYR-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/Standard)	5 bis 90%	5 bis 95%
Zusatzsteckkarten	5ACPCI.RAIC-02 (24 Stunden/Standard)	5 bis 90%	5 bis 95%
Zusatzsteckkarteri	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%
	5MMHDD.0250-00 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%
	5MMHDD.0500-00 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06	85%	85%
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04	85%	85%
Zubehör	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03	8 bis 95%	8 bis 95%
	Memory Stick 5MMUSB.2048-xx	10 bis 90%	5 bis 90%
	USB Media Drive 5MD900.USB2-01	20 bis 80%	5 bis 90%

Tabelle 11: Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 30°C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit der Temperatur ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.

2.3 Leistungshaushalt

2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der APC810 Spannungsversorgung für die Systemeinheiten dar.

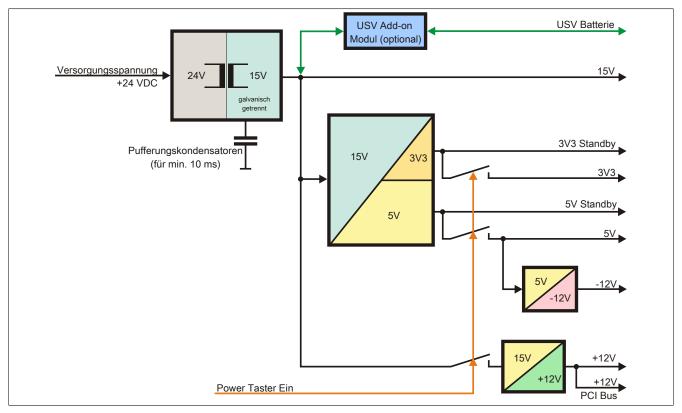


Abbildung 4: Spannungsversorgung für Systemeinheiten

Erläuterung

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese galvanisch getrennten 15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3 und 5 V auf den Bus gelegt. Beim 5 V Ausgang generiert ein weiterer DC/DC Wandler -12 V und legt diese auf den Bus. Ein zusätzlicher DC/DC Wandler generiert +12 V.

Die optional anschließbare Add-on USV inklusive Batterieeinheit wird über 15 V versorgt und gewährleistet bei Verlust der Versorgungsspannung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des 15 V Bus.

2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= D0

Info	rma	ation:			CPU	Board			Vorliegendes System
Bei ben	den der	gaben in Watt Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Anga- Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch eak-Werte.	5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
					tung Ge	samtne	tzteil (m	aximal)	130
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
				,			glich be		75
		CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
	>	Lüfter Kit, optional	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
	+12	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
	_	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit)1)							
						Verbr	aucher	+12 V ∑	
		maximal möglich bei +5 V							65
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
=		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
zte		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
net		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
amt		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Gesamtnetzteil	>	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
U	+2 \	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
					max	cimal m	öglich b	ei -12 V	1.2
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)¹)							
) i					raucher		_
						Verb	rauche	r +5 V ∑	
					ma	maximal möglich bei 3V3 40		40	
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		CompactFlash, je 1 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	3/3	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
						Ver	brauche	r 3V3 ∑	
							Verbra	ucher 5	

¹⁾ Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 12: Leistungskalkulation APC 1 Slot

2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < D0

Infor	ma	ition:			CPU	Board			Vorliegendes System
Bei d ben d	len der	gaben in Watt Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Anga- Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch eak-Werte.	5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
_			_		tung Ge	_			85
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
					_		glich be	_	75
		CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
	>	Lüfter Kit, optional	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
	+12	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
	+	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
			+12 V ∑						
			oei +5 V	65					
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
=		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
zte		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
net		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
Gesamtnetzteil		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
es;		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
9	+2 \	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
					max	imal m	öglich b	ei -12 V	1.2
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)¹)							
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				Verb	raucher	-12 V ∑	
						Verb	rauchei	r +5 V ∑	
					ma	aximal n	nöglich	bei 3V3	40
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		CompactFlash, je 1 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
9.0	3/3	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
					1	Ver	brauche	r 3V3 ∑	
							Verbrau	ucher ∑	
							nachere		

¹⁾ Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 13: Leistungskalkulation APC 1 Slot

2.3.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= D0

Info	rma	ation:				Board			Vorliegendes System
Bei ben	den der	gaben in Watt Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Anga- Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch leak-Werte.	5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
				_	tung Ge	_	•		130
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
		ODUD A STATE A	1 00			_	glich be	_	75
		CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W	1.0		4.0	4.0	4.0	4.0	
	>	Lüfter Kit, optional	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
	+12	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional							
		(max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
				l		Verbr	aucher ·	+12 V ∑	
					ma	ximal m	öglich k	pei +5 V	65
		Systemeinheit, Fixverbraucher		4	4	4	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,)		4	4	4	4	4	
eil		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
etzt		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
ntn		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Gesamtnetzteil	>	Grafikadapter (AP Link), optional	5	5	5	5	5	5	
Ge	+2	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
	т.	Leistungsangabe PCI Karte, optional							
		(max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
				T	max	cimal m	öglich b	ei -12 V	1.2
		Leistungsangabe PCI Karte, optional							
		(max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit) ¹⁾						40.45	
							raucher raucher		
			40						
		Customoinhoit Finnerhrougher	1 4			_	nöglich		i 3V3 40
		Systemeinheit, Fixverbraucher CompactFlash, je 1 W	4	4	4	4	4	4	
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
		Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	0.25 1.5	0.25 1.5	1.5	1.5	0.25 1.5	
	3/3		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	ñ	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
						Verl	orauche	r 3V3 ∑	
							Verbrau	ucher ∑	

¹⁾ Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 14: Leistungskalkulation APC 2 Slot

2.3.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < D0

Info	rma	ation:			CPU	Board			Vorliegendes System
Bei ben	den der	gaben in Watt Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Anga- Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch eak-Werte.	5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
	Add on UCV/ Modul ontional		7.5	_	tung Ge	_			85
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5 imal mö	7.5	7.5	75
		CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	75
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W	20	30	10	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 312 MB max. 2 Stück je 1,3 W	-						
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
		Lüfter Kit, optional	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
	+12 V	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
	÷	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
			+12 V ∑						
					ma	ximal m	öglich k	pei +5 V	65
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,)	4	4	4	4	4	4	
ztei		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W	-						
net		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
amt		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5 5	0.5 5	0.5 5	0.5 5	
Gesamtnetzteil	+5 \	Grafikadapter (AP Link), optional Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
0	+	Leistungsangabe PCI Karte, optional	3	3	3	3	3	3	
		(max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
			-	-	max	imal m	öglich b	ei -12 V	1.2
		Leistungsangabe PCI Karte, optional	Τ						
		(max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)1)							
		\ \frac{1}{2}				Verb	aucher	-12 V ∑	
	Verbraucher +5 V ∑								
						aximal n		bei 3V3	40
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		CompactFlash, je 1 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	က	Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	3V3	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
						Verl	orauche	r 3V3 ∑	
							Verbrau	ucher ∑	

¹⁾ Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 15: Leistungskalkulation APC 2 Slot

2.3.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00

Infor	ma	ion:			CPU	Board			Vorliegendes System
Bei d	len i der '	aben in Watt Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Anga- Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch ak-Werte.	5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
_				Leist	tung Ge	_			130
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	_						glich be		75
	-	CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	43	11	
	-	Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W							
	>	Lüfter Kit, optional	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	
	+12	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
			+12 V ∑						
					ma	ximal m	öglich k	pei +5 V	65
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,)	4	4	4	4	4	4	
ţe		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
etz		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W							
Gesamtnetzteil		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Sar	,	Grafikadapter (AP Link), optional	5	5	5	5	5	5	
တီ	+2 <	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
	•	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
					max	cimal m	öglich b	ei -12 V	1.2
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		7				Verb	raucher	-12 V ∑	
						Verb	rauchei	r +5 V ∑	
			maximal möglich bei 3V3	40					
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		CompactFlash, je 1 W							
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	_	Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	3/3	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
						Verl	brauche	r 3V3 ∑	
							Verbrai	ucher 5	

¹⁾ Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 16: Leistungskalkulation APC 3 Slot

2.3.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00

Info	rma	ation:			CPU	Board			Vorliegendes System
Bei ben	den der	gaben in Watt Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Anga- Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch eak-Werte.	5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
		Add at 100VAArd Lood's ad	7.5	_			tzteil (m		130
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	75
		CPU Board, Fixverbraucher	26	30	18	14	glich be	11 +12 V	75
		Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stück je 1,5 W	20	30	10	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 1,5 W Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 2,5 W							
		Lüfter Kit, optional	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
	2 \	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
	+12	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit) ¹⁾	10	10	10	10	10	10	
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Verbraucher +12 V ∑							
			1		_		öglich b		65
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,)	4	4	4	4	4	4	
ztei		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W							
net		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Gesamtnetzteil		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 5	
ess	>	Grafikadapter (AP Link), optional Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5 5	5	5 5	5	5	
0	+2		3	3	3	3	3	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾				rime al mai	öglich b	o: 42.V	1.2
		Laistungsangaha DCI Karta, antianal	Т	I	max	imai me	oglich b	ei -12 v	1.2
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit)¹)						101/5	
							raucher		
							raucher		40
		Customainhait Finnarhraushar	4	4	m a		nöglich 4		40
		Systemeinheit, Fixverbraucher CompactFlash, je 1 W	4	4	4	4	4	4	
			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	3/3	Leistungsangabe PCI Karte, optional	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	
	3	(max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit)1)							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
						Verl	orauche		
							Verbrau	ıcher ∑	

¹⁾ Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 17: Leistungskalkulation APC 5 Slot

2.4 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerät wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128) versehen, um eine eindeutige Identifizierung des Gerätes zu ermöglichen. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem System verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer, Lieferdatum und Garantieende) abgebildet.

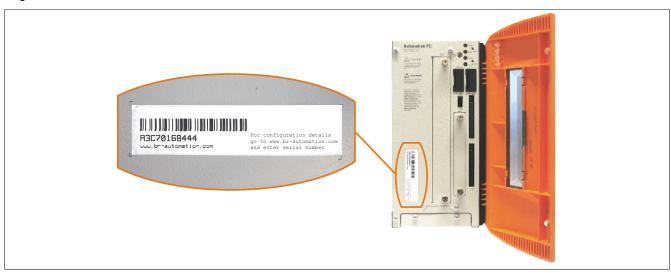


Abbildung 5: Serialnummernaufkleber Vorderseite

Ein Aufkleber mit detaillierten Informationen der verbauten Komponenten ist auch auf der Rückseite der Montageplatte zu finden.

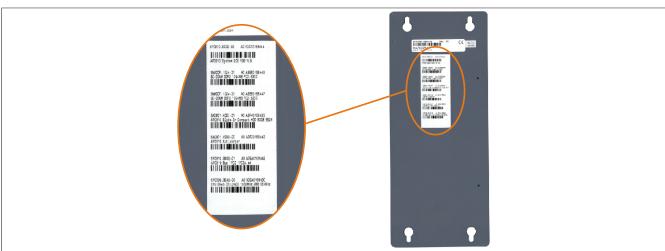


Abbildung 6: Serialnummernaufkleber Rückseite

Technische Daten • Gesamtgerät

Diese Information kann auch über die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der Startseite <u>www.brautomation.com</u> die Serialnummer des Gesamtgerätes im Suchfeld einzugeben auf den Tab "Serialnummer" zu wechseln. Nach der Suche erhält man eine detaillierte Auflistung der verbauten Komponenten.

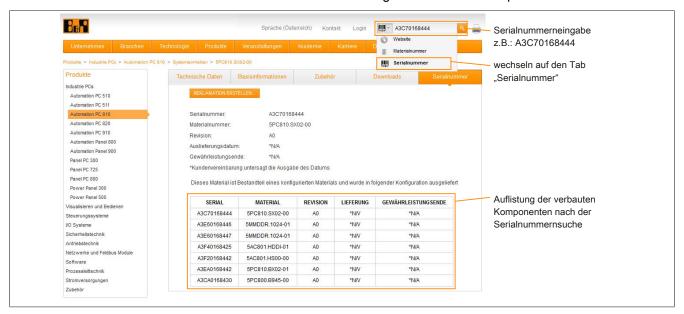


Abbildung 7: Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444

2.5 Blockschaltbilder

Die nachfolgenden Blockschaltbilder zeigen den vereinfachten Aufbau der Systemeinheiten mit einem CPU Board in Abhängigkeit der verschiedenen Buseinheiten.

2.5.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00

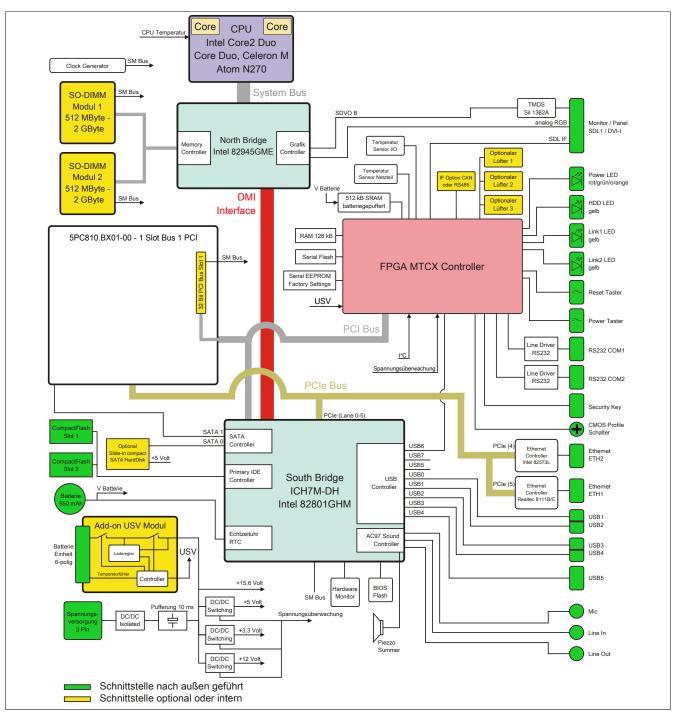


Abbildung 8: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-00 Blockschaltbild

2.5.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01

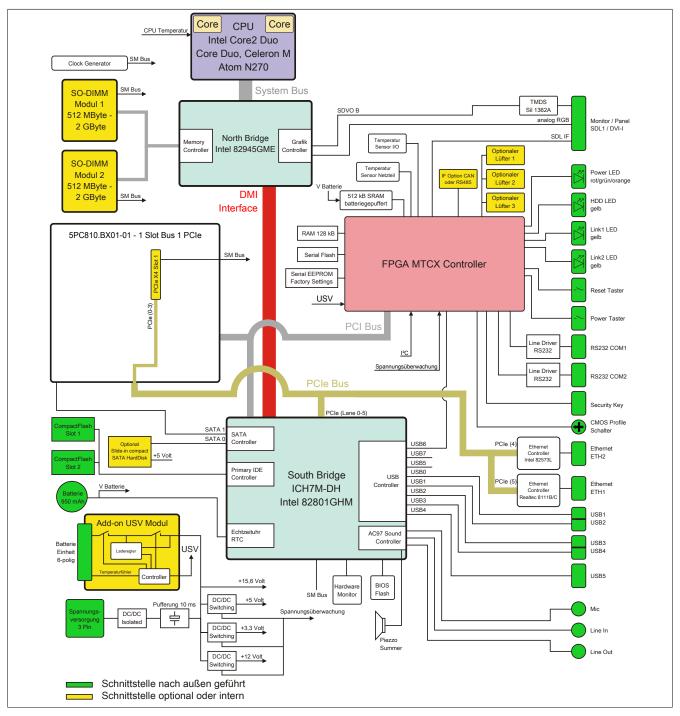


Abbildung 9: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-01 Blockschaltbild

2.5.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00

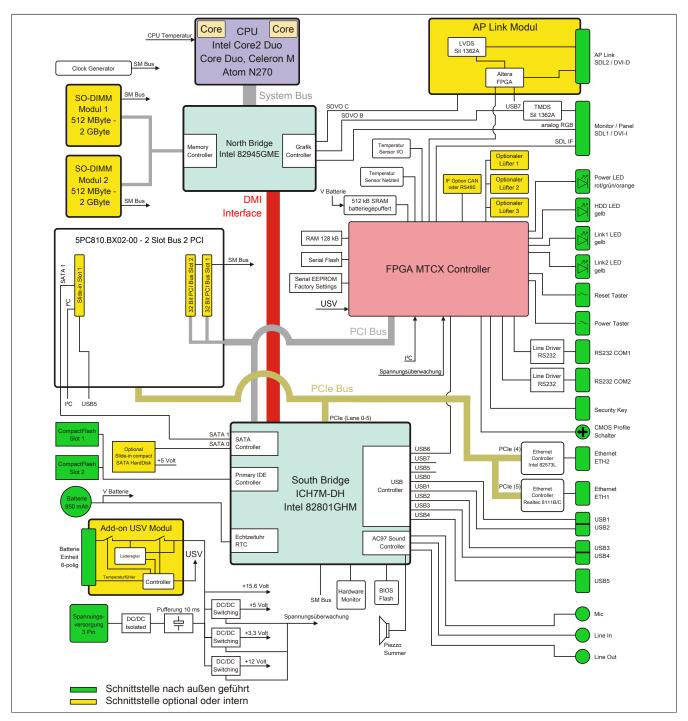


Abbildung 10: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-00 Blockschaltbild

2.5.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01

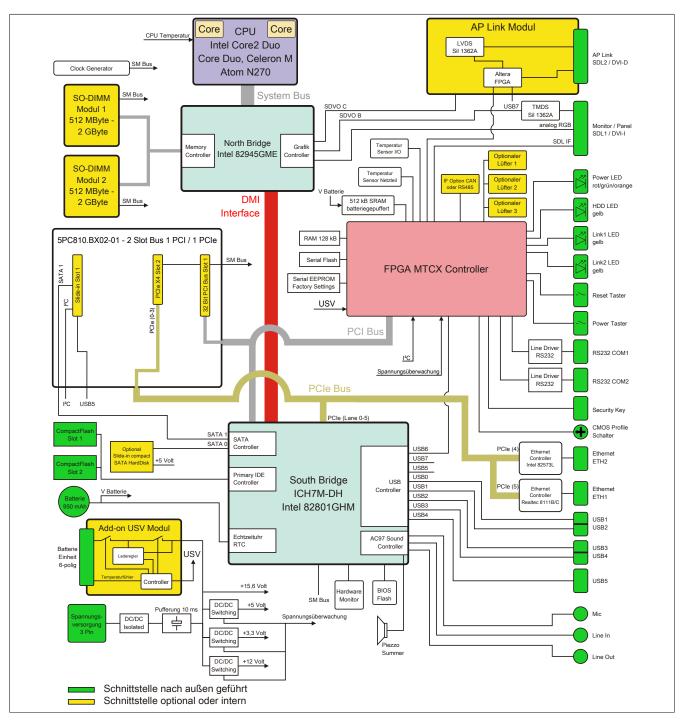


Abbildung 11: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-01 Blockschaltbild

2.5.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00

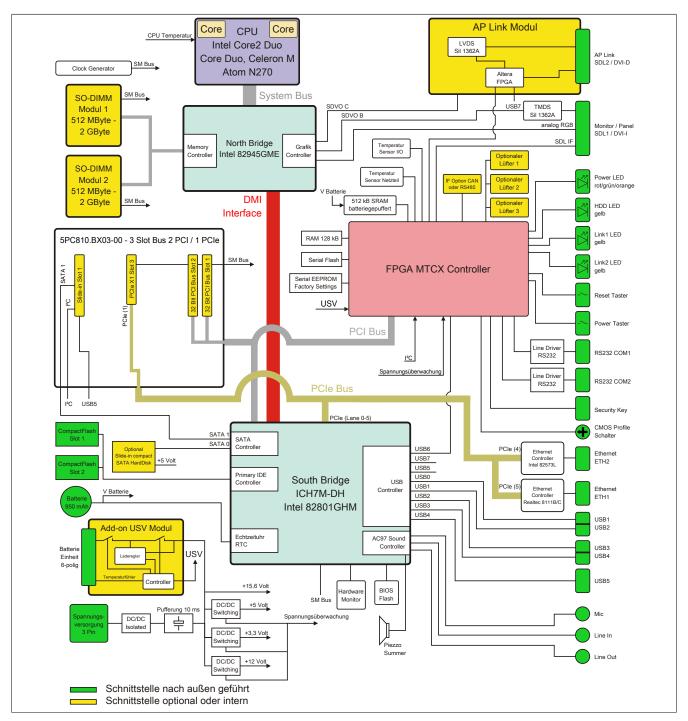


Abbildung 12: 5PC810.SX03-00 + 5PC810.BX03-00 Blockschaltbild

2.5.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00

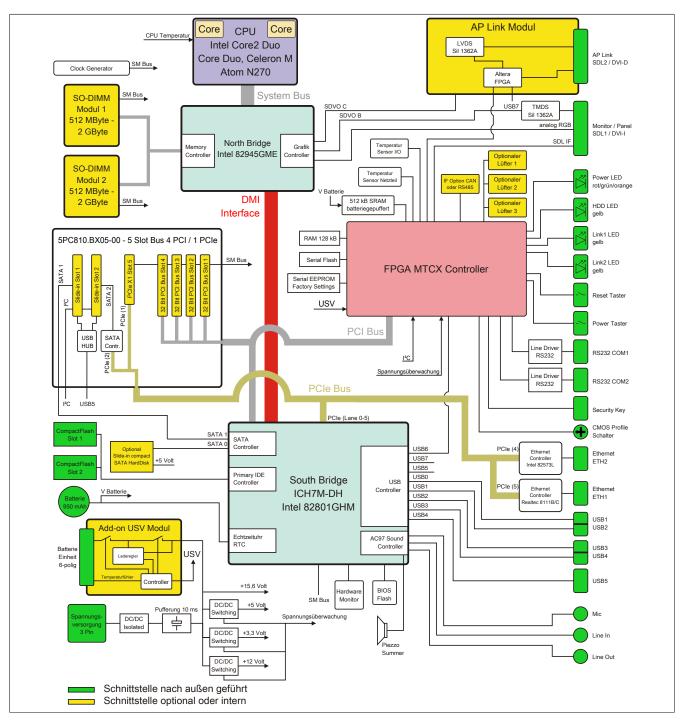


Abbildung 13: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-00 Blockschaltbild

2.5.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01

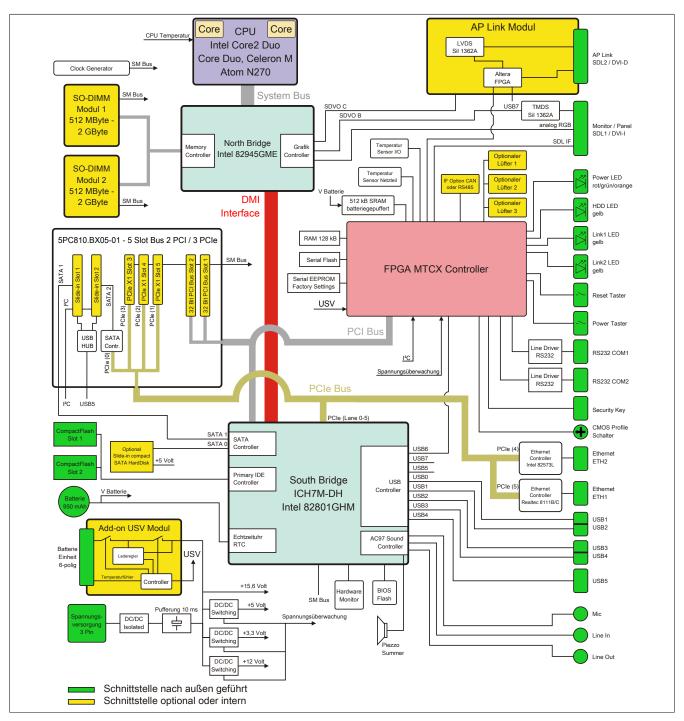


Abbildung 14: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-01 Blockschaltbild

2.5.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02

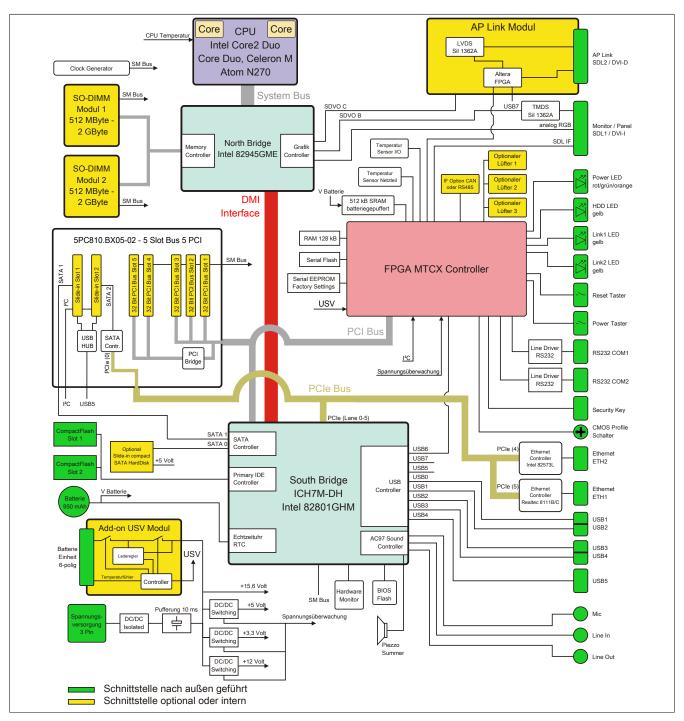


Abbildung 15: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-02 Blockschaltbild

2.6 Geräteschnittstellen

2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem APC810 Gehäuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (15A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

	Spannungsversor	gung
	verpolungssicher	3-polig, male
Pin	Beschreibung	
1	-	Line IN
2	Funktionserde	
3	+	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Feldklemmem	Power 24 VDC
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	- 📥 +
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	
		_1_2_3_

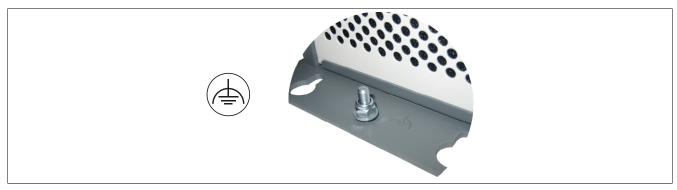
Tabelle 18: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC

Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Pin 2) ist möglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu empfehlen, den größt möglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwenden.

Die APC810 Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.



Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes oder der Anlage in der der APC810 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich (mindestens 2,5 mm²) gewählt werden.

2.6.2 Serielle Schnittstelle COM1

	Serielle Schnittstelle	COM1¹)
	RS232	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 115 kBit/s	
Buslänge	max. 15 m	9-poliger DSUB Stecke
Pin	Belegung	
1	DCD	1
2	RXD	6 6
3	TXD	
4	DTR	9 ° °
5	GND	5
6	DSR	
7	RTS	
8	CTS	
9	RI	_

Tabelle 19: Pinbelegung COM1

 Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.6.3 Serielle Schnittstelle COM2

	Serielle Schnittstelle	COM2 ¹⁾
	RS232	
0	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
IRT	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
pertragungsgeschwindig- it	max. 115 kBit/s	
ıslänge	max. 15 m	9-poliger DSUB Stecker
Pin	Belegung	
1	DCD	6 6 1
2	RXD	0 0
3	TXD	
4	DTR	9 ° 0
5	GND	5
6	DSR	
7	RTS	1
8	CTS	
9	RI	1

Tabelle 20: Pinbelegung COM2

 Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.6.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)

	Monitor / Panel Anschluss - SDL (Sm	art Display Link) / DVI
	zeigt einen Überblick der möglichen verfügbaren Videosi- usgang. Details siehe Technische Daten des verwende-	
CPU Board	Videosignale mit allenSystemeinheitenvarianten	
5PC800.B945-00 / -10	RGB, DVI, SDL	
5PC800.B945-01 / -11	RGB, DVI, SDL	
5PC800.B945-02 / -12	RGB, DVI, SDL	
5PC800.B945-03 / -13	RGB, DVI, SDL	
5PC800.B945-04 / -14	RGB, DVI, SDL	
5PC800.B945-05	RGB, DVI, SDL	

Tabelle 21: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL

Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung	
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect	
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)	
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)	
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1	
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)	
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)	
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair	DVI 24-polig, female
8	n.c.	not connected	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)	
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)	
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	ANALOG RED	Analog Red	9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 c5
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	ANALOG GREEN	Analog Green	
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	ANALOG BLUE	Analog Blue	
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	ANALOG HORZ SYNC	Analog Horizontal Synchro- nization	
14	+5 V Power ¹⁾	+5V Power Supply	C5	ANALOG GND	Analog ground (Return for R, G and B signals)	
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground				

Tabelle 22: Pinbelegung DVI Anschluss

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel	Auflösung						
	VGA	SVGA	XGA	SXGA	UXGA	FHD	
Segmentlänge [m]	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080	
	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	
1,8	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	
	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	
5	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	
	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	
10	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	
	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-	
15	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-	
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03	
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-	
20	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03	
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-	-	
25	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-	-	
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-	
30	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13	
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	=	5CASDL.0400-13	

Tabelle 23: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

¹⁾ Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des DVI Kabels:

DVI Kabel		Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080		
1,8	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00		
5	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00		

Tabelle 24: Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

2.6.5 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

		Ethernet 1 Anschluss	(ETH1¹))
Controller	Realtek RT	L8111B/C ²⁾	
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)	4
Übertragungsgeschwindig- keit	10/100/10	00 MBit/s ³⁾	
Kabellänge	ellänge max. 100 m (min. Cat5e)		
Speed LED	Ein	Aus	
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ⁴⁾	
Orange	1000 MBit/s	-	
Link LED	Ein	Aus	
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netz- werk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	Link LED Speed LED

Tabelle 25: Ethernet Anschluss (ETH1)

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- Bei den CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 ist der Realtek 8111B integriert.
 Bei den CPU Boards 5PC800.B945-05 und 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 ist der Realtek 8111C integriert.
- 3) Umschaltung erfolgt automatisch.
- 4) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Wichtige Information zur Übertragungsgeschwindigkeit

Auf Grund thermischer Gegebenheiten ist der Betrieb der ETH1 im 1000 MBit/s Modus mit den CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 nur unter Verwendung eines Lüfter Kits oder Verwendung von Kühlkörpern (5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01) ab Rev. D0 (siehe "Temperaturangaben" auf Seite 31) erlaubt. Bei den CPU Boards 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 mit den Kühlkörpern 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-01 und dem CPU Board 5PC800.B945-05 mit dem Kühlkörper 5AC801.HS00-02 entfällt diese Limitierung.

Treibersupport

Für den Betrieb des Realtek Ethernet-Controllers RTL8111B/C ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen

2.6.6 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im Basisboard integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

		Ethernet 2 Anschluss	(ETH2 ¹⁾)
Controller	Intel 8	2573L	
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)	4
Übertragungsgeschwindig- keit	10/100/10	00 MBit/s ²⁾	
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)	
Speed LED	Ein Aus		
Grün	100 MBit/s 10 MBit/s ³⁾		
Orange	1000 MBit/s	-	
Link LED	Ein	Aus	
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netz- werk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	Link LED Speed LED

Tabelle 26: Ethernet Anschluss (ETH2)

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Umschaltung erfolgt automatisch.
- 3) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82573L ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)

Die APC810 Geräte verfügen über einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon 5 nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Information:

Weitere Informationen siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt "Anschluss von USB Peripheriegeräten" auf Seite 217.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB1,2,3,4

·	Universal Serial Bus (USB1, USB1, US	SB2, USB3, USB4 ¹⁾)
Тур	USB 2.0	4 x USB Typ A, female
Ausführung	Тур А	
Übertragungsgeschwindig- keit	Low Speed (1,5 MBit/s),Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
Strombelastbarkeit2)		
USB1, USB3	max. 1 A	
USB2, USB4	max. 500 mA	
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
		USB1 USB2
		USB3 USB4
		6354
		000

Tabelle 27: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

- Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.

IISR5

	Universal Serial Bu	s (USB5) ¹⁾
Тур	USB 2.0	1 x USB Typ A, female
Ausführung	Тур А	
Übertragungsgeschwindig- keit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
Stromversorgung ²⁾		
USB5	max. 1 A	
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	
		USBS RIDD

Tabelle 28: USB5 Anschluss

- Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 1 A) abgesichert.

2.6.8 MIC, Line IN, Line OUT

Bei allen APC810 Systemen ist ein AC97 (Rev. 2.2) kompatibler Soundchip vorhanden bei dem die Kanäle MIC, Line IN und Line OUT von außen zugänglich sind.



Tabelle 29: MIC, Line IN, Line OUT

Treibersupport

Für den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.9 Add-on Schnittstellensteckplatz

Hier kann eine optionale Add-on Schnittstelle (z.B. CAN, RS485) gesteckt werden. Siehe auch "Schnittstellenoptionen (IF Option)" auf Seite 176.

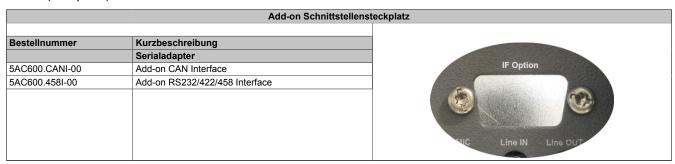


Tabelle 30: Add-on Schnittstellensteckplatz

2.6.10 Add-on USV Steckplatz

An diesem Steckplatz kann ein optionales Automation PC Add-on USV Modul oder das APC810 Ready Relais /2 montiert werden.

	Add-on USV Stee	ckplatz
Pinbelegi	ung bei montiertem Add-on USV Modul	
1	+	
2	+	
3	-	
4	-	
5	NTC (für Batterietemperaturmessung)	<u> </u>
6	NTC (für Batterietemperaturmessung)	GPS 1
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	Add-on USV Modul	+ + ┌⊴⁴≒
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5 Ah	
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m	CONTRACTOR CONTRACTOR
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m	
	APC810 Ready Relais	
5AC801.RDYR-01	APC810 Ready Relais /2	
		1 2 3 4 5 6 OFF

Tabelle 31: Add-on USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV)

Informationen zum USV Modul siehe Kapitel 6 "Zubehör", Abschnitt 358.

2.6.11 AP Link Steckplatz

In Verbindung mit der AP Link Steckkarte 5AC801.SDL0-00 besteht die Möglichkeit, einen zweiten Grafikstrang mit DVI und SDL aber ohne RGB Signalen zu realisieren. Weiters kann das APC810 Ready Relais 5AC801.RDYR-00 montiert werden.

Information:

Die Montage von AP Link Steckkarten ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 möglich.

2.6.12 Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)

Je nach Variante der Buseinheit können Standard PCI 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express (PCIe) half-size Karten gesteckt werden. Diese dürfen die nachfolgenden Abmessungen nicht überschreiten.

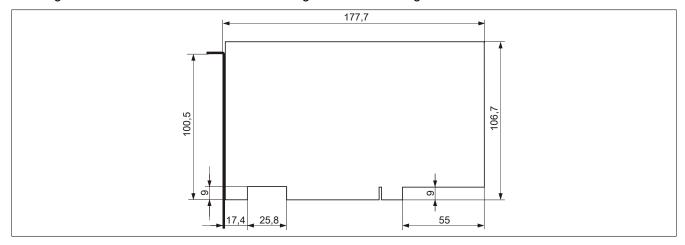


Abbildung 16: Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI Karte

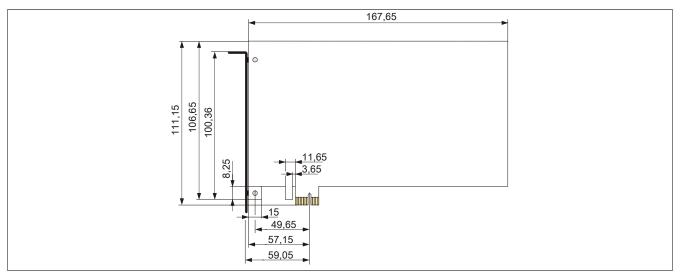
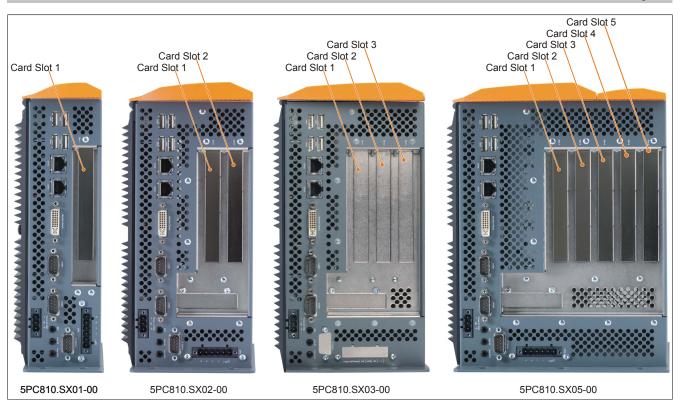


Abbildung 17: Abmessungen Standard half-size PCIe Karte

Aufgrund mechanischer Einschränkungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card Slot gesteckt werden. Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit Karten möglich ist.

		Card Slot 1	Card Slot 2	Card Slot 3	Card Slot 4	Card Slot 5
Systemeinheit	Buseinheit					
5PC810.SX01-00	5PC810.BX01-00	32-Bit PCI				
	5PC810.BX01-01	PCle				
5PC810.SX02-00	5PC810.BX02-00	32 und 64-Bit PCI	32-Bit PCI			
	5PC810.BX02-01	32 und 64-Bit PCI	PCle			
5PC810.SX03-00	5PC810.BX03-00	32 und 64-Bit PCI	32-Bit PCI	PCle		
5PC810.SX05-00	5PC810.BX05-00	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32-Bit PCI	PCle
	5PC810.BX05-01	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	PCle	PCle	PCle
	5PC810.BX05-02	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI

Tabelle 32: Übersicht 64-Bit Karten



2.6.13 Status LEDs

Die Status LEDs sind in der Systemeinheit integriert und befinden sich hinter der orangen Frontabdeckung.

			Status LEDs	
LED	Farbe	Status	Bedeutung	
Power	Grün	Ein	Spannungsversorgung OK	
	Rot	Ein	Das System befindet sich im Stromspar- Standby Modus (S5: Soft-off Modus; S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk oder S3: Suspend-to-RAM)	Power
	Orange ¹⁾	Ein	Spannungsversorgung nicht OK; das System läuft im Batteriebetrieb.	CMOS Profile
HDD	Gelb	Ein	Signalisiert einen IDE Laufwerkszugriff (CF, HDD, CD, usw.)	Link 1
Link1	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Monitor / Panel Stecker an.	Hardware Security Key Battery
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung wurde durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit unterbrochen.	
Link2	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am AP Link an.	
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung am AP Link wurde durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit unterbrochen.	

Tabelle 33: Daten Status LEDs

1) Leuchtet nur bei installierter Add-on USV.

Das Licht der Status LEDs wird über Lichtleiter an die Vorderseite der Frontabdeckung geführt.



Abbildung 18: Status LEDs Vorderseite

2.6.14 CMOS Profile Schalter

	CMOS Profile Sch	alter
Mit dem 16 stelligen CMOS profile eingestellt werden.	S Profile Schalter können verschiedene BIOS Defaultwerte-	0 - F Hex
Schalterstellung	Beschreibung	0-1 Hex
0	Profil 0: Defaultprofil reserviert.	
1	Profil 1: Optimiert für die Systemeinheiten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX03-00	Power HDD Power
2	Profil 2: Optimiert für die Systemeinheit 5PC810.SX05-00	CMOS Profile
3	Profil 3: Optimiert für die Systemeinheit 5PC820.SX01-00 und 5PC820.SX01-01	Link 1
4	Profil 4: Reserviert	Hardware Link 2 Reset
5	Profil 5: Optimiert für die Systemeinheiten 5PC820.1505-00 und 5PC820.1906-00	Security Key Battery
	Profil 5: Optimiert für die Systemeinheiten	Hardware Security Key Battery

Tabelle 34: CMOS Profile Schalter

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte für dieses System dar und sollte daher nicht geändert werden.

Die Position des CMOS Profile Schalters wird unter anderem in den BIOS Setupseiten und im B&R ADI Control Center angezeigt.

2.6.15 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstützung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitäten.

Power Taster

Der Power Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiberspitze) betätigt werden.

Der Power Taster verhält sich wie z.B. der Netzschalter bei aktuellen Desktop PCs mit ATX Netzteil:

kurzes Drücken ... APC810 einschalten bzw. Betriebssystem herunterfahren und APC810 ausschalten.

langes Drücken ... ATX Netzteil schaltet ohne herunterfahren den APC810 aus (Datenverlust möglich!).

Beim Drücken des Power Tasters wird der MTCX Prozessor nicht resetiert.



Tabelle 35: Power Taster

2.6.16 Reset Taster

Information:

Ab der MTCX PX32 Firmware ≥ V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert, das heißt, dass das Gerät trotz gedrückter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32 Firmware < V00.11 startet das System bei längerem Drücken (ca. 10 Sekunden) und wieder loslassen des Reset Tasters nicht mehr.

Reset Taster

Der Reset-Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiberspitze) betätigt werden.

Wenn der Reset Taster betätigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgelöst. Der APC810 startet neu (Kaltstart).

Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resetiert.



Tabelle 36: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust führen!

2.6.17 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC), der individuell gespeicherten BIOS Einstellungen sowie der Daten im SRAM sicher und befindet sich hinter der schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie beträgt mindestens 2½ Jahre (bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%). Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

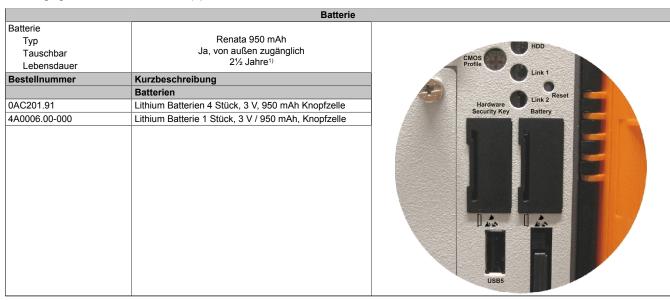


Tabelle 37: Batterie

1) Bei 50°C, 8,5 μA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 38: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

2.6.18 Hardware Security Key (Dongle)

Als Hardware Security Key (Dongle) für den Kopierschutz der Software empfiehlt B&R einen Dongle basierend auf dem DS1425 von MAXIM (früher Dallas Semiconductors).



Tabelle 39: Hardware Security Key

Warnung!

Ein- und Ausbau des Hardware Security Keys darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.19 CompactFlash Slot 1

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern über IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden.



Tabelle 40: CompactFlash Slot (CF1)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.20 CompactFlash Slot 2

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern über IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden.

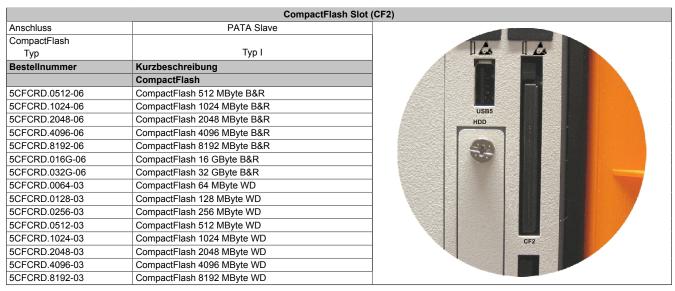


Tabelle 41: CompactFlash Slot (CF2)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.21 Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot 1 ist intern über SATA I und USB mit dem Chipset verbunden.

	Slide-in Slot 1	
Anschluss	SATA I und USB	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	Slide-In Slot 1 CMOS Profile
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).	Hardware Security Key

Tabelle 42: Slide-in Slot 1

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

2.6.22 Slide-in Slot 2

Der Slide-in Slot 2 ist intern über eine PCIe to SATA Bridge (SiL 3531) und USB mit dem Chipset verbunden.

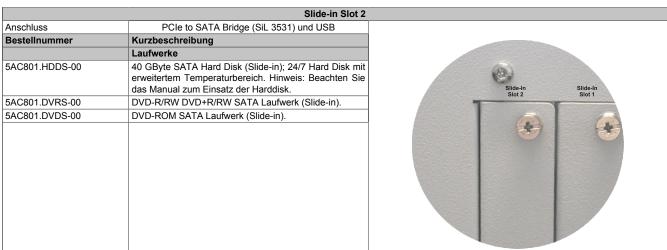


Tabelle 43: Slide-in Slot 2

Information:

Der APC810 Slide-in compact Adapter 5AC801.ADAS-00 kann aus mechanischen Gegebenheiten (Schließen der Fronttüre) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

Information:

Benötigte Treiber sind je nach verwendetem Betriebssystem von der B&R Homepage herunterzuladen.

2.6.23 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern über SATA I mit dem Chipset verbunden.

	Slide-in compact S	lot
Anschluss	SATAI	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	USB5 HDD
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	

Tabelle 44: Slide-in compact Slot

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

Einbau bzw. Tausch eines Slide-in compact Laufwerks siehe "Vorgangsweise" auf Seite 398.

3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

Die Systemeinheit vereint alle Einzelkomponenten in sich zu einem kompakten Gerät. Sie besteht aus dem Gehäuse mit integriertem Basisboard. Die Schnittstellen sind vorderseitig hinter der orangenen Fronttüre bzw. oberseitig leicht zugänglich. Die Systemeinheiten gibt es in den Größen mit 1, 2, 3 oder 5 Card Slots.

3.1.1 5PC810.SX01-00

Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 1 PCI oder 1 PCIe Slot
- · SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk

Bestelldaten

Model number	Short description	Figure	
	Systemeinheiten	Two and the same of the same o	
5PC810.SX01-00	APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)		
	Erforderliches Zubehör		
	Buseinheiten	o and a second	
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI		
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	at P	
	CPU Boards	e a la	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.		
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.		
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.		
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.		
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.		
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.		
	Feldklemmen		
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch		
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch		
	Hauptspeicher		
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300		
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300		
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300		
5AC801.HS00-00	Kühlkörper APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.		
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.		
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270. Optionales Zubehör		
	Laufwerke		

Tabelle 45: 5PC810.SX01-00 - Order data

Model number	Short description
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
	mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
JAC601.11DDI-04	Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
	das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
	Lüfter Kit
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.
	Serialadapter
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinhei-
	ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
	G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
	A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
	(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
	(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
	Zubehör
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 45: 5PC810.SX01-00 - Order data

Schnittstellen

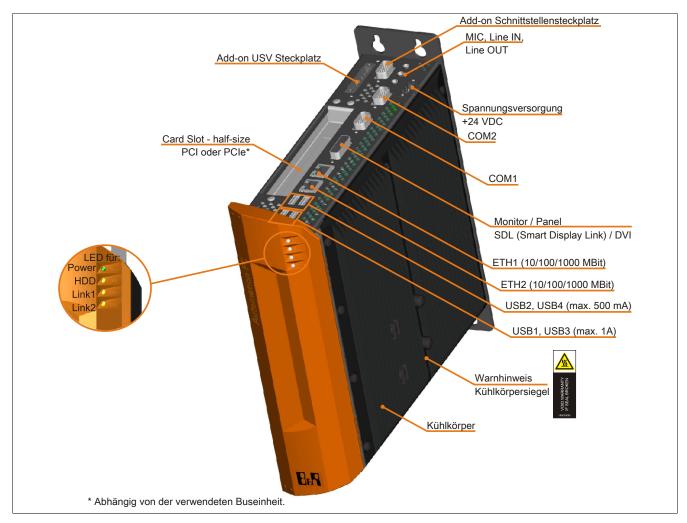


Abbildung 19: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Oberseite

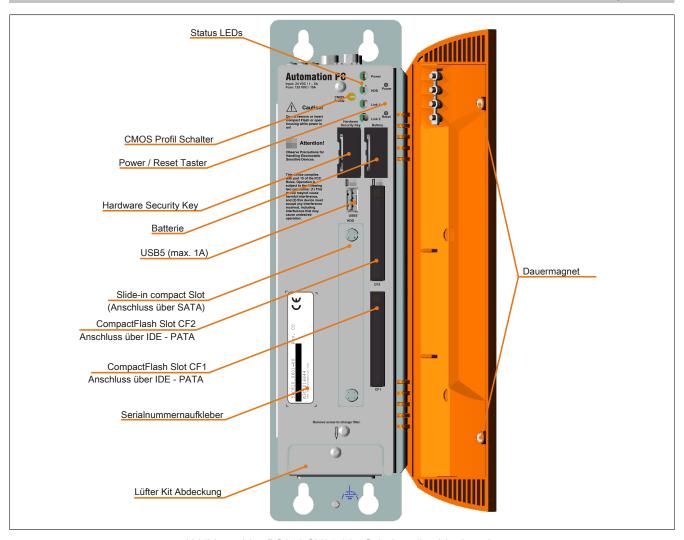


Abbildung 20: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX01-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit 1)
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	\$A3ED
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre ²⁾
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttüre zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja
ATEX Zone 22	Ja
GL	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX 3)
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX01-00
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher	
Тур	abhängig vom verwendeten CPU Board
Größe	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
COM2	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Anzahl	_1
Тур	Тур І
CompactFlash Slot 2	,
Anzahl	1
Тур	Тур І
USB	_
Anzahl	5
Тур	USB 2.0
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	
Anzahl	2
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate	1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle	DATE 1
Ausführung	DVI-I Buchse
Тур	SDL/DVI/Monitor
CAN	
Anmerkung	optional
Audio	A 007 0 I 4)
Тур	AC97 Sound 4)
Eingänge	Mikrofon, Line In Line Out
Ausgänge	Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz	1
Anzahl	1
Einschübe PCI / PCIe Slots	
Anzahl	1 PCI Slot oder 1 PCIe Slot 5)
Slide-in Laufwerke	Nein 4
Slide-in compact Laufwerke	1
Automation Panel Link Slot	Nein
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	6 A
Einschaltstrom	typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Galvanische Trennung	
Einsatzbedingungen	Ja
	Ja
Schutzart nach EN 60529	
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen	Ja
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur	Ja
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen	Ja IP20 komponentenabhängig
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung	Ja IP20 komponentenabhängig -20 bis 60°C
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport	Ja IP20 komponentenabhängig
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport Luftfeuchtigkeit	Ja IP20 komponentenabhängig -20 bis 60°C
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport	Ja IP20 komponentenabhängig -20 bis 60°C
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport Luftfeuchtigkeit	Ja IP20 komponentenabhängig -20 bis 60°C -20 bis 60°C
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	Ja IP20 komponentenabhängig -20 bis 60°C -20 bis 60°C komponentenabhängig
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport Vibration 6)	IP20 komponentenabhängig -20 bis 60°C -20 bis 60°C komponentenabhängig komponentenabhängig komponentenabhängig komponentenabhängig
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport Vibration ⁶⁾ Betrieb (dauerhaft)	Ja IP20 komponentenabhängig -20 bis 60°C -20 bis 60°C komponentenabhängig komponentenabhängig komponentenabhängig komponentenabhängig 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport Vibration 6)	IP20 komponentenabhängig -20 bis 60°C -20 bis 60°C komponentenabhängig komponentenabhängig komponentenabhängig komponentenabhängig 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport Vibration ⁶⁾ Betrieb (dauerhaft)	Ja IP20 komponentenabhängig -20 bis 60°C -20 bis 60°C komponentenabhängig komponentenabhängig komponentenabhängig komponentenabhängig 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX01-00
Schock 6)	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) 7)
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse 8)	
Material	verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen	
Breite	81,3 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02
	96,5 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01
Höhe	270 mm
Tiefe	252,7 mm
Gewicht	ca. 2200 g (komponentenabhängig)

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

- Beim APC810 GM45 ist ein Lüfter Kit zwingend erforderlich.
- Bei 50° C, $8,5~\mu\text{A}$ der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. 2)
- 3) Maintenance Controller Extended
- Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstützt.
- 4) 5) 6) Die PCI Slots und PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX01-00 und 5PC810.BX01-01.
- Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
- 7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.
- Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Abmessungen

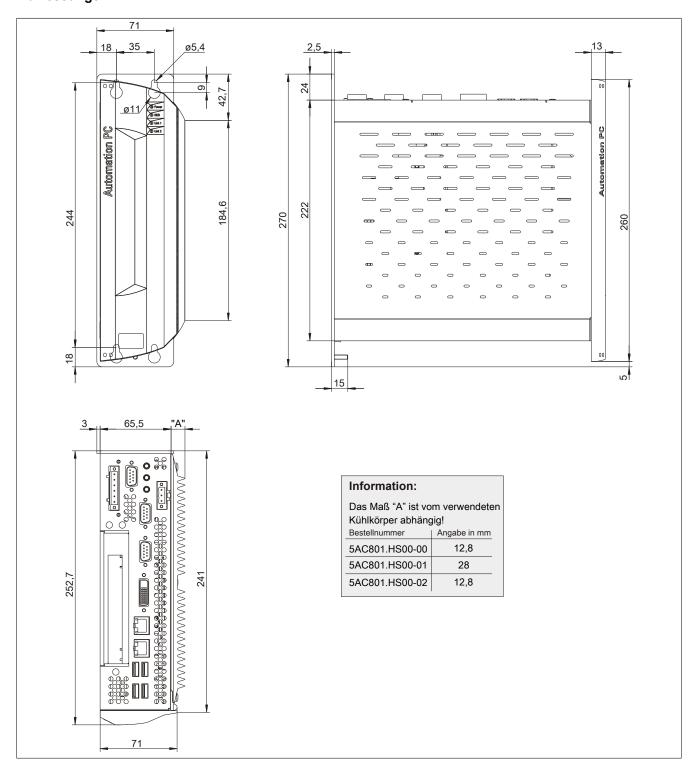


Abbildung 21: 5PC810.SX01-00 - Abmessungen

Bohrschablone

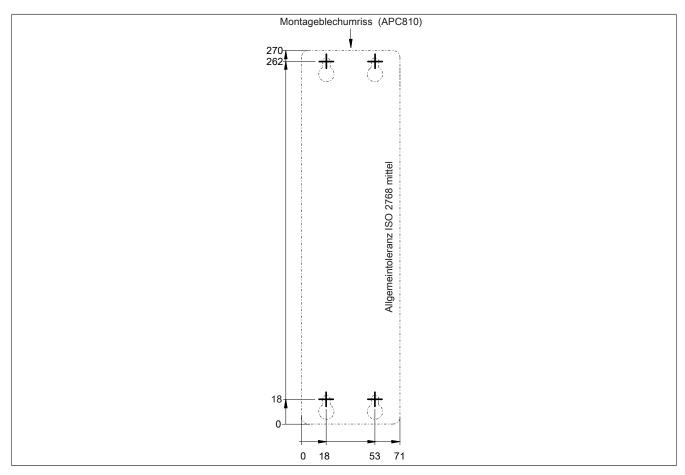


Abbildung 22: 5PC810.SX01-00 - Bohrschablone

3.1.2 5PC810.SX02-00

Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 2 PCI Slots oder 1 PCI und 1 PCIe Slot
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk
- Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL

Bestelldaten

Model number	Short description	Figure
	Systemeinheiten	
5PC810.SX02-00	APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Buseinheiten	
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	
	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	Eq
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270. Optionales Zubehör	
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 47: 5PC810.SX02-00 - Order data

Model number	Short description
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
	Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
	tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
	das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
	Lüfter Kit
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revi-
	sion D0.
	Serialadapter
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
1	11 07 00:
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00	Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinhei-
5AC600.UPSI-00	Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
5AC600.UPSI-00	Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. H0), 5PC600.S
5AC600.UPSI-00	Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. F0), 5PC600.S
5AC600.UPSI-00	Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. H0), 5PC600.S
5AC600.UPSI-00	Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SY05-01 (ab Rev. F0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen. Zubehör
5AC600.UPSI-00 5ACPCI.ETH1-01	Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Tabelle 47: 5PC810.SX02-00 - Order data

Schnittstellen

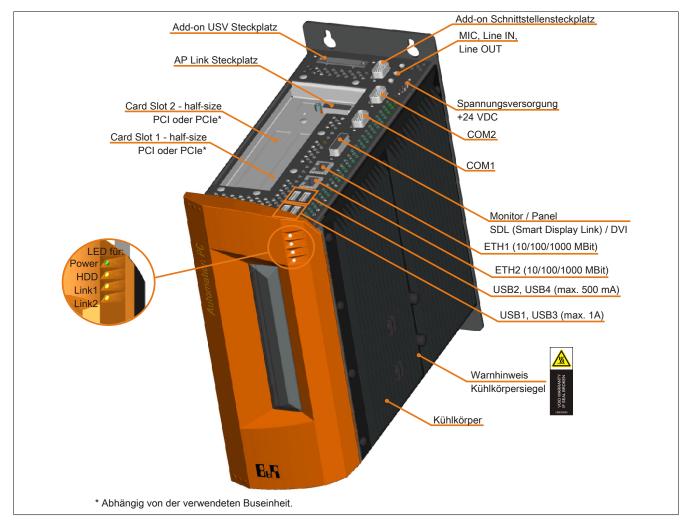


Abbildung 23: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Oberseite

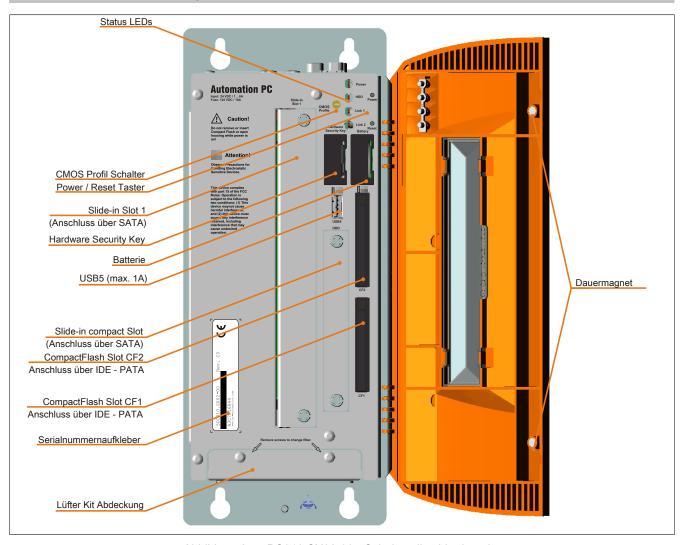


Abbildung 24: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX02-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit 1)
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	\$A3C7
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre ²⁾
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttüre zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja
ATEX Zone 22	Ja
GL	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX 3)
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX02-00
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher	
Тур	abhängig vom verwendeten CPU Board
Größe	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
COM2	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Anzahl	1
Тур	Тур І
CompactFlash Slot 2	
Anzahl	1
Тур	Тур І
USB	
Anzahl	5
Тур	USB 2.0
Ausführung	Тур А
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	
Anzahl	2
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate	1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle	
Ausführung	DVI-I Buchse
Тур	SDL/DVI/Monitor
CAN	
Anmerkung	optional
Audio	
Тур	AC97 Sound 4)
Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz	
Anzahl	1
Einschübe	
PCI / PCIe Slots	
Anzahl	2 PCI Slots oder 1 PCI und 1PCIe Slot 5)
Slide-in Laufwerke	1
Slide-in compact Laufwerke	1
Automation Panel Link Slot	Ja
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	6 A
Einschaltstrom	typ. 7 A, max. 50 A für < 300 μs
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	IDAA
Schutzart nach EN 60529	IP20
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	komponentenabhängig
Transport	komponentenabhängig
Vibration 6)	
5	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (dauerhaft)	
Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX02-00
Schock 6)	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) 7)
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse 8)	
Material	verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen	
Breite	120,8 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02
	136 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01
Höhe	270 mm
Tiefe	254,6 mm
Gewicht	ca. 2800 g (komponentenabhängig)

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

- 1) Beim APC810 GM45 ist ein Lüfter Kit zwingend erforderlich.
- 2) Bei 50° C, 8,5 μ A der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
- 3) Maintenance Controller Extended
- 4) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstützt.
- 5) Die PCI Slots und PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX02-00 und 5PC810.BX02-01.
- 6) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
- 7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.
- 8) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Abmessungen

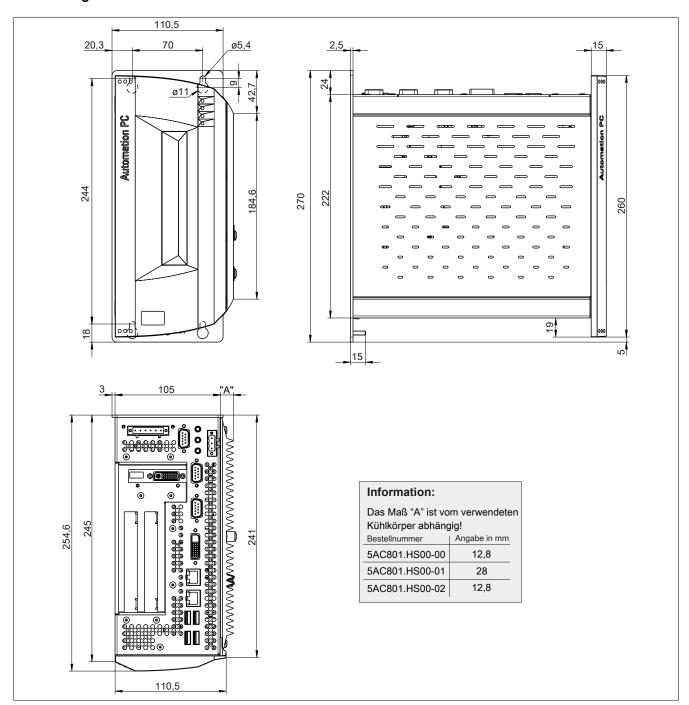


Abbildung 25: 5PC810.SX02-00 - Abmessungen

Bohrschablone

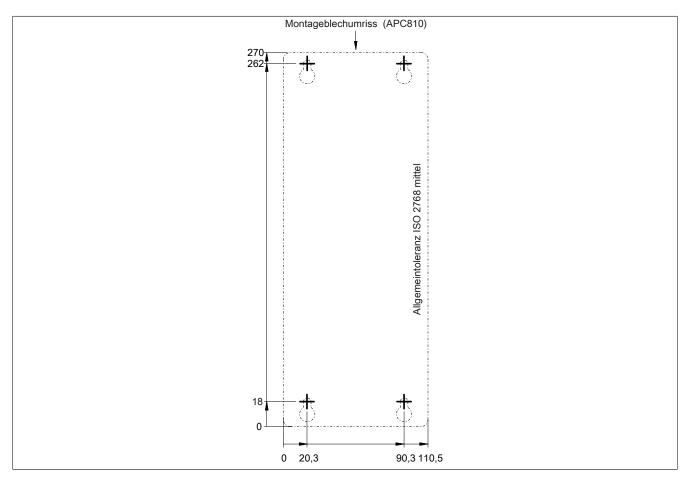


Abbildung 26: 5PC810.SX02-00 - Bohrschablone

3.1.3 5PC810.SX03-00

Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 2 PCI und 1 PCIe Slot
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk
- Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL

Bestelldaten

Model number	Short description
	Systemeinheiten
5PC810.SX03-00	APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen) Erforderliches Zubehör
	Buseinheiten
5PC810.BX03-00	APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)
31 CO10.BX03-00	CPU Boards
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
	Feldklemmen
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
0TB103.91	mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
51 11 1DDD 05 10 01	Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR 2049 01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 Kühlkörper
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.
	Optionales Zubehör
54 0004 BB\/T ==	Automation Panel Link Steckkarten
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
	Hard Disk in einem Slide-in Slot.
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 49: 5PC810.SX03-00 - Order data

Model number	Short description
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
	Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
	tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
	das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
	Lüfter Kit
5PC810.FA03-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.
	Serialadapter
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinhei-
	ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
	G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
	A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
	(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
	(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
	Zubehör
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 49: 5PC810.SX03-00 - Order data

Schnittstellen

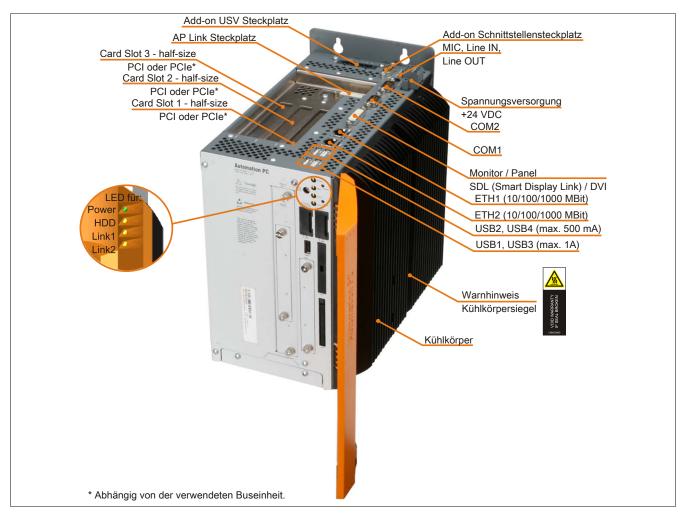


Abbildung 27: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Oberseite

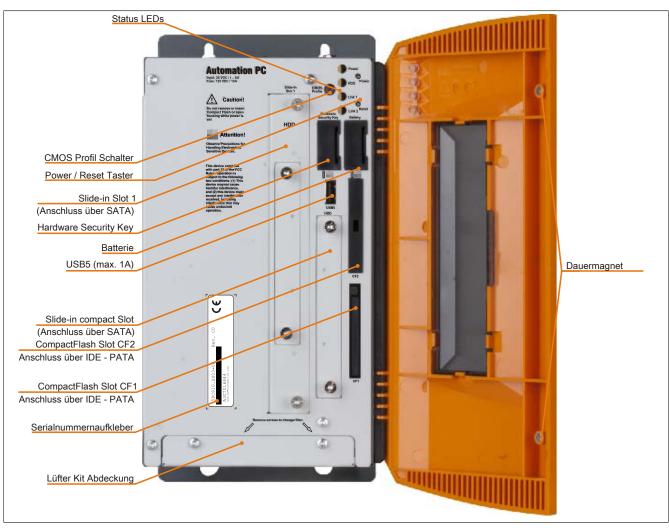


Abbildung 28: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX03-00				
Allgemeines					
Donglehalter	Ja				
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit 1)				
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2				
B&R ID-Code	\$B2C3				
Batterie					
Тур	Renata 950 mAh				
Lebensdauer	2½ Jahre 2)				
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttüre zugänglich				
Ausführung	Lithium Ionen				
Power Taster	Ja				
Reset Taster	Ja				
Summer	Ja				
Zertifizierungen					
CE	Ja				
cULus	Ja				
Controller					
Boot-Loader	BIOS				
Echtzeituhr					
batteriegepuffert	Ja				
Power Fail Logik					
Controller	MTCX 3)				
Pufferzeit	10 ms				
Grafik					
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board				
SRAM					
Größe 512 kByte					
batteriegepuffert	Ja				
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)				

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX03-00
Speicher	
Тур	abhängig vom verwendeten CPU Board
Größe	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
COM2	DOOGO mandamii minht ankaniank antanat
Typ Ausführung	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt 9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Anzahl	1
Тур	Тур І
CompactFlash Slot 2	
Anzahl	1
Тур	Тур І
USB	_
Anzahl	5
Typ	USB 2.0
Ausführung Übertragungsrate	Typ A Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	jo valoonidos max. ooo max ozw. 174
Anzahl	2
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate	1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle	
Ausführung	DVI-I Buchse
Тур	SDL/DVI/Monitor
CAN	
Anmerkung	optional
Audio	AC97 Sound 4)
Typ Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz	
Anzahl	1
Einschübe	
PCI / PCIe Slots	
Anzahl	2 PCI und 1PCIe Slot 5)
Slide-in Laufwerke	1
Slide-in compact Laufwerke	1
Automation Panel Link Slot	Ja
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	04.400 -0504
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom Einschaltstrom	6 A
Einschaltstrom Galvanische Trennung	typ. 7 A, max. 50 A für < 300 μs
Galvanische Trennung Einsatzbedingungen	Ja
Schutzart nach EN 60529	IP20
Umgebungsbedingungen	II ZU
Temperatur	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	komponentenabhängig
Transport	komponentenabhängig
Vibration 6)	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport Schock 6)	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Halispoit	

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC810.SX03-00			
Meereshöhe			
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) 7)		
Mechanische Eigenschaften			
Gehäuse 8)			
Material	verzinktes Blech, Kunststoff		
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)		
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)		
Abmessungen			
Breite	140,8 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02		
	156,5 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01		
Höhe	270 mm		
Tiefe	254,6 mm		
Gewicht	ca. 3200 g (komponentenabhängig)		

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

- Beim APC810 GM45 ist ein Lüfter Kit zwingend erforderlich.
- 2) Bei 50°C, 8,5 μA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
- 3) 4) 5) Maintenance Controller Extended
- Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstützt.
- Es kann die Buseinheit 5PC810.BX03-00 mit 2 PCI und 1 PCIe Slot verwendet werden.
- Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
- Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.
- Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Abmessungen

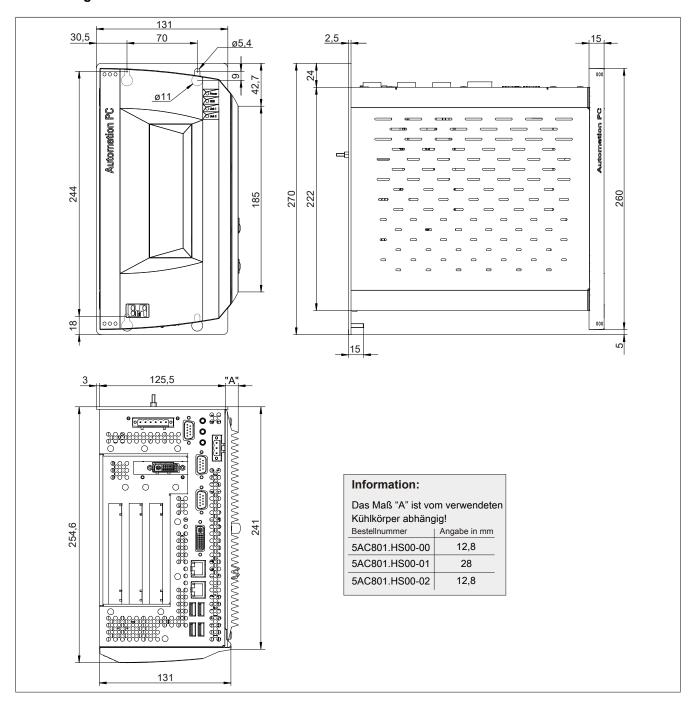


Abbildung 29: 5PC810.SX03-00 - Abmessungen

Bohrschablone

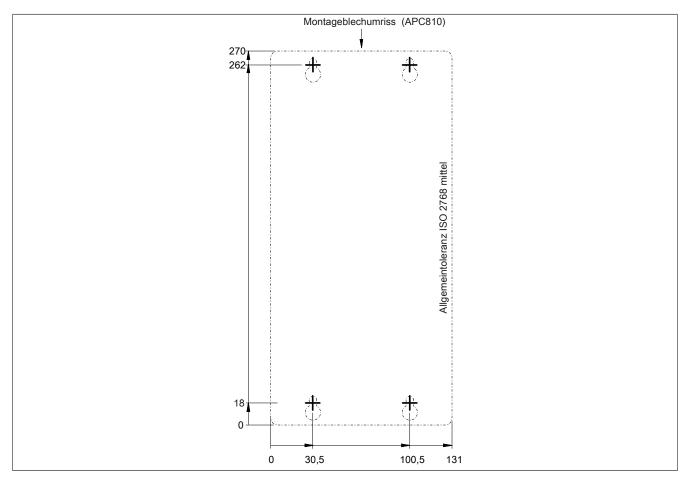


Abbildung 30: 5PC810.SX03-00 - Bohrschablone

3.1.4 5PC810.SX05-00

Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 4 PCI und 1 PCIe Slot oder 2 PCI und 3 PCIe Slots oder 5 PCI Slots
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 2 Slide-in Laufwerke
- Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL

Bestelldaten

Model number	Short description	Figure
	Systemeinheiten	
5PC810.SX05-00	APC810 Systemeinheit 5 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 2 Slide-in Steckplätze; Smart Display Link/ DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	e e
5D0040 DV05 00	Buseinheiten	
5PC810.BX05-00	APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)	
5PC810.BX05-01 5PC810.BX05-02	APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1) APC810 Bus, 5 PCI	e
JF C010.DX03-02	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	E.N
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
EMMDDD 0540 04	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01 5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Optionales Zubehör	
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	

Tabelle 51: 5PC810.SX05-00 - Order data

Model number	Short description
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
	mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
	Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
	tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
	das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
	Lüfter Kit
5PC810.FA05-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX05-00.
	Serialadapter
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinhei-
	ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
	G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
	A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
	(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
	(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
	Zubehör
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 51: 5PC810.SX05-00 - Order data

Schnittstellen

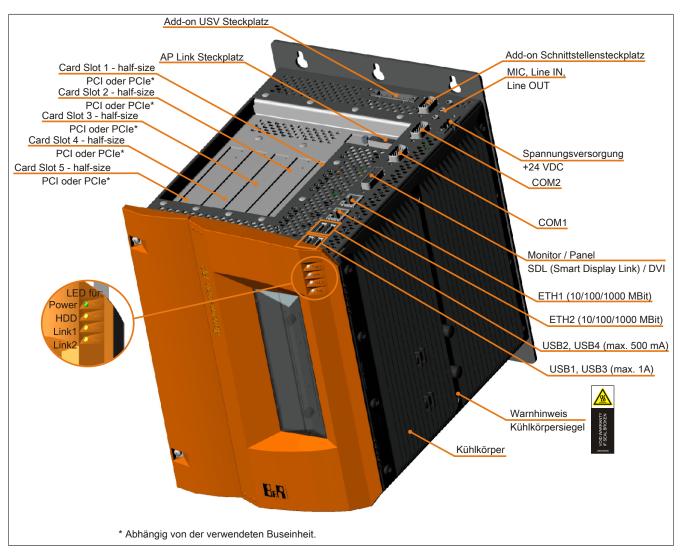


Abbildung 31: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Oberseite

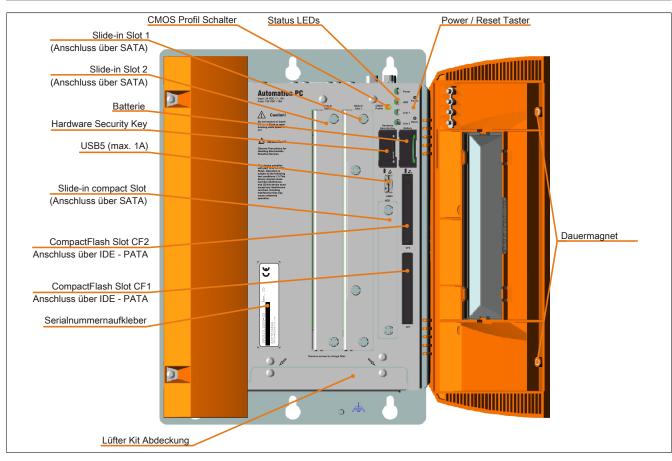


Abbildung 32: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX05-00				
Allgemeines					
Donglehalter	Ja				
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit 1)				
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2				
B&R ID-Code	\$A3EE				
Batterie					
Тур	Renata 950 mAh				
Lebensdauer	2½ Jahre ²⁾				
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttüre zugänglich				
Ausführung	Lithium Ionen				
Power Taster	Ja				
Reset Taster	Ja				
Summer	Ja				
Zertifizierungen					
CE	Ja				
cULus	Ja				
Controller					
Boot-Loader	BIOS				
Echtzeituhr					
batteriegepuffert	Ja				
Power Fail Logik					
Controller	MTCX 3)				
Pufferzeit	10 ms				
Grafik					
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board				
SRAM					
Größe	512 kByte				
batteriegepuffert	Ja				
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)				
Speicher					
Тур	abhängig vom verwendeten CPU Board				
Größe	abhängig vom verwendeten CPU Board				

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

Schmitstellen	Produktbezeichnung	5PC810.SX05-00			
Type	Schnittstellen				
Assidization	COM1				
MART	Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt			
max. Baudrate CDM2 Typ Assistance Typ Assistance Typ Typ: Typ: Typ: Typ: Typ: Typ: Typ:	Ausführung	9-poliger DSUB Stecker			
Ris232, modernfahig, nicht galvansch gehennt Austhrung Ris232, modernfahig, nicht galvansch gehennt Austhrung Speliger DSUB Stecker SUB Stecker	UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO			
Type	max. Baudrate	115 kBit/s			
Ausbithung	COM2				
MART	Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt			
max. Baudrate	Ausführung	9-poliger DSUB Stecker			
CompactFlash Slot 1	UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO			
Anzahl	max. Baudrate	115 kBit/s			
Typ Typ	CompactFlash Slot 1				
Compact Select	Anzahl	1			
Anzahl 1 Typ Typ	Тур	Тур І			
Typ	CompactFlash Slot 2				
USB	Anzahl	1			
Anzahi 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Тур	Тур І			
Typ	USB				
Austhburng					
Dobrtgagnigstate Low Speed (1.5 MBIts), Full Speed (480 MBIts) is High Speed (480 MBIts)	= :				
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A					
Climent					
Austifuturing Unertragungsrate max Baudrate 10H00/1000 MBits max Baudrate 10H00/1000 MBits max Baudrate 10H00/1000 MBits 1 GBMs 1 GBMs Panel Monitor Schnittstelle Ausführung Typ DVH Buchse SDL/DVIMonitor CAN Anmerkung Optional Audrid Typ AC97 Sound ¹⁰ Eingänge ALine Out Add-on Schnittstellensteckplatz Anzahl 1 Einschübe FOLI PCIe Stots Anzahl 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 2 PCI und 3 PCIe Stots oder 5 PCI Stots Anzahl 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIe Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIE Stots oder 5 PCI Stots 4 PCI und 1 PCIE Stots oder 5 PCI Stots 5 P		je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A			
Ausführung	Ethernet				
Debrit agungarate 10/100/1000 MBit/s max. Baudrate 1 GBit/s	1				
max. Baudrate 1 GBit/s Panel Montor Schritstelle DVI-I Buchse Typ SDL/DVI/Monitor CAN		-			
Panel Monitor Schnittstelle					
Austhung		1 GBit/s			
SDL/DV/Monitor	!	DV/I I Durchas			
Anmerkung	1				
Amerkung Audio Typ AC97 Sound " Eingänge Alkikrofon, Line in Lasgänge Line Out Add-on Schnittstellensteckplatz Anzahl 1 Einschübe PC17 PCle Siots Anzahl 4 PCl und 1 PCle Siots oder 2 PCl und 3 PCle Siots oder 5 PCl Siots of Siots oder 5 PCl Siots of Siots oder 5 PCl Siots of Siots oder 1 Automation Panel Link Siot Add-on USV Steckplatz Ja Bilde-in compact Laufwerke 1 1 Automation Panel Link Siot Add-on USV Steckplatz Ja Einschub für Laufker Kit Ja Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom Einschub für Laufker Kit Ja Elektrische Eigenschaften Nenspannung 3 24 VDC ±25% Nennstrom Einschub für Lenk Siot Add-on USV Steckplatz Ja Einstelbedingungen Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Einsatzbedingungen Einsatzbedingungen Fernperatur Betrieb Lagerung Transport Lagerung Transport Lagerung Transport Solinger Siot Her Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0.5 g Betrieb (dauerhaft) Betrieb (2 bis 9 Hz: 7,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock " Betrieb Eetrieb Lagerung Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock " Betrieb Eetrieb		SDL/DVI/MOTILOI			
Audio Auging		antional			
Typ		optional			
Eingange Ausgange Aufd-on Schnitstellensteckplatz Anzahl Einschübe PCI / PCIe Slots Anzahl PCI PCIe Slots oder 2 PCI und 1 PCIe Slots oder 2 PCI und 3 PCIe Slots oder 3 PCI slots oder 2 PCI und 3 PCIe Slots oder 2 PCI und 3 PCIe Slots oder 3 PCI slots oder 3 PCI slots oder 4 PCI und 1 PCIe Slots oder 5 PCI Slots oder 5 PCI Slots oder 2 PCI und 3 PCIe Slots oder 5 PCI Slots o		AC07 Sound 4)			
Automatic Aut	= :				
Add-on Schnittstellensteckplatz Anzahl Einschübe PCI / PCIs Slots Anzahl Applications Anzahl Anzahl Anzahl Applications Anzahl Anzahl Anzahl Applications Anzahl Anzahl Anzahl Applications Anzahl Anzahl Anzahl Applications Anzahl Anzahl Applications Anzahl Anzahl Applications Applications Anzahl Applications Anzahl Applications Applications Anzahl Applications Ap	1	·			
Anzahl		Lille Out			
PCI / PCIs Slots	·	1			
PCI / PCIe Slots Anzahl 4 PCI und 1 PCIe Slots oder 2 PCI und 3 PCIe Slots oder 5 PCI Slots ** Slide-in Laufwerke 2 Slide-in compact Laufwerke 1 Automation Panel Link Slot Add-on USV Steckplatz Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Einschaltsrom 6 A Einschaltstrom 7 A, max. 50 A für < 300 µs Galvanische Trennung Ja Einsatzbedingungen Schutzart nach EN 60529 IP20 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung 2-20 bis 60°C Luffleuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport Lagerung Transport Vibration ** Eschieb (dauerhaft) Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ** Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb (3 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport Discher Michael And Betrieb Bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ** Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb (3 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ** Betrieb Betrieb Size Officer Size Size Officer Size Size Officer Size Size Officer S		'			
Anzahl					
Series S		4 PCI und 1 PCIe Slots oder			
Slide-in Laufwerke 2 Slide-in Compact Laufwerke 1 Automation Panel Link Slot 3 Add-on USV Steckplatz 3 Einschub für Lüfter Kit 3 Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom 6 Einschaltstrom 6 Einschaltstrom 7 Einschaltstrom 9 Einsatzbedingungen 8 Einstatzbedingungen 9 Einsatzbedingungen 9 Einsatzbedingung					
Silde-in compact Laufwerke		5 PCI Slots 5)			
Automation Panel Link Slot Add-on USV Steckplatz Einschub für Lüfter Kit Eilektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom 86 A Einschaltstrom 87 A, max. 50 A für < 300 µs Galvanische Trennung Ja Einsatzbedingungen Schutzart nach EN 60529 Ungebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung -20 bis 60°C Transport Lufffeuchtigkeit Betrieb Lagerung Akomponentenabhängig Lagerung Transport Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Lagerung Seltrieb Se	Slide-in Laufwerke	2			
Add-on USV Steckplatz Ja Einschub für Lüfter Kit Ja Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom 6 A Einschallstrom (byp. 7 A, max. 50 A für < 300 μs Galvanische Trennung Einsatzbedingungen Schotzart nach EN 60529 IP20 Umgebungsbedingungen Betrieb komponentenabhängig Lagerung 20 bis 60°C Transport 20 bis 60°C Luffeuchtigkeit Betrieb komponentenabhängig komponentenabhängig Lagerung 20 bis 60°C Luffeuchtigkeit Betrieb komponentenabhängig Lagerung 30 komponentenabhängig Lagerung 40 komponentenabhängig Lagerung 50 komponentenabhängig Lagerung 60 komponentenabhängig Lagerung 70 komponentenabhängig Vibration 60 Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock 60 Betrieb Lagerung 15 g, 11 ms Lagerung 15 g, 11 ms Lagerung 15 g, 11 ms Lagerung 15 g, 15 ms	Slide-in compact Laufwerke	1			
Einschub für Lüfter Kit Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom 6 A Einschaltstrom 70 A max. 50 A für < 300 µs Galvanische Trennung Einsatzbedingungen Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport Betrieb Lagerung Transport Schotzart nach EN 60529 Lagerung Transport Lagerung Transport Schotzart nach EN 60529 Lagerung Transport Lagerung Transport Schotzart nach EN 60520 Lagerung Transport Lagerung Transport Schotzart nach EN 60529 Lagerung Transport Schotzart nach EN 60529 Lagerung Transport Schotzart nach EN 60529 Lagerung Schotzart nach EN	Automation Panel Link Slot	Ja			
Semble Semble	Add-on USV Steckplatz	Ja			
Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom 6 A Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A für < 300 μs Galvanische Trennung Ja Einsatzbedingungen Schutzart nach EN 60529 IP20 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb komponentenabhängig Lagerung -20 bis 60°C Luffteuchtigkeit Betrieb komponentenabhängig Lagerung komponentenabhängig Lagerung komponentenabhängig Transport komponentenabhängig Lagerung komponentenabhängig Transport tybration Betrieb lagerung komponentenabhängig Transport tybration Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (gelegentlich) 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock solution Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms Lagerung	Einschub für Lüfter Kit	Ja			
Nennstrom September Sep	Elektrische Eigenschaften				
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A für < 300 μs Galvanische Trennung Einsatzbedingungen Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Lagerung Lagerung Betrieb Lagerung Lagerung Lagerung Betrieb Lagerung Transport Vibration ⁶⁾ Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Lagerung Lager	Nennspannung	24 VDC ±25%			
Galvanische Trennung Einsatzbedingungen Schutzart nach EN 60529 Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb Lagerung Transport Lagerung Transport Schock 6) Betrieb Lagerung Lagerung Betrieb (dauerhaft) Lagerung Lagerung Lagerung Lagerung Lagerung Lagerung Lagerung Betrieb (dauerhaft) Lagerung Lagerung Lagerung Lagerung Lagerung Betrieb (gelegentlich) Lagerung	Nennstrom	6 A			
Einsatzbedingungen IP20 Umgebungsbedingungen IP20 Temperatur Betrieb komponentenabhängig Lagerung -20 bis 60°C Transport -20 bis 60°C Luftfeuchtigkeit komponentenabhängig Betrieb komponentenabhängig Lagerung komponentenabhängig Transport komponentenabhängig Vibration ⁶⁾ 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ⁶⁾ Betrieb Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms	Einschaltstrom	typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs			
Schutzart nach EN 60529 IP20	Galvanische Trennung	Ja			
Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb	Einsatzbedingungen				
Temperatur Betrieb komponentenabhängig Lagerung -20 bis 60°C Transport -20 bis 60°C Luftfeuchtigkeit Betrieb komponentenabhängig Lagerung komponentenabhängig Lagerung komponentenabhängig Transport komponentenabhängig Transport bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock 6) Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms	Schutzart nach EN 60529	IP20			
Betrieb komponentenabhängig Lagerung -20 bis 60°C Transport -20 bis 60°C Luftfeuchtigkeit komponentenabhängig Betrieb komponentenabhängig Lagerung komponentenabhängig Transport komponentenabhängig Vibration 6) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock 6) 15 g, 11 ms Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms	Umgebungsbedingungen				
Lagerung -20 bis 60°C Transport -20 bis 60°C Luftfeuchtigkeit komponentenabhängig Betrieb komponentenabhängig Lagerung komponentenabhängig Transport komponentenabhängig Vibration ® 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ® Betrieb Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms	Temperatur				
Transport Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport Vibration © Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Lagerung Betrieb (spelegentlich) Lagerung Transport Lagerung Transport Lagerung Transport Lagerung Transport Schock © Betrieb Lagerung Betrieb (spelegentlich) Lagerung Transport Schock © Betrieb Lagerung Betrieb Lagerung Schock © Betrieb Lagerung Betrieb Lagerung Schock Schock © Betrieb Lagerung Betrieb Lagerung Schock Sc	Betrieb	·			
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport Vibration ⁶⁾ Betrieb (dauerhaft) Lagerung Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (gelegentlich) Lagerung Lagerung Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung Lager					
Betrieb komponentenabhängig Lagerung komponentenabhängig Transport komponentenabhängig Vibration 6) Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock 6) Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms		-20 bis 60°C			
Lagerung komponentenabhängig Transport komponentenabhängig Vibration 6) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock 6) 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms	Luftfeuchtigkeit				
Transport komponentenabhängig Vibration ®) Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ®) Betrieb Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms	!				
Vibration 6) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock 6) 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms					
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ⁶⁾ 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms		komponentenabhängig			
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ⁶⁾ 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms	Vibration 6)				
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ⁶⁾ Betrieb Lagerung 15 g, 11 ms 30 g, 15 ms					
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g Schock ⁶⁾ Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms		, ,			
Schock ⁶⁾ 15 g, 11 ms Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms					
Betrieb 15 g, 11 ms Lagerung 30 g, 15 ms		2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g			
Lagerung 30 g, 15 ms	Schock 6)				
Transport 30 g, 15 ms					
	ıransport	30 g, 15 ms			

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX05-00			
Meereshöhe				
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) 7)			
Mechanische Eigenschaften				
Gehäuse 8)				
Material	verzinktes Blech, Kunststoff			
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)			
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)			
Abmessungen				
Breite	201,7 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02			
	216,9 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01			
Höhe	270 mm			
Tiefe	254,5 mm			
Gewicht ca. 3900 g (komponentenabhängig)				

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

- 1) Beim APC810 GM45 ist ein Lüfter Kit zwingend erforderlich.
- 2) Bei 50°C, 8,5 μA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
- 3) 4) Maintenance Controller Extended
- Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstützt.
- 5) Die PCI Slots und PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und 5PC810.BX05-02.
- Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
- Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN. 7)
- Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Abmessungen

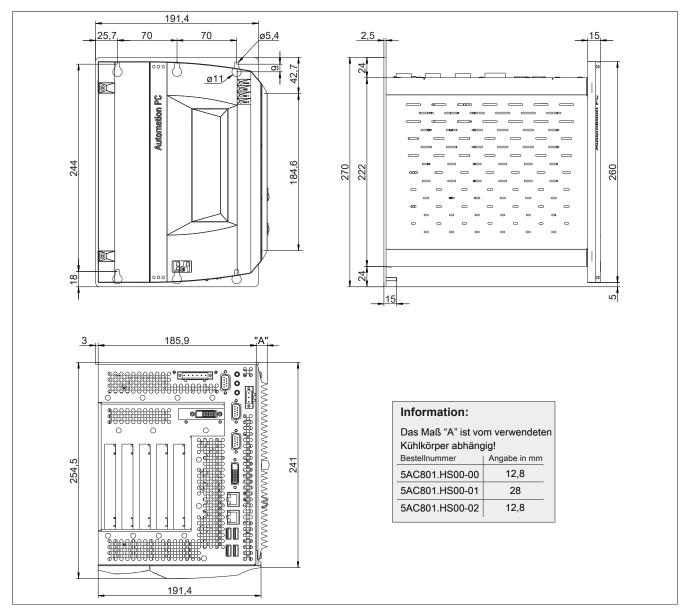


Abbildung 33: 5PC810.SX05-00 - Abmessungen

Bohrschablone

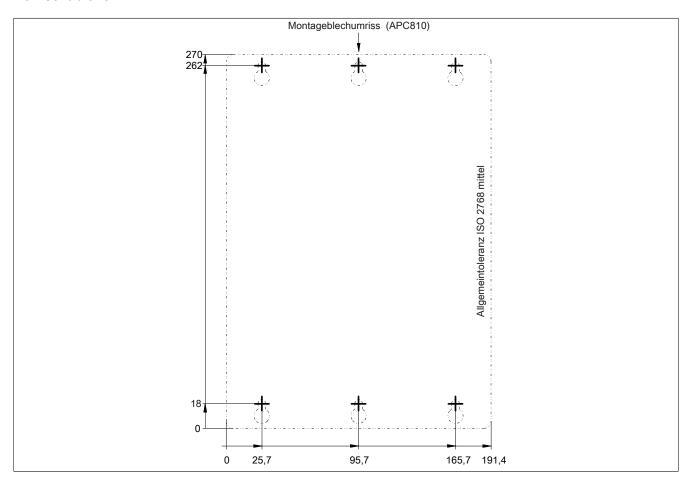


Abbildung 34: 5PC810.SX05-00 - Bohrschablone

3.2 Buseinheiten

3.2.1 Allgemeines

Die Buseinheiten sind passend zu den Systemeinheiten in 1, 2, 3 bzw. 5 Card Slot Größen mit PCI und / oder PCI Express Unterstützung erhältlich.

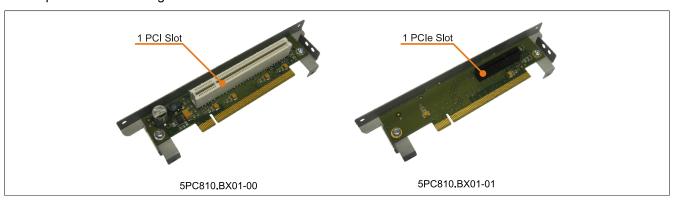


Abbildung 35: 1 Slot Buseinheiten

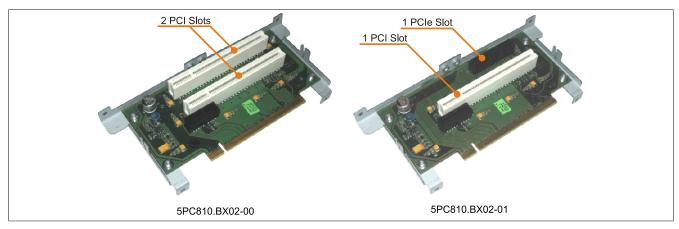


Abbildung 36: 2 Slot Buseinheiten

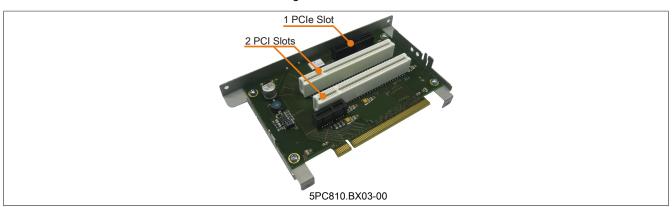


Abbildung 37: 3 Slot Buseinheit

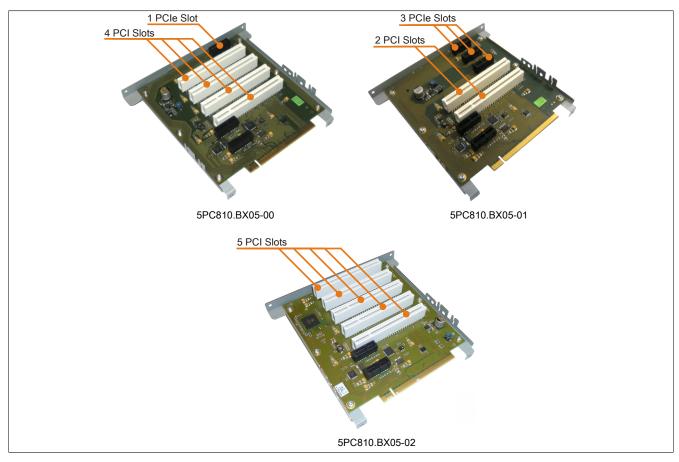


Abbildung 38: 5 Slot Buseinheiten

3.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Buseinheiten	
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	SET EXX. BIX. BIX. BIX. CO. XI.
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	A CONTROL OF THE PARTY OF THE P
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	
5PC810.BX03-00	APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)	
5PC810.BX05-00	APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)	
5PC810.BX05-01	APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)	
5PC810.BX05-02	APC810 Bus, 5 PCI	

Tabelle 53: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Bestelldaten

3.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810. BX01-00	5PC810. BX01-01	5PC810. BX02-00	5PC810. BX02-01	5PC810. BX03-00	5PC810. BX05-00	5PC810. BX05-01	5PC810. BX05-02
Allgemeines								
Zertifizierungen					-			
CE				J	la			
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja	-	Ja	-	-	-	-	-
ATEX Zone 22	Ja	-	Ja	-	-	-	-	-
GL	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Einschübe								
PCIe Slots		-						
Anzahl	-	1	-	1	1	1	3	-
Ausführung	-	PCle	-	PCle	PCle	PCle	PCle	-
		half-size		half-size	half-size	half-size	half-size	
Standard	-	1.0a	-	1.0a	1.0a	1.0a	1.0a	-
Bus Speed	-	x4 (10	-	x4 (10	x4 (10	x1 (2,5	x1 (2,5	-
		GByte/s)		GByte/s)	GByte/s)	GByte/s)	GByte/s)	

Tabelle 54: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.	5PC810.	5PC810.	5PC810.	5PC810.	5PC810.	5PC810.	5PC810.
	BX01-00	BX01-01	BX02-00	BX02-01	BX03-00	BX05-00	BX05-01	BX05-02
PCI Slots								
Anzahl	1 1	-	2	1	2	4	2	5
Тур	32 Bit	-	32 Bit					
Ausführung	PCI half-size	-	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size
Standard	2.2 1)	-	2.2 1)	2.2 1)	2.2 1)	2.2 1)	2.2 1)	2.2 1)
Bus Speed	33 MHz	-	33 MHz					
PCI to PCI Bridge	-	-	-	-	-	-	-	Ja, Slot
								4 und 5

Tabelle 54: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten

Aufgrund mechanischer Einschränkungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card Slot gesteckt werden. Eine Tabelle im Anwenderhandbuch gibt eine Übersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit Karten möglich ist.

3.3 CPU Boards 945GME

3.3.1 Allgemeines

- AMI BIOS
- Intel® 945GME Chipsatz
- 2x DDR2 Speichersockel
- Dual Channel Memory
- Intel® GMA 950
- · Gigabit Ethernet

3.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU Boards	
5PC800.B945-00	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-01	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-02	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-03	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 55: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung		Abbildung
	CPU Boards	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 56: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Bestelldaten

3.3.3 Technische Daten 5PC800.B945-0x

Produktbezeichnung	5PC800.B945-00	5PC800.B945-01	5PC800.B945-02	5PC800.B945-03	5PC800.B945-04	5PC800.B945-05			
Allgemeines									
Zertifizierungen		_							
CE	Ja								
cULus	-	-	-	-	-	Ja			
GL	-	-	-	-	-	Ja			
Controller									
Boot-Loader		embedded AMI BIOS							
Prozessor									
Тур	Intel® Core™	Intel® Core™2	Intel® Core™2	Intel® Cele-	Intel® Core™2	Intel®			
	Duo L2400	Duo L7400	Duo U7500	ron® M 423	Duo T7400	Atom™ N270			
Taktfrequenz	1660 MHz	1500 MHz	1060 MHz	1060 MHz	2160 MHz	1660 MHz			
Anzahl der Kerne	2	2	2	1	2	1			
Architektur	65 nm	65 nm	65 nm	65 nm	65 nm	45 nm			
L1 Cache	32 kByte	32 kByte	32 kByte	32 kByte	32 kByte	24 kByte			
L2 Cache	2 MByte	4 MByte	2 MByte	1 MByte	4 MByte	512 kByte			
Externer Bus	667 MHz	667 MHz	533 MHz	533 MHz	667 MHz	533 MHz			
Intel® 64 Architecture	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein			
Intel® Virtualization Technology	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein			
(VT-x)									
Enhanced Intel SpeedStep® Tech-	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja			
nology									
Chipsatz			Intel® 9						
			Intel® 82801 GF	HM (ICH7M-DH)					
Echtzeituhr									
Genauigkeit	bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag								
batteriegepuffert		-	J	a					
Speichersockel									
Тур	DDR2								
Größe	max. 3 GByte								
Grafik									
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 950								
Speicher	bis zu 224 MByte 1)								
Farbtiefe	max. 32 Bit								
Auflösung									
DVI	2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080								
RGB	400 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)								
Massenspeicherverwaltung	2x SATA, 1x IDE								
Power Management	ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)								

Tabelle 57: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Technische Daten

3.3.4 Technische Daten 5PC800.B945-1x

Produktbezeichnung	5PC800.B945-10	5PC800.B945-11	5PC800.B945-12	5PC800.B945-13	5PC800.B945-14			
Allgemeines								
Zertifizierungen								
CE		Ja						
cULus			Ja					
Controller								
Boot-Loader		_	embedded AMI BIOS					
Prozessor								
Тур	Intel® Core™	Intel® Core™2	Intel® Core™2	Intel® Cele-	Intel® Core™2			
	Duo L2400	Duo L7400	Duo U7500	ron® M 423	Duo T7400			
Taktfrequenz	1660 MHz	1500 MHz	1060 MHz	1060 MHz	2160 MHz			
Anzahl der Kerne	2	2	2	1	2			
Architektur	65 nm							
L1 Cache			32 kByte					
L2 Cache	2 MByte	4 MByte	2 MByte	1 MByte	4 MByte			
Externer Bus	667 MHz	667 MHz	533 MHz	533 MHz	667 MHz			
Intel® 64 Architecture	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja			
Intel® Virtualization Technology	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja			
(VT-x)								
Enhanced Intel SpeedStep® Tech-	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja			
nology								
Chipsatz	Intel® 945GME							
	Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)							
Echtzeituhr								
Genauigkeit	bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag							
batteriegepuffert	Ja							

Tabelle 58: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten

¹⁾ Wird im Hauptspeicher allokiert.

Produktbezeichnung	5PC800.B945-10	5PC800.B945-11	5PC800.B945-12	5PC800.B945-13	5PC800.B945-14				
Speichersockel									
Тур		DDR2							
Größe			max. 3 GByte						
Grafik									
Controller		Intel®	Graphics Media Accelera	ator 950					
Speicher		bis zu 224 MByte ¹)							
Farbtiefe		max. 32 Bit							
Auflösung									
DVI		2x Intel co	ompliant SDVO Ports, 19	920 x 1080					
RGB	400 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)								
Massenspeicherverwaltung		2x SATA, 1x IDE							
Power Management		ACPI 2.	0, S3 Support (suspend	to RAM)					

Tabelle 58: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten

¹⁾ Wird im Hauptspeicher allokiert.

3.4 Kühlkörper

3.4.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Kühlkörper
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.
	Erforderliches Zubehör
	CPU Boards
5PC800.B945-00	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-01	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-02	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-03	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Tabelle 59: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Bestelldaten

3.4.2 Technische Daten

Product ID	5AC801.HS00-00	5AC801.HS00-01	5AC801.HS00-02	
Allgemeines				
geeignet für CPU Boards	5PC800.B945-00 / -10	5PC800.B945-04 / -14	5PC800.B945-05	
	5PC800.B945-01 / -11			
	5PC800.B945-02 / -12			
	5PC800.B945-03 / -13			
Zertifizierungen				
CE Ja		Ja		
GL	-	-	Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	-	Ja	-	
ATEX Zone 22	-	Ja	-	
Mechanische Eigenschaften				
Material	Alumin	Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes		

Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Technical data

Technische Daten • Einzelkomponenten

Product ID	5AC801.HS00-00	5AC801.HS00-01	5AC801.HS00-02	
Abmessungen			-	
Breite		228,7 mm		
Höhe		218 mm		
Tiefe	12,8 mm	28 mm	12,8 mm	
Gewicht	ca. 1700 g	ca. 2000 q	ca. 1700 g	

Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Technical data

3.5 Hauptspeicher

3.5.1 Allgemeines

Diese 200-poligen DDR2 Hauptspeicher arbeiten mit einer Speichergeschwindigkeit von 677 MHz und sind mit einer Speichergröße von 512 MByte, 1 GByte und 2 GByte verfügbar.

Werden zwei gleich große (z.B. 1 GByte) Module gesteckt so wird die Dual-Channel Memory Technologie unterstützt. Werden zwei ungleich große (z.B. 1 GByte und 2 GByte) Module gesteckt, so wird diese Technologie nicht unterstützt

Werden zwei 2 GByte Module gesteckt, so sind nur 3 GByte Hauptspeicher verwendbar.

3.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung	
	Hauptspeicher		
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300		
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	The second secon	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	200	

Tabelle 61: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten

3.5.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMDDR.0512-01	5MMDDR.1024-01	5MMDDR.2048-01	
Allgemeines				
Тур		SO-DIMM DDR2 SDRAM		
Speichergröße	512 MByte	1 GByte	2 GByte	
Bauart		200 Pin		
Organisation	64M x 64 Bit	128M x 64 Bit	256M x 64 Bit	
Geschwindigkeit		DDR2-667 (PC2-5300)		
Zertifizierungen				
CE		Ja		
cULus		Ja		
GL		Ja		

Tabelle 62: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten

Information:

Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6 Laufwerke

3.6.1 5AC801.HDDI-00

Allgemeines

Diese 40 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 63: 5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Hard Disk	
Kapazität	40 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	78.140.160
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	750.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,6 ms
Datentransferrate	
intern	max. 450 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	12,5 ms
maximal (Lesezugriff)	23 ms

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-00	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur 2)		
Betrieb 3)	-30 bis 85°C	
Betrieb - 24 Stunden 4)	-30 bis 85°C	
Lagerung	-40 bis 95°C	
Transport	-40 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit 5)		
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Schock		
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
	150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 5000 m	
Lagerung	-300 bis 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Montage	fix 6)	
Abmessungen		
Breite	13 mm	
Höhe	98 mm	
Tiefe	105 mm	
Gewicht	134 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Seagate	
Herstellerbezeichnung	ST940817SM	

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
- 6) Montageweise auf Slide-in compact.

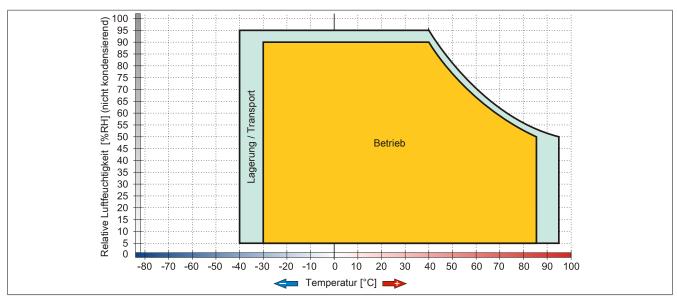


Abbildung 39: 5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.2 5AC801.HDDI-01

Allgemeines

Diese 80 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Undefined	
5AC801.HDDI-01	80 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 65: 5AC801.HDDI-01 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-01	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
Hard Disk		
Kapazität	80 GByte	
Anzahl der Köpfe	2	
Anzahl der Sektoren	156.301.488	
Bytes pro Sektor	512	
Cache	8 MByte	
Drehzahl	5400 rpm ±1%	
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)	
MTBF	750.000 POH ¹⁾	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Zugriffszeit	5,6 ms	
Datentransferrate		
intern	max. 450 MBits/s	
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)	
Positionierzeit		
minimal (Spur zu Spur)	1 ms	
nominal (Lesezugriff)	12,5 ms	
maximal (Lesezugriff)	23 ms	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur 2)		
Betrieb 3)	-30 bis 85°C	
Betrieb - 24 Stunden 4)	-30 bis 85°C	
Lagerung	-40 bis 95°C	
Transport	-40 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit 5)		
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-01	
Vibration		
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Schock		
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 5000 m	
Lagerung	-300 bis 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Montage	fix 6)	
Abmessungen		
Breite	13 mm	
Höhe	98 mm	
Tiefe	105 mm	
Gewicht	133 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Seagate	
Herstellerbezeichnung	ST980817SM	

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
- 6) Montageweise auf Slide-in compact.

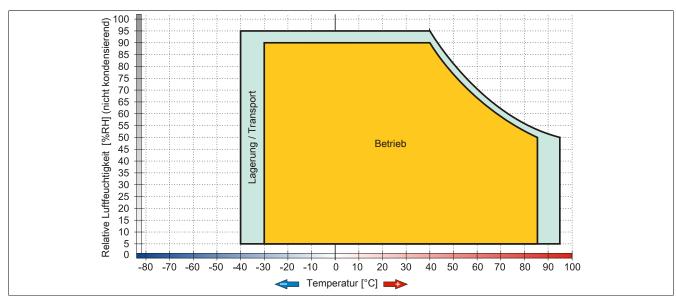


Abbildung 40: 5AC801.HDDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.3 5AC801.HDDI-02

Allgemeines

Diese 160 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	46
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-02
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
GL	Ja
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	300.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	12 ms
Datentransferrate	
intern	max. 84,6 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	12 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-02
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 2)	
Betrieb	-15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden 3)	-15 bis 80°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit 4)	
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend 5)
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend 6)
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend ⁶⁾
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 1 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschädigung
Schock	
Betrieb	325 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	900 g, 1 ms; keine Beschädigung
	120 g, 11 ms; keine Beschädigung
Transport	900 g, 1 ms; keine Beschädigung
	120 g, 11 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁷⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	135 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	MHY2160BH-ESW

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

- Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur. 1)
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
- 3) 4) 5) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
- Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
- Montageweise auf Slide-in compact.

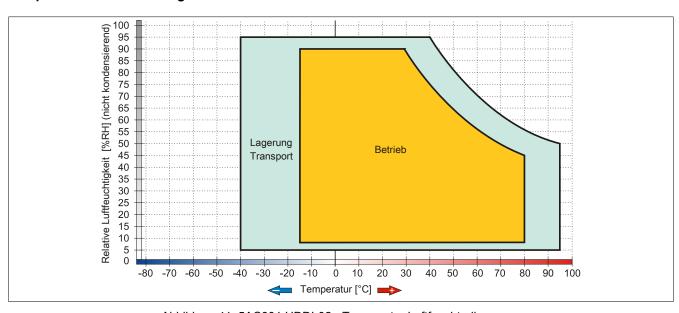


Abbildung 41: 5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.4 5AC801.HDDI-03

Allgemeines

Diese 250 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	W Seile
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	THE COLUMN TO SERVICE AND SERV

Tabelle 69: 5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-03
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja
ATEX Zone 22	Ja
GL	Ja
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	550.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
	PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferrate	
intern	max. 1175 MBit/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	14 ms
maximal (Lesezugriff)	30 ms

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-03
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾	
Betrieb 3)	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 4)	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 5)	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb	-300 bis 3048 m
	-300 bis 3046 iii
Lagerung Mechanische Eigenschaften	-300 DIS 12192 III
	fix ⁶⁾
Montage	IIX ⁰
Abmessungen	13 mm
Breite	98 mm
Höhe Tiefe	98 mm 105 mm
11010	11
Gewicht	134 g
Herstellerinformation	2
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
- 6) Montageweise auf Slide-in compact.

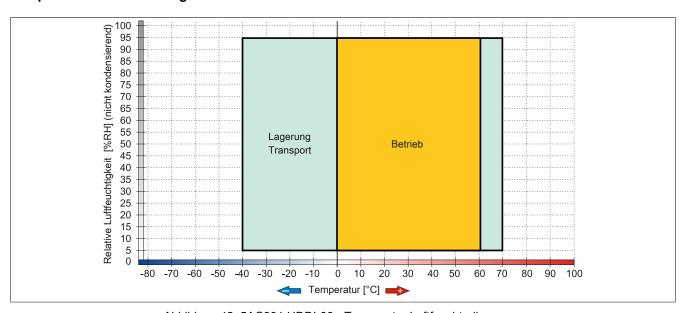


Abbildung 42: 5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.5 5AC801.HDDI-04

Allgemeines

Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

- 500 GByte Hard Disk
- · Slide-in compact
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.	
	Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Optionales Zubehör	30
	Laufwerke	
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04,	
	5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten	
	Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 71: 5AC801.HDDI-04 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-04
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Hard Disk	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,5 ms
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate	
intern	max. 147 MByte/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
nominal (Lesezugriff)	11 ms
maximal (Lesezugriff)	21 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾	
Betrieb 3)	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 4)	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C

Tabelle 72: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-04	
Luftfeuchtigkeit 5)		
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Schock		
Betrieb	400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Meereshöhe		
Betrieb	-305 bis 3048 m	
Lagerung	-305 bis 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Montage	fix ⁶⁾	
Abmessungen		
Breite	13 mm	
Höhe	98 mm	
Tiefe	105 mm	
Gewicht	134 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Western Digital	
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT	

Tabelle 72: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.
- 6) Montageweise auf Slide-in compact.

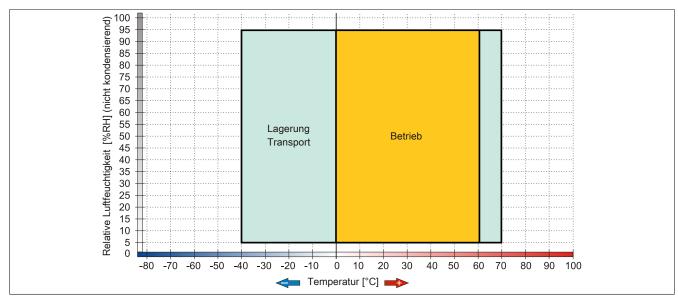


Abbildung 43: 5AC801.HDDI-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.6 5AC801.SSDI-00

Allgemeines

Dieses 32 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Single Level Cell (SLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

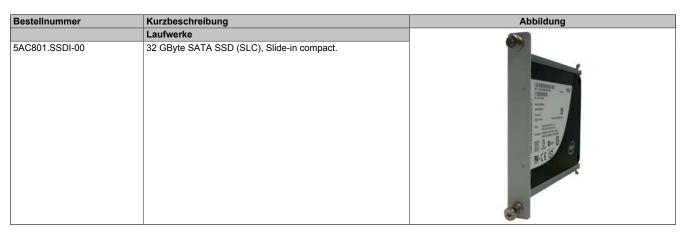


Tabelle 73: 5AC801.SSDI-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	32 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1015 Bit Lesezugriffen
MTBF	2.000.000 Stunden
Power On/Off Cycles	50.000
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 250 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 170 MByte/s

Tabelle 74: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-00
IOPS 1)	
4k lesen	35.000
4k schreiben	3.300
Endurance	
garantierte Datenmenge	
garantiert	700 TB
ergibt bei 5 Jahren	350 GByte/Tag
SLC-Flash	Ja
Wear Leveling	statisch
Error Correction Coding (ECC)	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 2.6 complient, kompatibel mit SATA 1,5 GBit/s und 3 GBit/s Interface Raten ATA/ATAPI-7 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	7 bis 800 Hz: 2,17 g
Lagerung	10 bis 500 Hz: 3,13 g
Transport	10 bis 500 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1000 g, 0,5 ms
Lagerung	1000 g, 0,5 ms
Transport	1000 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ²⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSA2SH032G1

Tabelle 74: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten

- IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 1) 2) Montageweise auf Slide-in compact.

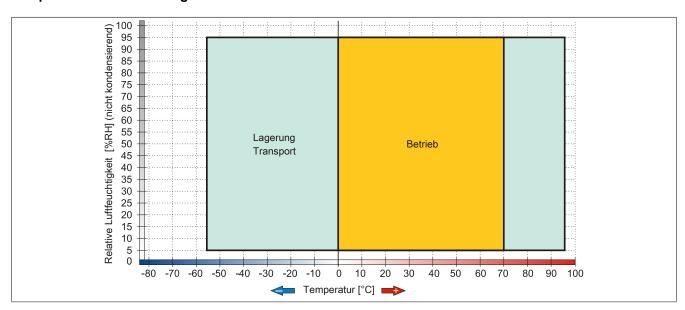


Abbildung 44: 5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Benchmark

Die nachfolgenden zwei Benchmarks zeigen einen Vergleich der Intel Solid State Drive (5AC801.SSDI-00) und der Seagate Hard Disk (5AC801.HDDI-00) beim zyklischen lesen bzw. schreiben.

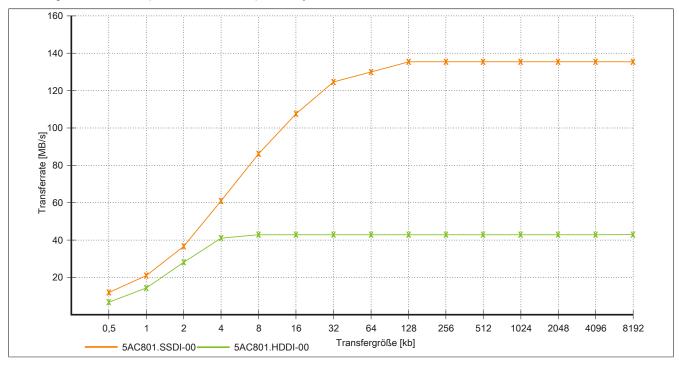


Abbildung 45: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen

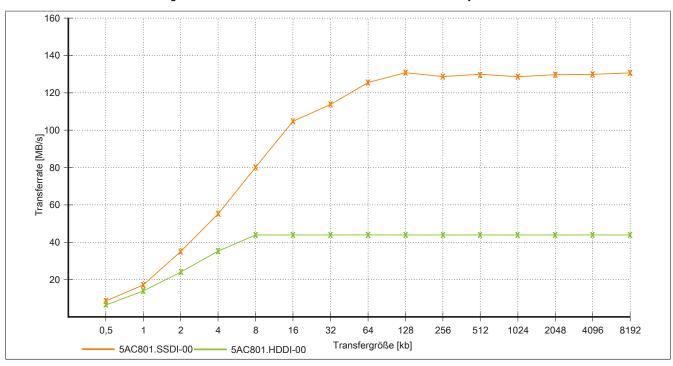


Abbildung 46: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben

3.6.7 5AC801.SSDI-01

Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	99
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-00	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	And And And And And And And And And And

Tabelle 75: 5AC801.SSDI-01 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-01
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

Tabelle 76: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-01
IOPS ¹⁾	
4k lesen	15.000
4k schreiben	
typisch	23.000
maximal	80.000
Endurance	
MLC-Flash	
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient
Tompationat	ACS-2
	SSD Enhanced SMART ATA feature set
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ²⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW060A3

Tabelle 76: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten

- IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 1) 2) Montageweise auf Slide-in compact.

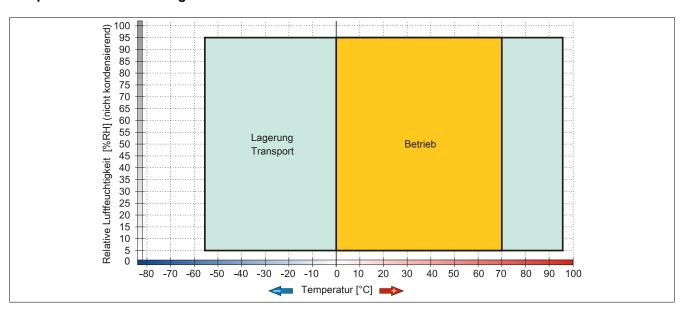


Abbildung 47: 5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.8 5AC801.SSDI-02

Allgemeines

Dieses 180 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	933
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0180-00	180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	The state of the s

Tabelle 77: 5AC801.SSDI-02 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-02
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	180 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

Tabelle 78: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

5AC801.SSDI-02
50.000
60.000
80.000
Ja
SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
0 bis 70°C
-55 bis 95°C
-55 bis 95°C
5 bis 95%, nicht kondensierend
5 bis 95%, nicht kondensierend
5 bis 95%, nicht kondensierend
5 bis 700 Hz: 2,17 g
5 bis 800 Hz: 3,13 g
5 bis 800 Hz: 3,13 g
1500 g, 0,5 ms
1500 g, 0,5 ms
1500 g, 0,5 ms
-300 bis 12.192 m
-300 bis 12.192 m
-300 bis 12.192 m
fix ²⁾
13 mm
98 mm
105 mm
118 g
Intel
SSDSC2CW180A3

Tabelle 78: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

- 1) 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- Montageweise auf Slide-in compact.

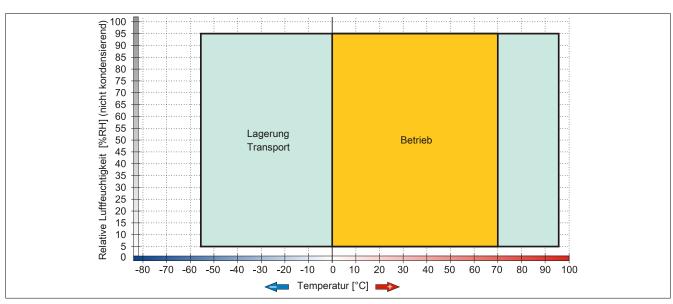


Abbildung 48: 5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.9 5AC801.SSDI-03

Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

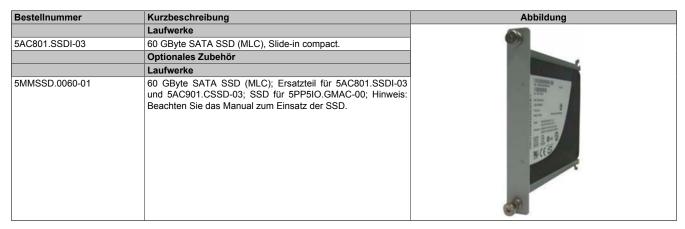


Tabelle 79: 5AC801.SSDI-03 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-03
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1015 Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 430 MByte/s

Tabelle 80: 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten

max. 60.000 (random)
max. 25.000 (random)
Ja
SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
0 bis 70°C
-40 bis 95°C
-40 bis 95°C
8 bis 95%, nicht kondensierend
8 bis 95%, nicht kondensierend
8 bis 95%, nicht kondensierend
10 bis 2000 Hz: 20 g
10 bis 2000 Hz: 20 g
10 bis 2000 Hz: 20 g
1500 g, 0,5 ms
1500 g, 0,5 ms
1500 g, 0,5 ms
-300 bis 12.192 m
-300 bis 12.192 m
-300 bis 12.192 m
fix ²⁾
13 mm
98 mm
105 mm
118 g
Toshiba
THNSNH060GBST

Tabelle 80: 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten

- 1) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 2) Montageweise auf Slide-in compact.

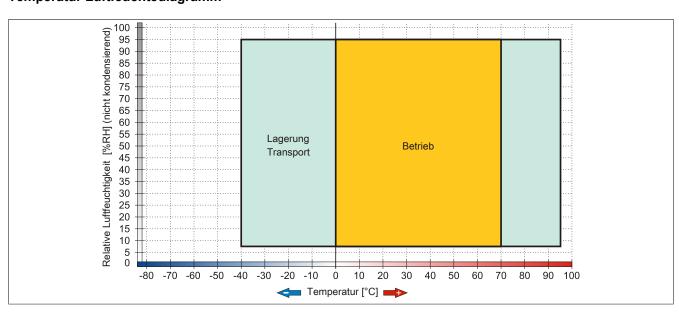


Abbildung 49: 5AC801.SSDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.10 5MMSSD.0060-00

Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Mulit Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-01 bzw. 5AC901.CSSD-01
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-00	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 81: 5MMSSD.0060-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁶ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS 1)	
4k lesen	15.000
4k schreiben	
typisch	23.000
maximal	80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient
	ACS-2
	SSD Enhanced SMART ATA feature set
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 82: 5MMSSD.0060-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW060A3

Tabelle 82: 5MMSSD.0060-00 - Technische Daten

1) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

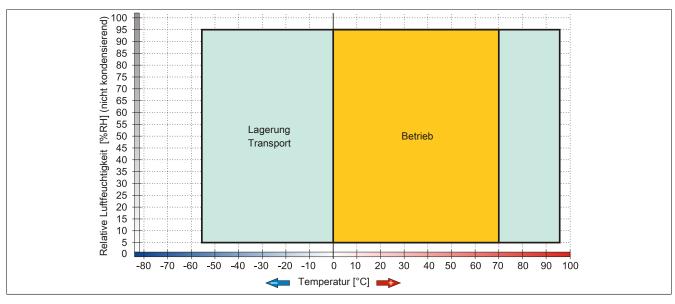


Abbildung 50: 5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.11 5MMSSD.0060-01

Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Mulit Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-03 bzw. 5AC901.CSSD-03
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	Image not found for 5MMSSD.0060-01!
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 83: 5MMSSD.0060-01 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 430 MByte/s
IOPS 1)	
4k lesen	max. 60.000 (random)
4k schreiben	max. 25.000 (random)
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient
	ACS-2
	SSD Enhanced SMART ATA feature set
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 84: 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01	
Vibration		
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Schock		
Betrieb	1500 g, 0,5 ms	
Lagerung	1500 g, 0,5 ms	
Transport	1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 12.192 m	
Lagerung	-300 bis 12.192 m	
Transport	-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	9,5 mm	
Höhe	69 mm	
Tiefe	100 mm	
Gewicht	78 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Toshiba	
Herstellerbezeichnung	THNSNH060GBST	

Tabelle 84: 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

1) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

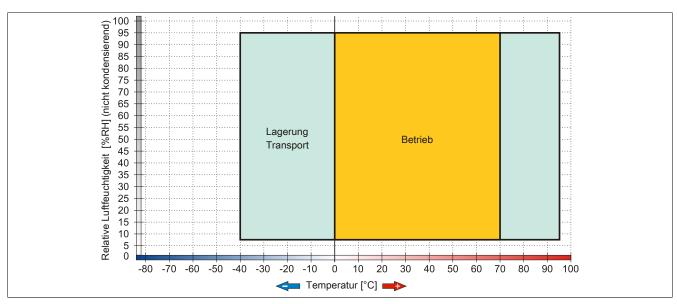


Abbildung 51: 5MMSSD.0060-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.12 5MMSSD.0180-00

Allgemeines

Dieses 180 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Erstzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-02 bzw. 5AC901.CSSD-02
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0180-00	180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 85: 5MMSSD.0180-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Produktbezeichnung	5MMSSD.0180-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	180 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS 1)	
4k lesen	50.000
4k schreiben	
typisch	60.000
maximal	80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient
	ACS-2
	SSD Enhanced SMART ATA feature set
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 86: 5MMSSD.0180-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0180-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW180A3

Tabelle 86: 5MMSSD.0180-00 - Technische Daten

1) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

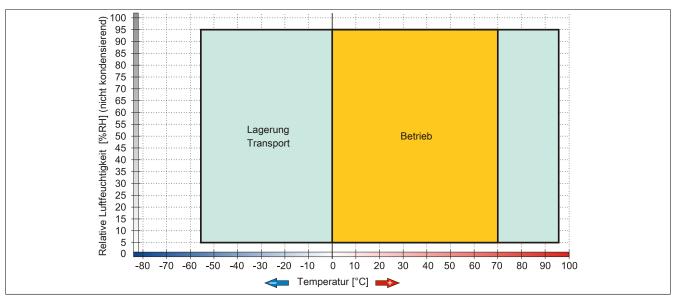


Abbildung 52: 5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.13 5AC801.ADAS-00

Allgemeines

Der Hard Disk Adapter ist ein Slide-in Adapter, in welchen man Slide-in compact Laufwerke stecken und somit am B&R Industrie PC betreiben kann. Dieser Adapter kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Der Slide-in compact Adapter kann aus mechanischen Gegebenheiten (Schließen der Fronttüre) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

Bestelldaten

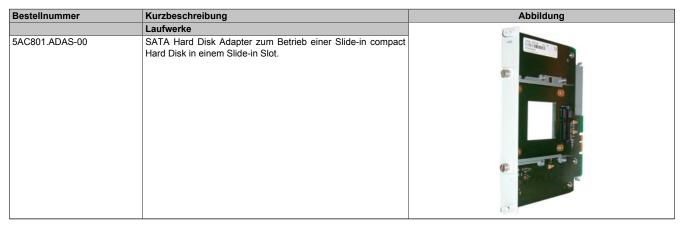


Tabelle 87: 5AC801.ADAS-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.ADAS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	328 g

Tabelle 88: 5AC801.ADAS-00 - Technische Daten

3.6.14 5AC801.HDDS-00

Allgemeines

Diese 40 GByte Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA und USB angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	97
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 89: 5AC801.HDDS-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.HDDS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Hard Disk	
Kapazität	40 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	78.140.160
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	750.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,6 ms
Datentransferrate	
intern	max. 450 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)

Tabelle 90: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDS-00
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	12,5 ms
maximal (Lesezugriff)	23 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 2)	
Betrieb 3)	-30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden 4)	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit 5)	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	J.
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 5000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁶⁾
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	387 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST940817SM

Tabelle 90: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

- Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur. 1)
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 4) 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
- Montageweise auf Slide-in compact.

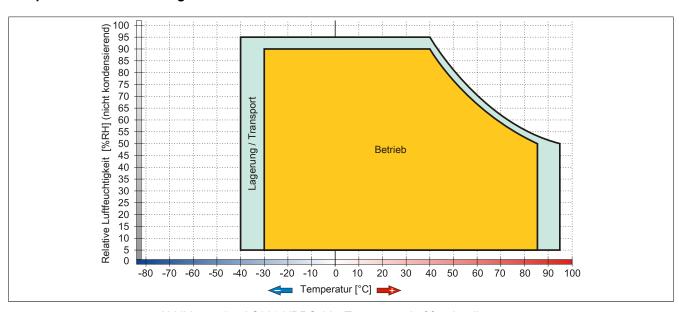


Abbildung 53: 5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.15 5AC801.DVDS-00

Allgemeines

Das DVD-ROM Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA und USB angesprochen.

Bestelldaten

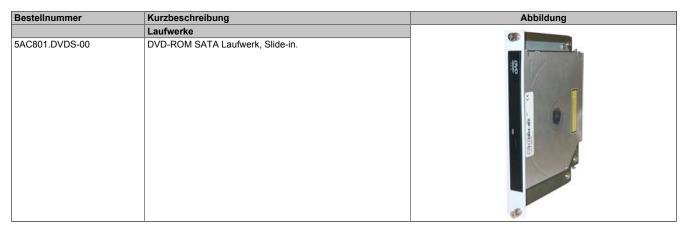


Tabelle 91: 5AC801.DVDS-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.DVDS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
CD / DVD Laufwerk	
Datentransferrate	max. 1,5 GBit/s
Drehzahl	max. 5090 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
	CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
	Photo CD (single/multi-session)
	Enhanced CD, CD-Text
	DVD-ROM, DVD-Video (Double Layer), DVD-R (Single/Multi-border), DVD-R DL (Sing-
	le/Multi-border), DVD-RW (Single/Multi-border), DVD+R (Single/Multi session), DVD+R
	DL (Single/Multi session), DVD+RW (Single/Multi session), DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	SATA
Hochlaufzeit	
CD	max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	durchschnittlich 130 ms
DVD	durchschnittlich 140 ms

Tabelle 92: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5AC801.DVDS-00
Lesbare Medien	
CD	CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-A CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 1)	
Betrieb	5 bis 55°C ²⁾
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 80%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,2g
Lagerung	5 bis 500 Hz: 2g
Transport	5 bis 500 Hz: 2g
Schock	
Betrieb	5 g und 11 ms Dauer
Lagerung	60 g und 11 ms Dauer
	200 g und 2 ms Dauer
Transport	60 g und 11 ms Dauer
	200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	455 g

Tabelle 92: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

- 1) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ü. NN. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.
- 2) Oberflächentemperatur des Laufwerks.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

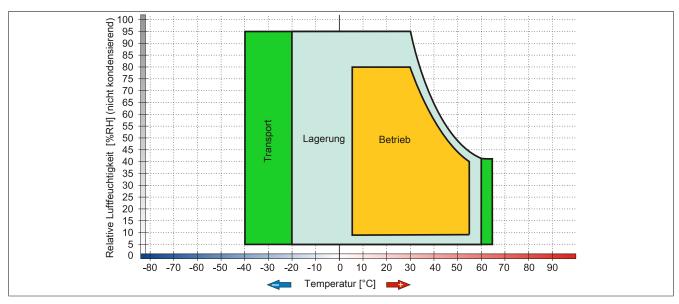


Abbildung 54: 5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Hot-Plug Fähigkeit

Hardwarerevision B0 des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfähigkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugfähig.

3.6.16 5AC801.DVRS-00

Allgemeines

Das DVD-R/RW Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA und USB angesprochen.

Bestelldaten

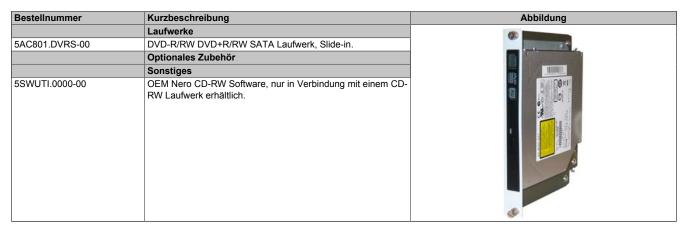


Tabelle 93: 5AC801.DVRS-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Produktbezeichnung	5AC801.DVRS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	2 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5160 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
	CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
	Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
	DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video
	DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
	DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	SATA
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	durchschnittlich 140 ms (24x)
DVD	durchschnittlich 150 ms (8x)

Tabelle 94: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5AC801.DVRS-00
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW. DVD-
	RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer),DVD+RW, DVD-RAM
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	24x, 16x, 10x und 4x
CD-RW	24x, 16x, 10x und 4x
DVD+R	8x, 4x und 2,4x
DVD+R (Double Layer)	6x, 4x und 2,4x
DVD+RW	4x und 2x
DVD-R	8x, 4x und 2x
DVD-R (Double Layer)	6x, 4x und 2x
DVD-RAM 1)	5x, 3x und 2x
DVD-RW	6x, 4x und 2x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾	
Betrieb	5 bis 55°C ³⁾
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 80%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,2q
Lagerung	5 bis 500 Hz: 2g
Transport	5 bis 500 Hz: 2g
Schock	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Betrieb	bei max. 5 g und 11 ms Dauer
Lagerung	bei max. 60 g und 11 ms Dauer
39	bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Transport	bei max. 60 g und 11 ms Dauer
	bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	400 g

Tabelle 94: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten

- 1) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Unterstützung der RAM Funktion durch die Brennsoftware "Nero" (Best. Nr. 5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.
- 2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern ü. NN.
- 3) Oberflächentemperatur des Laufwerks.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

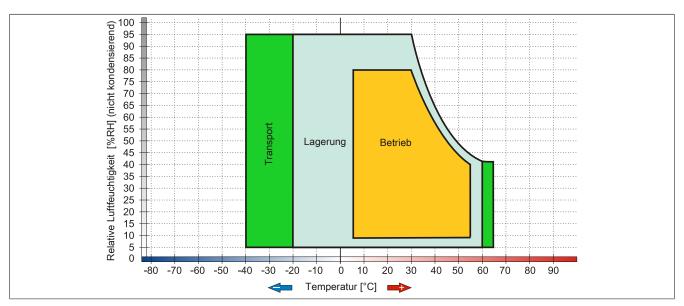


Abbildung 55: 5AC801.DVRS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.17 5ACPCI.RAIC-01

Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s



Abbildung 56: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine "Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)" eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel mindestens 50 Minuten (konigurierbar) in Anspruch.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Undefined	
5ACPCI.RAIC-01	PCI RAID System SATA 2x 60 GByte Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Optionales Zubehör	3/61 S 5 7 7
	Undefined	II 23 F. America
5ACPCI.RAIC-02	60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-01 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	1

Tabelle 95: 5ACPCI.RAIC-01 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-01
Allgemeines	SACI GIIIAIG-UI
Anzahl der Hard Disks	2
Zertifizierungen	2
CE	Ja
cULus	Ja
Controller	Ja
Тур	Sil 3512 SATA Link
Spezifikation	Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Hard Disk	
Kapazität	60 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	117.210.240
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	7200 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	4,2 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate	
intern	max. 539 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	10,5 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)
	1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 1)	
Betrieb 2)	5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden 3)	5 bis 40°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration 4)	,
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,125 g (1,225 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,25 g (2,45 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Lagerung	bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock	200 dangang
Betrieb	bei max. 125 g (1226 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung
Lagerang	bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung
	bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Transport	bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung
·	bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung
	bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage 5)	fix
Abmessungen	
Breite	70 mm
Länge	100 mm
Höhe	9,5 mm
	1 -7

Tabelle 96: 5ACPCI.RAIC-01 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-01
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	Momentus 7200.1 ST96023AS

Tabelle 96: 5ACPCI.RAIC-01 - Technische Daten

- Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1 °C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Minute maximal 3 °C betragen.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
- 5) Montageweise auf PCI Einschub.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

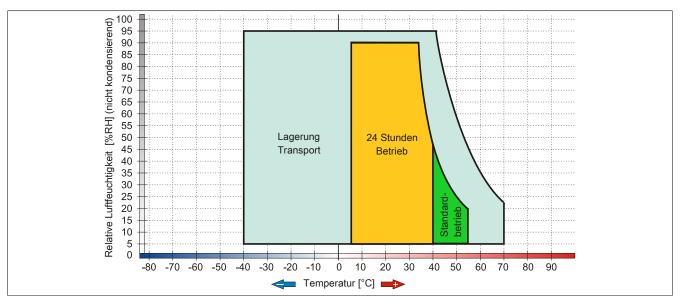


Abbildung 57: 5ACPCI.RAIC-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 219.

Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 60GB 5ACPCI.RAIC-02 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 11 "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 421.

3.6.18 5ACPCI.RAIC-02

Allgemeines

Die Hard Disk kann als Ersatzteil für eine HDD des PCI SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-01 verwendet werden.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Undefined	
5ACPCI.RAIC-02	60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-01 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 97: 5ACPCI.RAIC-02 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-02
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Hard Disk	
Kapazität	60 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	117.210.240
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	7200 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	4,2 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate	
intern	max. 539 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	10,5 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 1)	
Betrieb 2)	5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden 3)	5 bis 40°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration 4)	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,125 g (1,225 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,25 g (2,45 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Lagerung	bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung

Tabelle 98: 5ACPCI.RAIC-02 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-02
Schock	
Betrieb	bei max. 125 g (1226 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung
	bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Transport	bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	70 mm
Länge	100 mm
Höhe	9,5 mm
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	Momentus 7200.1 ST96023AS

Tabelle 98: 5ACPCI.RAIC-02 - Technische Daten

- Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-1) und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 4) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).

Temperatur Luftfeuchtediagramm

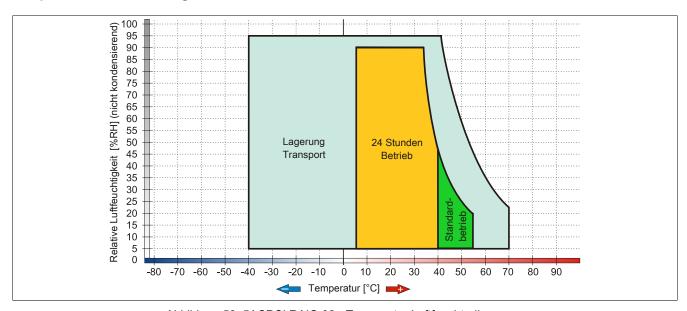


Abbildung 58: 5ACPCI.RAIC-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.19 5ACPCI.RAIC-03

Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bieten zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET).

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

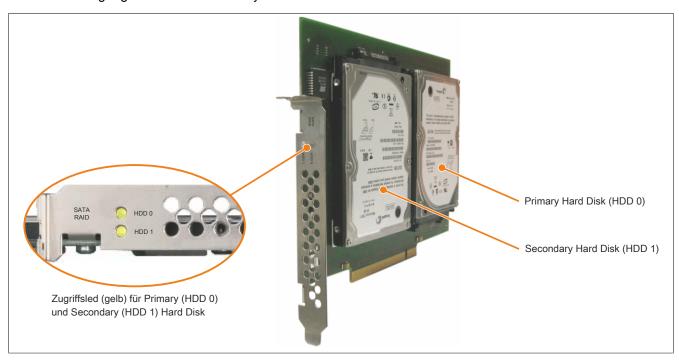


Abbildung 59: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine "Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)" eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel bei einer Speichergröße von 160 GByte ca. 160 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-03	PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Optionales Zubehör	3/64 S 0 7 7
	Laufwerke	H 23 E American
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	The state of the s

Tabelle 99: 5ACPCI.RAIC-03 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-03
Allgemeines	
Anzahl der Hard Disks	2
Zertifizierungen	
CE	Ja
Controller	
Тур	Sil 3512 SATA Link
Spezifikation	Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate	
intern	max. 84,6 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	12 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)
-	1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 1)	
Betrieb ²⁾	-15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden 3)	-15 bis 80°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	0.1:- 000/ -:
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend 4)
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend 5)
Transport Vibration 6	5 bis 95%, nicht kondensierend ⁵⁾
Vibration ⁶⁾ Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (dauernart) Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dader 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock	2 5.0 000 File Main 0 gr 2 000 0,0 0 Main or pro minute, none 2000 mangaring
Betrieb	max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
	max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
	max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Transport	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
	max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
Maaraahäha	max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	200 bio 2040
Betrieb	-300 bis 3048 m -300 bis 12192 m
Lagerung Mechanische Figenschaften	-300 nig 17.187 till
Mechanische Eigenschaften Montage 7)	fiv
	fix
Abmessungen Breite	70 mm
Länge	70 mm
Höhe	9,5 mm
	0,0 11111

Tabelle 100: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-03
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 100: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten

- Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
- Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
- 6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate)
- 7) Montageweise auf PCI Einschub.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

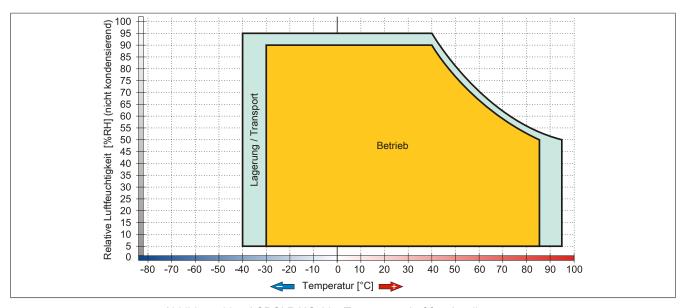


Abbildung 60: 5ACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 219.

Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 160GB 5ACPCI.RAIC-04 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 11 "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 421.

3.6.20 5ACPCI.RAIC-04

Allgemeines

Die Hard Disk kann als Ersatzteil für eine HDD des PCI SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 verwendet werden.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 101: 5ACPCI.RAIC-04 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-04
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate	
intern	max. 84,6 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	12 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)
	1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 1)	
Betrieb ²⁾	-15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden 3)	-15 bis 80°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	01'-000(1-1-1111111
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend ⁴⁾ 5 bis 95%, nicht kondensierend ⁵⁾
Lagerung	, '
Transport Vibration ®	5 bis 95%, nicht kondensierend 5
	E bio 500 Hz; may 0.125 g: Dayor 1 Oktovo pro Minuto; kojno njeht behabbaran Fablar
Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: max. 0,25 g, Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	5 515 555 FIZ. Max. 5 g, Dader 6,5 Oktaven pro williate, Keine Deschadigung

Tabelle 102: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-04
Schock	
Betrieb	max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
	max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
	max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Transport	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
	max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
	max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	70 mm
Länge	100 mm
Höhe	9,5 mm
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 102: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

- Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-1) und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 4) 5) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
- Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
- Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).

Temperatur Luftfeuchtediagramm

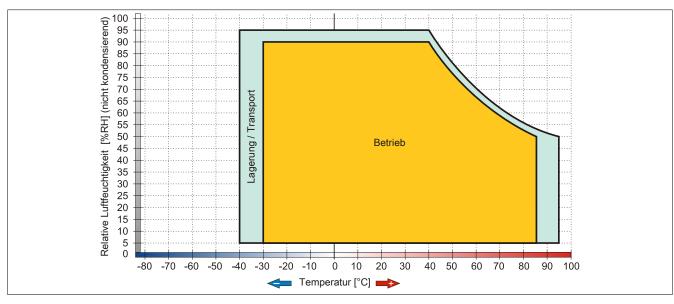


Abbildung 61: 5ACPCI.RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.21 5ACPCI.RAIC-05

Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten 250 GByte Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

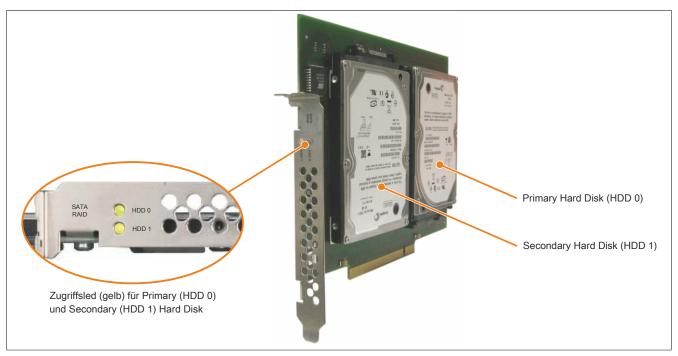


Abbildung 62: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine "Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)" eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel bei einer Speichergröße von 250 GByte ca. 250 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
	Optionales Zubehör	3/4
	Laufwerke	H 22 = America
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 103: 5ACPCI.RAIC-05 - Bestelldaten

Technische Daten

Anganistics	Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-05
Anzahi der Hard Dieks 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5		
Cottolie	Anzahl der Hard Disks	2
Cottolie		
Sin St12 SATA Link	_	Ja
Signate	cULus	Ja
Spezification Serial ATA 1.0	Controller	
Datentipetragungsrate max. 1,5 GBUs (150 MByles)	Тур	Sil 3512 SATA Link
Datentipetragungsrate max. 1,5 GBII/s (150 MBytes) RADIO Level	3.	Serial ATA 1.0
RAID Level	•	
BIOS Extension ROM Bedarf Ca. 32 kByte Hard Disk		
Hard Disk		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kapazzita		Cai Sa Nayto
Anzahl der Kopfe	110.000	250 GRute
Anzah der Sektore	·	
Eyles pro Sektor	•	·
Cache S.MByte S.MOu pm 10,2%		
Derbizah 5400 pm ±0.2%		
Hochlaufzelt S.M.A.R.T. Support Ja		·
SMAR.T. Support Ja		
August S.5.6 ms		
Unterstützte Transfermodi Datentransferrate inter Datentransferrate Datentransferrate inter Datentransferrate	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Datentransferrate intern max. 1175 MBit/s max. 150 MByte/s Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) 1 ms nominal (Lesezugriff) 14 ms 30 ms Elektrische Eigenschaften 30 ms Elektrische Eigenschaften 30 ms 1 he hebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1,0 Klaver pro Minute; keine Beschadigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschadigung max. 500 g, 5 ms; keine Beschadigung max. 500 g, 5 ms; keine Beschadigung max. 500 g, 5 ms; keine Beschadigung max. 500 g, 5 ms; keine Beschadigung max. 500 g, 5 ms; keine Beschadigung max. 500 g, 5 ms; keine Beschadigung max. 500 g, 5 ms; keine Beschadigung max. 50		,
Datentransferrate intern	unterstutzte Fransfermodi	, ,
intern zum / vom Host Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff) Beltrice 30 Betrice 24 Stunden 30 Lagerung Transport Lagerung Transport Setrice (deuerhaft) Betrice (deuerhaft) Betrice (deuerhaft) Sib is 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport Schock 30 Betrice 1 Betrice 4 Betrice 5 Betrice 5 Betrice 5 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 7 Betrice 8 Betrice 8 Betrice 8 Betrice 8 Betrice 9 Betrice 9 Betrice 9 Betrice 9 Betrice 9 Betrice 1 Betrice 2 Betrice 3 Betrice 1 Betrice 3 Betrice 1 Betrice 1 Betrice 1 Betrice 1 Betrice 1 Betrice 1 Betrice 2 Betrice 3 Betrice 3 Betrice 3 Betrice 4 Betrice 1 Betrice 2 Betrice 1 Betrice 2 Betrice 2 Betrice 2 B	Datentransferrate	FTO IVIOUGS 0-4, IVIUILIWOTU DIVIA IVIOUGS 0-2, ODIVIA IVIOUGS 0-0
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff) 30 ms Elektrische Eigenschaften Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen Temperatur '' Betrieb - 24 Stunden '') Lagerung Transport Lagerung Transport Luffleuchtigkeit '-) Betrieb b Setrieb Setrie		may 1175 MPit/o
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) 14 ms 30 ms 14 ms 30 ms 14 ms 30 ms 14 ms 30 ms 14 ms 30 ms 14 ms 30 ms 14 ms 30 ms 14 ms 30 ms 14 ms 30 ms 14 ms 30 ms 15 ms 15 ms		
minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff) 30 ms Elektrische Eigenschaften Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen Temperatur ') Betrieb '? Betrieb -24 Stunden '?) Lagerung Transport Lagerung Transport Betrieb (selegentiich) Lagerung Transport So bis 50°C Loffeuchtigkeit '0 Betrieb (selegentiich) Lagerung Transport So bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport Schock '8 Betrieb Lagerung Transport So bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Transport Transport Transport So bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Transport Transport Transport Transport So bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Transp		max. 150 Mbyte/s
Description		1 700
maximal (Lesezugriff) 30 ms		
Elektrische Eigenschaften		
Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus) Temperatur 1) Betrieb 20 Betrieb 24 Stunden 3) Lagerung Transport Luftfeuchtigkeit 4) Betrieb Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung Transport Vibration 9 Betrieb (dauerhaft) Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport S bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport Schock 3) Betrieb S bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport S bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport S bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Schock 4) Betrieb Lagerung Transport S bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Schock 5) Transport Max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung		30 IIIS
Table 5 V (PCI Bus)		0.2 A hai 2.2 W (DCI Dua)
Umgebungsbedingungen Temperatur ¹¹ 0 bis 60°C Betrieb ²¹ 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffleuchtigkeit ⁴¹ 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagrung 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration ⁵¹ 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration ⁵¹ 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock ⁵¹ max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 200 g, 1 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung	Leistungsaumanme	
Temperatur ¹) Betrieb ²2 Stunden ³) Lagerung Transport Luffeuchtigkeit ⁴) Betrieb b 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung Transport Lagerung Transport Setrieb b 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung Transport Setrieb b 5 bis 95%, nicht kondensierend Setrieb b 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport Setrieb (dauerhaft) S	Umgebungsbedingungen	
Betrieb ²⁾ Betrieb -24 Stunden ³⁾ Lagerung Transport Luffeuchtigkeit ⁴⁾ Betrieb Betrieb Lagerung Transport So bis 95%, nicht kondensierend Lagerung Transport So bis 95%, nicht kondensierend So bis 95%, nicht kondensierend So bis 95%, nicht kondensierend So bis 95%, nicht kondensierend So bis 95%, nicht kondensierend Vibration ⁵⁾ Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport So bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler So bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Schock ⁵⁾ Betrieb Lagerung Transport So bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe Betrieb Lagerung Agerung Fix ⁶⁾ Betrieb Agerung Fix ⁶⁾ Betrieb Agerung Betrieb		
Betrieb - 24 Stunden 3) Lagerung Transport -40 bis 70°C Luffleuchtigkeit 4) Betrieb Betrieb Lagerung Transport Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Betrieb (auerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport S bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Schock 9 Betrieb Lagerung Transport Schock 9 Betrieb Lagerung Transport Transport Merershöhe Betrieb	-	0 bis 60°C
Lagerung Transport Lufffeuchtigkeit 4) Betrieb Lagerung Transport Setrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Sobis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Sobis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Schock 5) Betrieb (auerhaft) Betrieb (auerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Schock 5) Betrieb Lagerung Transport Schock 5) Betrieb Lagerung Transport Schock 5) Betrieb Lagerung Transport Merershöhe Betrieb Lagerung Transport Meereshöhe Betrieb		
Transport Luffeuchtigkeit 4) Betrieb Lagerung Transport S bis 95%, nicht kondensierend S bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration 5) Betrieb (dauerhaft) S bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport S bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport S bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Schock 5) Betrieb Lagerung max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 30		
Luftfeuchtigkeit *) Betrieb Lagerung Transport S bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration *) Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport S bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 6 max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung 6 max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung 7 max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung 7 max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung 7 max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung 7 max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung 8 max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung 8 max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung 9 max. 300 g, 0,5 ms;		
Betrieb		
Lagerung Transport S bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration 5) Betrieb (dauerhaft) S bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport S bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1, Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport S bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport S bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport Max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung Max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung Max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung Max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung Max. 500 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Max. 5		5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport S bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Schock S Betrieb Lagerung Transport Trans		·
Vibration 5) Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Schock 5) Betrieb Lagerung Transport Betrieb Betrie		
Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Schock ⁵⁾ Betrieb Lagerung Transport Betrieb Lagerung Transport Schock ⁵⁾ Betrieb Betrieb Lagerung Transport Betrieb Betri	•	
Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Schock 5) Betrieb Lagerung Transport Betrieb Betrieb Lagerung Betrieb Betrieb Betrieb Lagerung Transport Betrieb Betrieb Lagerung Transport Betrieb Betrieb Lagerung Transport Betrieb Lagerung Betrieb Betrieb Lagerung Betrieb Bet		5 bis 500 Hz; max, 0.125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung Transport Schock 5) Betrieb Lagerung Transport Transport Schock 5) Betrieb Lagerung Transport Transport Schock 5) Betrieb Lagerung Transport Transport	,	
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock 5) Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe Betrieb - 300 bis 3048 m - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 6) Gewicht 350 g		
Schock 5) Betrieb	5 5	
Betrieb Lagerung max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 bis 3048 m - 300 bis 3048 m - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 6) Gewicht 350 g		
Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe Betrieb - 300 bis 3048 m - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 6) Gewicht 350 g		max. 125 a. 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe Betrieb - 300 bis 3048 m - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 6) Gewicht 350 g		=
max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe Betrieb - 300 bis 3048 m - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 6) Gewicht 350 g	J J	
max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe Betrieb - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 6) Gewicht 350 g		
Meereshöhe - 300 bis 3048 m Betrieb - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften fix 6) Gewicht 350 g	Transport	
Meereshöhe - 300 bis 3048 m Betrieb - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften fix 6) Montage fix 6) Gewicht 350 g		
Betrieb		max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften fix 6) Montage fix 6) Gewicht 350 g		
Mechanische EigenschaftenMontagefix 6)Gewicht350 g		
Montage fix 6) Gewicht 350 g		- 300 bis 12192 m
Gewicht 350 g	Mechanische Eigenschaften	
	Montage	
Haretallarinformation		350 g
THE STEIN OF THE S	Herstellerinformation	
Hersteller Seagate	Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung ST9250315AS	Herstellerbezeichnung	-

Tabelle 104: 5ACPCI.RAIC-05 - Technische Daten

- Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-1) und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 4) 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
- Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
- Montageweise auf PCI Einschub.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

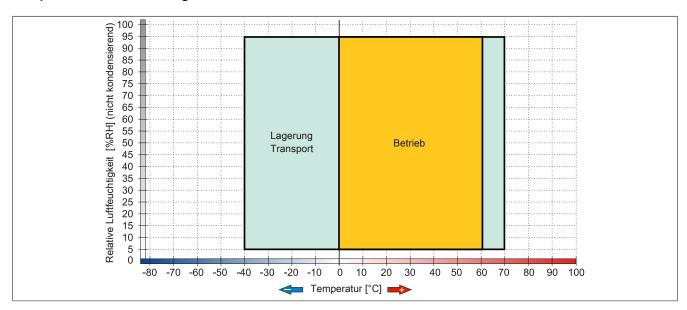


Abbildung 63: 5ACPCI.RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 219.

Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 250GB 5MMHDD.0250-00 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 421.

3.6.22 5ACPCI.RAIC-06

Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten 500 GByte Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2x 500 GByte SATA Hard Disk (geeignet f
 ür 24 Stunden Betrieb)
- · Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

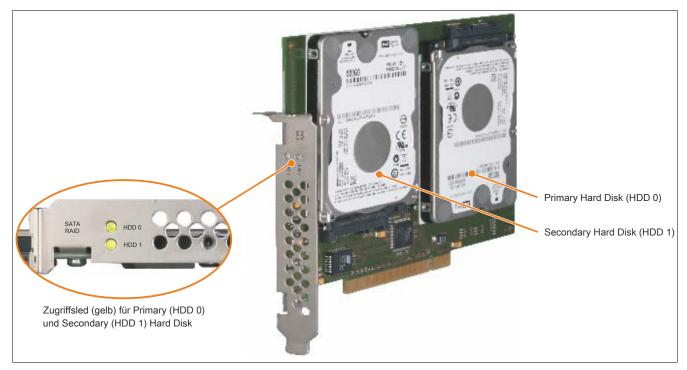


Abbildung 64: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine "Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)" eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel bei einer Speichergröße von 500 GByte ca. 500 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	Tania .
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie	
	das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	The second of th
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	3 8
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 105: 5ACPCI.RAIC-06 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Kapazitat	Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-06
Anzahl der Hard Disks CE Ja CE Ja CELLUS CONTROLOR CE JA CONTROLOR SPECIAL STAP	Allgemeines	
Zerifficient/page Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja J	Kapazität	2x 500 GByte
Countroller	Anzahl der Hard Disks	·
Countroller	Zertifizierungen	
Second S	=	Ja
Suit Stand	cULus	Ja
Secrit ATA 1.0	Controller	
Secrit ATA 1.0	Тур	Sil 3512 SATA Link
DatentDetrragungsrate		
BRD Level	Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
Hard Disk 'n		
Hard Disk 'n	BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Anzahl der Köpfe 97.73.168 Bytes pro Sektor 97.73.168 Bytes pro Sektor 1512 (logical) / 4096 (physical) Cache 150 Möyte 150 minarah 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% MTBF 10,000.00 POH 2.9 SAM A.T. Support 3 Ja 3 SAM A.T. Support 3 Ja 3 Schnittstelle 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms Ungebungsbedingungen 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützlei	Hard Disk 1)	
Anzahl der Köpfe 97.73.168 Bytes pro Sektor 97.73.168 Bytes pro Sektor 1512 (logical) / 4096 (physical) Cache 150 Möyte 150 minarah 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% Hochlaufzeit 15400 prp so 2.% MTBF 10,000.00 POH 2.9 SAM A.T. Support 3 Ja 3 SAM A.T. Support 3 Ja 3 Schnittstelle 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms unterstützle 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms Ungebungsbedingungen 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützleit 7 sansfermodi 5.5 ms 500 hz. 0.12 ms Unterstützlei	Kapazität	500 GBvte
Anzahl der Sektoren 976.773.188		
Bytes pro Sektor	-	
Cache		
Dehzahl		
Hochlaufzeit Sp. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)		·
Lebensdauer		
MTBF		
SMART. Support SATA		
Schnittstelle		
Zugriffszeit 5,5 ms unterstützte Transfermodi SATA II Datentransferrate intern max. 147 MByte/s zum / vom Host max. 150 MByte/s (SATA II), max. 300 MByte/s (SATA II) Positionierzeit nominal (Lesezugriff) 11 ms maximal (Lesezugriff) 21 ms Umgebungsbedingungen 11 ms Temperatur ⁵¹ 0 bis 60°C Betrieb ⁴² 0 bis 60°C Betrieb ⁴³ 0 bis 60°C Betrieb ⁴⁴ 0 bis 70°C Lagerung 40 bis 70°C Transport 40 bis 70°C Luffeuchtigkeit ⁶¹ 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration ⁷² 7 Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Schock 20 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler		
unterstützte Transferrade SATA II zum / vom Host max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II) Positionierzeit nominal (Lesezugriff) nominal (Lesezugriff) 11 ms maximal (Lesezugriff) 21 ms Umgebungsbedingungen Umgebungsbedingungen Temperatur ³ Betrieb ⁴ Betrieb - 24 Stunden ⁵ 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Lagerung -40 bis 70°C Untfleuchtigkeit ⁵ Betrieb Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration ⁷ Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz; 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz; 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz; 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Transport 10 bis 500 Hz; 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz; 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz; 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Lageru		
Datentransferrate intern	<u> </u>	
intern		SAIAII
Zum / vom Host		may 147 MPyto/s
Positionierzeit nominal (Lesezugriff) naximal (Lesezugriff) 21 ms Ungebungsbedingungen Temperatur 3 Betrieb 4 Betrieb 24 Stunden 5 Lagerung 40 bis 60°C Latifeuchtigkeit 6 Betrieb 5 Betrieb 6 Betrieb 6 Betrieb 7 Betrieb 7 Betrieb 7 Betrieb 8 Betrieb 8 Betrieb 8 Betrieb 9 Betrieb 9 Betrieb 9 Betrieb 10 Betr		-
nominal (Lesezugriff)		max. 100 Mbyte/3 (OATA I), max. 000 Mbyte/3 (OATA II)
maximal (Lesezugriff) 21 ms Umgebungsbedingungen Temperatur 39 0 bis 60°C Betrieb - 9 0 bis 60°C Edrieb - 24 Stunden 59 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit 69 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration 79 8 Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Schock 8etrieb Betrieb 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport 305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m <	!	11 ms
Umgebungsbedingungen Temperatur ³) 0 bis 60°C Betrieb • 0 0 bis 60°C Betrieb - 24 Stunden ⁵) 0 bis 70°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit ⁰) 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Yibration ¹) 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration ¹) 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Schock 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Herieb -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften 350 g <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Temperatur ³) 0 bis 60°C Betrieb - 24 Stunden ⁵) 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Lufffeuchtigkeit ⁵) 8etrieb Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration ¹? 5 bis 95%, nicht kondensierend Wibration ¹? 8etrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Schock 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Schock 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Meereshöhe -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften 350 g Montage fix ³0 Gewicht 350 g		
Betrieb - 9		
Betrieb - 24 Stunden 5) Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Lufffeuchtigkeit 6) Betrieb -5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung -5 bis 95%, nicht kondensierend Transport -5 bis 95%, nicht kondensierend Transport -7 Betrieb (dauerhaft) -5 bis 95%, nicht kondensierend Transport -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb (gelegentlich) -7 Betrieb -7 Betri	· ·	0 bis 60°C
Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit 6) Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration 7) Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Schock Betrieb 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Meereshöhe Betrieb -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 8) Gewicht 350 g Herstellerinformation Hersteller	Betrieb - 24 Stunden 5)	0 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit 6) Betrieb	Lagerung	-40 bis 70°C
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend 6 bis 95%, nicht kondensierend 6 bis 95%, nicht kondensierend 6 bis 95%, nicht konden	Transport	-40 bis 70°C
Lagerung Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration 7) Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g u	Luftfeuchtigkeit 6)	
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration 7) Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Schock Betrieb 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Meereshöhe Betrieb -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 8) Gewicht 350 g Herstellerinformation Hersteller Western Digital	Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration 7) Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Betrieb B	Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Betrieb Schock B	Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Schock Schock Betrieb Schock Schock Schock Betrieb Schock Schock Schock Schock Schock Betrieb Schock	Vibration 7)	
Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Duss 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Schock Betrieb Lagerung Transport Duss 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung Transport Duss Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport Duss Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport Duss Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport Duss Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Transport Duss Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 m		
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler Schock Betrieb 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Meereshöhe Betrieb Lagerung -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 8) Gewicht 350 g Herstellerinformation Hersteller Western Digital		
Schock Betrieb 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Meereshöhe Betrieb -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix ®) Gewicht 350 g Herstellerinformation Hersteller Western Digital		
Betrieb Lagerung Transport Meereshöhe Betrieb Lagerung Betrieb		10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Meereshöhe Betrieb Lagerung -305 bis 3048 m -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix ®) Gewicht 350 g Herstellerinformation Hersteller Western Digital	!	
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler Meereshöhe Betrieb -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften Montage fix 8) Gewicht 350 g Herstellerinformation Hersteller Western Digital		
Meereshöhe -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften fix 8) Montage fix 8) Gewicht 350 g Herstellerinformation Western Digital		=
Betrieb -305 bis 3048 m Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften fix ®) Montage fix ®) Gewicht 350 g Herstellerinformation Western Digital		1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung -305 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften fix ®) Montage fix ®) Gewicht 350 g Herstellerinformation Western Digital		00-11-22-2
Mechanische Eigenschaften fix 8) Montage fix 8) Gewicht 350 g Herstellerinformation Western Digital	!	
Montage fix 8) Gewicht 350 g Herstellerinformation Western Digital		-305 bis 12192 m
Gewicht 350 g Herstellerinformation Western Digital		
Hersteller Western Digital	Montage	
Hersteller Western Digital		350 g
Herstellerbezeichnung WD5000LUCT		_
	Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 106: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten

- 1) Technische Daten für eine Hard Disk.
- . 2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

- 4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.
- 7) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
- 8) Montageweise auf PCI Einschub.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

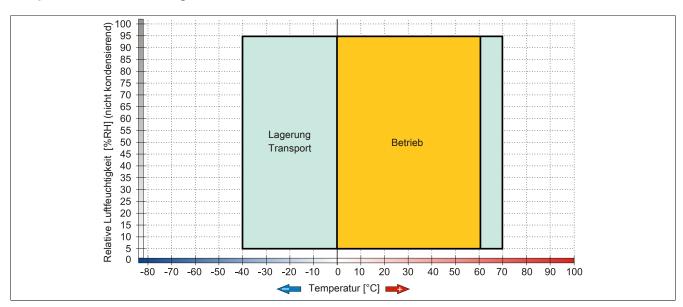


Abbildung 65: 5ACPCI.RAIC-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 219.

Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 500 GByte 5MMHDD.0500-00 als Ersatzteil für eine Hard Disk verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 421.

3.6.23 5MMHDD.0250-00

Allgemeines

Diese 250 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehörteil verwendet werden.

- · 250 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk für die Hard Disk 5AC801.HDDI-03 oder für den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-05
- Zubehör für APC510 (optionale Hard Disk für I/O-Board)
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 107: 5MMHDD.0250-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	550.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
	PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferrate	
intern	max. 1175 MBit/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	14 ms
maximal (Lesezugriff)	30 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 2)	
Betrieb 3)	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 4)	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C

Tabelle 108: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00
Luftfeuchtigkeit 5)	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	100 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 108: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

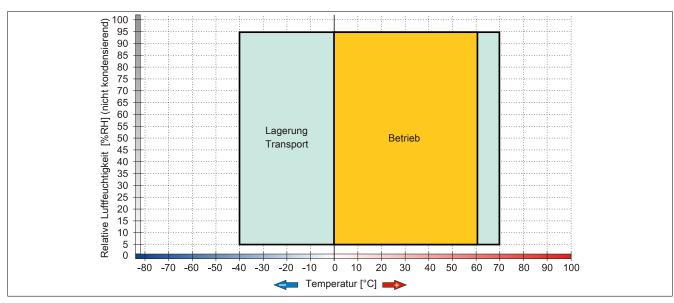


Abbildung 66: 5MMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.24 5MMHDD.0500-00

Allgemeines

Diese 500 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehörteil verwendet werden.

- · 500 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk für die Hard Disk 5AC801.HDDI-04 bzw. 5AC901.CHDD-01 oder für den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-06
- Zubehör für APC510 (optionale Hard Disk für I/O-Board)
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 109: 5MMHDD.0500-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMHDD.0500-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Hard Disk	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,5 ms
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate	
intern	max. 147 MByte/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
nominal (Lesezugriff)	11 ms
maximal (Lesezugriff)	21 ms

Tabelle 110: 5MMHDD.0500-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMHDD.0500-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾	
Betrieb 3)	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 4)	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 5)	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-305 bis 3048 m
Lagerung	-305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	7 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	100 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Western Digital
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 110: 5MMHDD.0500-00 - Technische Daten

- Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

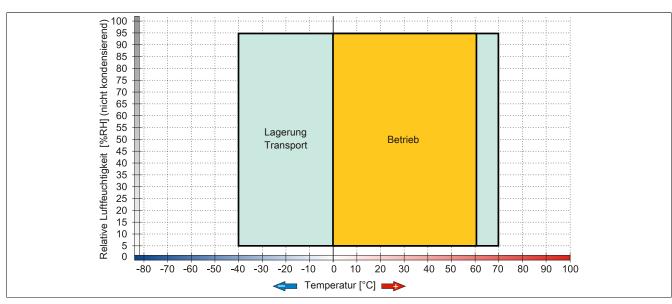


Abbildung 67: 5MMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.7 Lüfter Kit

Information:

Lüfter sind notwendig wenn Komponenten eingesetzt werden, die eine eingeschränkte Umgebungstemperatur aufweisen, z.B. RAID Controller, DVD Combo, PCI Karten.

Die Lüfter bzw. Staubfilter stellen ein Verschleißteil dar und müssen in angemessenem Abstand kontrolliert und bei nicht ausreichender Funktion (z. B. durch Verschmutzung) gereinigt oder ausgetauscht werden.

Für Informationen zu den Einschaltgrenzen des Lüfters siehe Anhang A.

3.7.1 5PC810.FA01-00

Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 1 Card Slot eingebaut werden.

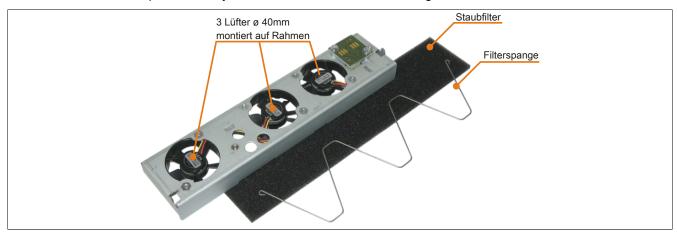


Abbildung 68: 5PC810.FA01-00 - Lüfter Kit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA01-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX01-00; 5 Stk.	

Tabelle 111: 5PC810.FA01-00 - Bestelldaten

Produktbezeichnung	5PC810.FA01-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	3
Drehzahl	max. 6100 rpm
Geräuschpegel	21 dB
Lebensdauer	29000 Stunden bei 70°C 95000 Stunden bei 20°C
Тур	doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja
ATEX Zone 22	Ja
GL	Ja

Tabelle 112: 5PC810.FA01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA01-00
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	10 mm

Tabelle 112: 5PC810.FA01-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 402.

3.7.2 5PC810.FA02-01

Allgemeines

Diese Lüfter Kits können optional bei Systemeinheiten mit 2 Card Slots eingebaut werden.

Das Lüfter Kit 5PC810.5A02-01 unterscheidet sich vom 5PC810.FA02-00 nur insofern, als zusätzliche Führungselemente wie bei den Lüfter Kits der 1 und 5 Slot Variante eingearbeitet sind. Somit wird der Lüfter Kit Einbau bzw. Tausch erleichtert. Für die Systemeinheit 5PC810.SX02- 00 kann ab der Revision D0 nur noch das Lüfer Kit 5PC810.5A02-01 eingebaut werden.

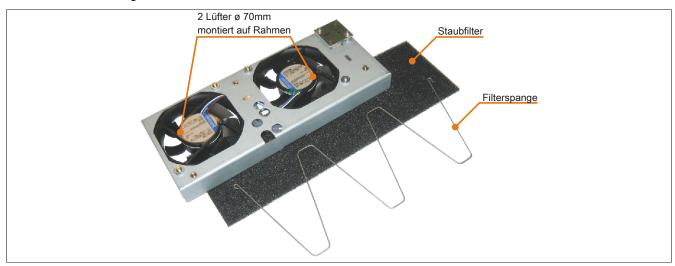


Abbildung 69: 5PC810.FA02-00 und 5PC810.FA02-01 - Lüfter Kit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Undefined	
5PC810.FA02-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00	
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA02-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk.	

Tabelle 113: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Bestelldaten

Produktbezeichnung	5PC810.FA02-00	5PC810.FA02-01	
Allgemeines			
Anzahl der Lüfter	2		
Drehzahl	max. 4300 rpm ±12,5%		
Geräuschpegel	32 dB		
Lebensdauer	60000 Stunden bei 40°C		
Тур	doppelt kugelgelagert		

Tabelle 114: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5PC810.FA02-00	5PC810.FA02-01		
Zertifizierungen				
CE	J	a		
cULus HazLoc Class 1 Division 2	-	Ja		
ATEX Zone 22	-	Ja		
GL	-	Ja		
Mechanische Eigenschaften				
Abmessungen				
Lüfter				
Breite	70 mm			
Höhe	70 mm			
Tiefe	15 mm			

Tabelle 114: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 402.

3.7.3 5PC810.FA03-00

Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 3 Card Slots eingebaut werden.

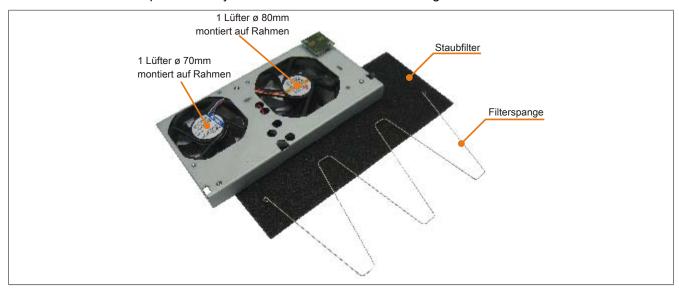


Abbildung 70: 5PC810.FA03-00 - Lüfter Kit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung	
	Lüfter Kit		
5PC810.FA03-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.		
	Optionales Zubehör		
	Zubehör		
5AC801.FA03-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk.		

Tabelle 115: 5PC810.FA03-00 - Bestelldaten

Produktbezeichnung	5PC810.FA03-00	
Allgemeines		
Anzahl der Lüfter	2	
Drehzahl	Lüfter 1: max. 4300 rpm ±12,5%	
	Lüfter 2: max. 3200 rpm ±10%	

Tabelle 116: 5PC810.FA03-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA03-00		
Geräuschpegel	Lüfter 1: 32 dB		
	Lüfter 2: 33 dB		
Lebensdauer	Lüfter 1: 60000 Stunden bei 40°C		
	Lüfter 2: 75000 Stunden bei 40°C		
Тур	doppelt kugelgelagert		
Zertifizierungen			
CE	Ja		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Lüfter			
Breite	Lüfter 1: 70 mm		
	Lüfter 2: 80 mm		
Höhe	Lüfter 1: 70 mm		
	Lüfter 2: 80 mm		
Tiefe	Lüfter 1: 15 mm		
	Lüfter 2: 15 mm		

Tabelle 116: 5PC810.FA03-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 402.

3.7.4 5PC810.FA05-00

Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 5 Card Slots eingebaut werden.

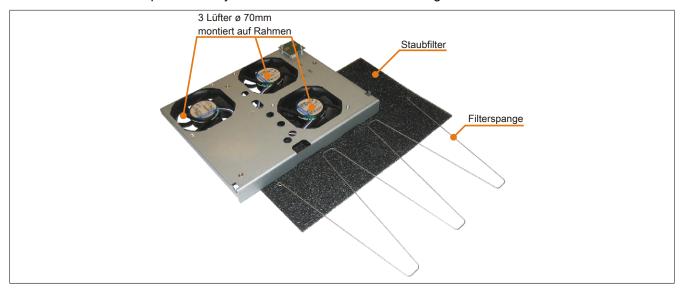


Abbildung 71: 5PC810.FA05-00 - Lüfter Kit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA05-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX05-00.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA05-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX05-00; 5 Stk.	

Tabelle 117: 5PC810.FA05-00 - Bestelldaten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA05-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	3
Drehzahl	max. 4300 rpm ±10%
Geräuschpegel	32 dB
Lebensdauer	60000 Stunden bei 40°C
Тур	doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen	
CE	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	70 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	15 mm

Tabelle 118: 5PC810.FA05-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 402.

3.8 AP Link Steckkarten

AP Link Steckkarten können bei den APC810 Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 montiert werden.

3.8.1 5AC801.SDL0-00

Allgemeines

Mit einer AP Link Grafikadapter Steckkarte ist es möglich einen 2-ten Grafikstrang zu realisieren. Bei diesem stehen die Signale DVI und SDL zur Verfügung. RGB Signale werden nicht unterstützt. Details sind den Technische Daten des verwendeten CPU Boards zu entnehmen.

Information:

Die Montage des AP Link SDL Transmitters ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 möglich.

Informationen zum Einbau des AP Link SDL Transmitters finden sie unter "AP Link Montage" auf Seite 420.



Abbildung 72: 5PC810.SX02-00 - Montagebeispiel mit der Systemeinheit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	

Tabelle 119: 5AC801.SDL0-00 - Bestelldaten

Produktbezeichnung	5AC801.SDL0-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
GL	Ja
Schnittstellen	
Panel/ Monitor Schnittstelle	
Ausführung	DVI-D Buchse
Тур	SDL/DVI

Tabelle 120: 5AC801.SDL0-00 - Technische Daten

Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung	
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect	
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)	
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)	
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1	
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)	
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)	DVI 24-polig, female
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair	
8	n.c.	not connected	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)	
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)	9 10 11 12 13 14 15 16
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	n.c.	not connected	17 18 19 20 21 22 23 24 C3 C4 C5
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	n.c.	not connected	
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	n.c.	not connected	
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	n.c.	not connected	
14	+5 V Power1)	+5V Power Supply	C5	n.c.	not connected	
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground				

Tabelle 121: Pinbelegung DVI Anschluss

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel	Auflösung					
	VGA	SVGA	XGA	SXGA	UXGA	FHD
Segmentlänge [m]	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080
	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
1,8	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
5	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
10	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
15	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-
20	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-	-
25	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-
30	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 122: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

¹⁾ Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

3.8.2 5AC801.RDYR-00

Allgemeines

Information:

Die Montage des Ready Relais ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 möglich.



Abbildung 73: Montagebeispiel mit der Systemeinheit 5PC810.SX02-00

Wird der APC810 eingeschaltet (Power On) werden die Relaiskontakte geschlossen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Automation Panel Link Steckkarten	Handy Rain's
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	9 P
0TB704.9	Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²	
OTB704.91	Zubehör Feldklemme, 4-polig, Federzugklemme 2,5 mm²	

Tabelle 123: 5AC801.RDYR-00 - Bestelldaten

Pinbelegung

	Ready Relais Pinbelegung				
F Schließ	inbelegung 4-polige Steckerleiste er und Öffner, max. 30 VDC, max. 10 A				
Pin	Belegung	1			
1	Schließer				
2	Wurzel				
3	Öffner				
4	n.c.				

Tabelle 124: 5AC801.RDYR-00 - Pinbelegung Ready Relais

3.9 Ready Relais

3.9.1 5AC801.RDYR-01

3.9.2 Allgemeines

Das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 kann in den Add-on USV Steckplatz des APC810 gesteckt werden, hierzu muss dieser Steckplatz noch frei verfügbar sein.

Nähere Informationen zur Montage des Ready Relais siehe Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" Abschnitt 13 "Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz" auf Seite 424.

In dem Beipackzettel ist beschrieben, wie die Aufklebestreifen an den Automation PC 810 anzubringen sind.

3.9.3 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC801.RDYR-01	Ready Relais für APC810 für die Montage an einem Add-on USV Steckplatz	23 F10 23 F10 21 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F1

Tabelle 125: 5AC801.RDYR-01 - Bestelldaten

3.9.4 Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Abbildung
1	-	nicht verbunden	
2	-	nicht verbunden	
3	NO	normally open	
4	COM	Wechselkontakt	
5	NC	normally closed	
6	-	nicht verbunden	
			NO COM NC B/IC BIRET

Tabelle 126: 5AC801.RDYR-01 - Pinbelegung

3.9.5 Lieferumfang

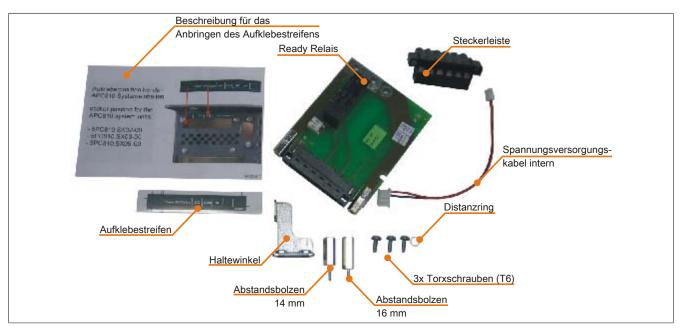


Abbildung 74: 5AC801.RDYR-01 - Lieferumfang

3.10 Schnittstellenoptionen (IF Option)

3.10.1 Allgemeines

Es kann eine zusätzliche Schnittstelle (CAN oder kombinierte RS232/422/485) in den IF Option Steckplatz des APC810 montiert werden.



Abbildung 75: Schnittstellenoptionen (IF Option)

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption ist jederzeit möglich.

Information:

Der Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

3.10.2 5AC600.CANI-00

Allgemeines

Das Add-on CAN Interface ist mit einem Intel 82527 CAN Controller ausgerüstet, welcher der CAN Spezifikation 2.0 Part A/B entspricht. Der CAN-Controller kann einen NMI (Non Maskable Interrupt) auslösen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Serialadapter	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	

Tabelle 127: 5AC600.CANI-00 - Bestelldaten

Produktbezeichnung	5AC600.CANI-00	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
Schnittstellen		
CAN		
Anzahl	1	
Controller	Bosch CC770 (kompatibel zum Intel 82527 CAN Controller)	
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker	
Abschlusswiderstand		
Тур	aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter	
Defaulteinstellung	deaktiviert	

Tabelle 128: 5AC600.CANI-00 - Technische Daten

Pinbelegung

	Add-on CAN	
Тур	potenzialgetrennt	
Übertragungs- geschwindigkeit	max. 500 kBit/s	
Buslänge	max. 1000 Meter	O ANTINA POND OVALA
Pin	Belegung	9-poliger DSUB-Stecker
1	n.c.	
2	CAN LOW	$6 \parallel \circ \circ \parallel 1$
3	GND	
4	n.c.	9 ° °
5	n.c.	5
6	Reserviert	
7	CAN HIGH	
8	n.c.	
9	n.c.	

Tabelle 129: Pinbelegung CAN

I/O Adresse und IRQ

Ressource	Default-Einstellung	Weitere Einstellmöglichkeiten
I/O Adresse	384h / 385h	-
IRQ	IRQ10	NMI ¹

Tabelle 130: Add-on CAN - I/O Adresse und IRQ

Die Einstellung des IRQ kann im BIOS Setup geändert werden. Bei Veränderung ist auf einen möglichen Konflikt mit einer anderen Ressource zu achten.

I/O Adresse	Register	Funktion
384h	Adressregister	Definiert die Registernummer, auf die zugegriffen werden soll.
385h	Datenregister	Zugriff auf das im Adressregister definierte Register.

Buslänge und Kabeltyp

Der zu verwendende Kabeltyp hängt weitgehend von der geforderten Buslänge und der Knotenzahl ab. Die Buslänge wird von der Übertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation) ist die maximale Buslänge 1000 Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121 % sind folgende Buslängen zulässig:

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
≤ 1000	typ. 50
≤ 200	typ. 250
≤ 60	typ. 500

Tabelle 131: CAN Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

CAN Kabel	Eigenschaft
Signalleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	2x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 82 Ω / km Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 59 Ω / km
Außenmantel Material Eigenschaften Gesamtschirmung	PUR Mischung halogenfrei aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 132: CAN Kabel Anforderungen

¹ NMI = Non Maskable Interrupt.

Abschlusswiderstand

Die Verdrahtung eines CAN-Netzes erfolgt in Busstruktur, wobei die beiden Busenden mit einem Abschlusswiderstand zu beschalten sind. Die Add-on CAN Interface Schnittstelle besitzt einen integrierten Abschlusswiderstand (Auslieferungszustand: deaktiviert auf Stellung "Aus").

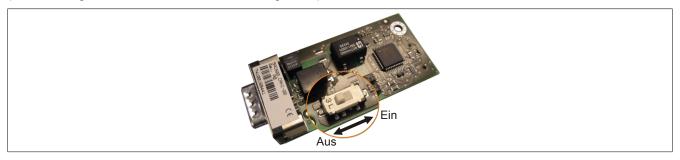


Abbildung 76: 5AC600.CANI-00 - Abschlusswiderstand Add-on CAN Interface

Lieferumfang

Für den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.



Abbildung 77: 5AC600.CANI-00 - Lieferumfang / Montagematerial

Treibersupport

Auf Grund der Dual Core Prozessoren ist für Betrieb die INACAN.SYS Treiberversion 2.36, enthalten im PVI Setup 2.6.0.3105, Voraussetzung.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.10.3 5AC600.485I-00

Allgemeines

Die Serielle Schnittstelle ist eine kombinierte RS232/RS422/RS485-Schnittstelle. Die Auswahl der Betriebsart (RS232/RS422/RS485) erfolgt dabei automatisch je nach elektrischer Anschaltung.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	

Tabelle 133: 5AC600.485I-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC600.485I-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, nicht modemfähig, galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
max. Baudrate	115 kBit/s

Tabelle 134: 5AC600.485I-00 - Technische Daten

Pinbelegung

		Add-on RS232/42	2/485
	RS232	RS422/485	
Тур		modemfähig; h getrennt	
UART	16550 kompatik	el, 16 Byte FIFO	
Übertragungs-	max. 1	15 kBit/s	
geschwindigkeit			9-poliger DSUB-Stecker
Buslänge	max. 15 Meter	max. 1200 Meter	
Pin	Belegung RS232	Belegung RS422	1
1	n.c.	TXD\	6 0 0 1
2	RXD	n.c.	0 0
3	TXD	n.c.	9 • •
4	n.c.	TXD	5
5	GND	GND	
6	n.c.	RXD\	
7	RTS	n.c.	
8	CTS	n.c.	
9	n.c.	RXD	

Tabelle 135: Pinbelegung RS232/RS422

I/O Adresse und IRQ

Ressource	Default-Einstellung	Weitere Einstellmöglichkeiten
I/O Adresse	2E8h	238, 2F8, 338, 3E8, 3F8
IRQ	IRQ10	IRQ 3, 4, 5, 7, 11, 12

Tabelle 136: Add-on RS232/422/485 - I/O Adresse und IRQ

Die Einstellung der I/O Adresse und des IRQ kann im BIOS Setup (unter "Advanced" - Untermenü "Baseboard/Panel Features" - Untermenü "Legacy Devices" Einstellung "COM E") geändert werden. Bei Veränderung ist auf einen möglichen Konflikt mit einer anderen Ressource zu achten.

Buslänge und Kabeltyp RS232

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Technische Daten • Einzelkomponenten

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
≤ 15	typ. 64
≤ 10	typ. 115
≤ 5	tvp. 115

Tabelle 137: RS232 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS232 Kabel	
Signalleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	4x 0,16 mm² (26AWG), verzinnte Cu-Litze PE $\leq 82~\Omega~/~km$ Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE \leq 59 Ω / km
Außenmantel Material Eigenschaften Gesamtschirmung	PUR Mischung halogenfrei aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 138: RS232 Kabel Anforderungen

Buslänge und Kabeltyp RS422

Die RTS- Leitung muss eingeschaltet werden um den Sender aktiv zu schalten.

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
1200	typ. 115

Tabelle 139: RS422 Buslänge und Übertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS422 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω / km Adern zum Paar verseilt
Verseilung	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Schirm	r adisciminary the radiations
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation	PE 450 0 H m
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω / km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 140: RS422 Kabel Anforderungen

Betrieb als RS485-Schnittstelle

Für den Betrieb sind die Pins der RS422 Defaultschnittstelle (1, 4, 6 und 9) zu verwenden. Dazu sind die Pins wie abgebildet zu verbinden.

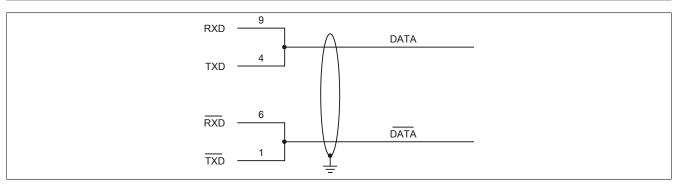


Abbildung 78: Add-on RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus

Das Schalten der RTS Leitung muss für jedes Senden wie auch Empfangen vom Treiber durchgeführt werden, es gibt keine automatische Rückschaltung. Dies kann nicht in Windows konfiguriert werden.

Bei großen Leitungslängen kann es durch den Spannungsabfall zu größeren Potentialdifferenzen zwischen den Busteilnehmern kommen, die die Kommunikation behindern. Dies kann durch mitführen der Masseleitung verbessert werden.

Die Leitungsenden der RS485 Schnittstelle sollten (zumindest bei größeren Leitungslängen bzw. größeren Übertragungsraten) abgeschlossen werden. Dazu kann in der Regel ein passiver Abschluss durch verbinden der Signalleitungen über jeweils einen 120 Ω Widerstand an den beiden Busenden verwendet werden.

Buslänge und Kabeltyp RS485

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
1200	typ. 115

Tabelle 141: RS485 Buslänge und Übertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS485 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω / km Adern zum Paar verseilt
Verseilung	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Schirm	i daisonimiding mit Adminidinolic
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation	PE . FO O / I
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω / km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 142: RS422 Kabel Anforderungen

Lieferumfang

Für den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.



Abbildung 79: 5AC600.485I-00 - Lieferumfang / Montagematerial

Kapitel 3 • Inbetriebnahme

1 Montage

Die Geräte werden mit den am Gehäuse befindlichen Befestigungslaschen montiert. Die Laschen sind für M5 Schrauben konzipiert.

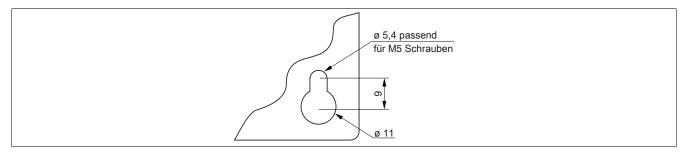


Abbildung 80: Befestigungslasche

Die genaue Position für die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen im Kapitel 2 "Technische Daten", Abschnitt "Einzelkomponenten" auf Seite 75 entnommen werden.

1.1 Vorgehensweise

- 1. Den Schaltschrank mit den benötigten Bohrungen versehen. Die genaue Position für die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen entnommen werden.
- 2. Den B&R Industrie PC mit M5 Schrauben am Schaltschrank montieren.

1.2 Wichtige Informationen zur Montage

- Es müssen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.
- · Das Gerät muss auf planer Oberfläche montiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- · Die Lüftungslöcher dürfen nicht verdeckt werden.
- Bei der Montage des Geräts sind unbedingt die zulässigen Einbaulagen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des Geräts tragen kann.
- Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.

1.3 Einbaulagen

Ein APC810 System darf nur wie nachfolgend abgebildet bzw. beschrieben montiert werden.

1.3.1 Einbaulage - senkrecht

Diese Art der Montage kann sowohl für APC810 Systeme mit und ohne Lüfter Kit verwendet werden.

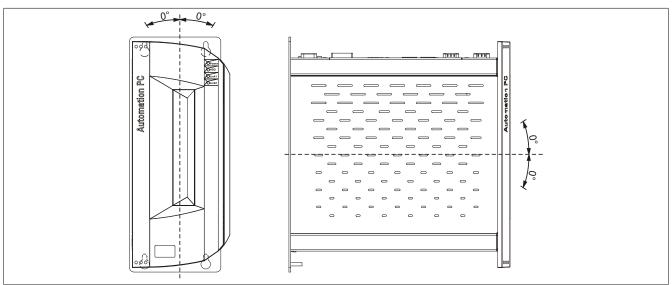


Abbildung 81: Einbaulage - senkrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 184 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.3.2 Einbaulage - waagrecht

Der Betrieb in waagrechter Einbaulage (Kühlkörper nach oben) ist nur in Verbindung mit einem Lüfter Kit erlaubt. Die maximale Umgebungstemperaturspezifikation muss um 5°C herabgesetzt werden.

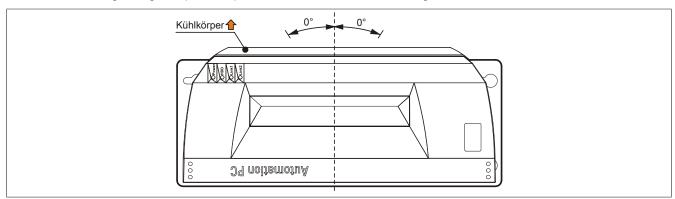


Abbildung 82: Einbaulage - waagrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 184 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.4 Luftzirkulationsabstände

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und rückseitig des Automation PC 810 ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden Zeichnungen entnommen werden. Dieser ist für sämtliche Automation PC 810 Varianten gültig.

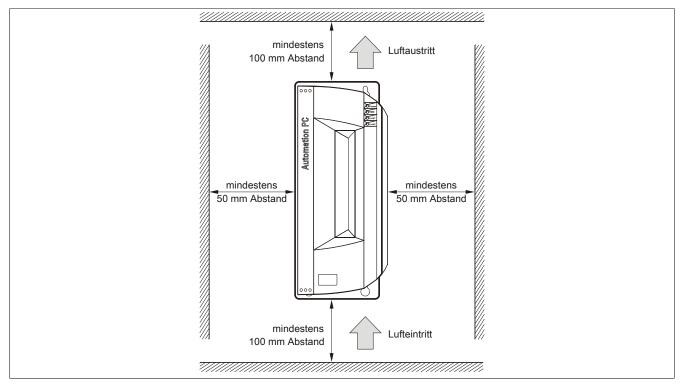


Abbildung 83: Standardmontage - Montageabstände

Diese definierten Abstände gelten sowohl für die senkrechte als auch die waagrechte Montage des APC810.

Information:

Die angegebenen Luftzirkulationsabstände gelten für den Worst Case Betrieb bei der maximal spezifizierten Umgebungstemperatur (siehe "Temperaturangaben" im Kapitel "Technische Daten").

Können die angegebenen Luftzirkulationsabstände nicht eingehalten werden, sind die maximal spezifizierten Temperaturen der Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" im Kapitel "Technische Daten") vom Anwender zu überwachen und bei Überschreiten dieser Werte entsprechende Maßnahmen zu setzen.

2 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln muss die Biegeradiusspezifikation eingehalten werden.

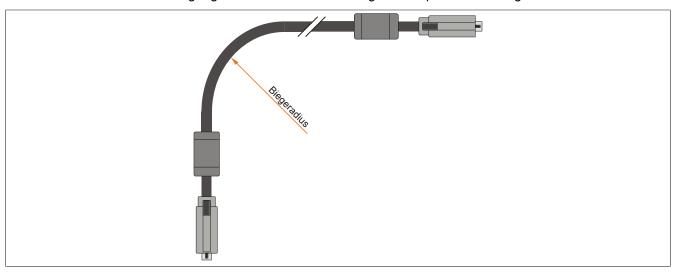


Abbildung 84: Biegeradius Kabelanschluss

Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist dem Automation Panel 800 bzw. dem Automation Panel 900 Anwenderhandbuch, welches in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden kann, zu entnehmen.

3 Erdungskonzept

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutzmaßnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Störfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Störungsableitung und nicht als Berührungsschutz für Personen.

Die Funktionserde des Gerätes besitzt 2 Anschlüsse:

- Spannunsversorgung
- Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Störungen zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät auf möglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.
- Ausführung der Kabel mit mind. 2,5 mm² pro Anschluss; wird ein Kabel mit Aderendhülse an der Feldklemme 0TB103.9 oder 0TB103.91 verwendet ist ein Kabel mit maximal 1,5 mm² pro Anschluss möglich.
- Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerät angeschlossenen Datenkabel sind mit geschirmten Leitungen auszuführen.

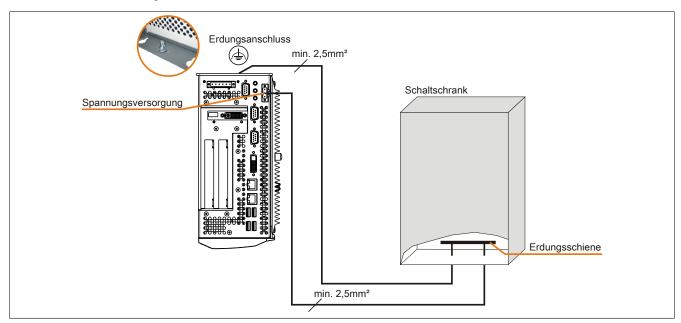


Abbildung 85: Erdungskonzept

4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests

Zweck dieser Anleitung ist die allgemeine Vorgehensweise von applikationsspezifischen Temperaturtests mit B&R Industrie PCs oder Power Panels zu erklären. Diese Anleitung stellt jedoch lediglich eine Richtlinie dar.

4.1 Vorgehensweise

Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollten die Testbedingungen den Bedingungen im Feldeinsatz entsprechen. Dies bedeutet, dass während den Temperaturtests die Zielapplikation laufen sollte, der PC im später verwendeten Schaltschrankgehäuse montiert sein sollte, etc.

Weiters sollte ein Temperatursensor für das zu testende Gerät montiert werden, um die Umgebungstemperatur laufend zu überwachen. Um korrekte Werte zu erhalten, ist dieser in einem Abstand von ca. 5 bis 10 cm vom B&R Industrie PC, in der Nähe der Luftansaugung (nicht in der Nähe der Abgabeluft), anzubringen.

Jeder B&R Industrie PC oder jedes Power Panel ist mit internen Temperatursensoren ausgestattet. Je nach Gerätefamilie sind diese an verschiedenen Positionen angebracht. Die Anzahl und Temperaturgrenzen sind je nach Gerätefamilie unterschiedlich.

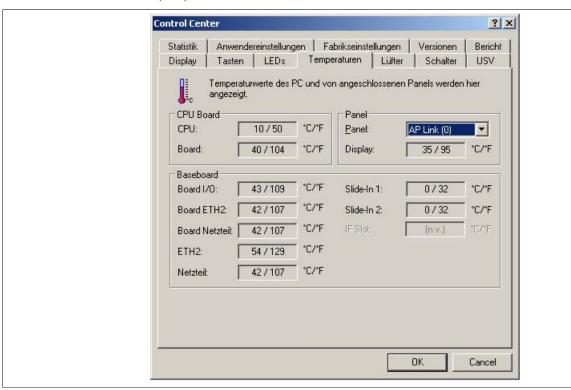
Angaben zur Lage der Temperatursensoren sowie deren maximal spezifizierte Temperaturen sind dem Abschnitt "Temperatursensorpositionen" im Kapitel 2 "Technische Daten" zu entnehmen.

Zur optimalen Bestimmung und Beurteilung der Temperatursituation wird eine Mindesttestzeit von 8 Stunden empfohlen.

4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen

4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center

Zur Auswertung der Temperaturen kann das B&R Control Center verwendet werden. Die Temperaturen können im Reiter "Temperaturen" angesehen werden. Das B&R Control Center kann als freier Download von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Das B&R Control Center verwendet das B&R Automation Device Interface (ADI).



Ist eine historische Aufzeichnung der Daten notwendig, so kann eine eigene Applikation erstellt werden.

Information:

Zur Erstellung einer eigenen Applikation sind auf der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) eigene SDK's verfügbar, wie z.B. das ADI .NET SDK.

4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark

Wird zur Temperaturauswertung keine eigene Applikation erstellt bzw. verwendet, so empfiehlt B&R die Verwendung des Softwaretools BurnIn Test der Firma Passmark.

Das Softwaretool BurnIn ist in einer Standard und Professional Version erhältlich. Zusätzlich zum Softwarepaket sind auch noch verschiedene Loopback Adapter (Seriell, Parallel, USB, ...) und Test-CDs bzw. DVDs erhältlich. Je nach Ausbaustufe der Software und vorhandenen Loopback Adapter kann eine entsprechend hohe Systemund Peripherielast erzeugt werden.

Information:

Loopback Adapter können ebenfalls von der Firma Passmark bezogen werden. Mehr Informationen dazu sind unter www.passmark.com zu finden.

Die nachfolgenden Screenshots beziehen sich auf die Passmark Burnln Pro Version V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD.

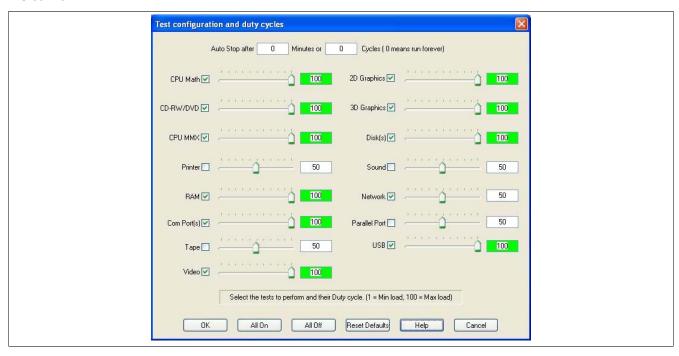


Abbildung 86: Einstellungen für Passmark BurnIn Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD

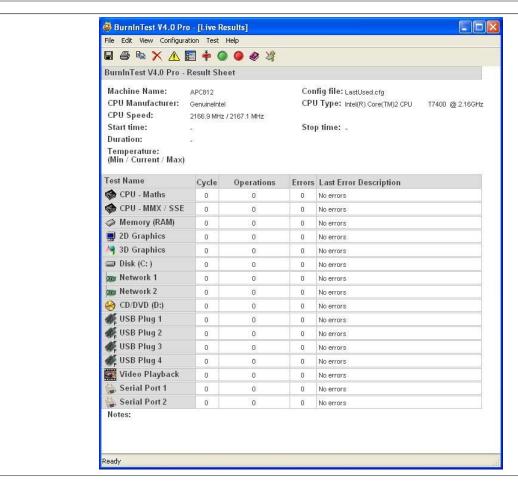


Abbildung 87: Testübersicht eines APC810 2 Slot mit DVD

Je nach Verfügbarkeit der Loopback Adapter und DVDs muss eine entsprechende Feineinstellung in den jeweiligen Testproperties vorgenommen werden.

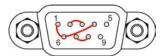
Information:

Stehen keine USB- Loopback Adapter zur Verfügung, so können auch USB Memory Sticks verwendet werden. Die USB Memory Sticks müssen unter Windows als formatiertes Laufwerk zur Verfügung stehen. Der Test USB ist dann abzuwählen und die USB Memory Stick Laufwerke müssen in den Diskproperties als Testdevice konfiguriert werden.



Information:

Serielle Loopback Adapter können relativ einfach selbst erstellt werden. Dazu sind lediglich einige Pins mit Drähten an der seriellen Schnittstelle zu verbinden.



4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.

Die Implementierungsanleitung beschreibt nur die gerätespezifischen Funktionen und nicht die Hauptfunktion der Beispielprogramme.

Wird der Code aus den Beispielprogrammen übernommen, sind die Hinweise in der Implementierungsanleitung zu den TODO Anweisungen, I/O Zugriffsfunktionen usw. zu beachten!

Information:

Für jeden B&R Industrie PC oder jedes Power Panel können Beispielprogramme und Implementierungsanleitungen von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden.

4.4 Auswertung der Messergebnisse

Der aufgezeichnete maximale Temperaturwert jedes einzelnen Sensors darf die in den Anwenderhandbüchern spezifizierte Temperaturgrenze nicht überschreiten.

Wenn die Temperaturtests nicht in einer geregelten Klimakammer durchgeführt werden können, so können diese z.B. in Büroumgebung durchgeführt werden. Dabei ist allerdings die Erfassung der Umgebungstemperatur notwendig. Auf Grund der im Hause B&R gewonnenen Erfahrung, können bei passiven Systemen (Systeme ohne Lüfter Kit) die gemessenen Temperaturwerte linear zur Umgebungstemperatur hochgerechnet werden. Um auch die Temperaturwerte bei Systemen mit Lüfter Kit hochrechnen zu können, müssen die Lüfter laufen. Weiters ist dabei auf die Drehzahl, usw. zu achten.

Werden die Temperaturtests in einer geregelten Klimakammer mit Lüfter durchgeführt, so werden die zu testenden Geräte durch diesen Lüfter gekühlt und somit auch die Messergebnisse verfälscht. Bei passiven Geräten sind die Messergebnisse somit unbrauchbar. Um jedoch auch Temperaturtests in Klimakammern mit Lüfter durchführen zu können ohne die Messergebnisse zu verfälschen, ist der Lüfter der Klimakammer auszuschalten und eine entsprechend große Vorlaufzeit (mehrere Stunden) einzuhalten.

Beispiel anhand eines APC810 2 Slot

Nachfolgendes Beispiel ist nur unter Einhaltung der Montage- und Einbaulagenvorschriften laut Anwenderhandbuch gültig.

Temperatursensor	Gemessene Temperatur	Hochgerechnete Tem	peratur
Umgebungstemperatur	20°C	35°C	45°C
CPU	48°C	63°C	73°C
CPU Board	51°C	66°C	76°C
Board I/O	51°C	66°C	76°C
Board ETH2	52°C	67°C	77°C
Board Netzteil	51°C	66°C	76°C
ETH2	65°C	80°C	90°C
Netzteil	51°C	66°C	76°C

Tabelle 143: Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot

5 Anschlussbeispiele

Die nachfolgenden Beispiele bieten einen Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten, in welcher Art Automation Panel 900 Geräte und/oder Automation Panel 800 Geräte mit dem APC810 verbunden werden können. Es sollen dabei unter anderem folgende Fragen beantwortet werden:

- Wie k\u00f6nnen Automation Panel 900 Ger\u00e4te am Monitor / Panel Ausgang des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Wie k\u00f6nnen Automation Panel 800 Ger\u00e4te am Monitor / Panel Ausgang des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Wie k\u00f6nnen Automation Panel 900 Ger\u00e4te gleichzeitig am Monitor / Panel Ausgang und am optionalen SDL AP Link des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Was bedeutet "Display Clone" und "Erweiterter Desktop" Betrieb?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte können pro Strang angeschlossen werden?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte k\u00f6nnen mit einem Automation Panel 800 Ger\u00e4t pro Strang angeschlossen werden?
- Wie werden die angeschlossenen Geräte intern nummeriert?
- Gibt es Einschränkungen bei der Segmentlänge, wenn ja welche?
- Welche Kabel und Linkbaugruppen werden benötigt?
- · Müssen BIOS Einstellungen für eine bestimmte Konfiguration geändert werden?

5.1 Auswahl der Displayeinheiten

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen, müssen die Geräte den gleichen Displaytyp besitzen. In der folgenden Tabelle werden die möglichen AP900 Geräte aufgelistet die mit einem AP800 Gerät an einem Strang angeschlossen werden können.

Automation Panel 800	Automation Panel 900
5AP820.1505-00	5AP920.1505-01
	5AP951.1505-01
	5AP980.1505-01
	5AP981.1505-01
5AP880.1505-00	5AP920.1505-01
	5AP951.1505-01
	5AP980.1505-01
	5AP981.1505-01

Tabelle 144: Auswahl der Displayeinheiten

5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard

An die integrierte DVI Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 mit max. SXGA Auflösung angeschlossen. Alternativ kann auch ein Office TFT mit DVI Schnittstelle oder ein analoger Monitor (über Adapter Best. Nr. 5AC900.1000-00) betrieben werden. Touch Screen und USB werden jeweils über eigene Kabel geführt. Sollen USB Geräte am Automation Panel 900 betrieben werden, so kann die Distanz max. 5 Meter betragen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

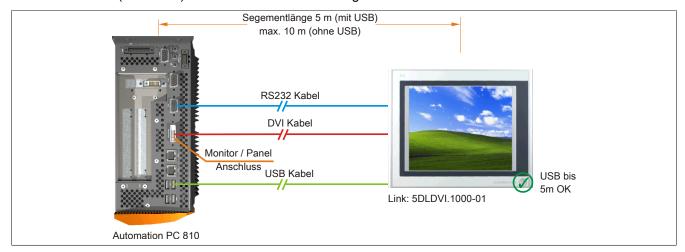


Abbildung 88: Ein Automation Panel 900 über DVI onboard (Symbolfoto)

5.2.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit			Einschränkung	
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	✓	✓	max. SXGA

Tabelle 145: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.2.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLDVI.1000-01	Automation Panel Link DVI Receiver	für Automation Panel 900
	Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug-	
	klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	

Tabelle 146: Linkbaugruppen

5.2.3 Kabel

Auswahl jeweils eines Automation Panel 900 Kabels aus den 3 benötigten Typen.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	5 m ±80 mm
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	10 m ±100 mm
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	5 m ±80 mm
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	10 m ±100 mm
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	5 m ±50 mm

Tabelle 147: Kabel für DVI Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

Es können folgende Automation Panel 900 Geräte verwendet werden, wobei in seltenen Fällen eine Einschränkung der Segmentlänge in Abhängigkeit der Auflösung besteht.

Bestellnummer	Diagonale	Auflösung	Touchscreen	Tasten	max. Segmentlänge
5AP920.1043-01	10,4"	VGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1214-01	12,1"	SVGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1505-01	15,0"	XGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1706-01	17,0"	SXGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1906-01	19,0"	SXGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾

Tabelle 148: Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

1) Keine USB Unterstützung am Automation Panel 900 möglich, da USB nur bis 5 m begrenzt einsetzbar ist.

Information:

Bei der Übertragunsart DVI ist kein Auslesen von Statistikwerten bei den Automation Panel 900 Geräten möglich.

5.2.5 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

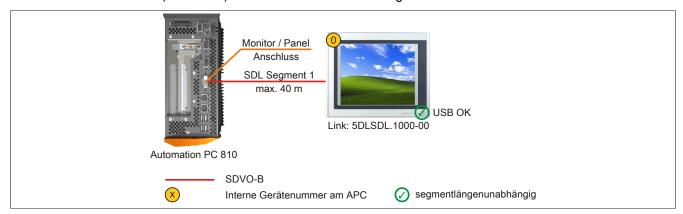


Abbildung 89: Ein Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.3.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 149: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.3.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver	für Automation Panel 900
	Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-	
	vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	

Tabelle 150: Linkbaugruppen

5.3.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm

Tabelle 151: Kabel für SDL Konfigurationen

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 151: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel			Auflö	sung		
	VGA	SVGA	XGA	SXGA	UXGA	FHD
Segmentlänge [m]	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080
	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
1,8	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
5	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
10	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
15	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-
20	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-	-
20	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-
30	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 152: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.3.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.4 Ein Automation Panel 800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 800 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Extension Keyboard angeschlossen werden.

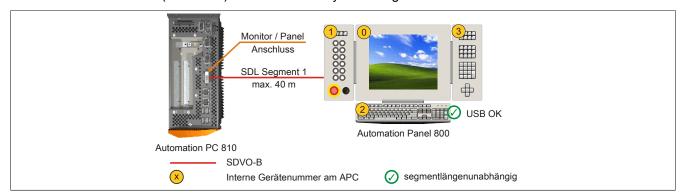


Abbildung 90: Ein Automation Panel 800 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.4.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board		mit Syste	emeinheit		Einschränkung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 153: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.4.2 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 800 SDL Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 25 m.	25 m ±230 mm
5CASDL.0300-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm

Tabelle 154: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel	Auflösung
Segmentlänge [m]	XGA 1024 x 768
1,8	5CASDL.0018-20
5	5CASDL.0050-20
10	5CASDL.0100-20
15	5CASDL.0150-20
20	5CASDL.0200-20
25	5CASDL.0250-20
30	5CASDL.0300-30
40	5CASDL.0400-30

Tabelle 155: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.4.3 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.5 Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) sind ein Automation Panel 900 und ein Automation Panel 800 über SDL angeschlossen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den beiden Displays unterstützt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur am ersten Display (front- und rückseitig), bis maximal 40 m, zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Automation Panel 900 bzw. am Extension Keyboard angeschlossen werden.

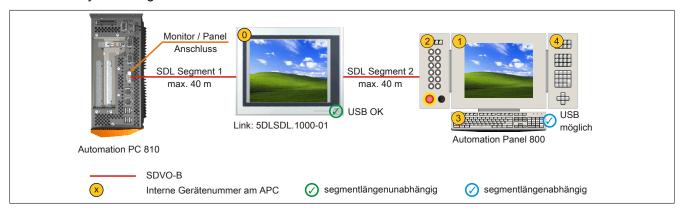


Abbildung 91: Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.5.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board		mit Systemeinheit				
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung	
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. UXGA	
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. UXGA	
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. UXGA	
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. UXGA	
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. UXGA	
5PC800.B945-05	✓	1	1	✓	max. UXGA	

Tabelle 156: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.5.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver	für Automation Panel 900
	Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten,	
	und Servicedaten, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert	
	bestellen).	

Tabelle 157: Linkbaugruppen

5.5.3 Kabel

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 194.

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 196.

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehör".

5.5.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. An diesem Automation Panel werden bis zu drei weitere Automation Panel des selben Typs über SDL Kabel betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr am ersten Panel (front- und rückseitig) zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

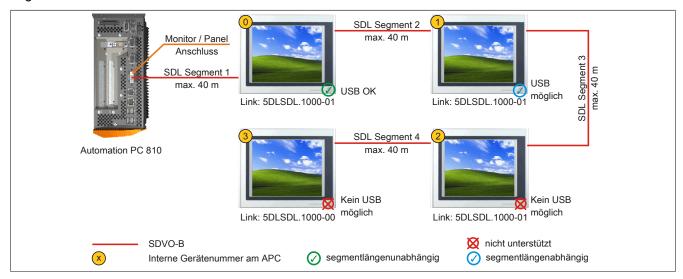


Abbildung 92: Vier Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.6.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board		Einschränkung			
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 158: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.6.2 Linkbaugruppen

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver	für Automation Panel 900
	Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-	
	vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver	für Automation Panel 900
	Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten,	
	und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert	
	bestellen).	

Tabelle 159: Linkbaugruppen

5.6.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 160: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel			Auflö	isung		
Segmentlänge [m]	VGA	SVGA	XGA	SXGA	UXGA	FHD
	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03		- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	-		
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13		- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 161: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.6.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.7 Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

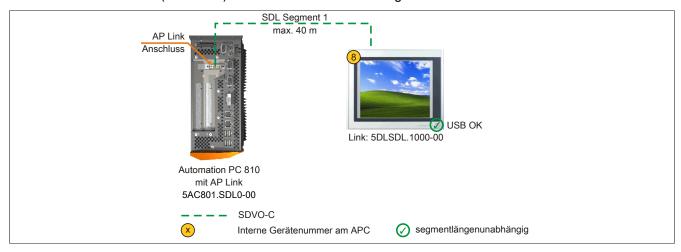


Abbildung 93: Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)

5.7.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board		Einschränkung			
	5PC810.SX01-00 ¹⁾	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung
5PC800.B945-00		/	,	,	max. UXGA
5PC800.B945-10	-	•	,	,	
5PC800.B945-01		,		,	max. UXGA
5PC800.B945-11	-	•	,	~	
5PC800.B945-02		,		,	max. UXGA
5PC800.B945-12	-	•	,	V	
5PC800.B945-03		,	,	,	max. UXGA
5PC800.B945-13	-	•	,	~	
5PC800.B945-04		/	,	,	max. UXGA
5PC800.B945-14	-	~	'	~	
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 162: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.7.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver	für Automation Panel 900
	Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-	
	vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter	für Automation PC 810
	Automation Panel Link Transmitter SDL	

Tabelle 163: Linkbaugruppen

5.7.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 164: Kabel für SDL Konfigurationen

¹⁾ Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

Inbetriebnahme • Anschlussbeispiele

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 164: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel			Auflö	isung		
0	VGA	SVGA	XGA	SXGA	UXGA	FHD
Segmentlänge [m]	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080
	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
1,8	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
·	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
5	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
10	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
15	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-
20	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-	-
25	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-
30	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 165: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.7.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am AP Link Anschluss, muss die COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.8 Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 über ein SDL Kabel angeschlossen. An diesem Automation Panel werden drei weitere Automation Panel des selben Typs über SDL betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr am ersten Panel (front- und rückseitig) zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

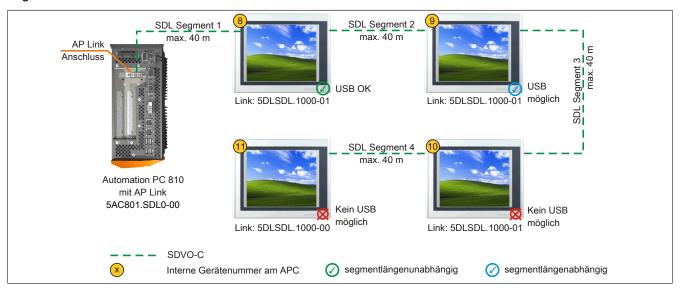


Abbildung 94: Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)

5.8.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board		Einschränkung			
	5PC810.SX01-001)	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 166: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

¹⁾ Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.8.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 167: Linkbaugruppen

5.8.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 168: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA	SVGA	XGA	SXGA	UXGA	FHD	
	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080	
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-	
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-	
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03	

Tabelle 169: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

SDL Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080	
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-	
	5CASDL.0200-03 5CASDL.0250-00	5CASDL.0200-03 5CASDL.0250-00	5CASDL.0200-03 5CASDL.0250-00	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03	
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	- -	-	
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-	
30	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13	
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13	

Tabelle 169: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.8.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am AP Link Anschluss, muss die COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.9 Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 (max. UXGA) über SDL angeschlossen. An dem optionalen SDL Transmitter (AP Link) wird ein weiteres Automation Panel 900 (max. UXGA) über SDL betrieben. Die Automation Panel zeigen unterschiedliche Bildinhalte (Erweiterter Desktop) und können verschiedene Typen sein.

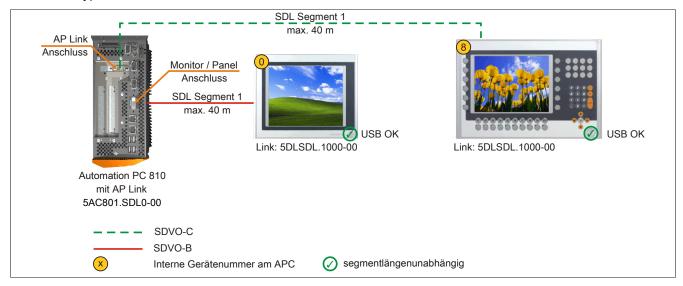


Abbildung 95: Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)

5.9.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board		mit Syste	emeinheit	Eins			
	5PC810.SX01-001)	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung		
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	-	✓	✓	✓	max. UXGA		
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	-	✓	✓	✓	max. UXGA		
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	-	✓	✓	✓	max. UXGA		
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	-	✓	✓	✓	max. UXGA		
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	-	✓	✓	✓	max. UXGA		
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA		

Tabelle 170: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.9.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver	für Automation Panel 900
	Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter	für Automation PC 810
	Automation Panel Link Transmitter SDL	

Tabelle 171: Linkbaugruppen

Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.9.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 172: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel			Auflö	sung		
	VGA	SVGA	XGA	SXGA	UXGA	FHD
Segmentlänge [m]	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080
	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
1,8	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
5	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
10	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
15	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-
20	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-	-
25	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-
30	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 173: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.9.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Inbetriebnahme • Anschlussbeispiele

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel bzw. AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.10 Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind vier Automation Panel 900 (max. UXGA) über SDL angeschlossen. An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) werden zusätzlich vier Automation Panel 900 (max. UXGA) betrieben. Die Automation Panel in jedem Strang müssen jeweils vom gleichen Typ sein. Die Bildinhalte der beiden Stränge sind verschieden (Erweiterter Desktop), wobei die Panel im jeweiligen Strang denselben Bildinhalt (Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) der beiden Stränge unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr jeweils am ersten Panel jedes Stranges zur Verfügung. USB Geräte können dabei nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

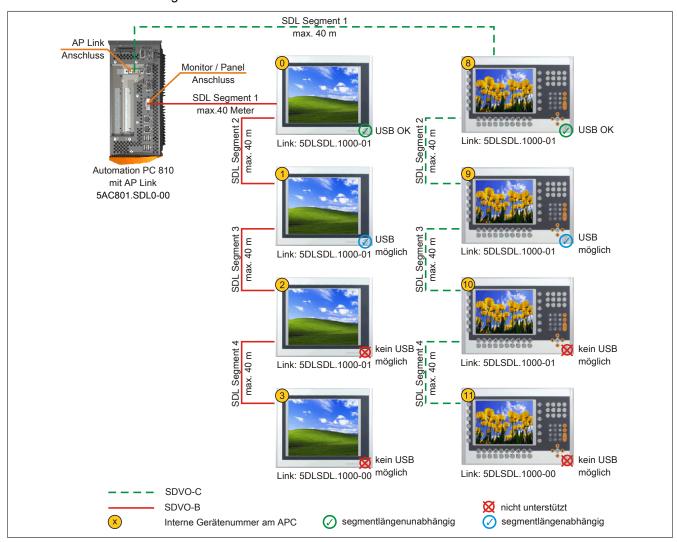


Abbildung 96: Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)

5.10.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board		Einschränkung			
	5PC810.SX01-00 ¹⁾	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 174: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

Inbetriebnahme • Anschlussbeispiele

CPU Board		Einschränkung			
	5PC810.SX01-00 ¹⁾	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung
5PC800.B945-03		/	,	,	max. UXGA
5PC800.B945-13	-	•	•	•	
5PC800.B945-04		/	,		max. UXGA
5PC800.B945-14	_	•	V	•	
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 174: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.10.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 175: Linkbaugruppen

5.10.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 176: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

¹⁾ Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel	Auflösung						
Segmentlänge [m]	VGA	SVGA	XGA	SXGA	UXGA	FHD	
	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080	
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-	
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-	
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03	
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-	
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03	
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	-		-	
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13		- 5CASDL.0300-13	
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13	

Tabelle 177: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.10.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel bzw. AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.11 Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind drei Automation Panel 900 (max. UXGA) und ein Automation Panel 800 über SDL angeschlossen. An den optionalen SDL Transmitter werden zusätzlich drei Automation Panel 900 (max. UXGA) und ein Autoamtion Panel 800 betrieben. Die Automation Panel in jedem Strang müssen jeweils vom gleichen Typ sein. Die Bildinhalte der beiden Stränge sind verschieden (Erweiterter Desktop), wobei die Displays im jeweiligen Strang denselben Bildinhalt (Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Displays unterstützt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur am ersten Display (front- und rückseitig), bis maximal 40 m, zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an den Automation Panel 900 Geräten angeschlossen werden.

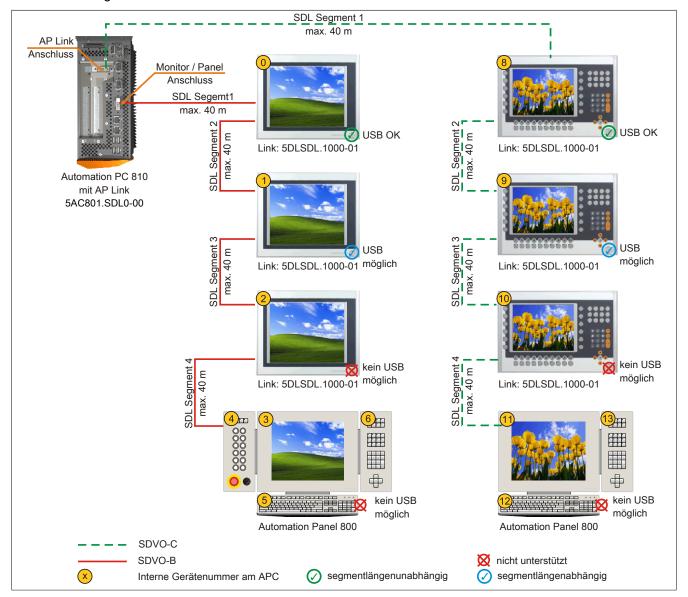


Abbildung 97: Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)

5.11.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen, müssen die Geräte den gleichen Displaytyp besitzen.

CPU Board		Einschränkung			
	5PC810.SX01-00 ¹⁾	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 178: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.11.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 179: Linkbaugruppen

5.11.3 Kabel

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 194.

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 196

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehör".

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel	Auflösung					
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	
	-	-	5CASDL.0018-00	-	-	
4.0	-	-	5CASDL.0018-01	-	-	
1,8	-	-	5CASDL.0018-20	-	-	
	-	-	5CASDL.0018-03	-	-	
	-	-	5CASDL.0050-00	-	-	
_	-	-	5CASDL.0050-01	-	-	
5	-	-	5CASDL.0050-20	-	-	
	-	-	5CASDL.0050-03	-	-	
	-	-	5CASDL.0100-00	-	-	
40	-	_	5CASDL.0100-01	-	-	
10	-	-	5CASDL.0100-20	-	-	
	-	-	5CASDL.0100-03	-	-	
	-	-	5CASDL.0150-00	-	-	
45	-	-	5CASDL.0150-01	-	-	
15	-	_	5CASDL.0150-20	-	-	
	-	-	5CASDL.0150-03	-	-	
	-	-	5CASDL.0200-00	-	-	
20	-	-	5CASDL.0200-20	-	-	
	-	-	5CASDL.0200-03	-		
	-	-	5CASDL.0250-00	-	-	
25	_	_	5CASDL.0250-20	-	_	
	_	-	5CASDL.0250-03	-	_	

Tabelle 180: Segmentlängen, Auflösungen und SDL Kabel

¹⁾ Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

Inbetriebnahme • Anschlussbeispiele

Kabel			Auflösung				
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200		
	-	-	5CASDL.0300-10	-	-		
30	_	-	5CASDL.0300-13	_	-		
	-	-	5CASDL.0300-30	-	-		
	-	-	5CASDL.0400-10	-	-		
40	_	-	5CASDL.0400-13	_	-		
	-	-	5CASDL.0400-30	-	-		

Tabelle 180: Segmentlängen, Auflösungen und SDL Kabel

5.11.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel bzw. AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

6 Anschluss von USB Peripheriegeräten

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

6.1 Lokal am APC810

An die 5 USB Schnittstellen können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können die USB Schnittstellen USB1, USB3 und USB5 hierzu jeweils mit 1A bzw. die USB Schnittstellen USB2 und USB4 jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.



Abbildung 98: Anschluss von USB Peripheriegeräten lokal am APC810

6.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.

Information:

Am Automation Panel 900 kann kein HUB, sondern es können nur Endgeräte angeschlossen werden.



Abbildung 99: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP900 über DVI

6.3 Remote am Automation Panel 800 / 900 über SDL

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 bzw. USB Anschlüsse bei Automation Panel 800 Geräten können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 1.1.

Information:

Am Automation Panel 800/900 kann kein HUB, sondern es können nur Engeräte angeschlossen werden.



Abbildung 100: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP800/900 über SDL

7 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

Information:

Die nachfolgende Softwarebeschreibung ist für die PCI SATA Controller 5ACPCI.RAIC-01, 5ACPCI.RAIC-05 und 5ACPCI.RAIC-06 gültig.

Für die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des "RAID Configuration Utility" einzusteigen. Nach dem POST <Strg+S> oder <F4> Drücken um das RAID BIOS aufzurufen.

```
SiI 3512A SATARaid BIOS Verison 4.3.79
Copyright (C) 1997-2006 Silicon Image, Inc.

Press <Ctrl+S> or F4 to enter RAID utility

0 ST96023AS
55 GB
1 ST96023AS
55 GB
```

Abbildung 101: Einstieg in das RAID Configuration Utility

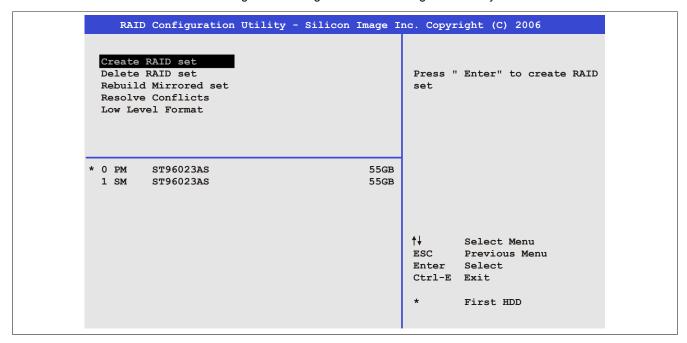


Abbildung 102: RAID Configuration Utility - Menü

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
Cursor ↑	Zum vorherigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Enter	Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermenüs.
ESC	Rücksprung zum vorherigen Menü.
Ctrl+E	Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 181: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility

7.1 Create RAID Set

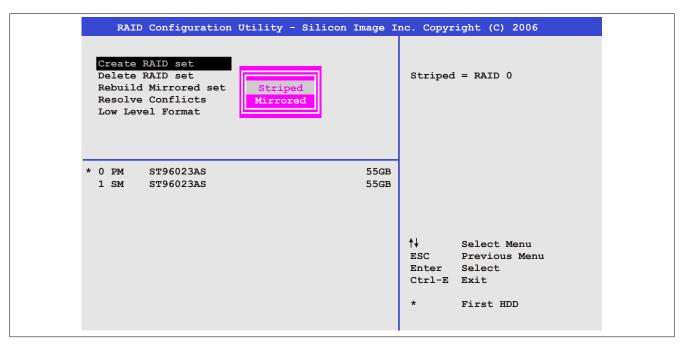


Abbildung 103: RAID Configuration Utility - Menü

Über das Menü "Create RAID set" ist es möglich das RAID System als "Striped" = RAID0 oder "Mirrored" = RAID1 neu zu erstellen.

7.2 Create RAID Set - Striped

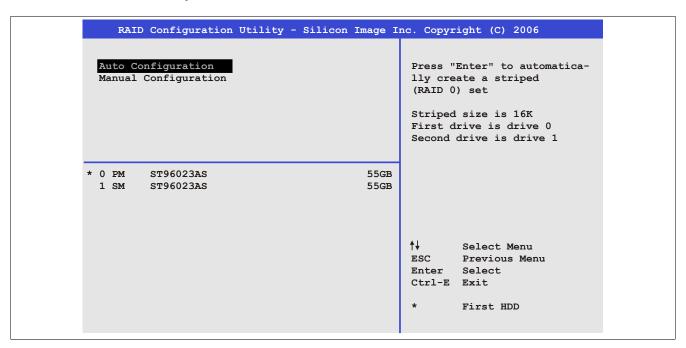


Abbildung 104: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped

"Auto Configuration"

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

"Manual Configuration"

Es ist möglich die erste und zweite HDD zu bestimmen sowie die "Chunk Size" (=Blockgröße, applikationsabhängig) auszuwählen.

7.3 Create RAID Set - Mirrored

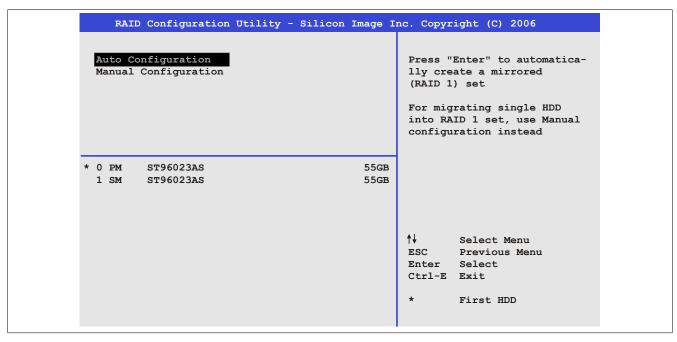


Abbildung 105: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored

"Auto Configuration"

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

"Manual Configuration"

Es ist möglich die "Source" und "Target" HDD zu bestimmen, sowie ob sofort ein Rebuild (Spiegelung) durchgeführt werden soll (Dauer ca. 50 Minuten) oder nicht.

7.4 Delete RAID Set

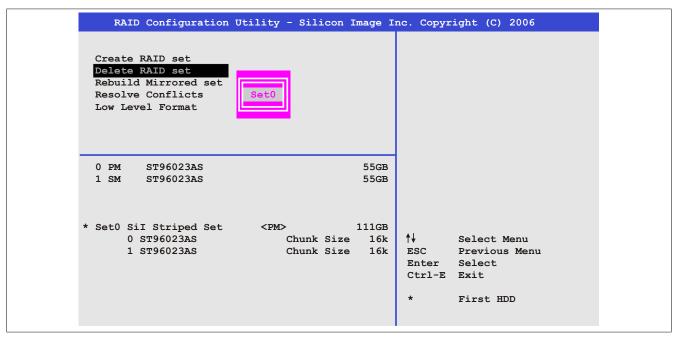


Abbildung 106: RAID Configuration Utility - Delete RAID set

Über das Menü "Delete RAID set" kann ein bestehender RAID Verbund aufgelöst werden.

7.5 Rebuild Mirrored Set

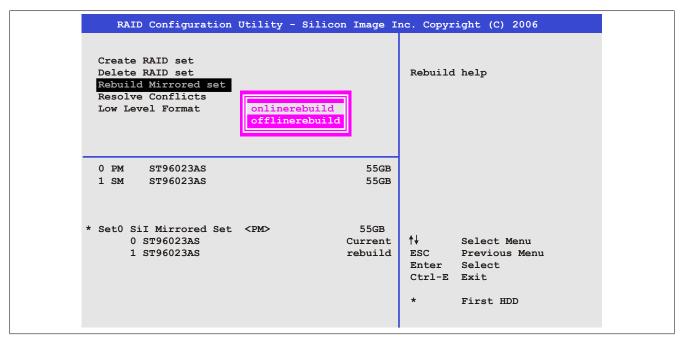


Abbildung 107: RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set

Über das Menü "Rebuild Mirrored set" kann ein Rebuild Vorgang bei RAID 1 Verbund bei einem Fehlerfalle, nach vorheriger Unterbrechung des Rebuild Vorganges oder beim Tausch einer Hard Disk neu gestartet werden.

Bei der Auswahl "onlinerebuild" wird der Rebuild nach dem Hochfahren des Systems im laufenden Betrieb durchgeführt. Durch z.B. das installierte SATA RAID Konfigurationsprogramm wird ein Event Pop Up angezeigt: SA-TARaid detected a new event und der Rebuild wird gestartet. Dauer des kompletten Rebuilds beträgt ca. 50 Minuten.

Bei der Auswahl "offlinerebuild" wird sofort ein Rebuild vor dem Start des Beriebssystems durchgeführt (Dauer abhänging von der jeweiligen Speichergröße).

7.6 Resolve Conflicts

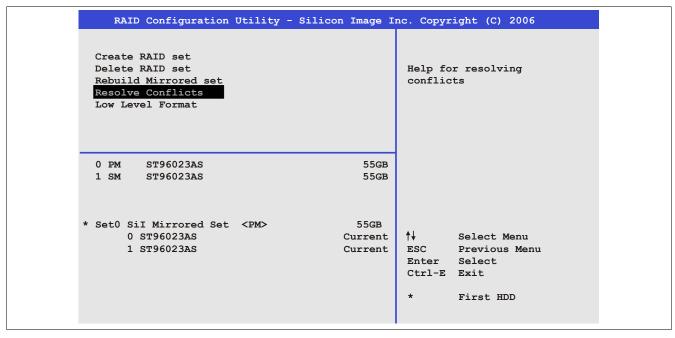


Abbildung 108: RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts

Über das Menü "Resolve Conflicts" kann man Konflikte eines RAID Verbundes lösen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Status der Festplatten "conflict" ist.

7.7 Low Level Format

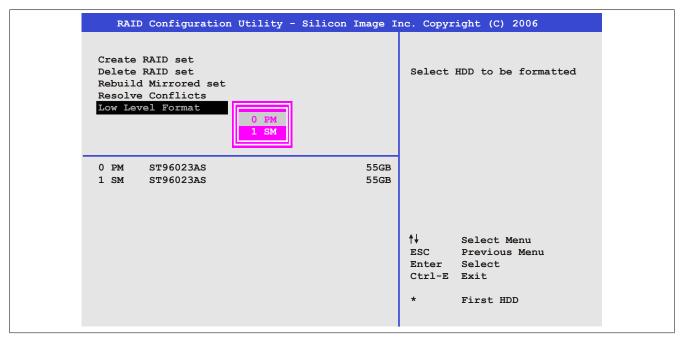


Abbildung 109: RAID Configuration Utility - Low Level Format

Über das Menü "Low Level Format" können einzelne Hard Disks formatiert werden. Zu diesem Zweck darf kein RAID Verbund konfiguriert sein. Ein Low Level Format einer Festplatte dauert ca. 40 Minuten.

8 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Die nachfolgend aufgelisteten Punkte sind bis einschließlich 07.05.2008 bei den APC800 Geräten des ersten Fertigungsloses bekannt:

- Die Hardware Security Key Schnittstelle wird ab der MTCX FPGA Version 00.06 unterstützt.
- Die Statusanzeige der Link bzw. Activity LED der ETH1 Schnittstelle funktionierte noch nicht korrekt. Die Netzwerkverbindung wurde dadurch aber nicht beeinträchtig. Ab den Hardwarerevisionen 5PC810.SX02-00 (Revision B0) und 5PC800.B945-0x (Revision B0) funktioniert die Statusanzeige korrekt.
- Sporadisch konnte es bei einem Power On passieren, dass die ETH2 Schnittstelle nicht initialisiert wurde und diese somit nicht funktionierte. Das Problem konnte durch einen Reset bzw. Warmstart (Strg+Alt+Entf) behoben werden. Ab der MTCX FPGA Version 00.03 ist dieses Problem behoben.
- First Boot Agent Windows XP Embedded und eingebautes SATA HDD Laufwerk vor dem Einstecken einer CompactFlash mit einem Windows XP Embedded Image und Ausführung des First Boot Agent muss die BIOS Einstellung "Legacy IDE Channels" unter Advanced - IDE Configuration auf "PATA only" eingestellt werden oder es kann das SATA Laufwerk zuvor entfernt werden.
- Bei Verwendung von zwei Grafiksträngen werden beim Windows XP Grafiktreiber die Bezeichnungen "Digitalanzeige" für den Monitor / Panel Stecker und "Digitalanzeige 2" für den AP Link Stecker zugewiesen. In der Betriebsart "Erweiterter Desktop" zeigt sich folgendes Verhalten: Wird das Anzeigegerät Digitalanzeige am Monitor / Panel Stecker entfernt (z.B. Kabelbruch), so wird automatisch die Digitalanzeige 2 zur Digitalanzeige und somit wechseln auch die getätigten Einstellungen im Grafiktreiber von der Digitalanzeige 2 zur Digitalanzeige über. Beim nächsten Reboot des Systems wird der Bildinhalt vom Monitor / Panel Stecker auf den AP Link Stecker umgeleitet. Wird nun die BIOS Option "SDVO/DVI Hotplug Support" auf "Enabled" (zu finden unter dem BIOS Menüpunkt "Advanced Graphics Configuration") gestellt, wird sofort der Bildinhalt automatisch vom getrennten Monitor / Panel Stecker auf den 2'ten Grafikstrang am AP Link Stecker umgeleitet.
- Besonderheiten beim "Kurzen Ausschalten" Befindet sich der APC810 im "Standby" Betrieb Power LED leuchtet rot (z.B. Windows XP herunterfahren) hält die Pufferung auf Grund von Kondensatoren und dem geringen Leistungsverbrauch etwas länger an. Ist im BIOS die Option "Power Loss Control" auf "Power On" oder "Last State" eingestellt, kann es trotzdem vorkommen, dass das System nicht wieder neu startet, da kein Power Off/On erkannt wurde. Um mit diesen Systemeinheiten sicher zu gehen, dass das System nach einem Power Off/On wieder startet, sollte die Abschaltzeit mindestens 10 Sekunden betragen.
- Ab der MTCX PX32 Firmware ≥ V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert, das heißt, dass das Gerät trotz gedrückter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32 Firmware < V00.11 startet das System bei längerem Drücken (ca. 10 Sekunden) und wiederloslassen des Reset Tasters nicht mehr.
- Hardwarerevision B0 des Slide-in DVD-ROM 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfähigkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugfähig.
- Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs zu Problemen führen. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt wird. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten älterer Technologie benötigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfür während des Hochlaufs zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwendeten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.
- Im Daisy Chain Betrieb von mehreren AP800/AP900 Geräten via SDL kann es bei der Erkennung des Touchcontrollers zur Anzeige eines roten "X" beim Touchcontroller Status im Control Center Applet des Touchtreibers kommen. Die Funktion des Touchsystems ist dadurch nicht beeinträchtigt. Dies kann durch Einstellen einer Panel Sperrzeit von 50 ms vermieden werden. Die Panel Sperrzeit kann mit dem B&R Key Editor konfiguriert werden.

Kapitel 4 • Software

1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Menüpunkte einschließlich Beschreibungen beziehen sich auf die BIOS Version 1.18. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschreibungen nicht mit der installierten BIOS Version übereinstimmen.

1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkürzung für "Basic Input and Output System". Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS des American Megatrends Inc. verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermöglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Drücken des Power Buttons wird das BIOS aktiviert. Es wird überprüft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM "OK" sind. Sind diese "OK", werden sie in das CMOS übertragen. Sind diese "nicht OK", werden die CMOS Daten auf Gültigkeit überprüft. Sind die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste <Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, überprüft das System und konfiguriert es durch den Power On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser "Vorbereitungen" durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Festplatte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und übergibt diesem die Kontrolle über die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die "Entf" Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedrückt werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (während POST): "Press DEL to run Setup"

```
AMIBIOS(C)2003 American Megatrends, Inc.
[APC2R118] Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik H1.18
                 : 133453
Serial Number
CPU : Intel(R) Core(TM)2 CPU
                                       T7400 @ 2.16GHz
 Speed: 2.16 Ghz
Press DEL to run Setup
Press T11 for DDS POPUP
The MCH is operating with DDR2-677/CL5 in Dual-Channel Interleaved Mode
Initializing USB Controllers .. Done
2048MB OK
USB Device(s): 1 Keyboard, 1 Hub
Auto-Detecting Sec Master..IDE Hard Disk
Auto-Detecting Sec Slave...IDE Hard Disk
Sec Master: SILICONSYSTEMS INC 4GB 240-0230
Sec Slave : SILICONSYSTEMS INC 4GB 240-0230
Auto-Detecting USB Mass Storage Devices ...
00 USB mass storage devices found an configured.
```

Abbildung 110: Boot Screen

1.2.1 BIOS Setup Tasten

Folgende Tasten sind während dem POST aktiviert:

Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers angenommen.

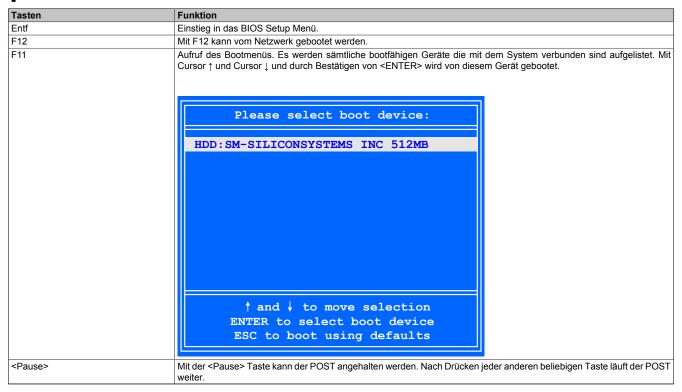


Tabelle 182: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
F1	Generelle Hilfe.
Cursor ↑	Zum vorigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Cursor ←	Zum vorigen Objekt.
Cursor →	Zum nächsten Objekt.
+-	Ändert die Einstellung der ausgewählten Funktion.
Enter	In das ausgewählte Menü wechseln.
Bild ↑	Auf die vorherige Seite wechseln.
Bild ↓	Auf die nächste Seite wechseln.
Pos 1	Man springt zum ersten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
Ende	Man springt zum letzten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
F2 / F3	Die Farben des BIOS Setups werden getauscht.
F7	Änderungen werden zurückgesetzt.
F9	CMOS Default Werte für alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10	Speichern und schließen.
Esc	Untermenü verlassen.

Tabelle 183: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü

1.3 Main

Unmittelbar nach Drücken der Taste "Entf" beim Systemstart erscheint das Hauptmenü des BIOS Setups:

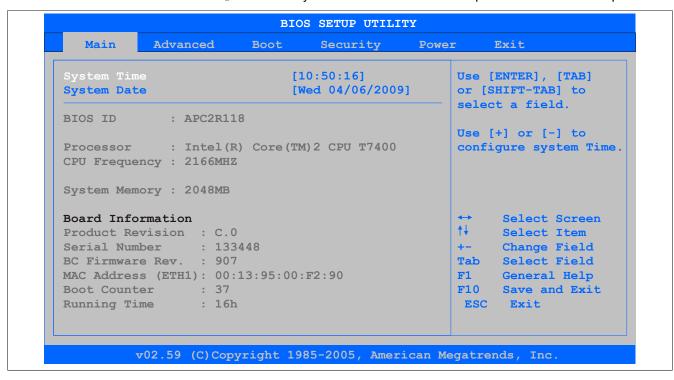


Abbildung 111: 945GME BIOS Main Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
System Time	Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batte- rie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung der Systemzeit	Individuelle Einstellung der Systemzeit im Format Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).
System Date	Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung vom Systemdatum	Individuelle Einstellung des Systemdatums im Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).
BIOS ID	Anzeige der BIOS Erkennung.	keine	-
Processor	Anzeige des Prozessortyps.	keine	-
CPU Frequency	Anzeige der Prozessor Frequenz.	keine	-
System Memory	Anzeige der Arbeitsspeichergröße.	keine	-
Product Revision	Anzeige der HW-Revision des CPU Boards.	keine	-
Serial Number	Anzeige der Serialnummer des CPU Boards.	keine	-
BC Firmware Rev.	Anzeige der Firmware Revision des CPU Board-controllers.	keine	-
MAC Address (ETH1)	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH1 Schnittstelle.	keine	-
Boot Counter	Anzeige des Boot Zählers - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins (max. 16777215).	keine	-
Running Time	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden. (max. 65535).	keine	-

Tabelle 184: 945GME Main Menü Einstellmöglichkeiten

1.4 Advanced



Abbildung 112: 945GME Advanced Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ACPI Configuration	Konfiguration der ACPI Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "ACPI Configuration" auf Seite 230
PCI Configuration	Konfiguration der PCI Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Configuration" auf Seite 231
PCI Express Configuration	Konfiguration der PCI Express Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Configuration" auf Seite 234
Graphics Configuration	Konfiguration der Grafikeinstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Graphics Configuration" auf Seite 236
CPU Configuration	Konfiguration der CPU Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Configuration" auf Seite 238
Chipset Configuration	Konfiguration der Chipset Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Chipset Configuration" auf Seite 239
I/O Interface Configuration	Konfiguration der I/O Geräte Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "I/O Interface Configuration" auf Seite 240
Clock Configuration	Konfiguration der Clock Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Clock Configuration" auf Seite 241
IDE Configuration	Konfiguration der IDE Funktionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "IDE Configuration" auf Seite 241
USB Configuration	Konfiguration der USB Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "USB Configuration" auf Seite 247
Keyboard/Mouse Confi- guration	Konfiguration der Keyboard/Mouse Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Keyboard/Mouse Configuration" auf Sei- te 248
Remote Access Configuration	Konfiguration der Remote Access Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Remote Access Configuration" auf Seite 249
CPU Board Monitor	Zeigt die aktuellen Spannungen wie auch die aktuellen Temperaturen des verwendeten Prozessors an.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Board Monitor" auf Seite 251
Baseboard/Panel Fea- tures	Anzeige gerätespezifischer Informationen und Einstellung gerätespezifischer Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard/Panel Features" auf Seite 252

Tabelle 185: 945GME Advanced Menü Einstellmöglichkeiten

1.4.1 ACPI Configuration

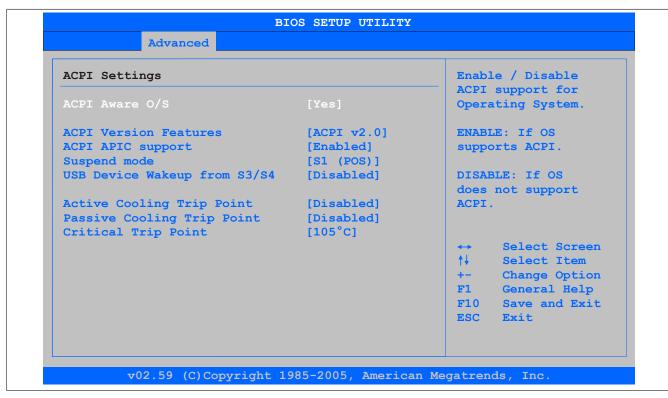


Abbildung 113: 945GME Advanced ACPI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ACPI Aware O/S	Über diese Funktion wird festgelegt, ob das Be-	Yes	Das Betriebssystem unterstützt ACPI.
	triebssystem die ACPI-Funktion (Advanced Configuration and Power Interface) unterstützt.	No	Das Betriebssystem unterstützt ACPI nicht.
ACPI Version Features	Option zum Einstellen der zu unterstützenden	ACPI v1.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v1.0
	Energieoptionsspezifikationen. Die Nutzung der	ACPI v2.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v2.0
	ACPI-Funktionen setzt eine entsprechende Unterstützung in den Treibern sowie in den eingesetzten Betriebssystemen voraus.	ACPI v3.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v3.0
ACPI APIC support	Über diese Option wird die Unterstützung des	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Advanced Programmable Interrupt Controllers im Prozessor festgelegt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion
Suspend mode	Auswahl des ACPI Status welcher bei Aktivierung des Suspend Modus verwendet werden soll.	S1 (POS)	Einstellung S1 als Suspend Mode. Es werden nur wenige Funktionen ausgeschaltet und diese stehen auf Tastendruck wieder zur Verfügung
		S3 (STR)	Einstellung S3 als Suspend Mode. Hier wird der aktuelle Zustand des Betriebssystems in das RAM geschrieben und nur dieser wird dann mit Strom versorgt.
USB Device Wakeup from	Mit dieser Option kann eine Aktivität an einem an-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
S3/S4	geschlossenen USB-Gerät das System aus dem S3/S4 Schlafzustand aufwecken.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Active Cooling Trip Point	Über diese Funktion wird ein optionaler CPU Lüf-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	ter über das Betriebssystem eingeschaltet, wenn die eingestellte CPU Temperatur erreicht ist.	50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C	Temperatureinstellung für den Active Cooling Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.
Passive Cooling Trip Point	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	CPU Temperatur das Betriebssystem die CPU Geschwindigkeit drosselt.	50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C	Temperatureinstellung für den Passive Cooling Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.
Critical Trip Point	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher CPU Temperatur das Betriebssystem das System herunterfährt.	80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C, 105°C, 110°C	Temperatureinstellung für den Critical Trip Point. In 5 Grad Schritten einstellbar.

Tabelle 186: 945GME Advanced ACPI Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.2 PCI Configuration

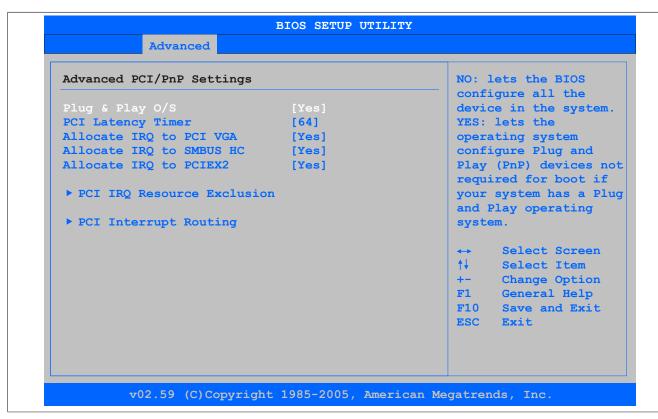


Abbildung 114: 945GME Advanced PCI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Plug & Play O/S	Dem BIOS kann hier mitgeteilt werden ob das verwendete Betriebssystem Plug & Play-fähig ist.	Yes	Das Betriebssystem übernimmt die Verteilung der Ressourcen.
		No	BIOS übernimmt die Verteilung der Ressourcen.
PCI Latency Timer	Diese Option kontrolliert, wie lange (in PCI-Ticks) eine Karte des PCI-Bus den Master noch für sich beanspruchen darf, wenn eine andere PCI-Karte bereits einen Zugriff angemeldet hat.	32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 248	Manuelle Einstellung des Wertes in PCI-Ticks.
Allocate IRQ to PCI VGA	Mit dieser Funktion wird festgelegt ob dem PCI VGA ein Interrupt zugewiesen wird.	Yes	Automatische Zuweisung eines Interrupts.
		No	Keine Zuweisung eines Interrupts.
Allocate IRQ to SMBUS	Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der SM	Yes	Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
HC	(System Management) Bus Controller einen PCI Interrupt zugewiesen bekommt oder nicht.	No	Keine Zuweisung eines Interrrupts.
Allocate IRQ to PCIEX2	Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der	Yes	Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
	PCIEX2 einen PCI Interrupt zugewiesen bekommt oder nicht.	No	Keine Zuweisung eines Interrrupts.
PCI IRQ Resource Exclusion	Konfiguration der PCI IRQ Resource Einstellungen für ISA Legacy Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI IRQ Resource Exclusion" auf Seite 232
PCI Interrupt Routing	Konfiguration des PCI Interrupt Routings	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Interrupt Routing" auf Seite 233

Tabelle 187: 945GME Advanced PCI Configuration Einstellmöglichkeiten

PCI IRQ Resource Exclusion

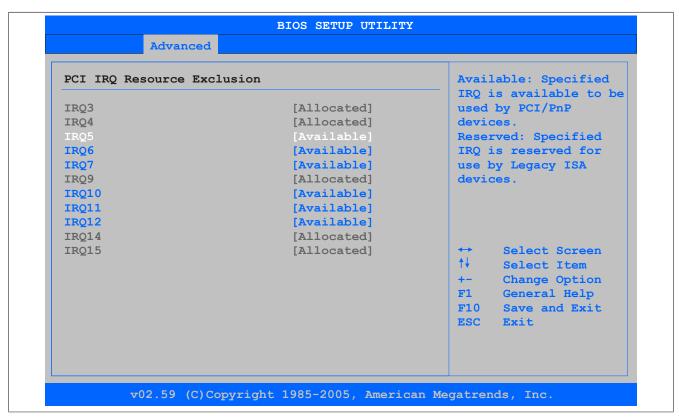


Abbildung 115: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
IRQx	IRQ Interruptzuweisung für Legacy ISA Geräte.	Allocated	Vom System belegt - kann nicht verwendet wer-
			den.
		Available	Verfügbar - kann verwendet werden.
		Reserved	Reserviert - kann nicht verwendet werden.

Tabelle 188: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellmöglichkeiten

PCI Interrupt Routing

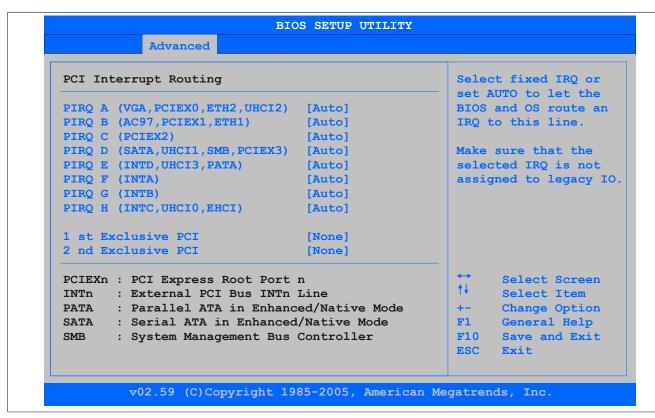


Abbildung 116: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PIRQ A (VGA,PCIEX0, ETH2,UHCI2)	Option zum Einstellen des PIRQ A.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ B (AC97,PCIEX1, ETH1)	Option zum Einstellen des PIRQ B.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ C (PCIEX2)	Option zum Einstellen des PIRQ C.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ D (SATA,UHCI1,SMB,	Option zum Einstellen des PIRQ D.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
PCIEX3)		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ E (INTD,UHCI3,PATA)	Option zum Einstellen des PIRQ E.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ F (INTA)	Option zum Einstellen des PIRQ F.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ G (INTB)	Option zum Einstellen des PIRQ G.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ H (INTC,UHCI0,EHCI)	Option zum Einstellen des PIRQ H.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
1 st Exclusive PCI	Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
	PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ sharing) behandelt wird.	x	Zuweisung des PIRQ als 1st Exclusiv PCI IRQ.
	Information: Wird nur angezeigt wenn ein PIRQ manuell eingestellt wird (z.B. 5).		

Tabelle 189: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
2 nd Exclusive PCI	Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter		Es wird kein Interrupt zugewiesen.
	PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ sharing) behandelt wird.	Х	Zuweisung des PIRQ als 2nd Exclusiv PCI IRQ.
	Information:		
	Wird nur angezeigt wenn zwei PIRQ ma- nuell eingestellt werden.		

Tabelle 189: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten

1.4.3 PCI Express Configuration

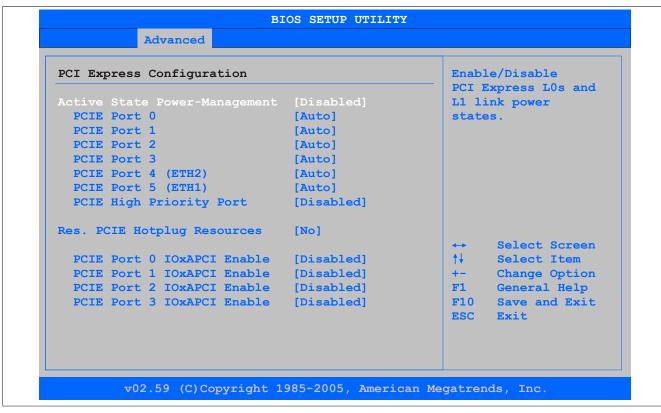


Abbildung 117: 945GME Advanced PCI Express Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Active State Power- Ma-	Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion	Enabled	Aktivierung der Funktion.
nagement	(L0s/L1) für PCIE Slots wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 0	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
	1	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 1	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 2	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
	1	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 3	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.

Tabelle 190: 945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	1	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 4 (ETH2)	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 5 (ETH1)	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte, sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE High Priority Port	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den Prioritätsport für den PCIE.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
,		Port 0	Aktivierung des Port 0 als Prioritätsport.
		Port 1	Aktivierung des Port 1 als Prioritätsport.
		Port 2	Aktivierung des Port 2 als Prioritätsport.
		Port 3	Aktivierung des Port 3 als Prioritätsport.
		ETH2	Aktivierung des ETH2 Port als Prioritätsport.
		ETH1	Aktivierung des ETH1 Port als Prioritätsport.
Res. PCIE Hotplug Re-	Mit dieser Option kann eine I/O und Memory Re-	Yes	Resource wird reserviert.
source	source für einen nicht benützten PCIE Port reserviert werden. Einen PCIE Port auf Enabled zu setzen und Resourcen zu reservieren ist für eine ExpressCard hot-plug Unterstützung am betreffenden Port notwendig.	No	Resource wird nicht reserviert.
PCIE Port 0 IOxAPCI	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Enable	Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 0. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 1 IOxAPCI	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Enable	Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 1. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 2 IOxAPCI	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Enable	Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 2. Bei aktiviertem APIC- Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 3 IOxAPCI	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Enable	Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 3. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 190: 945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.4 Graphics Configuration

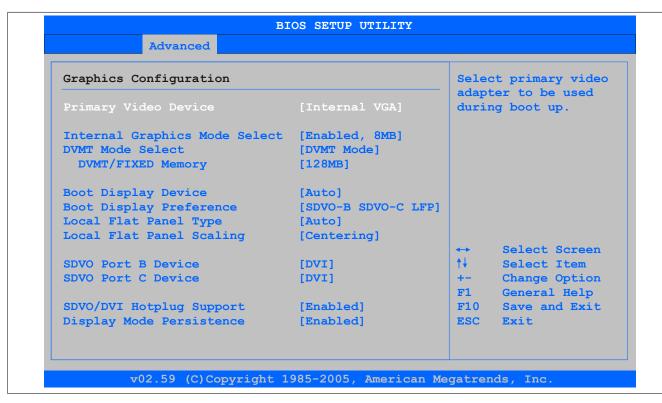


Abbildung 118: 945GME Advanced Graphics Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Video Device	Option zur Auswahl des primären Anzeigegerätes.	Internal VGA	Als Anzeigegerät wird der interne Grafikchip am CPU Board verwendet (Monitor / Panel Anschluss).
		PCI / Int. VGA	Als Anzeigegerät wird der Grafikchip einer gesteckten Grafikkarte verwendet.
Internal Graphics Mode Select	Option zur Einstellung der Speichergröße, welche für den internen Grafikcontroller verwendet	Disabled	Keine Reservierung - Deaktivierung des Grafik- controllers.
	werden kann.	Enabled, 1MB	1MB Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
		Enabled, 8MB	8MB Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
DVMT Mode Select	Option zur Festlegung des DVMT Mode (Dynamic Video Memory Technology) des DVMT Grafiktreibers.	Fixed Mode	Dem Grafikchip wird eine feste Speichergröße zugeteilt, die dann allerdings dem PC nicht mehr zur Verfügung steht.
		DVMT Mode	Es erfolgt eine dynamische Regelung des Spei- cherbedarfs durch den DVMT Grafiktreiber. Es wird nur der benötigte Speicher belegt.
		Combo Mode	Der DVMT Grafiktreiber reserviert mind. 64MB, kann aber bei Bedarf bis zu 224MB belegen.
DVMT/FIXED Memory	Option zur Einstellung der verwendeten Speichergröße für den DVMT Modus.	64MB	64MB Hauptspeicher können verwendet werden.
		128MB	128MB Hauptspeicher können verwendet werden.
		Maximum DVMT	Der restliche freie Hauptspeicher kann verwendet werden.
Boot Display Device	Hier kann festgelegt werden, welcher Videokanal für ein Anzeigegerät beim Booten aktiviert werden soll.	Auto	Automatische Auswahl.
		CRT only	Nur den CRT (Cathode Ray Tube) Kanal benutzen.
		SDVO only	Nur den SDVO (Serial Digital Video Out) Kanal benutzen.
		CRT + SDVO	CRT und SDVO Kanal benutzen.
		LFP only	Nur den LFP (Local Flat Panel) Kanal benutzen.
		CRT + LFP	CRT + LFP Kanal benutzen.
Boot Display Preference	Die Option legt die Reihenfolge fest, in welcher die Geräte an den angeschlossenen Kanälen LFP und SDVO überprüft und gebootet werden sollen.	LFP SDVO-B SDVO-C	Local Flat Panel - Serial Digital Video B output - Serial Video C output.
		LFP SDVO-C SDVO-B	Local Flat Panel - Serial Digital Video C output - Serial Video B output.
	I Information.	SDVO-B SDVO-C LFP	Serial Digital Video B output - Serial Digital Video C output - Local Flat Panel.
	Information: Die Einstellung hat nur Auswirkung auf das System, wenn die Option Boot Display Device auf "Auto" gestellt ist.	SDVO-C SDVO-B LFP	Serial Digital Video C output - Serial Digital Video B output - Local Flat Panel.

Tabelle 191: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Local Flat Panel Type	Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Profil für	Auto	Automatische Erkennung und Einstellung an-
	den LVDS Kanal eingestellt werden.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	hand der EDID Daten.
		VGA 1x18 (002h)	640 x 480
	_	VGA 1x18 (013h) SVGA 1x18 (004h)	640 x 480
	_	XGA 1x18 (0041)	800 x 600 1024 x 768
		XGA 2x18 (000h)	1024 x 768
	_	XGA 1x24 (008h)	1024 x 768
	-	XGA 2x24 (012h)	1024 x 768
		SXGA 2x24 (00Ah)	1280 x 1024
		SXGA 2x24 (018h)	1280 x 1024
		UXGA 2x24 (00Ch)	1600 x 1200
		Customized EDID 1	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 2	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 3	Benutzerdefiniertes Profil
Local Flat Panel Scaling	Option zur Ausgabemöglichkeit des Bildinhaltes in Abhängigkeit des eingestellten Local Flat Pa-	Centering	Der Bildinhalt wird zentriert am Display ausgegeben.
	nel Types.	Expand Text	Der Text wird auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
		Expand Graphics	Grafiken werden auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
		Expand Text & Graphics	Text und Grafiken werden auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
SDVO Port B Device	Option zur Auswahl des Anzeigegerätes welches	None	Kein Anzeigegerät angeschlossen.
	am SDVO Port B angeschlossen ist.	DVI	Videosignale werden für ein DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		TV	Videosignale werden für ein TV kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		CRT	Videosignale werden für ein CRT kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		LVDS	Videosignale werden für ein LVDS kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		DVI-Analog	Videosignale werden für ein analoges DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
SDVO Port C Device	Option zur Auswahl des Anzeigegerätes welches am SDVO Port A angeschlossen ist.	None	Kein Anzeigegerät angeschlossen.
		DVI	Videosignale werden für ein DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		TV	Videosignale werden für ein TV kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		CRT	Videosignale werden für ein CRT kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		LVDS	Videosignale werden für ein LVDS kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		DVI-Analog	Videosignale werden für ein analoges DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
SDVO/DVI Hotplug Support	Ist die Option auf Enabled gestellt, so unterstützt der Windows XP Grafik Treiber "hotplug" und	Enabled	Aktivierung des "Hotplug"- und "Configuration mode persistence"- Modus.
	"configuration mode persistence" für DVI- Monitore, die an einen DVI SDVO Transmitter angeschlossen sind. "Hotplug"-Unterstützung bedeutet, dass ein angeschlossener DVI Monitor während laufendem Betriebssystem automatisch erkannt und aktiviert wird. "Configuration mode persistance" bedeutet, dass z.B. eine duale DVI Anzeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt wird wenn beide DVI Monitore wieder angeschlossen sind auch wenn während eines früheren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlossen und aktiviert wurde.	Disabled	Deaktivierung des "Hotplug"- und "Configuration mode persistence"- Modus.
Display Mode Persistence	Display Mode Persistance bedeutet, dass sich	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	das Betriebssystem an vergangene Display-An- schlusskonfigurationen erinnern und wiederher- stellen kann. z.B. wird eine duale DVI An- zeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt wenn beide DVI Monitore wieder angeschlos- sen werden, auch wenn während eines früheren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlos- sen und aktiviert wurde.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 191: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.5 CPU Configuration

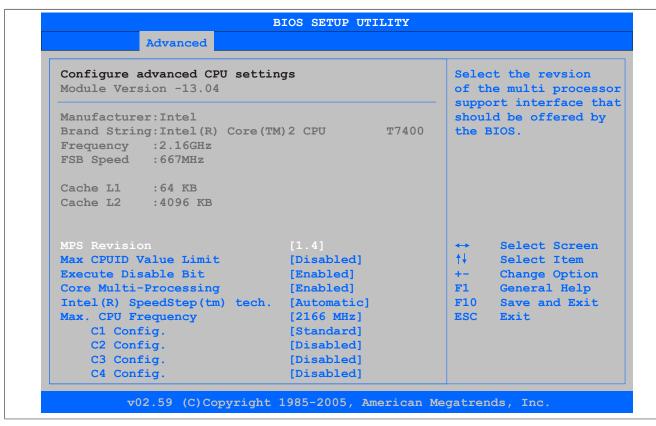


Abbildung 119: 945GME Advanced CPU Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
MPS Revision	Diese Option unterstützt den Einsatz von mehreren CPUs (MPS=Multiprozessorsystem).	1.1	Einstellung der MPS Unterstützung Revision 1.1
		1.4	Einstellung der MPS Unterstützung Revision 1.4
Max CPUID Value Limit	Option zur Limitierung des CPUID Eingangswertes. Dies kann z.B. bei älteren Betriebssystemen notwendig sein.	Enabled	Der Prozessor limitiert bei Bedarf den maxima- len CPUID Eingangswert auf 03h wenn der Pro- zessor einen höheren Wert unterstützt.
		Disabled	Bei Anfrage des CPUID Eingangswertes liefert der Prozessor den aktuell maximalen Wert zurück.
Execute Disable Bit	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Hardwareunterstützung zur Unterbindung der Datenausführung.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Core Multi-Processing	Bei einem Dual Core Prozessor kann mit dieser Option ein Kern deaktiviert werden.	Enabled	Bei einem Dual Core Prozessor werden beide Kerne genutzt.
		Disabled	Bei einem Dual Core Prozessor wird nur ein Kern verwendet.
Intel(R) SpeedStep(TM) tech.	Option zum Regeln der Intel(R) SpeedStep(TM) Technologie. Der Prozessor wird entsprechend der Menge von auszuführenden Berechnungen hoch- oder heruntergetaktet. Dadurch hängt der Energieverbrauch stark von der Auslastung des Prozessors ab.	Automatic	Die Prozessorgeschwindigkeit wird durch das Betriebssystem geregelt.
		Maximum Speed	Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Ma- ximum gesetzt.
		Minimum Speed	Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Minimum gesetzt.
		Disabled	Deaktivierung der SpeedStep Technologie.
Max. CPU Frequency	Option zur Einstellung der maximalen Prozessorgeschwindigkeit wenn bei der Option "Intel(R) SpeedStep(TM) tech." die Werte "Automatic" oder "Maximum Speed" eingestellt ist.	xxxx MHz	Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf den eingestellten Wert begrenzt.
C1 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozessores.	Standard	Standard C1 Unterstützung.
		Enhanced	Enhanced C1 Unterstützung.
C2 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozes-	Standard	Standard C2 Unterstützung.
	sores.	Enhanced	Enhanced C2 Unterstützung.
		Disabled	Disabled C2 Unterstützung.
C3 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozes-	Standard	Standard C3 Unterstützung.
	sores.	Enhanced	Enhanced C3 Unterstützung.
		Disabled	Disabled C3 Unterstützung.
C4 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozes-	Standard	Standard C4 Unterstützung.
	sores.	Enhanced	Enhanced C4 Unterstützung.
		Disabled	Disabled C4 Unterstützung.

Tabelle 192: 945GME Advanced CPU Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.6 Chipset Configuration

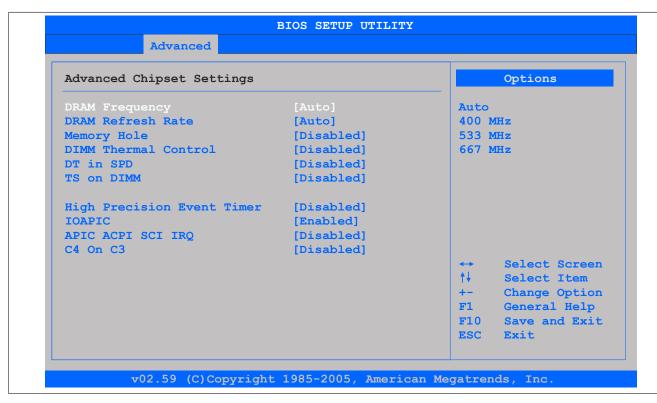


Abbildung 120: 945GME Advanced Chipset Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
DRAM Frequency	Option zum Einstellen der Arbeitsspeicherfrequenz.	Auto	Automatische Einstellung der Frequenz durch das BIOS.
		400, 533, 667 MHz	Manuelle Einstellung der gewünschten Taktfrequenz.
DRAM Refresh Rate	Option zum Einstellen der DRAM Refresh Rate.	Auto	DRAM Refresh wird aus den SPD Daten des DRAM Moduls gelesen.
		7,8µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
		3,9µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
Memory Hole	Option interessant für ISA-Karten mit einem	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Framebuffer. Bei einem APC810 nicht von Bedeutung.	15MB-16MB	Der Adressbereich wird reserviert.
DIMM Thermal Control	Option zum Einstellen der maximalen Oberflä-	Disabled	Keine Begrenzung der Oberflächentemperatur.
	chentemperatur der DIMM Module. Wird die eingestellte Oberflächentemperatur erreicht, dann wird durch eine Limitierung der Speicherbandbreite eine Kühlung des Modules erreicht.	40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 85°C, 90°C	Temperaturgrenzwert für die Limitierung.
DT in SPD	Option, ob der GMCH (Graphics and Memory Controller Hub) die DT (Delta Temperature) im SPD (Serial Presence Detect) Management Algorithmus des DIMM Moduls unterstützt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
TS on DIMM	Option, ob der GMCH (Graphics and Memory	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Controller Hub) den TS (Thermal Sensor) im Thermal Management Algorithmus des DIMM Moduls unterstützt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
High Precision Event Timer	r Der HPET ist ein Zeitgeber im PC. Er ist in der Lage einen Interrupt mit sehr hoher Präzision auszulösen und andere Programme können diverse Anwendungen besser synchronisieren.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Bei Mulitmedia An- wendungen wird empfohlen, die Funktion auf Enabled zu stellen.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
IOAPIC	Diese Option wird verwendet, um den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) zu aktivieren oder zu deaktivieren.	Enabled	Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Res- sourcen erweitert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information: Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.		

Tabelle 193: 945GME Advanced Chipset Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
APIC ACPI SCI IRQ	Diese Option wird verwendet, um den SCI IRQ		IRQ20 wird für SCI verwendet.
	bei APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Modus zu modifizieren.	Disabled	IRQ9 wird für SCI verwendet.
C4 On C3	Verfeinerung der Energiesparfunktion bei einem ACPI Betriebssystem.	Enabled	Prozessor wird in C4 gebracht, wenn das Betriebssystem in einen C3 Zustand initiiert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 193: 945GME Advanced Chipset Einstellmöglichkeiten

1.4.7 I/O Interface Configuration

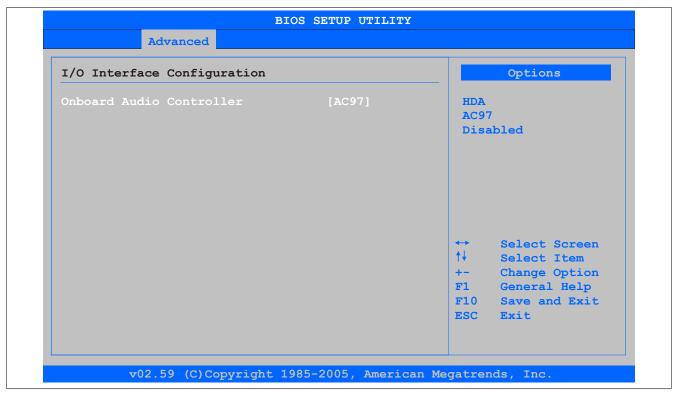


Abbildung 121: 945GME Advanced I/O Interface Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Onboard Audio Controller	Hier kann der Audio Modus ausgewählt bzw. aus-	HDA	Aktivierung des High Definition Audio Sound.
	geschaltet werden.	AC97	Aktivierung des AC'97 Sound.
		Disabled	Deaktivierung des Audio Controllers.

Tabelle 194: 945GME Advanced I/O Interface Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.8 Clock Configuration



Abbildung 122: 945GME Advanced Clock Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Spread Spectrum	Mit dieser Option kann der Takt geringfügig fre-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	quenzmoduliert werden, wodurch sich die elektromagnetische Störstrahlung verringert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 195: 945GME Advanced Clock Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.9 IDE Configuration

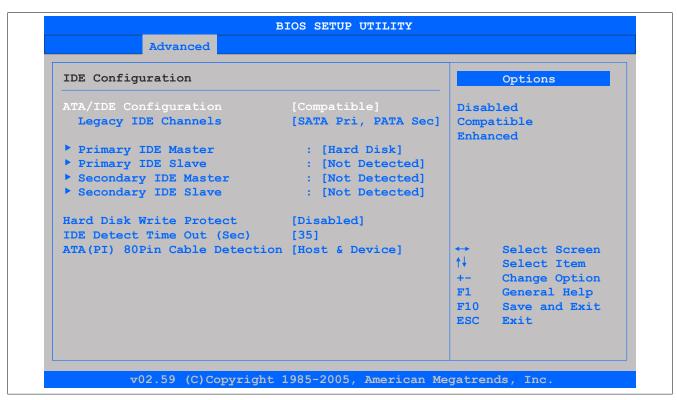


Abbildung 123: 945GME Advanced IDE Configuration

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ATA/IDE Configuration	Option zum Konfigurieren der integrierten PATA und SATA Controller.	Compatible	Beide Controller arbeiten in Legacy oder Compatible Modus.
		Disabled	Deaktivierung beider Controller.
		Enhanced	Beide Controller arbeiten in Enhanced oder Native Modus.
Legacy IDE Channels ¹⁾	Option zum Konfigurieren der Legacy IDE Kanäle im "Compatible" Modus.	SATA Pri, PATA Sec	SATA Laufwerke werden primär und PATA Laufwerke werden sekundär angesprochen.
		SATA only	Nur SATA Laufwerke verwenden.
		PATA only	Nur PATA Laufwerke verwenden.
Configure SATA as ²⁾	Hier können die von der Southbridge unterstützten Serial ATA Anschlüsse eingestellt werden.	IDE	Die Serial ATA-Festplatte wird als Parallel ATA physikalisches Speicherlaufwerk benutzt.
		RAID	Hier kann RAID 0, 1, 5, 10 oder die Intel® Matrix Storage Technologie mit der Serial ATA Fest- platte konfiguriert werden.
		AHCI	Mit der Einstellung AHCI kann man den inter- nen Speichertreiber der SATA-Funktionen akti- vieren, welche die Speicherleistung bei zufälli- gem Schreib-Lese-Zugriff erhöhen, indem das Laufwerk die Reihenfolge der Befehle selbst festlegt.
Configure SATA Chan- nels ³⁾	Hier können SATA- bzw. PATA- Laufwerke als Primary bzw. Secondary Device eingestellt werden.	Before PATA	Die SATA- Laufwerke sind die Primary Devices, und PATA somit die Secondary.
		Behind PATA	Die PATA- Laufwerke sind die Primary Devices, und SATA somit die Secondary.
AHCI/RAID SATA Hotp-	Hier kann der Hotplug-Support für AHCI/RAID-	Enabled	Aktiviert den Hotplug-Support.
lug ⁴⁾	Systeme eingestellt werden.	Disabled	Deaktiviert den Hotplug-Support.
Primary IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Primary Master Port angeschlossen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Primary IDE Master" auf Seite 243
Primary IDE Slave	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Primary Slave Port angeschlossen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Primary IDE Slave" auf Seite 244
Secondary IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Secondary Master Port angeschlos- sen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Secondary IDE Master" auf Seite 245
Secondary IDE Slave	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Secondary Slave Port angeschlos- sen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Secondary IDE Slave" auf Seite 246
Hard Disk Write Protect	Hier kann der Schreibschutz für die Festplatte ak-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	tiviert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
IDE Detect Time Out (Sec)	Einstellung des Zeitüberschreitungsgrenzwertes der ATA/ATAPI Geräteerkennung.	0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35	Zeiteinstellung in Sekunden.
ATA(PI) 80Pin Cable Detection	Hier wird eingestellt, ob ein 80Pin Kabel am Laufwerk, am Controller oder am Laufwerk und Con-	Host & Device	Verwendung beider IDE Controller. (mother-board, disk drive).
	troller angeschlossen ist.	Host	Verwendung des Motherboard IDE Controllers.
	Information: Diese Option ist beim APC810 CPU Board nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.	Device	Verwendung des IDE disk drive Controllers.

Tabelle 196: 945GME Advanced IDE Configuration Einstellmöglichkeiten

- Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Compatible eingestellt ist.
- Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced eingestellt ist.
- 3) 4) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced und Configure SATA as auf IDE oder AHCI eingestellt ist.
- Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced und Configure SATA as auf RAID oder AHCI eingestelltist.

Primary IDE Master

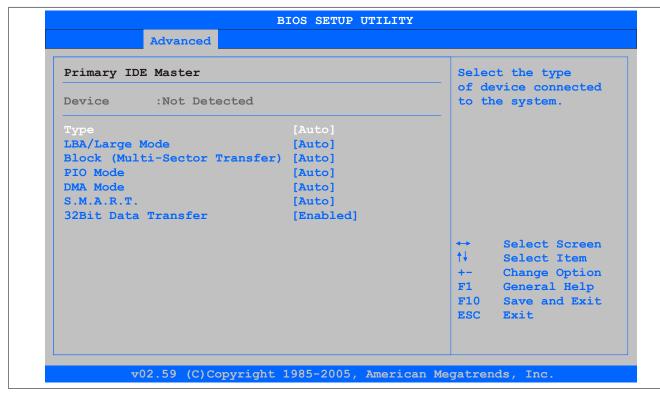


Abbildung 124: 945GME Primary IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Туре	Hier wird der Typ des am Primary Master ange-	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
	schlossenen Laufwerks parametriert.	Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird der Logical-Block- Ad-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	dressing/Large Modus für IDE aktiviert.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Trans-	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
fer)	Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- platte.	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modus.
	Information: Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.		
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Primary Master Laufwerk festgelegt.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
	Der DMA-Mode muss unter Windows im Geräte- manager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
	(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nology).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Daten-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	transfer.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 197: 945GME Primary IDE Master Einstellmöglichkeiten

Primary IDE Slave



Abbildung 125: 945GME Primary IDE Slave

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Туре	Hier wird der Typ des am Primary Slave ange-	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
	schlossenen Laufwerks parametriert.	Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addres-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	sing/Large Modus für IDE aktiviert.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Trans-	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
fer)	Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- platte.	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modus.
	Information: Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.		
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Primary Slave Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätemanager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
		Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
	(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nology).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Daten-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	transfer.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 198: 945GME Primary IDE Slave Einstellmöglichkeiten

Secondary IDE Master

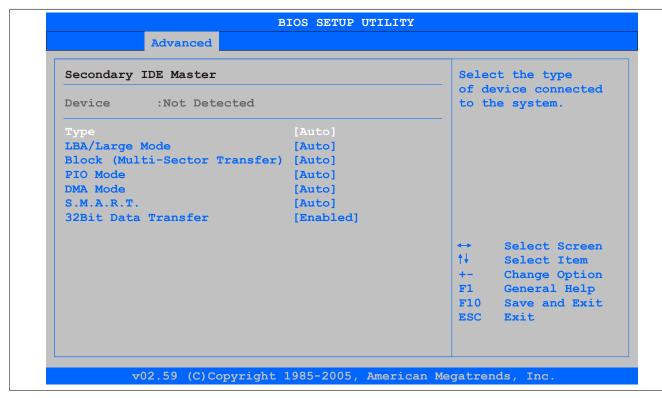


Abbildung 126: 945GME Secondary IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Туре	Hier wird der Typ des am Secondary Master an-	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
	geschlossenen Laufwerks parametriert.	Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addres-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	sing/Large Modus für IDE aktiviert.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Trans-	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
fer)	Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- platte.	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modus.
	Information: Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.		
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Secondary Master Laufwerk festgelegt.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
	Der DMA-Mode muss unter Windows im Geräte- manager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
	(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nology).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Daten-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	transfer.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 199: 945GME Secondary IDE Master Einstellmöglichkeiten

Secondary IDE Slave



Abbildung 127: 945GME Secondary IDE Slave

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Туре	Hier wird der Typ des am Secondary Slave ange-	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
	schlossenen Laufwerks parametriert.	Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addres-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	sing/Large Modus für IDE aktiviert.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Trans-	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
fer)	Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- platte.	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modus.
	Information: Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.		
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Secondary Slave Laufwerk festgelegt.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
	Der DMA-Mode muss unter Windows im Geräte- manager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
	(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nology).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Daten-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	transfer.		

Tabelle 200: 945GME Secondary IDE Slave Einstellmöglichkeiten

1.4.10 USB Configuration



Abbildung 128: 945GME Advanced USB Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
USB Function	Hier können die USB-Ports aktiviert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der USB-Ports.
		2 USB Ports	USB1, USB3 werden aktiviert.
	Die USB Nummern (z.B. USB1, USB3, usw.) sind	4 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4 werden aktiviert.
	am Gehäuse des APC810 aufgedruckt).	6 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4, USB5 werden aktiviert.
		8 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4, USB5, USB an einem AP über SDL werden aktiviert.
USB 2.0 Controller	Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des USB 2.0 Modus.	Enabled	Alle USB Schnittstellen laufen im USB 2.0 Modus.
		Disabled	Alle USB Schnittstellen laufen im USB 1.1 Modus.
Legacy USB Support	Hier kann der Legacy USB Support aktiviert/	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	deaktiviert werden. Es funktioniert keine USB	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Schnittstelle während des Startens. Nach dem Betriebssystemstart steht der USB Support wieder zur Verfügung. Eine USB Tastatur wird während des POST noch erkannt.	Auto	Automatische Aktivierung.
USB Legacy POST-Always	Option um den Legacy USB Support während des POST (Power On Self Test) gleichgültig der Legacy USB Support Einstellung zu aktivieren.	Enabled	Das BIOS Setup kann während des POST mittels einer USB Tastatur aufgerufen werden.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Keyboard Legacy	Hier kann die USB-Keyboard Unterstützung akti-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Support	viert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Mouse Legacy Sup-	Hier kann die USB-Mouse Unterstützung akti-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
port	viert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Storage Device Sup-	Hier kann die USB-Massenspeichergerät Unter-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
port	stützung aktiviert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Port 64/60 Emulation	Hier kann die Port 64/60 Emulation aktiviert/de-	Enabled	USB-Keyboard funktioniert unter Windows NT.
	aktiviert werden.	Disabled	USB-Keyboard funktioniert unter allen Systemen außer Windows NT.
USB 2.0 Controller Mode	Hier können Einstellungen für den USBController	FullSpeed	12 MBps
	vorgenommen werden.	HiSpeed	480 MBps
BIOS EHCI Hand-Off	Hier kann die Unterstützung für Betriebssysteme	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	ohne vollautomatische EHCIFunktion eingerichtet werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Beep Message	Option zur Ausgabe jeweils eines Pieptones,	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	wenn ein USB Gerät während des POST vom BIOS erkannt wurde.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Stick Default Emulation	Hier kann eingestellt werden, wie ein USB-Gerät verwendet wird.	Auto	USB-Geräte, deren Speicherkapazität kleiner als 530MB ist werden als Diskettenlaufwerk und die anderen Geräte mit größerer Kapazität als Festplatte simuliert.

Tabelle 201: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
		Hard Disk	Ein als HDD formatiertes Laufwerk als FDD (z.B. ZIP-Laufwerk) kann zum Starten des Systems verwendet werden.
USB Mass Storage Reset Delay	Hier kann die Zeit, die der POST für USB-Speichergeräte nach dem Gerätestartbefehl warten soll, eingestellt werden. Information: Die Meldung "No USB Mass Storage device detected" (Kein USB Massenspeichergerät entdeckt) wird angzeigt, wenn kein USB Massenspeichergerät installiert wurde.	10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 40 Sec	Manuelle Einstellung des Wertes.
Special Delay for USB HDDs	Option zum Einstellen eines Boot Delay (Bootverzögerung) vor der USB 2.0 Geräteaufzählung,	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Es wird kein Boot Delay hinzugefügt.
	um das Booten von langsam hochlaufenden USB Devices (z.B. USB Hard Disks) zu ermöglichen.	1 Sec, 2 Sec, 3 Sec, 4 Sec, 5 Sec, 7 Sec, 10 Sec	Es wird ein Boot Delay von 1, 2, 3, 4, 5, 7 bzw. 10 Sekunden hinzugefügt.
	Information: Diese Option sollte nur bei Bedarf verwendet werden, da der Bootvorgang dann immer um die eingestellte Zeit länger dauert.		

Tabelle 201: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration



Abbildung 129: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Bootup Num-Lock	Mit diesem Feld kann man den Zustand der Zeh-	Off	Vom numerischen Tastenblock sind lediglich
	nertastatur (NumLock) beim Booten des Systems		die Cursorfunktionen aktiviert.
	definieren.	On	Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
Typematic Rate	Hier wird die Tastenwiederholfunktion eingestellt.	Slow	Langsame Tastenwiederholung.
		Fast	Schnelle Tastenwiederholung.

Tabelle 202: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.12 Remote Access Configuration

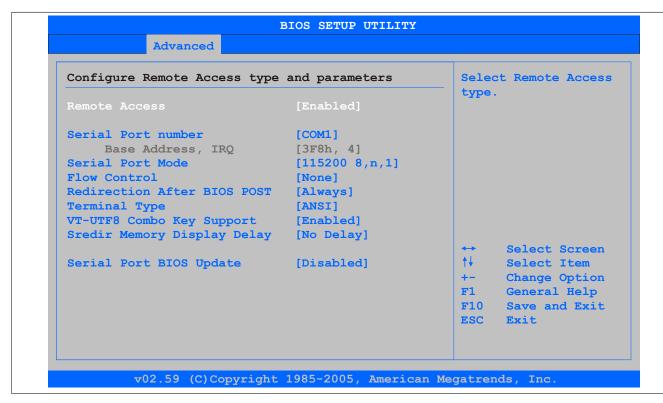


Abbildung 130: 945GME Advanced Remote Access Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Remote Access	Hier kann die Remote Access Funktion akti-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	viert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Serial Port number	Unter dieser Option kann die serielle Schnittstelle eingestellet werden, vorausgesetzt im Feld Remote Access ist nicht Disabled eingetragen.	COM1	Aktivierung der Schnittstelle COM1 als Remote Access Schnittstelle.
		COM2	Aktivierung der Schnittstelle COM2 als Remote Access Schnittstelle.
Base Address, IRQ	Anzeige der logischen Adresse und des Interrupts für den seriellen Anschluss, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Access</i> ist nicht Disabled eingetragen.	keine	-
Serial Port Mode	Hier kann die Übertragunsrate der seriellen Schnittstelle festgelegt werden, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Access</i> ist nicht Disabled eingetragen.	115200 8,n,1 57600 8,n,1 38400 8,n,1 19200 8,n,1 09600 8,n,1	Manuelle Einstellung des Wertes.
Flow Control	Diese Einstellung bestimmt, wie die Übertragung über die Schnittstelle gesteuert wird.	None	Die Schnittstelle wird ohne Übertragungssteuerung betrieben.
	Information:	Hardware	Die Übertragungssteuerung der Schnittstelle erfolgt durch Hardware. Dieser Modus muss durch das Kabel unterstützt werden.
	Die Einstellung muss sowohl am Termi- nal als auch am Server gleich sein.	Software	Die Übertragungssteuerung der Schnittstelle erfolgt durch Software.
Redirection After BIOS POST	Hier kann die Umlenkung nach dem Systemstart eingestellt werden, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Access</i> ist nicht Disabled eingetragen.	Disabled	Die Umlenkung wird nach dem Systemstart abgestellt.
		Boot Loader	Die Umlenkung ist während des Systemstarts und während der Aufladung aktiv.
		Always	Die Umlenkung ist immer aktiviert.
Terminal Type	Hier kann die Anschlussart ausgewählt werden, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Access</i> ist nicht Disabled eingetragen.	ANSI, VT100, VT-UTF8	Manuelle Einstellung der Anschlussart.
VT-UTF8 Combo Key Sup-	Mit dieser Option kann die VT-UTF8 Combo Key	Enabled	Aktivierung der Funktion.
port	Support für die Anschlüsse ANSI und VT100 akti- viert werden, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Ac-</i> cess ist nicht Disabled eingetragen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Sredir Memory Display De-	Mit dieser Option kann die Verzögerung der Spei-	No Delay	Keine Verzögerung.
lay	cherausgabe eingestellt werden, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Access</i> ist nicht Disabled eingetragen (Sredir -> Serialredirection).	Delay 1 Sec, Delay 2 Sec, Delay 4 Sec	Manuelle Einstellung des Wertes.

Tabelle 203: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Serial Port BIOS Update	Während dem Systemstart wird das Update über		Aktivierung der Funktion.
	die serielle Schnittstelle in den Prozessor gela-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	den.		
	Information:		
	lst diese Option auf Disabled wird die Zeit zum booten verkürzt.		

Tabelle 203: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.13 CPU Board Monitor

Information:

Die angezeigten Spannungswerte (z.B. Corespannung, Batteriespannung) auf dieser BIOS Setup Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarme bzw. Fehlerzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

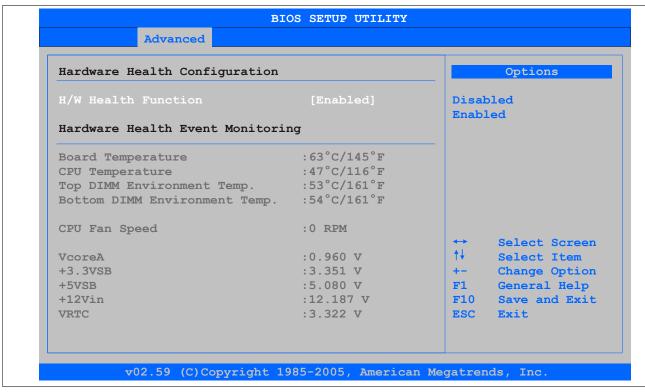


Abbildung 131: 945GME Advanced CPU Board Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
H/W Health Function	Option zum Anzeigen sämtlicher Werte auf dieser Seite.	Enabled	Anzeigen sämtlicher Werte.
		Disabled	Es werden keine Werte auf dieser Seite angezeigt.
Board Temperature	Anzeige der Boardtemperatur in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
CPU Temperature	Anzeige der Prozessortemperatur in Grad Celcius und Fahrenheit.	keine	-
Top DIMM Enviroment Temp.	Anzeige der Temperatur des 1. DRAM Moduls.	keine	-
Bottom DIMM Enviroment Temp.	Anzeige der Temperatur des 2. DRAM Moduls.	keine	-
CPU Fan Speed	Anzeige der Umdrehungsgeschwindigkeit eines Prozessorlüfters.	keine	-
VcoreA	Anzeige der Prozessorkernspannung A in Volt.	keine	-
+3.3VSB	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 3,3 Volt Versorgung.	keine	-
+5VSB	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 5 Volt Versorgung.	keine	-
+12Vin	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 12 Volt Versorgung.	keine	-
VRTC	Anzeige der Batteriespannung in Volt.	keine	-

Tabelle 204: 945GME Advanced CPU Board Monitor Einstellmöglichkeiten

1.4.14 Baseboard/Panel Features

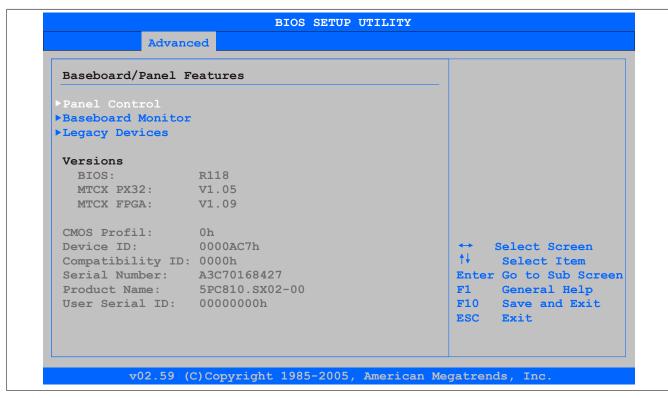


Abbildung 132: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Panel Control	Hier können spezielle Einstellungen für ange- schlossene Panel (Displayeinheiten) vorgenom- men werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Panel Control" auf Seite 253
Baseboard Monitor	Anzeige verschiedener Temperaturwerte und Lüfterdrehzahlen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard Monitor" auf Seite 254
Legacy Devices	Hier können spezielle Einstellungen für die Schnittstellen vorgenommen werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Legacy Devices" auf Seite 255
BIOS	Anzeige der BIOS Version	keine	-
MTCX PX32	Anzeige der MTCX PX32 Firmwareversion.	keine	-
MTCX FPGA	Anzeige der MTCX FPGA Firmwareversion.	keine	-
CMOS Profil	Zeigt die CMOS Profil Nummer an.	keine	-
Device ID	Hexwertanzeige der Hardware-Geräte ID.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der glei- chen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Serialnummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen "B&R Control Center" über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-

Tabelle 205: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmöglichkeiten

Panel Control

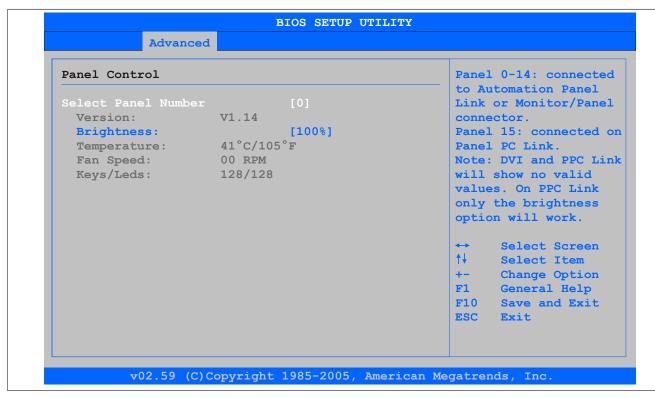


Abbildung 133: 945GME Panel Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Select Panel Number	Auswahl der Panelnummer, bei dem Werte ausgelesen bzw. geändert werden sollen.	015	Panelauswahl 0 15. Panel 15 ist speziell für Panel PC 800 Systeme vorgesehen.
Version	Anzeige der Firmwareversion des SDLR Controllers.	keine	-
Brightness	Einstellung der Helligkeit beim ausgewählten Panel.	0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%	Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewählten Panel. Wird erst beim Speichern und Neustart des Systems wirksam (z.B. durch Drücken von <f10>).</f10>
Temperature	Temperaturanzeige des ausgewählten Panels in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Fan Speed	Lüfterumdrehungsanzeige des ausgewählten Panels.	keine	-
Keys/Leds	Anzeige der vorhandenen Tasten und LEDs des ausgewählten Panels.	keine	-

Tabelle 206: 945GME Panel Control Einstellmöglichkeiten

Baseboard Monitor

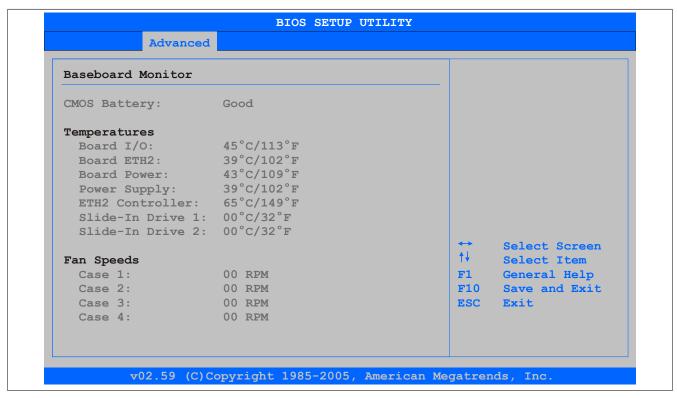


Abbildung 134: 945GME Baseboard Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
CMOS Battery	Zeigt den Status der Batterie an. n.a not available Good - Batterie ist in Ordnung. Bad - Batterie ist kaputt.	keine	-
Board I/O	Anzeige der Temperatur im I/O Bereich in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Board ETH2	Anzeige der Temperatur im ETH2 Controller Chipbereich in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Board Power	Anzeige der Netzteiltemperatur in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Power Supply	Anzeige der Temperatur im Netzteil in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
ETH2 Controller	Anzeige der Temperatur des ETH2 Controllers in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Slide-In Drive 1	Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks 1 in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Slide-In Drive 2	Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks 2 in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Case 1	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 1.	keine	-
Case 2	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 2.	keine	-
Case 3	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 3.	keine	-
Case 4	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 4.	keine	-

Tabelle 207: 945GME Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten

Legacy Devices



Abbildung 135: 945GME Legacy Devices

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COM A	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM1 im	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
	System.	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8,	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adres-
		328, 338, 3E8, 3F8	se.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM B	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM2 im	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
	System.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM C	Einstellung des COM Ports für den Touch	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
	Screen am Monitor/Panel Stecker.	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM D	Einstellung des COM Ports für den Touch	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
	Screen am AP Link Stecker.	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM E	Einstellung des COM Ports der B&R Add-on	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
	Schnittstellenoption 5AC600.485I-00 (IF-Option).	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
CAN	Einstellung des CAN Ports der B&R Add-	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
	on CAN Schnittstellenoption 5AC600.CANI-00 (IF-Option).	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Anzeige der Base I/O Adresse des CAN Ports.	keine	-
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den CAN Port.	IRQ 10, NMI	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
Hardware Security Key	Hier werden Einstellungen für den Hardware Se-	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
	curity Key (Dongle) vorgenommen.	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O adress	Auswahl der Base I/O Adresse der Hardware Security Schnittstelle.	278, 378, 3BC	Zuweisung für die Base I/O Adresse für den parallelen Port.

Tabelle 208: 945GME Legacy Devices Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ETH2 LAN controller	Hier kann der Onboard LAN Controller (ETH2)	Enabled	Aktivierung des Controllers.
	ein- bzw. ausgeschaltet werden.	Disabled	Deaktivierung des Controllers.
ETH2 MAC Address	Zeigt die MAC-Adresse des Ethernet 2 Control-	keine	-
	lers.		

Tabelle 208: 945GME Legacy Devices Einstellmöglichkeiten

1.5 Boot



Abbildung 136: 945GME Boot Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Boot Priority Selection	Hier kann eingestellt werden, nach welcher Methode die Laufwerke gebootet werden sollen.	Device Based	Es werden nur die vom System erkannten Geräte aufgelistet. Bei dieser Liste kann danach die Reihenfolge geändert werden.
			Information: Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwenden. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig.
		Type Based	Man kann die Bootreihenfolge einer Gerätety- penliste ändern. Es ist auch möglich nicht an- geschlossene Gerätetypen in dieser Liste anzu- geben.
			Information: Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwenden. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig.

Tabelle 209: 945GME Boot Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
1st Boot Device	Unter dieser Option können die Boot- Laufwerke	Disabled, Primary Master, Pri-	Auswahl der gewünschten Reihenfolge.
2nd Boot Device	eingestellt werden.	mary Slave, Secondary Master,	
3rd Boot Device		Secondary Slave, Legacy Flop-	
4th Boot Device		py, USB Floppy, USB Harddisk,	
5th Boot Device		USB CDROM, USB Remove- able Device, Onboard LAN, Ex-	
6th Boot Device		ternal LAN, PCI Mass Storage,	
7th Boot Device	-	PCI SCSI Card, Any PCI BEV	
8th Boot Device		Device, Third Master, Third Slave, PCI RAID, Local BEV ROM	
Quick Boot	Diese Funktion verringert die Zeit zum Booten	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	durch überspringen von einigen POST Vorgängen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Quiet Boot	Bestimmt, ob POST Nachricht oder das OEM Logo (Default=schwarzer Hintergrund) angezeigt	Enabled	Anzeige des OEM Logos anstatt der POST Nachricht.
	wird.	Disabled	Anzeige der POST Nachricht.
Automatic Boot List Retry	Mit dieser Option wird versucht, das Betriebssys-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	tem bei einem Fehlstart automatisch neu zu starten.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
AddOn ROM Display Mode	Setzt das Anzeigemodus für das ROM (während	Force BIOS	Ein weiterer BIOS Teil kann angezeigt werden.
	dem Bootvorgang).	Keep Current	BIOS Informationen werden angezeigt.
Halt On Error	Die Option legt fest, ob nach einem Fehler der Systemstart während des Power On Self Test	Enabled	System hält an. Bei jedem Fehler wird das System angehalten.
	(POST) fortgesetzt werden soll.	Disabled	System hält nicht an. Alle Fehler werden ignoriert.
Hit 'DEL' Message Display	Hier können Einstellungen für die Anzeige der	Enabled	Die Nachricht wird angezeigt.
	"Hit 'DEL' Message" vorgenommen werden. Information: Wenn Quiet Boot aktiviert ist wird die Nachricht nicht angezeigt.	Disabled	Die Nachricht wird nicht angezeigt.
Interrupt 19 Capture	Mit dieser Funktion kann die BIOS Unterbre-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	chung eingeschlossen werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PXE Boot to LAN (ETH1)	Aktivierung/Deaktivierung der Funktion vom LAN	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	(ETH1) zu booten.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Slide-In 2 Option-ROM	Aktivierung/Deaktivierung der Funktion von ei-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nem Option ROM für ein Slide-In 2 Laufwerk.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Power Loss Control	Stellt fest ob das System nach einem Leistungs-	Remain Off	Bleibt ausgeschaltet.
	abfall an/aus ist.	Turn On	Schaltet ein.
		Last State	Aktiviert den vorherigen Zustand.

Tabelle 209: 945GME Boot Menü Einstellmöglichkeiten

1.6 Security

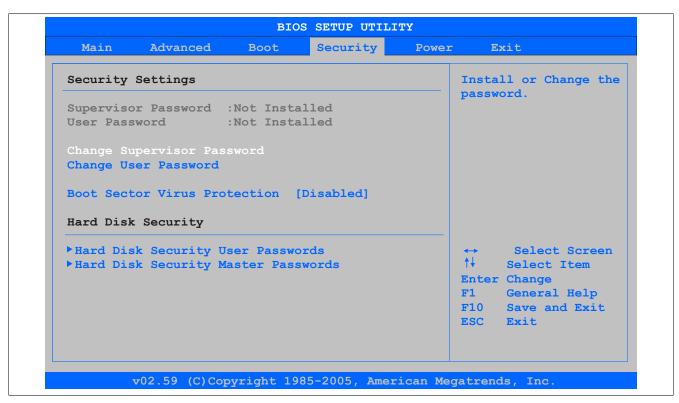


Abbildung 137: 945GME Security Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Supervisor Password	Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
User Password	Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
Change Supervisor Password	Funktion zum Eingeben/Ändern eines Supervisor Passwortes. Nur mit dem Supervisor Passwort können alle BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Change User Password	Funktion zum Eingeben eines User Passwortes. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Boot Sector Virus Protec-	Mit dieser Option wird beim Zugriff durch ein Pro-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
tion	gramm oder Virus auf den Bootsektor eine Warnung ausgegeben.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information: Mit dieser Option wird nur der Bootsektor geschützt, nicht aber die gesamte Festplatte.		
Hard Disk Security User Passwords	Hier kann das Hard Disk Security User Passwort erstellt werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Security User Password" auf Seite 259
Hard Disk Security Mas- ter Passwords	Hier kann das Hard Disk Security Master Passwort erstellt werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Security Master Password" auf Seite 259

Tabelle 210: 945GME Security Menü Einstellmöglichkeiten

1.6.1 Hard Disk Security User Password

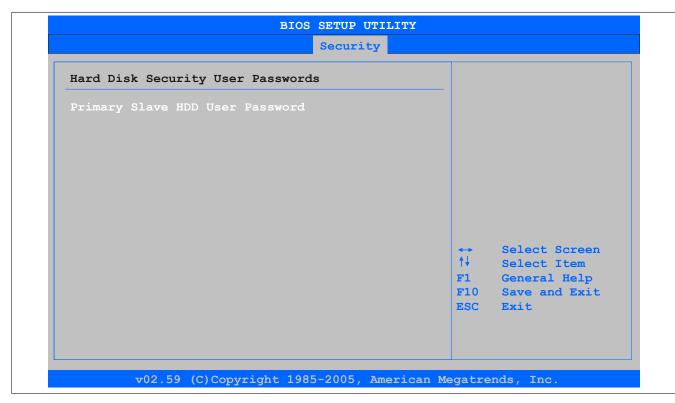


Abbildung 138: 945GME Hard Disk Security User Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Slave HDD User	Mit dieser Funktion ist es möglich das User Pass-	Enter	Passwort eingeben.
Password	wort jeder Festplatte einzustellen oder zu ändern		
	ohne das Gerät neu zu booten. Mit dem User		
	Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellun-		
	gen editiert werden.		

Tabelle 211: 945GME Hard Disk Security User Password

1.6.2 Hard Disk Security Master Password

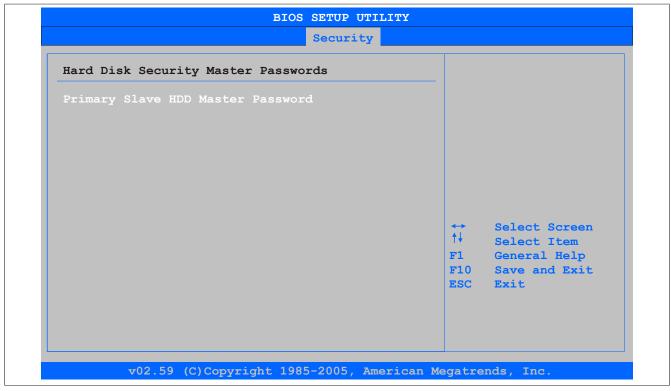


Abbildung 139: 945GME Hard Disk Security Master Password

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Slave HDD Master	Mit dieser Funktion ist es möglich das Master	Enter	Passwort eingeben.
Password	Passwort jeder Festplatte einzustellen oder zu		
	ändern ohne das Gerät neu zu booten.		

Tabelle 212: 945GME Hard Disk Securitiy Master Password

1.7 Power



Abbildung 140: 945GME Power Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Power Management/APM	Diese Option schaltet die APM-Funktionalität ein	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	oder aus. Es handelt sich hierbei um eine erweiterte Plug & Play- und Power Management-Funktionalität.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Suspend Time Out	Unter dieser Option stellen Sie ein, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität des Systems, dieses in den Suspend Modus (es werden alle Komponen-	1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 50 Min, 60 Min;	Manuelle Einstellung des Wertes.
	ten, außer der CPU, soweit wie möglich abgeschaltet) gefahren wird.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Video Power Down Mode	Unter dieser Option wird der Energiesparmodus	Disabled	Kein Ausschalten des Bildschirms.
	für den Bildschirm festgelegt.	Standby	Bildschirm geht in Standby Modus.
		Suspend	Bildschirm geht in Suspend Modus.
Hard Disk Power Down	Unter dieser Option wird der Energiesparmodus	Disabled	Kein Ausschalten des Bildschirms.
Mode	für die Festplatte festgelegt.	Standby	Bildschirm geht in Standby Modus.
		Suspend	Bildschirm geht in Suspend Modus.
Keyboard & PS/2 Mouse	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am Keyboard oder der PS/2 Mouse kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zu- rück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
FDC/LPT/COM Ports	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am Parallel Port, dem Serial 1&2 Port oder dem Floppy Port kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Primary Master IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Primary Slave IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.

Tabelle 213: 945GME Power Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Secondary Master IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Secondary Slave IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Resume On Ring	Bei einem eingehenden Anruf am Modem wird der PC aus dem Stromsparmodus geholt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Resume On PME#	Unter dieser Option können Sie die PME Weck-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	funktion ein- bzw. ausschalten.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Resume On RTC Alarm	Unter dieser Option können Sie den Alarm aktivieren und Datum und Uhrzeit für den Systemstart eingeben.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Power Button Mode	Diese Funktion legt fest, welche Funktion der	On/Off	Power Taster schaltet Ein/Aus.
	Power Taster haben soll.	Suspend	Unterdrückt die Funktion.

Tabelle 213: 945GME Power Menü Einstellmöglichkeiten

1.8 Exit

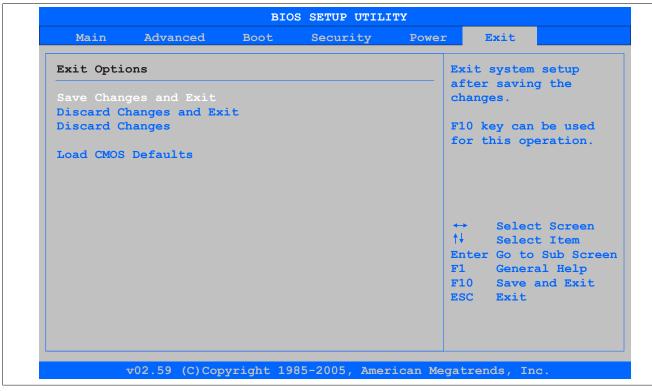


Abbildung 141: 945GME Exit Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Save Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet. Vorgenommene Änderungen werden nach Be- stätigung im CMOS gespeichert und das System wird rebootet.	OK / Cancel	
Discard Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet, ohne die vorgenommenen Änderungen zu spei- chern. Der Startvorgang wird fortgesetzt.	OK / Cancel	
Discard Changes	Wurden Einstellungen vorgenommen und man weiß nicht mehr welche, so können diese (sofern sie nicht schon gespeichert wurden) wieder zurückgesetz werden.	OK / Cancel	
Load CMOS Defaults	Bei diesem Punkt werden die in Abhängigkeit der DIP Switch Stellungen definierten CMOS Default Werte geladen. Diese Werte werden für alle BIOS Einstellungen geladen und eingestellt.	OK / Cancel	

Tabelle 214: 855GME (XTX) Exit Menü Einstellmöglichkeiten

1.9 BIOS Defaulteinstellungen

Mit Hilfe des CMOS Profile Hex Schalters lassen sich je nach Stellung vordefinierte BIOS Profileinstellungen laden.

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte für dieses System dar und sollte daher nicht geändert werden.

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche nach dem Ausführen der Funktion "Load Setup Defaults" im BIOS Setup Hauptmenü "Exit" oder beim Drücken von <F9> bei den einzelnen BIOS Setup Seiten für diese BIOS Setup Seite optimierten Werte.

Profilnummer	Optimiert für	Schalterstellung	Anmerkung
Profil 0	Reserviert	0	
Profil 1	Systemeinheit 5PC810.SX01-00 / 5PC810.SX02-00 / 5PC810.SX03-00	1	Die Defaulteinstellungen für diese Profile befinden sich im APC810 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten-
Profil 2	Systemeinheit 5PC810.SX05-00	2	los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.
Profil 3	Systemeinheit 5PC820.SX01-00 / 5PC820.SX01-01	3	Die Defaulteinstellungen für dieses Profil befinden sich im APC820 Anwenderhandbuch. Dieses kann kostenlos von der B&R Homepage heruntergeladen werden.
Profil 4	Reserviert	4	
Profil 5	Systemeinheit 5PC820.1505-00 / 5PC820.1906-00	5	Die Defaulteinstellungen für diese Profile befinden sich im PPC800 Anwenderhandbuch. Dieses kann kostenlos von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Tabelle 215: Profilübersicht

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die BIOS Defaulteinstellungen abhängig von der CMOS Profil Schalterstellung. Gelb eingefärbte Einstellungen stellen die Abweichungen zum BIOS Defaultprofil (=Profil 0) dar.

1.9.1 Main

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
System Time	-	-	-	
System Date	-	-	-	
BIOS ID	-	-	-	
Prozessor	-	-	-	
CPU Frequency	-	-	-	
System Memory	-	-	-	
Product Revision	-	-	-	
Serial Number	-	-	-	
BC Firmware Rev.	-	-	-	
MAC Address (ETH1)	-	-	-	
Boot Counter	-	-	-	
Running Time	-	-	-	

Tabelle 216: 945GME Main Profileinstellungsübersicht

1.9.2 Advanced

ACPI Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
ACPI Aware O/S	Yes	Yes	Yes	
ACPI Version Features	ACPI v2.0	ACPI v2.0	ACPI v2.0	
ACPI APIC support	Enabled	Enabled	Enabled	
Suspend mode	S1 (POS)	S1 (POS)	S1 (POS)	
USB Device Wakeup from S3/S4	Disabled	Disabled	Disabled	
Active Cooling Trip Point	Disabled	Disabled	Disabled	
Passive Cooling Trip Point	Disabled	Disabled	Disabled	
Critical Trip Point	105°C	105°C	105°C	

Tabelle 217: 945GME Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsübersicht

PCI Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Plug & Play O/S	No	Yes	Yes	
PCI Latency Timer	64	64	64	
Allocate IRQ to PCI VGA	Yes	Yes	Yes	
Allocate IRQ to SMBUS HC	Yes	Yes	Yes	
Allocate IRQ to PCIEX2	Yes	Yes	Yes	
PCI IRQ Resource Exclusion				
IRQ3	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ4	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ5	Available	Available	Available	
IRQ6	Available	Available	Available	
IRQ7	Available	Available	Available	
IRQ9	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ10	Available	Available	Available	
IRQ11	Allocated	Available	Available	
IRQ12	Available	Available	Available	
IRQ14	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ15	Allocated	Allocated	Allocated	
PCI Interrupt Routing				
PIRQ A (VGA,PCIEX0, ETH2,UHCI2)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ B (AC97,PCIEX1, ETH1)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ C (PCIEX2)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ D (SATA,UHCI1,SMB, PCIEX3)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ E (INTD,UHCI3,PATA)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ F (INTA)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ G (INTB)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ H (INTC,UHCI0,EHCI)	Auto	Auto	Auto	
1st Exclusive PCI	-	-	-	
2nd Exclusive PCI	-	-	-	

Tabelle 218: 945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht

PCI Express Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Active State Power-Management	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 0	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 1	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 2 (IF-Slot)	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 3	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 4 (ETH2)	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 5 (ETH1)	Auto	Auto	Auto	
PCIE High Priority Port	Disabled	Disabled	Disabled	
Res. PCIE Hotplug Resource	No	No	No	
PCIE Port 0 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 1 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 2 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 3 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 219: 945GME Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsübersicht

Graphics Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Primary Video Device	Internal VGA	Internal VGA	Internal VGA	
Internal Graphics Mode Select	Enabled, 8MB	Enabled, 8MB	Enabled, 8MB	
DVMT Mode Select	DVMT Mode	DVMT Mode	DVMT Mode	
DVMT/FIXED Memory	128MB	128MB	128MB	
Boot Display Device	Auto	Auto	Auto	
Boot Display Preference	SDVO-B SDVO-C LFP	SDVO-B SDVO-C LFP	SDVO-B SDVO-C LFP	
Local Flat Panel Type	Auto	Auto	Auto	
Local Flat Panel Scaling	Centering	Centering	Centering	

Tabelle 220: 945GME Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht

Software • BIOS Optionen

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
SDVO Port B Device	DVI	DVI	DVI	
SDVO Port C Device	DVI	DVI	DVI	
SDVO/DVI Hotplug Support	Enabled	Enabled	Enabled	
Display Mode Persistance	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 220: 945GME Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht

CPU Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
MPS Revision	1.4	1.4	1.4	
Max CPUID Value Limit	Disabled	Disabled	Disabled	
Execute Disable Bit	Enabled	Enabled	Enabled	
Core Multi-Processing	Enabled	Enabled	Enabled	
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.	Automatic	Automatic	Automatic	
Max. CPU Frequency	xxxx MHz	xxxx MHz	xxxx MHz	
C1 Config.	Standard	Standard	Standard	
C2 Config.	Disabled	Disabled	Disabled	
C3 Config.	Disabled	Disabled	Disabled	
C4 Config.	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 221: 945GME Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht

Chipset Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
DRAM Frequency	Auto	Auto	Auto	
DRAM Refresh Rate	Auto	Auto	Auto	
Memory Hole	Disabled	Disabled	Disabled	
DIMM Thermal Control	Disabled	Disabled	Disabled	
DT in SPD	Disabled	Disabled	Disabled	
TS on DIMM	Disabled	Disabled	Disabled	
High Precision Event Timer	Disabled	Disabled	Disabled	
IOAPIC	Enabled	Enabled	Enabled	
APIC ACPI SCI IRQ	Disabled	Disabled	Disabled	
C4 On C3	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 222: 945GME Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht

I/O Interface Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 3	Meine Einstellung
Onboard Audio Controller	AC97	AC97	AC97	

Tabelle 223: 945GME Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsübersicht

Clock Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Spread Spectrum	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 224: 945GME Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsübersicht

IDE Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
ATA/IDE Configuration	Compatible	Compatible	Compatible	
Legacy IDE Channels	SATA Pri, PATA Sec	SATA Pri, PATA Sec	SATA Pri, PATA Sec	
Configure SATA as	-	-	-	
Configure SATA as Channels	-	-	-	
AHCI/RAID SATA Hotplug	-	-	-	
Hard Disk Write Protect	Disabled	Disabled	Disabled	
IDE Detect Time Out (Sec)	35	35	35	
ATA(PI) 80Pin Cable Detection	Host & Device	Host & Device	Host & Device	
Primary IDE Master				
Туре	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	
Primary IDE Slave				
Туре	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	
Secondary IDE Master				
Туре	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	
Secondary IDE Slave				
Туре	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 225: 945GME Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht

USB Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
USB Function	8 USB Ports	8 USB Ports	8 USB Ports	
USB 2.0 Controller	Enabled	Enabled	Enabled	
Legacy USB Support	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Legacy POST-Always	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Keyboard Legacy Support	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Mouse Legacy Support	Disabled	Disabled	Disabled	
USB Storage Device Support	Enabled	Enabled	Enabled	
Port 64/60 Emulation	Disabled	Disabled	Disabled	
USB 2.0 Controller Mode	HiSpeed	HiSpeed	HiSpeed	
BIOS EHCI Hand-Off	Disabled	Disabled	Disabled	
USB Beep Message	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Stick Default Emulation	Hard Disk	Hard Disk	Hard Disk	
USB Mass Storage Reset Delay	20 Sec	20 Sec	20 Sec	

Tabelle 226: 945GME Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht

Keyboard/Mouse Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Bootup Num-Lock	On	On	On	
Typematic Rate	Fast	Fast	Fast	

Tabelle 227: 945GME Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsübersicht

Remote Access Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Remote Access	Disabled	Disabled	Disabled	
Serial Port Number	-	-	-	
Base Address, IRQ	-	-	-	
Serial Port Mode	-	-	-	
Flow Control	-	=	-	
Redirection After BIOS POST	-	-	-	
Terminal Type	=	=	=	
VT-UTF8 Combo Key Support	-	-	-	
Sredir Memory Display Delay	-	=	-	
Serial Port BIOS Update	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 228: 945GME Advanced - Remote Access Configuration Profileinstellungsübersicht

CPU Board Monitor

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
H/W Health Function	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 229: 945GME Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsübersicht

Baseboard/Panel Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung		
Panel Control						
Select Panel Number	-	-	-			
Version	-	-	-			
Brightness	100%	100%	100%			
Temperature	-	-	-			
Fan Speed	-	-	-			
Keys/Leds	-	-	-			
Baseboard Monitor						
CMOS Battery	-	-	-			
Board I/O	-	-	-			
Board ETH2	-	-	-			
Board Power	-	-	-			
Power Supply	-	-	-			
Slide-In Drive 1	-	-	-			
Slide-In Drive 2	-	-	-			
ETH2 Controller	-	-	-			
Case 1	-	-	-			
Case 2	-	-	-			
Case 3	-	-	-			
Case 4	-	-	-			
Legacy Devices						
COM A	Enabled	Enabled	Enabled			
Base I/O address	3F8	3F8	3F8			
Interrupt	IRQ4	IRQ4	IRQ4			
COM B	Enabled	Enabled	Enabled			
Base I/O address	2F8	2F8	2F8			
Interrupt	IRQ3	IRQ3	IRQ3			
COM C	Enabled	Disabled	Disabled			
Base I/O address	3E8	-	-			
Interrupt	IRQ11	-	-			
COM D	Disabled	Disabled	Disabled			
Base I/O address	-	-	-			
Interrupt	-	-	-			
COM E	Disabled	Disabled	Disabled			
Base I/O address	-	-	-			
Interrupt	-	-	-			
CAN	Disabled	Disabled	Disabled			
Hardware Security Key	Enabled	Enabled	Enabled			
Base I/O address	378	378	378			
ETH2 LAN Controller	Enabled	Enabled	Enabled			
ETH2 MAC Adress	-	-	-			

Tabelle 230: 945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht

1.9.3 Boot

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Boot Priority Selection	Type Based	Type Based	Type Based	
1st Boot Device	Onboard LAN	Primary Master	Primary Master	
2nd Boot Device	Primary Master	Primary Slave	Primary Slave	
3rd Boot Device	Primary Slave	USB Floppy	USB Floppy	
4th Boot Device	USB Floppy	USB Removable Device	USB Removable Device	
5th Boot Device	USB Removable Device	USB Harddisk	USB Harddisk	
6th Boot Device	USB CDROM	USB CDROM	USB CDROM	
7th Boot Device	Secondary Master	Secondary Master	Secondary Master	
8th Boot Device	Secondary Slave	Secondary Slave	Secondary Slave	
Quick Boot	Enabled	Enabled	Enabled	
Quiet Boot	Disabled	Disabled	Disabled	
Automatic Boot List Retry	Disabled	Disabled	Disabled	
Add-on ROM Display Mode	Keep Current	Keep Current	Keep Current	
Halt On Error	Disabled	Disabled	Disabled	
Hit "DEL" Message Display	Enabled	Enabled	Enabled	
Interrupt 19 Capture	Disabled	Disabled	Disabled	
PXE Boot to LAN (ETH1)	Enabled	Disabled	Disabled	
Slide-In 2 Option ROM	Enabled	Disabled	Enabled	
Power Loss Control	Turn On	Turn On	Turn On	

Tabelle 231: 945GME Main Profileinstellungsübersicht

1.9.4 Security

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Supervisor Password	-	=	=	
User Password	-	-	-	
Boot Sector Virus Protection	Disabled	Disabled	Disabled	
Hard Disk Security User Password	-	-	-	
Hard Disk Security Master Password	-	-	-	

Tabelle 232: 945GME Security Profileinstellungsübersicht

1.9.5 Power

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Power Management/APM	Enabled	Enabled	Enabled	
Suspend Time Out	Disabled	Disabled	Disabled	
Video Power Down Mode	Suspend	Suspend	Suspend	
Hard Disk Power Down Mode	Suspend	Suspend	Suspend	
Keyboard & PS/2 Mouse	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
FDC/LPT/COM Ports	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Primary Master IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Primary Slave IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Secondary Master IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Secondary Slave IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Resume On Ring	Disabled	Disabled	Disabled	
Resume On PME#	Disabled	Disabled	Disabled	
Resume On RTC Alarm	Disabled	Disabled	Disabled	
Power Button Mode	On/Off	On/Off	On/Off	

Tabelle 233: 945GME Power Profileinstellungsübersicht

1.10 BIOS Fehlersignale (Beep Codes)

Während des Booten eines B&R Industrie PCs können von Seiten des BIOS folgende Meldungen bzw. Fehler auftreten, die durch verschiedene Piepscodes signalisiert werden.

Piepsintervall	Bedeutung	erforderliche Benutzerreaktion
1x kurz	Speicher - Refresh ausgefallen.	BIOS Default Werte laden. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
2x kurz	Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist fehlerhaft).	Den korrekten Sitz der gesteckten Karten überprüfen. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
3x kurz	Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler innerhalb der ersten 64 KB.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
4x kurz	Timer not Operational: System - Timer.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
5x kurz	Prozessor Error: Prozessor defekt.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
6x kurz	8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt (8042- Baustein/ A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protected Mode schalten.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
7x kurz	Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode Ausnahmefehler (CPU hat einen Interruptfehler generiert).	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
8x kurz	Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler Fehler).	Bei gesteckter Grafikkarte diese auf korrekten Sitz überprüfen und eventuell austauschen. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
9x kurz	ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht korrekt, EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt oder nicht korrekt updated.	
10x kurz	CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS kann nicht gelesen/geschrieben werden.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
11x kurz	Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem Mainboard defekt.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.

Tabelle 234: BIOS Postcode Meldungen BIOS 945GME

1.11 Ressourcenaufteilung

1.11.1 RAM-Adressbelegung

RAM Adresse	Adresse in Hex	Ressource		
(TOM - 192 kB) – TOM ¹⁾	N.A.	ACPI reclaim, MPS und NVS area2)		
(TOM - 8 MB - 192 kB) - (TOM - 192 kB)	N.A.	VGA frame buffer ³⁾		
1024 kB – (TOM - 8 MB - 192 kB)	100000h - N.A.	Extended memory		
869 kB – 1024 kB	0E0000h - 0FFFFFh	Runtime BIOS		
832 kB – 869 kB	0D0000h - 0DFFFFh	Upper memory		
640 kB – 832 kB	0A0000h - 0CFFFFh	Video memory and BIOS		
639 kB – 640 kB	09FC00h - 09FFFFh	Extended BIOS data		
0 – 639 kB	000000h - 09FC00h	Conventional memory		

Tabelle 235: RAM-Adressbelegung

- 1) TOM Top of memory: max. installierter DRAM
- Nur wenn ACPI Aware OS im Setup auf "YES" eingestellt ist.
- 3) Der VGA Grafikspeicher kann im Setup auf 1 MB reduziert werden.

1.11.2 I/O-Adressbelegung

I/O Adresse	Ressource
0000h - 00FFh	Motherboard Resourcen
0170h - 0177h	Secondary IDE Kanal
01F0h - 01F7h	Primary IDE Kanal
0238h - 023Fh	COM5
0278h - 027Fh	Hardware Security Key (LPT2)
02E8h - 02EFh	COM4
02F8h - 02FFh	COM2
0376h - 0376h	Secondary IDE Kanal Kommando Port
0377h - 0377h	Secondary IDE Kanal Status Port
0378h - 037Fh	Hardware Security Key (LPT1)
0384h - 0385h	CAN Controller
03B0h - 03DFh	Video System
03E8h - 03EFh	COM3
03F6h - 03F6h	Primary IDE Kanal Kommando Port
03F7h - 03F7h	Primary IDE Kanal Status Port
03F8h - 03FFh	COM1
0480h - 04BFh	Motherboard Resourcen
04D0h - 04D1h	Motherboard Resourcen
0800h - 087Fh	Motherboard Resourcen
0CF8h - 0CFBh	PCI Config Address Register
0CFCh - 0CFFh	PCI Config Data Register
0D00h - FFFFh	PCI / PCI Express Bus ¹⁾
4100h - 417Fh	MTCX
FF00h - FF07h	IDE Bus Master Register

Tabelle 236: I/O-Adressbelegung

1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode

IRQ		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NMI	NONE
System	timer	•																	
Tastatu	r		•																
IRQ Ka	skade			•															
COM1	(Serial port A)				0	•	0	0	0			0	0	0					
COM2	(Serial port B)				•	0	0	0	0			0	0	0					
ACPI ¹⁾											•								
Echtzei	tuhr									•									
Coproz	essor (FPU)														•				
Primär	IDE Kanal															•			
Second	lary IDE Kanal																•		
	COM3 (COM C)				0	0	0	0	0			0	0	0					•
B&R	COM4 (COM D)				0	0	0	0	0			0	0	0					•
	COM5 (COM E)				0	0	0	0	0			0	0	0					•
	CAN		1		0	0	0	0	0			0	0	0				0	•

Tabelle 237: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode

1) Advanced Configuration and Power Interface.

¹⁾ Das BIOS weist dem PCI und PCI Express Bus I/O Resourcen von FFF0h abwärts zu. Nicht PnP/PCI/PCI Express fähige Geräte dürfen die I/O Resourcen in diesem Bereich nicht verwenden.

- ... Standardeinstellung
- o ... mögliche Einstellung

1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

Im APIC (**A**dvanced **P**rogrammable Interrupt **C**ontroller) Mode stehen ingesamt 23 IRQs zur Verfügung. Die Aktivierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation des Windows Betriebssystems aktiviert wird.

IRQ		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	NMI	NO- NE
Systemtimer		•																									
Tastatu	•		•																								
IRQ Kas	skade			•																							
	Serial port A)				0	•	0	0	0			0	0	0													
COM2 (Serial port B)				•	0	0	0	0			0	0	0													
ACPI ¹⁾											•																
Echtzeit	uhr									•																	
Coprozessor (FPU)															•												
Primary IDE Kanal																•											
Second	ary IDE Kanal																•										
	COM3 (COM C)				0	0	0	0	0			0	0	0													•
B&R	COM4 (COM D)				0	0	0	0	0			0	0	0													•
Dan	COM5 (COM E)				0	0	0	0	0			0	0	0													•
	CAN				0	0	0	0	0			0	0	0												0	•
PIRQ A	2)																	•									
PIRQ B	3)																		•								
PIRQ C	4)																			•							
PIRQ D	5)																				•						
PIRQ E ⁶⁾																						•					
PIRQ F	7)																						•				
PIRQ G	8)																							•			
PIRQ H	9)																								•		

Tabelle 238: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

- 1) Advanced Configuration and Power Interface.
- 2) PIRQ A: für PCIe; UHCI Host Controller 3, VGA Controller, PCI Express Root Port 0, Intel High Definition Audio Controller, PCI-EX to SATA Bridge
- 3) PIRQ B: für PCle; AC'97 Audio, PCI Express Root Port 1, onboard Gigabit LAN Controller
- 4) PIRQ C: für PCIe; UHCI Host Controller 1, SMBus Controller, PCI Express Root Port 3, Serial ATA Controller in enhanced/native Modus
- 5) PIRQ D: für PCle; UHCl Host Controller 3, Parallel ATA Controller in enhanced/native Modus
- 6) PIRQ E: PCI Bus INTD
- 7) PIRQ F: PCI Bus INTA
- 8) PIRQ G: PCI Bus INTB
- 9) PIRQ H: PCI Bus INTC, UHCI Host Controller 0, EHCI Host Controller
- ... Standardeinstellung
- o ... mögliche Einstellung

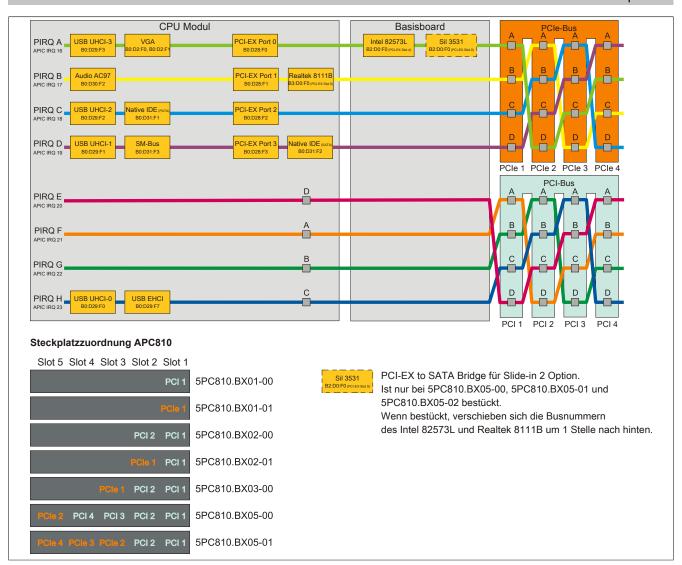


Abbildung 142: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME (COM Express) für BIOS Version ≤ 1.12

Software • BIOS Optionen

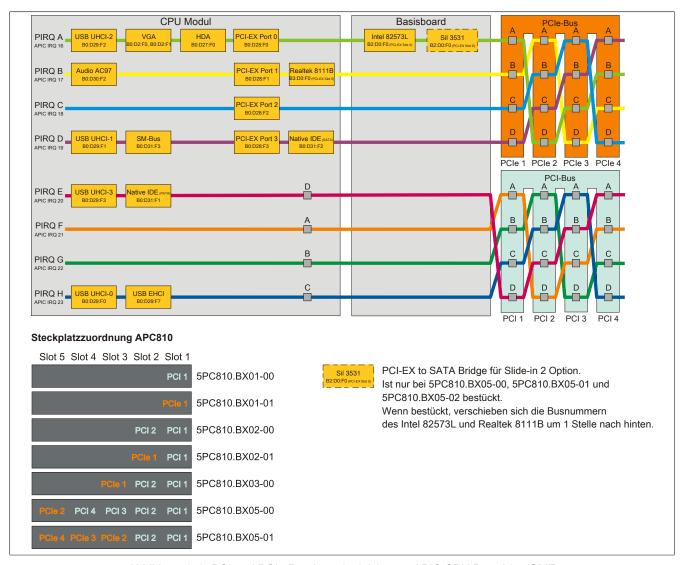


Abbildung 143: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME (COM Express) für BIOS Version ≥ 1.14 (Buseinheiten 5PC810.BX0x-0x)

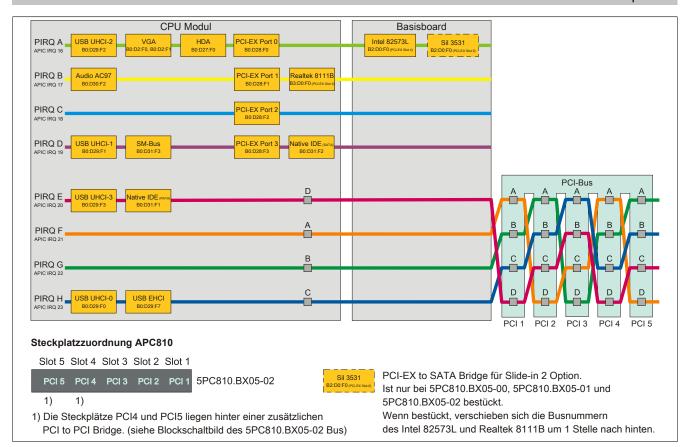


Abbildung 144: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards 945GME (COM Express) für BIOS Version ≥ 1.14 (Buseinheit 5PC810.BX05-02)

2 Upgradeinformationen

Warnung!

Das BIOS und die Firmware von B&R Geräten sind stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Neue Versionen können von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.1 BIOS Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

 Um die im BIOS Setup implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte Funktionen oder Komponenten hinzuzufügen (Informationen über Änderungen können der Liesmich bzw. der Readme Datei des BIOS Upgrades entnommen werden).

2.1.1 Was muss ich wissen?

Information:

Bei einem BIOS Upgrade werden individuell gespeicherte BIOS Einstellungen gelöscht.

Bevor man mit dem Upgrade beginnt, ist es sinnvoll die verschiedenen Softwareversionen festzustellen.

Welche BIOS Version und Firmware ist bereits am APC810 installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit "Entf" ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü "Advanced" den Unterpunkt "Baseboard/Panel Features" auswählen.

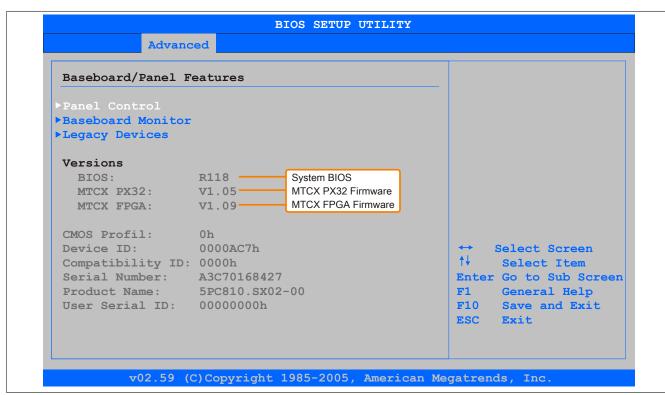


Abbildung 145: Softwareversion

Welche Firmware ist am Automation Panel Link Transmitter installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit "Entf" ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü "Advanced" den Unterpunkt "Baseboard/Panel Features" und danach den Punkt "Panel Control" auswählen.

Information:

Die Version kann nur bei angeschlossenem Automation Panel mit AP Link SDL Transmitter (5AC801.SDL0-00) angezeigt werden.

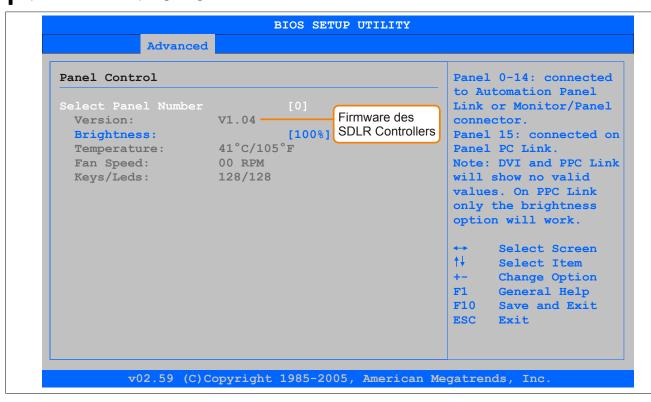


Abbildung 146: Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter

2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS

- 1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
- 2. Bootfähiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile "sys a:" oder "format a: /s" bootfähig gemacht werden.

Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 280.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks für ein B&R Upgrade siehe Seite 282.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte für ein B&R Upgrade siehe Seite 283.

- 3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfähige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefügt wurde, entfällt dieser Schritt.
- 4. Das bootfähige Medium am B&R Gerät anstecken und das Gerät neu booten.
- 5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmenü:

```
    Upgrade AMI BIOS for B945
    Exit
```

zu Punkt 1:

Das BIOS wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 Sekunden).

zu Punkt 2:

Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wird automatisch der Punkt 1 "Upgrade AMI BIOS for B945" ausgeführt und der Industrie PC selbstständig aktualisiert.

- 6. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.
- 7. Reboot und Taste "Del" drücken um in das BIOS Setup Menü zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwählen.

2.2 Firmwareupgrade

Mit der "Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)" Software ist es möglich, je nach Ausführung des APC810 Systems die Firmware mehrerer Controller (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) zu aktualisieren.

Ein aktuelles Firmware Upgrade kann direkt über den Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

2.2.1 Vorgangsweise

Um einen Firmwareupgrade durchzuführen, sind folgende Schritte auszuführen:

- 1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
- 2. Bootfähiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile "sys a:" oder "format a: /s" bootfähig gemacht werden.

Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 280.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks für ein B&R Upgrade siehe Seite 282.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte für ein B&R Upgrade siehe Seite 283.

- 3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfähige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefügt wurde, entfällt dieser Schritt.
- 4. Das bootfähige Medium am B&R Gerät anstecken und das Gerät neu booten.
- 5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmenü:

Information:

Die nachfolgenden Bootmenüoptionen einschließlich Beschreibung beziehen sich auf die Version 1.00 der APC800 Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) Disks. Es kann daher vorkommen, dass diese Beschreibungen nicht mit der vorliegenden Version übereinstimmen.

```
1. Upgrade MTCX (APC810) PX32 and FPGA
2. Upgrade SDLT (APC810) only
3. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on Monitor/Panel
3.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
3.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
3.3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)
3.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)
3.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
3.6 Return to Main Menu
4. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on AP Link Slot
4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)
4.2 Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)
4.3 Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)
4.4 Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)
4.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
4.6 Return to Main Menu
5. Upgrade Add-on UPS (Firmware and Battery Settings)
5.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)
5.2 Upgrade Battery Settings(5AC600.UPSB-00)
5.3 Return to Main Menu
6. Exit
```

zu Punkt 1

Es wird automatisch der PX32 und FPGA des MTCX aktualisiert (Default nach 5 sec).

zu Punkt 2:

Es wird automatisch der FPGA des SDLT Controllers am AP Link Slot aktualisiert.

zu Punkt 3:

Es wird das Submenü 1 zum Upgrade der SDLR Controller am Monitor/Panel Stecker geöffnet.

3.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 0 aktualisiert.

Software • Upgradeinformationen

3.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 1 aktualisiert.

3.3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 2 aktualisiert.

3.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 3 aktualisiert.

3.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)

Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am Monitor/ Panel aktualisiert (Default nach 5 sec).

3.6 Return to Main Menu

Zurück ins Hauptmenü

zu Punkt 4:

Es wird das Submenü 2 zum Upgrade der SDLR Controller am AP Link Slot geöffnet.

4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 8 aktualisiert.

4.2 Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 9 aktualisiert.

4.3 Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 10 aktualisiert.

4.4 Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 11 aktualisiert.

4.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)

Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am AP Link Slot aktualisiert (Default nach 5 sec).

4.6 Return to Main Menu

Zurück ins Hauptmenü

zu Punkt 5:

Es wird das Submenü 3 zum Upgrade der Add-on UPS Firmware und Upgrade der Batterie Settings geöffnet.

5.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)

Es wird automatisch die Firmware der Add-on UPSI aktualisiert.

5.2 Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSB-00)

Es werden automatisch die Battery Settings für 5AC600.UPSB-00 aktualisiert.

5.3 Return to Main Menu

Zurück ins Hauptmenü

zu Punkt 6:

Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Nach erfolgreichem Upgrade muss ein Power Off/On des Systems durchgeführt werden.

2.2.2 Mögliche Upgradeprobleme und Softwareabhängigkeiten (für V1.00)

- Ein Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenem Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) möglich.
- Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 dürfen nicht mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware größer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.
- Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfähig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betätigt werden (um das System in den Standby Modus zu verset-

- zen), bevor der geforderte PowerOff/ On durchgeführt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.
- Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05) gegeben.

2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP

- 1. Eine leere 1,44MB HD Diskette in das Diskettenlaufwerk stecken
- 2. Windows Explorer öffnen
- 3. Mit der rechten Maustaste auf das 3½-Diskettenlaufwerk Symbol klicken und den Punkt "Formatieren…" auswählen.

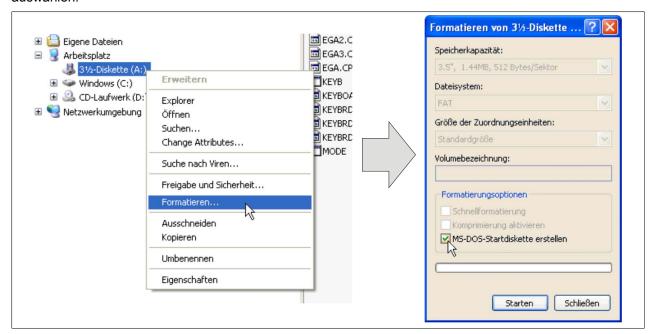


Abbildung 147: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1

4. Danach die Checkbox "MS-DOS-Startdiskette erstellen" anhaken, "Starten" drücken und die nachfolgende Warnmeldung mit "OK" bestätigen.



Abbildung 148: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2



Abbildung 149: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3

Nach der Erstellung der Startdiskette müssen nun nachträglich einige Dateien dieser Diskette gelöscht werden, da dies wegen der Größe der Updates erforderlich ist.

Dazu müssen alle Dateien (versteckte Systemdateien,...) auf der Diskette angezeigt werden.

Im Explorer- Menüpunkt "Extras" die Option "Ordneroptionen…", Registrierkarte "Ansicht", Punkt "Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)" (ist standardmäßig aktiviert) nun deaktivieren und den Punkt "Alle Dateien und Ordner anzeigen" aktivieren.

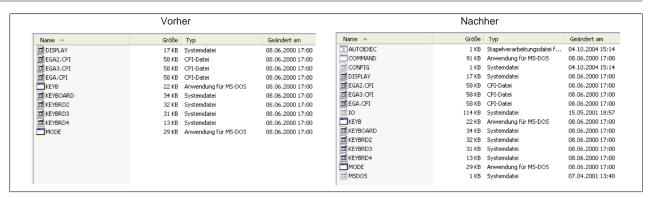


Abbildung 150: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4

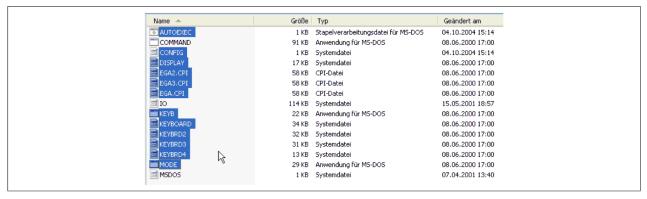


Abbildung 151: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5

Es können nun alle Dateien (markiert) bis auf Command.com, IO.sys und MSDOS.sys gelöscht werden.

2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen USB Memory Sticks ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss der USB Memory Stick speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.4.1 Was wird benötigt

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen eines bootfähigen USB Memory Sticks benötigt:

- B&R USB Memory Stick
- · B&R Industrie PC
- USB Media Drive
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.00)

2.4.2 Vorgangsweise

- 1. Verbinden des USB-Memorysticks mit dem PC.
- 2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl Laufwerke > Aktualisieren aktualisiert werden.
- 3. Markieren des USB-Memorysticks in der Laufwerksliste.
- 4. Wechseln auf die Registerkarte **Aktion** und als Aktionstyp **Ein B&R Upgrade auf einen USB-Memorystick** installieren auswählen.
- 5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche **Aus einer ZIP-Datei...** klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche **Aus einem Verzeichnis...** klicken.
- 6. In die Textbox **B&R Upgrade** kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
- 7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche Aktion starten klicken.



Abbildung 152: Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files

2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt siehe "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 280 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

2.5 So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen CompactFlash Karten ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss die CompactFlash Karte speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.5.1 Was wird benötigt?

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen einer bootfähigen CompactFlash benötigt:

- · CompactFlash Karte
- B&R Industrie PC
- · USB Media Drive
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.10)

2.5.2 Vorgangsweise

- 1. Einstecken der CompactFlash Karte in den CF-Slot des Industrie PCs.
- 2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl Laufwerke > Aktualisieren aktualisiert werden.
- 3. Markieren der CompactFlash Karte in der Laufwerksliste.
- 4. Wechseln auf die Registerkarte **Aktion** und als Aktionstyp **Ein B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte installieren** auswählen.
- Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche Aus einer ZIP-Datei... klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche Aus einem Verzeichnis... klicken.
- 6. In die Textbox **B&R Upgrade** kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
- 7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche Aktion starten klicken.



Abbildung 153: Erstellung einer CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files

2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt siehe "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 280 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

2.6 Upgradeprobleme

Mögliche Upgradeprobleme können in den Liesmich.txt bzw. Readme.txt Dateien der Upgrade Disks nachgelesen werden.

3 Microsoft DOS

3.1 Bestelldaten



Tabelle 239: 9S0000.01-010, 9S0000.01-020 - Bestelldaten

3.2 Bekannte Probleme

Für folgende Hardwarekomponenten stehen keine Treiber zur Verfügung oder es ist mit Einschränkungen zu rechnen:

- AC97 Sound keine Unterstützung
- USB 2.0 es kann nur USB 1.1 Geschwindigkeit erreicht werden.
- Ein zweiter Grafikstrang und somit der Erweiterte Desktop Modus kann nicht genutzt werden.
- Einige "ACPI Control" Funktionen des BIOS können nicht verwendet werden.

3.3 Auflösungen und Farbtiefe

Die nachfolgende Tabelle zeigt die getesteten Auflösungen und Farbtiefen am Monitor / Panel Stecker mit 945GME CPU Boards.

	Farbtiefe							
Auflösungen bei DVI	8 Bit	16 Bit	24 Bit					
640 x 480	✓	✓	✓					
800 x 600	✓	✓	✓					
1024 x 768	✓	✓	✓					
1280 x 1024	✓	✓	✓					

Tabelle 240: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei DVI Signalen

	Farbtiefe								
Auflösungen bei RGB	8 Bit	16 Bit	24 Bit						
640 x 480	✓	✓	✓						
800 x 600	✓	✓	✓						
1024 x 768	✓	✓	✓						
1280 x 1024	✓	✓	✓						
1600 x 1200	✓	✓	✓						
1920 x 1440	✓	✓	✓						

Tabelle 241: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei RGB Signalen

4 Windows XP Professional

4.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Professional	
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	Microsoft ^a
5SWWXP.0500-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	Windows xp
5SWWXP.0500-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	Professional
5SWWXP.0500-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	

Tabelle 242: 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL, 5SWWXP.0500-ENG, 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten

4.2 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Spei- cherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Ar- beitsspeicher
5SWWXP.0600-ENG	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC705 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Englisch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600-GER	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC700 PPC725 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Deutsch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600-MUL	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC705 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Multilangua- ge	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-ENG	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Englisch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-GER	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Deutsch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-MUL	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Multilangua- ge	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte

4.3 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows XP Professional Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

4.3.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06

Um Windows XP Professional auf dem PCI SATA RAID Controller zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

- Herunterladen des RAID-Treibers von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> und die Dateien auf eine Diskette kopieren.
- 2. Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle anstecken.
- 3. Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.
- 4. Im Setup die Taste F6 drücken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.
- 5. Die Taste "s" drücken, wenn gefragt wird ob ein zusätzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in das Floppy Laufwerk stecken. "Enter" drücken und den Treiber auswählen.
- 6. Den Setup Anweisungen folgen.
- 7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den Automation PC 810 neu.

4.3.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante

Bei Installation auf eine Slide-in HDD, welche im Slide-in Slot 2 (liegt hinter der PCI to SATA Bridge) des APC810 betrieben wird, sind folgende Schritte notwendig:

- 1. Herunterladen des Si3531 SATA Treibers von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> und die Dateien auf eine Diskette kopieren.
- 2. Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle anstecken.
- 3. Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.
- 4. Im Setup die Taste F6 drücken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.
- 5. Die Taste "s" drücken, wenn gefragt wird ob ein zusätzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in das Floppy Laufwerk stecken. "Enter" drücken und den Treiber auswählen.
- 6. Den Setup Anweisungen folgen.
- 7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den Automation PC 810 neu.

Information:

- Nicht alle USB-FDD Laufwerke werden vom Windows XP Setup unterstützt (siehe Microsoft KB 916196).
- Abhängig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.

4.4 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

5 Windows 7

5.1 Allgemeines

Windows® 7 bietet eine Vielzahl innovativer Features und Leistungsverbesserungen. Die 64 Bit Varianten nutzen die aktuelle PC Infrastruktur voll aus. Schnelleres Versetzen in den Energiesparmodus, schnelleres Wiederherstellen, geringere Speichernutzung und schnelleres Erkennen von USB-Geräten sind nur einige der Vorteile, die Windows® 7 bietet. In der Professional Ausführung steht Windows® 7 in den Sprachvarianten Deutsch und Englisch zur Verfügung, während Windows® 7 Ultimate bis zu 35 Sprachen (ab Service Pack 1 bis zu 36 Sprachen) unterstützt. Eine Produktaktivierung ist beim Einsatz auf B&R PCs nicht erforderlich, ein großer Vorteil für einfache logistische Abläufe im Zuge der Maschinenautomatisierung.

Alle von B&R angebotenen Windows® Betriebssysteme stammen von der Microsoft Embedded Division. Dies bedeutet eine gegenüber dem Consumermarkt erheblich längere Verfügbarkeit.

5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows 7 Professional/Ultimate	/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
5SWWI7.1100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	Windows 7
5SWWI7.1100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	

Tabelle 243: 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.1200-ENG, 5SWWI7.1300-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bestelldaten

5.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Deutsch	auf Wunsch		1 GByte
5SWWI7.1100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch		1 GByte
5SWWI7.1200-GER	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Co- re™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Deutsch	auf Wunsch		2 GByte
5SWWI7.1200-ENG	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Co- re™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Englisch	auf Wunsch		2 GByte
5SWWI7.1300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch		1 GByte
5SWWI7.1400-MUL	Ultimate	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Co- re™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch		2 GByte

5.4 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows 7 Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

5.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06

Um Windows 7 auf dem PCI SATA RAID Controler zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

- 1. Herunterladen des Raid-Treibers für Windows 7 von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Daten auf ein Verzeichnis eines USB Memory Sticks kopieren.
- 2. Mit Windows 7 DVD booten.
- 3. Den Installationsdialogen folgen bis der Dialog "Wo möchten Sie Windows installieren?" angezeigt wird.
- 4. Den USB Memory Stick mit den RAID Treibern an einen freien USB-Port anstecken.
- 5. Auf "Treiber laden" klicken, und mit dem Durchsuchen Button auf das Verzeichnis mit den RAID-Treibern gehen. Anschließend auf Weiter klicken.
- Den USB Memory Stick entfernen.
- 7. Nun kann die Windows 7 Installation wie gewohnt durchgeführt werden.

5.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante

Bei der Installation auf eine Slide-in HDD, welche im Slide-in Slot 2 (liegt hinter der PCI to SATA Bridge) des APC810 betrieben wird, sind folgende Schritte notwendig:

- 1. Herunterladen des Sil3531 SATA Treibers für Windows 7 von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> und die Daten auf ein Verzeichnis eines USB Memory Sticks kopieren.
- 2. Mit Windows7 DVD booten.
- 3. Den Installationsdialogen folgen bis der Dialog "Wo möchten Sie Windows installieren?" angezeigt wird.
- 4. Den USB Memory Stick mit den RAID Treibern an einen freien USB-Port anstecken.
- 5. Auf "Treiber laden" klicken, und mit dem Durchsuchen Button auf das Verzeichnis mit den RAID-Treibern gehen. Anschließend auf Weiter klicken.
- 6. Den USB Memory Stick entfernen.
- 7. Nun kann die Windows 7 Installation wie gewohnt durchgeführt werden.

Information:

Abhängig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.

5.5 Eigenheiten, Einschränkungen

- In Windows 7 ist kein Beep.sys mehr enthalten, somit ist auch z.B. bei einem Tastendruck kein akustisches Signal mehr hörbar.
- Die Ermittlung der Windows 7 Systembewertung (Systemklassifikation) wird aktuell nicht unterstützt (dies gilt nicht für PP500, APC510, APC511, APC910 und PPC800 mit NM10 Chipsatz).

5.6 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

6 Windows XP Embedded

6.1 Allgemeines

Windows XP Embedded ist die modularisierte Version des Desktop Betriebssystems Windows XP Professional. Windows XP Embedded basiert auf den gleichen Binaries wie Windows XP Professional und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows XP Professional liefert Windows XP Embedded in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Embedded	
5SWWXP.0426-ENG	Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash se- parat bestellen (mind. 512 MByte).	
	Erforderliches Zubehör	Embedded
	CompactFlash	Lilibeaaca
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 244: 5SWWXP.0426-ENG - Bestelldaten

6.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0426-ENG	APC810	945GME	Englisch	Ja	512 MByte	128 MByte

6.4 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows XP Embedded mit Feature Pack 2007 (FP2007).

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	✓
File Based Write Filter	✓
Administrator Account	✓
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	✓
Registry Filter	✓
Internet Explorer 6.0 + SP2	✓
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	✓
Windows Firewall	✓
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	✓
Remote Desktop	✓
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
Codepages/User Locale/Keyboard	✓
Disk Management Service	✓
Windows Installer Service	✓
Class Installer	✓
CoDevice Installer	✓
Media Player	-
DirectX	-
Accessorries	✓
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 245: Gerätefunktionen unter Windows XP Embedded mit FP2007

6.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows XP Embedded schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 512 MByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

6.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

6.6.1 Touchscreentreiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touchscreen Geräte betrieben werden, so muss der Touchscreentreiber manuell nachinstalliert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen möglich aktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

7 Windows Embedded Standard 2009

7.1 Allgemeines

Windows® Embedded Standard 2009 ist die modulare Variante von Windows® XP Professional. Es kommt zum Einsatz wenn XP Applikationen bei minimierter Betriebssystemgröße ablaufen sollen. In Kombination mit Compact-Flash Speichern ermöglicht Windows® Embedded Standard 2009 den Einsatz des Microsoft Desktop Betriebssystems bei rauen Umgebungsbedingungen. Zusätzlich zu bekannten Features von Windows® XP Professional ist Windows® Embedded Standard 2009 durch einen Write Filter für einzelne Speicherpartitionen in Bezug auf die Zuverlässigkeit verbessert worden. Durch den Schutz einzelner Partitionen, wie der Bootpartition kann das PC System auch nach einem Stromausfall wieder problemlos gestartet werden. Um den Einstieg bei Windows® Embedded Standard 2009 so einfach wie möglich zu gestalten bietet B&R komplette Images für Industrie PCs, Power Panel und Mobile Panel an. Neben Windows® Embedded Standard 2009 steht auch das Standard Betriebssystem Windows® XP Professional in den Varianten deutsch, englisch und multilanguage zur Verfügung.

Windows® Embedded Standard 2009 basiert auf den gleichen Binaries wie Windows® XP Professional mit Service Pack 3 und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows® XP Professional mit SP3 liefert Windows® Embedded Standard 2009 in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0726-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GByte).	Windows Embedded Standard 2009
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 246: 5SWWXP.0726-ENG - Bestelldaten

7.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0726-ENG	APC810	945GME	Englisch	Ja	1 GByte	256 MByte

7.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 2009.

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓
Pagefile	konfigurierbar
Administrator Account	✓
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	✓
Registry Filter	✓
Internet Explorer 7.0	✓
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	✓
Windows Firewall	✓
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	✓
Remote Desktop	✓
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
Local Network Bridge	✓

Tabelle 247: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

Software • Windows Embedded Standard 2009

Funktion	vorhanden
Codepages/User Locale/Keyboard	✓
Disk Management Service	✓
Windows Installer Service	✓
Class Installer	✓
CoDevice Installer	✓
Media Player 6.4	✓
DirectX 9.0c	✓
Accessories	✓
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 247: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

7.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 2009 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 1 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

7.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

7.6.1 Touch Screen Treiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touch Screen Geräte betrieben werden, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert bzw. im Geräte-Manager die Touch Screen Schnittstelle aktualisiert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen aktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

8 Windows Embedded Standard 7

8.1 Allgemeines

Das Pendant zu Windows® XP Embedded heißt in der neuen Variante Windows® Embedded Standard 7. Wie bei den Vorgängerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstützung von B&R Industrie PCs. Windows® Embedded Standard 7 beinhaltet neben neuen Features, die auch in Windows® 7 Professional enthalten sind, die bewährten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter und USB Boot. Windows® Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Möglichkeit der mehrsprachigen Ausführung. Die Basisvariante Windows® Embedded Standard 7 wird in einer Sprachversion geliefert, während Windows® Embedded Standard 7 Premium mehrere gleichzeitig installierte Sprachen unterstützt.

Bei Windows® Embedded Standard 7 hat Microsoft beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker der Premium Variante kann die Ausführung von unbekannten und möglicherweise unerwünschten Applikationen verhindern, die zum Beispiel über Netzwerk oder direkt angeschlossene Laufwerke installiert werden sollen. Dabei kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx) unterschieden werden. Der AppLocker kann so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitäten aufzeichnet und im EventViewer darstellt. Windows® Embedded Standard 7 wird sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit Version angeboten.⁵⁾ Damit werden auch anspruchsvolle Applikationen unterstützt, die auf 64-Bit Basis laufen.

8.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1526-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; Compact-Flash separat bestellen (mind. 16 GByte).	Windows Embedded Standard 7
5SWWI7.1626-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit 945GME Chipsatz; Compact-Flash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.1726-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32- Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.1826-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64- Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	
	Optionales Zubehör	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.1900-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Language Pack DVD	
5SWWI7.2000-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Language Pack DVD	

Tabelle 248: 5SWWI7.1526-ENG, 5SWWI7.1626-ENG, 5SWWI7.1726-MUL, 5SWWI7.1826-MUL - Bestelldaten

8.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1526-ENG	Embedded	APC810	945GME	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1626-ENG	Embedded	APC810	945GME Intel® Co- re™2 Duo	SP1	64-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	2 GByte
5SWWI7.1726-MUL	Premium	APC810	945GME	SP1	32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte 1)	1 GByte
5SWWI7.1826-MUL	Premium	APC810	945GME Intel® Co- re™2 Duo	SP1	64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte 1)	2 GByte

¹⁾ Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

8.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 7.

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Enhanced Write Filter (EWF)	✓	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓	✓
Administrator Account	✓	✓
User Account	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows Explorer Shell	✓	✓
Registry Filter	✓	✓
Internet Explorer 8.0	✓	✓
Internet Information Service (IIS) 7.0	✓	✓
AntiMalware (Windows Defender)	-	✓
Add-ons (Snipping tool, Sticky Notes)	-	✓
Windows Firewall	✓	✓
.NET Framework 3.5	✓	✓
32-Bit und 64-Bit Support	✓	✓
Remote Dektop Protocol 7.0	✓	✓
File Compression Utility	✓	✓
Windows Installer Service	✓	✓
Windows XP Mode	-	-
Media Player 12	✓	✓
DirectX	✓	✓
Multilingual User Interface Packs im selben Image	-	✓
International Components and Language Services	✓	✓
Language Pack Setup	✓	✓
Windows Update	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows PowerShell 2.0	✓	✓
Bitlocker	-	✓
Applocker	-	✓
Tablet PC Support	-	✓
Windows Touch	-	✓
Boot from USB Stick	✓	✓
Accessorries	✓	✓
Pagefile	konfigurierbar	konfigurierbar
Anzahl der Fonts	134	134

Tabelle 249: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

8.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 7 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (32-Bit: mind. 8 GByte; 64-Bit: mind. 16 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

Information:

Wenn der EWF verwendet werden soll, sind während des Setup oder SYSPREP alle Massenspeicher (außer dem Bootlaufwerk) aus dem System zu entfernen. Alternativ können die zusätzlichen Massenspeicher auch im BIOS deaktiviert werden.

8.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversionen installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

8.6.1 Touch Screen Treiber

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert. Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein Automation Panel 800/900 nachträglich angeschlossen, muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert oder in den Touch Screen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung die zusätzliche Touch Screen Schnittstelle ausgewählt werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kein "Enhanced Write Filter (EWF)" oder "File Based Write Filter (FBWF)" aktiviert ist.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

9 Windows CE

9.1 Allgemeines

B&R Windows CE ist ein Betriebssystem, das für das von B&R angebotene Gerät optimal zugeschnitten ist, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Dadurch ist dieses Betriebssystem äußerst robust und stabil. Ein weiterer Vorteil den B&R Windows CE gegenüber anderen Betriebssystemen mit sich bringt sind die geringen Lizenzkosten.

9.2 Bestelldaten

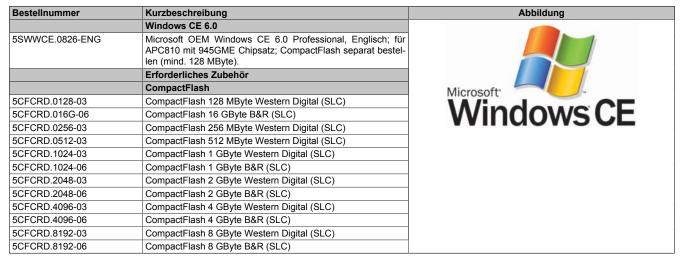


Tabelle 250: 5SWWCE.0826-ENG - Bestelldaten

9.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWCE.0826-ENG	APC810	945GME	Englisch	Ja	128 MByte	128 MByte

9.4 Features Windows CE 6.0

Eine ausführliche Anleitung zu Windows CE für B&R Geräte kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

Ausstattung	Windows CE 6.0
Unterstützte Bildschirmauflösung	VGA (TFT), SVGA (TFT), XGA (TFT)
Chipset	Intel 945GME
Farbtiefe	16 Bit bzw. 65.536 Farben ¹⁾
Grafikkartentreiber	Intel(R) Embedded Graphics Driver
Hauptspeicher	Automatische Erkennung und Verwendung von bis zu 512 MByte RAM
Bootzeit / Hochlaufzeit	ca. 25 Sekunden
Screenrotation	wird nicht unterstützt
Webbrowser	Internet Explorer
.Net	Compact Framework
Imagegröße	ca. 38 MByte ²⁾ , nicht komprimiert
Kundenspezifische Tasten	werden unterstützt
PVI	wird unterstützt
Automation Device Interface	wird unterstützt
Remote Desktop Protokoll für Thin Client	wird unterstützt
B&R VNC Viewer	wird unterstützt
B&R Task Manager	wird unterstützt
B&R Picture Viewer	wird unterstützt
Kompatibel mit zenOn	Ja
Kompatibel mit Wonderware	Nein
Serielle Schnittstellen zur freien Verwendung	3
DirectX	Nein
Audio Schnittstellen	"Line OUT" und "MIC" werden unterstützt. "Line IN" wird nicht unterstützt

Tabelle 251: Eigenschaften Windows CE 6.0

- 1) Die Farbtiefe hängt auch vom verwendeten Display ab.
- 2) Verwenden Sie die Funktion "Windows CE Image komprimieren" des B&R Embedded OS Installers um die Imagegröße zu reduzieren.

9.5 Was wird benötigt

Das Gerät muss folgende Kriterien erfüllen um das Betriebssystem Windows CE zu betreiben.

- · Mindestens 128 MByte Hauptspeicher
- Mindestens eine 128 MByte CompactFlash Karte (Größe ist bei der Bestellung mitanzugeben)

9.6 Installation

Generell wird Windows CE schon im Hause B&R vorinstalliert.

9.7 B&R Embedded OS Installer

Mit dem B&R Embedded OS Installer ist es möglich bestehende B&R Windows CE Images zu installieren. Es müssen dazu die 4 Dateien NK.BIN, BLDR, LOGOXRES.BMP und LOGOQVGA. BMP von einer bereits funktionierenden B&R Windows CE Installation vorliegen.

Der B&R Embedded OS Installer kann im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden. Weitere Informationen sind der Online Hilfe des B&R Embedded OS Installers zu entnehmen.

10 Automation Runtime

10.1 Allgemeines

Integraler Bestandteil des Automation Studio ist das Echtzeit Betriebssystem. Dieses Echtzeit Betriebssystem bildet den Softwarekern um Anwendungen auf einem Zielsystem laufen zu lassen.

- · Garantiert höchst mögliche Leistung für die eingesetzte Hardware
- · Läuft auf allen B&R Zielsystemen
- Macht die Anwendung hardwareunabhängig
- Anwendungen können einfach zwischen B&R Zielsystemen portiert werden
- · Garantierter Determinismus durch zyklisches Laufzeitsystem
- · Multitasking nach dem deterministischen Verfahren der Laufzeitgarantie
- · Konfiguration der Prioritäten, Zeitklassen und Jitter-Toleranz
- Bis zu 8 verschiedene Zeitklassen mit beliebigen Unterprogrammen
- Garantierte Reaktion auf Zeitverletzungen und Jitter-Überschreitung
- Ausnahmebehandlung
- Jitter-Toleranz in allen Task-Klassen konfigurierbar
- Unterstützung aller relevanten Programmiersprachen wie IEC 61131-3 und ANSI-C
- Umfangreiche Funktionsbibliothek nach IEC 61131-3 und zusätzlich die erweiterte Automation Bibliothek
- Zugriff auf alle Netzwerke und Bussysteme durch die Konfiguration in Automation Studio oder über Funktionsaufrufe

Das B&R Automation Runtime ist voll im entsprechenden Zielsystem (Hardware, auf der das Automation Runtime installiert wird) eingebettet. Es ermöglicht damit den Zugriff der Anwenderprogramme auf I/O Systeme (auch via Feldbus) und andere Geräte wie Schnittstellen und Netzwerke.

10.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Based Runtime	
1A4600.10	B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	
1A4600.10-2	B&R Automation Runtime ARwin, ARNC0	
1A4600.10-3	B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls inkl. Lizenzauf- kleber und Kopierschutz	
1A4600.10-4	B&R Automation Runtime ARwin+ARNC0+PVIControls	
1A4601.06	B&R Automation Runtime ARemb, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	1
1A4601.06-2	B&R Automation Runtime ARemb. ARNC0	

Tabelle 252: 1A4600.10, 1A4600.10-2, 1A4600.10-3, 1A4600.10-4, 1A4601.06, 1A4601.06-2 - Bestelldaten

10.3 Automation Runtime Windows (ARwin)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das ARwin auf Basis eines AS 2.7 / AR 2.xx Upgrades.

10.4 Automation Runtime Embedded (ARemb)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das ARemb auf Basis eines AS 3.0.90 / AR 4.00 Upgrades.

11 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center

ADI (Automation Device Interface) ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Die Einstellungen dieser Geräte können mit dem B&R Control Center Applet in der Systemsteuerung ausgelesen und geändert werden.

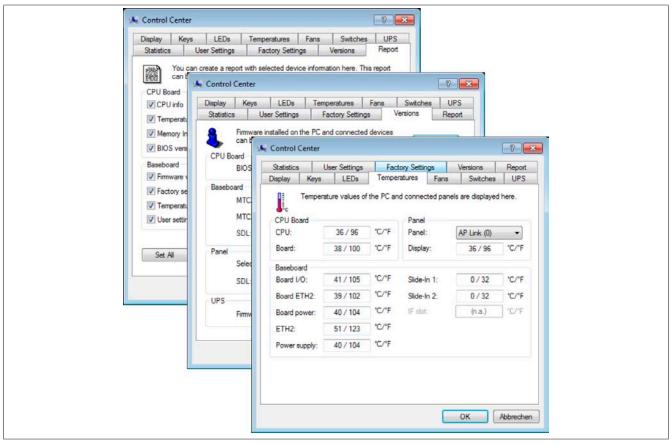


Abbildung 154: ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto)

Information:

Die angezeigten Temperatur- und Spannungswerte (z.B. CPU Temperatur, Corespannung, Batteriespannung) auf der entsprechenden ADI Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarme bzw. Fehlzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

11.1 Funktionen

Information:

Die vom Automation Device Interface (ADI) - Control Center verfügbaren Funktionen sind von der Gerätefamilie abhängig.

- Ändern von displayspezifischen Parametern
- Auslesen von gerätespezifischen Tasten
- · Update der Tastenkonfiguration
- Aktivierung von gerätespezifischen LEDs einer Folientastatur
- Auslesen bzw. Kalibrieren von Befehlsgeräten (z.B. Schlüsselschalter, Handrad, Joystick, Potentiometer)
- Auslesen von Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten, Statistikdaten und Schalterstellungen
- Auslesen der Betriebsstunden (Power On hours)
- · Auslesen von User Settings und Factory Settings
- Auslesen von Softwareversionen
- Aktualisieren und Sichern von BIOS und Firmware
- · Reporterstellung über das aktuelle System (Supportunterstützung)
- Einstellung des SDL Equalizerwertes für die SDL Kabelanpassung

Ändern der User Serial ID

Unterstützt werden folgende Systeme:

- · Automation PC 510
- · Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- · Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- · Panel PC 725
- Panel PC 800
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- · Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- · angeschlossene Automation Panel 800
- · angeschlossene Automation Panel 900

11.2 Installation

Eine detaillierte Beschreibung des Control Centers ist der integrierten Online Hilfe zu entnehmen. Der B&R Automation Device Interface (ADI) Treiber (beinhaltet auch Control Center) kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

- 1. Herunterladen und entpacken des ZIP Archives
- 2. Schließen aller Anwendungen
- 3. Starten der Setup.exe Datei (z.B. durch Doppelklick im Explorer)

Information:

In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Sollte eine aktuellere ADI Treiberversion existieren (siehe Downloadbereich der B&R Homepage), so kann diese nachinstalliert werden. Bei der Installation ist auf einen deaktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

11.3 SDL Equalizer Einstellung

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Die Registerkarte Display auswählen
- 3. Auf Einstellungen klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt:



Abbildung 155: ADI Control Center - SDL Equalizer Einstellung

In diesem Dialog können Sie die SDL Equalizereinstellung des Displays ändern. Der Equalizer ist im Automation Panel eingebaut und passt das DVI Signal für unterschiedliche Kabellängen an. Der Equalizerwert wird automatisch anhand der Kabellänge ermittelt. Sie können einen anderen Equalizerwert einstellen, um die beste optische Darstellung auf dem Display zu erreichen (z.B. bei schlechter Kabelqualität oder schlechter DVI Signalqualität).

Bei der "Automatischen Einstellung" wird der Wert anhand der Kabellänge optimal eingestellt.

Der Equalizerwert kann nur geändert werden, wenn die Funktion vom Automation Panel 900 unterstützt wird (ab Panel Firmware Version 1.04 oder höher).

11.4 USV Parametrierung

Hier können die Statuswerte einer optional eingebauten B&R Add-on USV angezeigt und die Batterieeinstellungen der USV bearbeitet, aktualisiert und gesichert werden. Ebenfalls können die Systemeinstellungen der USV konfiguriert werden.

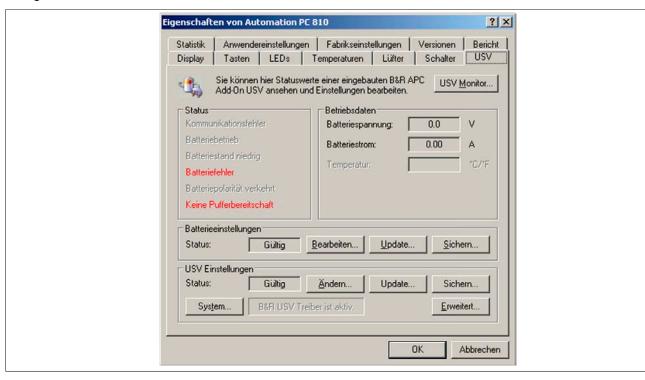


Abbildung 156: ADI Control Center - USV Einstellungen

Vorsicht!

Die eingebaute USV muss in der Systemsteuerung mit Energieoptionen ausgewählt und konfiguriert werden, damit der Batteriebetrieb unterstützt wird.

Information:

Der USV Dienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.10 oder höher unterstützt.

11.4.1 Installation des USV Dienstes für die B&R Add-on USV

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- Registerkarte USV auswählen.
- Unter USV Einstellungen auf System klicken. Die Energieoptionen in der Systemsteuerung werden geöffnet. (Die Energieoptionen k\u00f6nnen auch direkt aus der Systemsteuerung ge\u00f6ffnet werden.)
- 4. Registerkarte USV auswählen und Auswählen klicken.
- Als Hersteller 'Bernecker + Rainer' und als Modell 'APC Add-on USV' auswählen und auf Fertig stellen klicken. Der Wert für den COM Anschluss wird nur für eine seriell angeschlossene USV benötigt und vom APC Add-on USV Treiber ignoriert.
- 6. Auf **Übernehmen** klicken, um den USV Dienst zu starten. Das dauert ein paar Sekunden und danach werden USV Status und Details angezeigt.
- 7. Klicken Sie auf OK.

Das Textfeld neben **System** (auf der **USV** Registerkarte im **Control Center**) zeigt ebenfalls an, ob der B&R USV Treiber aktiv ist.

Information:

Man benötigt Administratorrechte zum Ändern von Energieoptionen und zum Anzeigen des USV Status.

11.4.2 Statuswerte der USV anzeigen

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- Registerkarte **USV** auswählen.Die angezeigten Werte werden automatisch aktualisiert.

Information:

Der "Batteriepolarität verkehrt" Zustand wird erst mit USV Firmware Version 1.08 oder höher angezeigt. Bei USV Firmware Version 1.07 oder kleiner kann es beim Wechsel zwischen Batteriebetrieb und Normalbetrieb zu einem Kommunikationsfehler kommen.

3. USV Monitor auswählen, um die Änderungen des USV Status seit dem letzten Start des Systems bzw. des USV Treibers anzuzeigen.

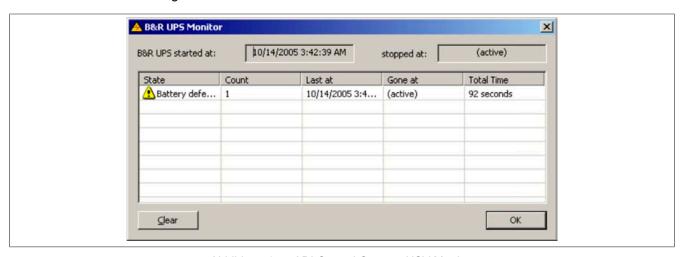


Abbildung 157: ADI Control Center - USV Monitor

Der Dialog wird bei Änderungen des Status automatisch aktualisiert.

Um die angezeigten Zustände aus der Liste zu entfernen, auf Löschen klicken.

Information:

Der aktuelle Zustand der USV wird auch bei gestartetem USV Dienst in der Windows Systemsteuerung auf der USV Seite bei den Energieoptionen angezeigt.

Information:

In einer deutschen Windows XP Professional Version wird der Batteriezustand in den Energieoptionen mit "Niedrig" angezeigt, auch wenn die Batterie in Ordnung ist (Windows Fehler). In einer englischen Version werden normalerweise drei Batteriezustände angezeigt: unbekannt, OK, zu ersetzen. Niedriger Batteriestand wird niemals angezeigt.

11.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten

- 1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
- 2. Registerkarte **USV** auswählen.
- 3. Unter Batterieeinstellungen auf Bearbeiten klicken. Datei "Öffnen" Dialog wird geöffnet.
- 4. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und öffnen der Datei.



Abbildung 158: ADI Control Center - USV Batterieeinstellungen

In diesem Dialog kann man Einstellungen für die verwendete USV Batterie bearbeiten.

Durch Klicken auf **OK** werden die geänderten Einstellungen in die Datei geschrieben. Anschließend können die Batterieeinstellungen der USV mit dieser Datei aktualisiert werden.

Information:

Wenn Einstellungen für nicht von B&R gelieferte Batterien gemacht werden sollen, kopiert man am Besten eine Datei mit Batterieeinstellungen von B&R mit einem neuen Namen ab und passt die Einstellung dieser Datei für die verwendete Batterie an.

Aktuelle Dateien mit Einstellungen für die von B&R gelieferten Batterien können über die B&R "Upgrade PPC800 MTCX" Software aktualisiert werden.

Information:

- Ladeschlussspannung, Tiefentladespannung, Lebensdauer und Tiefentladezyklen werden von der aktuellen USV Firmware Version 1.10 nicht verwendet.
- Lebensdauer ist erst ab Version 2 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur gültig für B&R USV Batterien bei 25°C Umgebungstemperatur.
- Tiefentladezyklen ist erst ab Version 3 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur gültig für B&R USV Batterien.

Information:

Wenn die auf der USV aktuell vorhandenen Batterieeinstellungen bearbeitet werden sollen, müssen diese vorher in einer Datei gesichert werden.

11.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- Registerkarte USV auswählen.
- 3. Unter Batterieeinstellungen auf Update klicken. Datei "Öffnen" Dialog wird geöffnet.
- 4. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und öffnen der Datei. Der "Download" Dialog wird geöffnet.

Die Übertragung kann durch Klicken auf **Abbrechen** im Download Dialog abgebrochen werden. Abbrechen ist während des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.

- Während der Aktualisierung der Batterieeinstellungen ist kein USV- Betrieb möglich.
- Wenn die Übertragung abgebrochen wurde, muss der Vorgang so lange wiederholt werden, bis die Batterieeinstellungen erfolgreich aktualisiert wurden. Andernfalls ist anschließend kein Batteriebetrieb mehr möglich.

Das Löschen der Daten im Flashspeicher kann, abhängig vom verwendeten Speicherbaustein, mehrere Sekunden dauern. Während dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:

Die USV wird nach erfolgreichem Download automatisch neu gestartet. Dabei kann es kurzzeitig zu einem Ausfall der USV- Kommunikation kommen.

11.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Registerkarte **USV** auswählen.
- 3. Unter Batterieeinstellungen auf **Sichern** klicken. "Speichern unter" Dialog wird geöffnet.
- 4. Dateiname eingeben oder eine bestehende Datei auswählen und auf Speichern klicken.

Information:

Das Sichern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt.

Die Übertragung kann durch klicken auf Abbrechen im "Download" Dialog abgebrochen werden.

11.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Registerkarte **USV** auswählen.
- 3. Unter USV Einstellungen auf Ändern klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.



Abbildung 159: ADI Control Center - USV Einstellungen

Weitere Informationen zu den Systemeinstellungen der USV finden Sie in der Windows Hilfe.

- Das Ändern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt. Wenn auf der USV keine geänderten Einstellungen vorhanden sind, werden Fabriks- oder Defaulteinstellungen verwendet.
- Die USV wird nach dem Ändern von USV Einstellungen automatisch neu gestartet. Dabei kann es kurzzeitig zu einem Ausfall der Kommunikation mit der USV kommen.
- Man benötigt Administratorrechte zum Ändern von Energieoptionen und zum Anzeigen des USV Status.

Ausschalten der 8 A Strombegrenzung

Information:

Ein Ausschalten der 8 A Strombegrenzung bei Geräten im Batteriebetrieb ist nicht UL-konform!

Ein "Low Battery" Shutdown bei einem Überstrom von > 8 A bei Geräten im Batteriebetrieb ist nicht UL-konform!

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Strombegrenzung (8 A) ausschalten.

Wenn die Strombegrenzung eingeschaltet ist (Kontrollkästchen ist deaktiviert), prüft die USV im Batteriebetrieb, ob die USV Batterie länger als 16 Sekunden mit mehr als 8 A entladen wird. In diesem Fall wird ein Überstromalarm zum PC signalisiert.

Information:

Die Strombegrenzung wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt.

Durch Aktivieren einer der beiden folgenden Optionen können Sie auswählen, wie sich die USV bei einem Überstromalarm verhält:

Mit innerhalb 1 Minute ausschalten schaltet die USV bei Überstrom innerhalb einer Minute ab.

Warnung!

Das Betriebssystem wird dann bei einem Überstrom Alarm nicht ordnungsgemäß niedergefahren!

Mit "Low Battery" Shutdown durchführen signalisiert die USV zusätzlich zum Überstromalarm einen "Low Battery" Alarm und schaltet sich nach der eingestellten "Low Battery" Abschaltzeit aus. Dadurch wird das Betriebssystem bei aktiviertem USV Dienst ordnungsgemäß niedergefahren.

Ändern der Abschaltzeit der USV bei niedrigem Batteriepegel

Geben Sie die **"Low Battery" Abschaltzeit** in Sekunden an. Das ist die Zeit, die von der USV bei niedrigem Batteriepegel gewartet wird, bevor sie die Stromversorgung abschaltet.

Damit wird verhindert, dass die USV Batterie zu sehr entladen wird, wenn der Windows USV Dienst nicht aktiv ist und die USV daher nicht vom Betriebssystem ausgeschaltet wird.

Wenn der USV Dienst aktiv ist, wird die USV bei niedrigem Batteriepegel vom Betriebssystem mit der Windows USV Dienst **Abschaltzeit** (siehe "Weitere USV Einstellungen ändern" auf Seite 306) abgeschaltet. Die **"Low Battery" Abschaltzeit** wird dann ignoriert.

Information:

- Die "Low Battery" Abschaltzeit muss mit mindestens 60 Sekunden angegeben werden, damit das Betriebssystem genug Zeit hat, um bei niedrigem Batteriestand den Abschaltbefehl an die USV zu senden (erfolgt normalerweise nach ca. 30 Sekunden).
- Die "Low Battery" Abschaltzeit kann erst ab USV Firmware Version 1.10 eingestellt werden. USV Firmware Version 1.08 verwendet fix 180 Sekunden als Abschaltzeit. USV Firmware Versionen kleiner 1.08 schalten bei niedrigem Batteriepegel nicht selbständig ab.

11.4.7 Weitere USV Einstellungen ändern

Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.

- 2. Registerkarte USV auswählen.
- Unter USV Einstellungen auf Erweitert klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.



Abbildung 160: ADI Control Center - Erweiterte USV Einstellungen

Man benötigt Administratorrechte zum Anzeigen dieses Dialoges.

Abschaltzeit der USV ändern

Unter **Windows USV Dienst** kann die **Abschaltzeit** in Sekunden angegeben werden. Das ist die Zeit, in der gewartet wird, bis die USV die Stromversorgung abschaltet. Dazu wird vom Windows USV Dienst bei einem kritischen Alarm (z.B. bei niedrigem Batteriestand) ein Shutdown Kommando mit der Abschaltzeit an die USV gesendet und das System heruntergefahren.

Information:

Diese Zeit wird vom Windows USV Dienst ausgewertet, kann aber in den USV Systemeinstellungen der Energieoptionen nicht eingestellt werden. Dieser Wert sollte nur geändert werden, wenn das System länger als die standardmäßig eingestellten 180 Sekunden zum Niederfahren benötigt.

Vorsicht!

Die angegebene Zeit muss größer sein als die für das Niederfahren des Betriebssystems benötigte Zeit.

Benachrichtigungen der USV aktivieren

Unter **B&R USV Treiber** das Kontrollkästchen **Nachrichten für USV Status ausgeben** aktivieren. Es wird dann vom B&R USV Treiber bei jeder Änderung des USV Status eine Meldung ausgegeben.

Information:

Das Niederfahren des Systems wird nur vom Windows USV Dienst gemeldet. Vom USV Dienst werden auch weitere Benachrichtigungen gesendet, wenn diese in den USV Systemeinstellungen der Energieoptionen aktiviert sind. Diese Benachrichtigungen werden nur ausgegeben, wenn der Windows Nachrichtendienst (Messenger)⁶⁾ gestartet ist und der PC an einem Netzwerk angeschlossen ist. Außerdem werden einige Zustände der B&R Add-on USV vom Windows USV Dienst nicht erkannt und daher nicht gemeldet, z.B. wenn keine Batterieeinstellungen auf der USV vorhanden sind. Die Windows Dienste sind in der Systemsteuerung unter Verwaltung in Dienste zu finden.

Ist zusätzlich das Kontrollkästchen **USV Status mit USV Monitor anzeigen** aktiviert, so wird nicht bei jeder Änderung eine neue Meldung ausgegeben, sondern nur eine allgemeine Meldung und Aufforderung zum Starten des B&R USV Monitors. Solange der USV Monitor aktiv ist, werden keine neuen Meldungen ausgegeben.

Alle Änderungen des USV Status werden unabhängig von diesen Optionen im Windows Ereignisprotokoll (unter "Anwendung") eingetragen.

11.4.8 Ablauf bei einem Powerfail

Over Current Shutdown

Wenn im Batteriebetrieb für eine Dauer von 16 Sekunden ein Überstrom >8 A erreicht wird, wird der Over Current Shutdown eingeleitet. Dem System steht insgesamt eine Abschaltzeit von einer Minute zur Verfügung.

Wird während dieser Zeit die Versorgung wieder hergestellt wird der Abschaltvorgang abgebrochen.

Information:

Der Over Current Shutdown hat die höchste Priorität.

Low Battery Shutdown

Wird bei einem Spannungsausfall das LowBatteryFlag gesetzt wird der "Low Battery" Shutdown eingeleitet, er verhindert die Totentladung des Akkus. Nach Ablauf der Ausschaltzeit (per Default 3 Minuten) schaltet die USV aus.

Sollte während dem Abschaltvorgang ein "Overcurrent" Shutdown oder ein "Standard" Shutdown erkannt werden, wird der "Low Battery" Shutdown durch den jeweiligen Vorgang ersetzt.

Standard Shutdown

Der Standard Shutdown wird bei aktiviertem USV Dienst schlagend, die Ausschaltzeit beträgt per Default 3 Minuten.

Wenn die Versorgungsspannung während der Ausschaltzeit wiederkehrt, wird der Shutdown abgebrochen.

Wenn die Versorgungsspannung während des Abschaltvorganges wiederkehrt läuft der Shutdowntimer solange bis der B&R Industrie PC den Standby Modus erreicht hat und führt dann einen Reboot des Systems aus.

12 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z.B. mit folgenden Entwicklungsumgebungen erstellt wurden:

- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- · Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer)

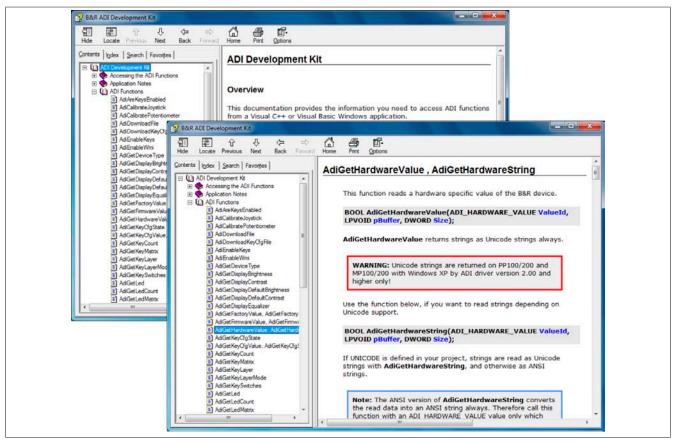


Abbildung 161: ADI Development Kit Screenshots (Version 3.40)

Features:

- Ein Microsoft Visual Basic Modul mit Deklarationen der ADI Funktionen
- Header Dateien und Import Libraries für Microsoft Visual C++
- Hilfedateien f
 ür Visual Basic und Visual C++
- Beispielprojekte für Visual Basic und Visual C++
- · ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist)

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 3.40):

- · Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- · Panel PC 700
- Panel PC 800
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500

Software • B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamile installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

13 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer) erstellt wurden.

Unterstützte Programmiersprachen:

- · Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#

Systemvoraussetzungen:

- · Entwicklungssystem: PC mit Windows XP/7 mit
 - Microsoft Visual Studio 2005 oder neuer
 - ° Microsoft .NET Framework 2.0 und / oder Microsoft .NET Compact Framework 2.0 oder neuer

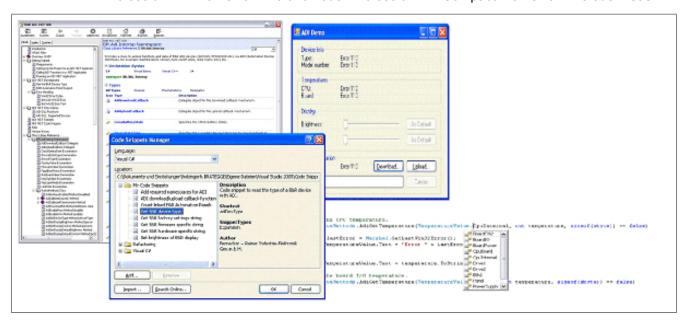


Abbildung 162: ADI .NET SDK Screenshots (Version 1.80)

Features (ab Version 1.80):

- · ADI .NET Class Library.
- Hilfedateien im HTML Help 1.0 Format (.chm Datei) und MS Help 2.0 Format (.HxS Datei). (Hilfe ist in Englisch)
- Beispielprojekte und Code Snippets für Visual Basic, Visual C++, Visual C#.
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist).

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 1.80):

- Automation PC 510
- · Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- · Panel PC 700
- Panel PC 800
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200

Software • B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamile installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das ADI .NET SDK kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

14 B&R Key Editor

Eine häufig auftretende Anforderung bei Displayeinheiten ist die Anpassung der Funktionstasten und LEDs an die Applikationssoftware. Mit dem B&R Key Editor ist die individuelle Anpassung an die Applikation schnell und problemlos möglich.

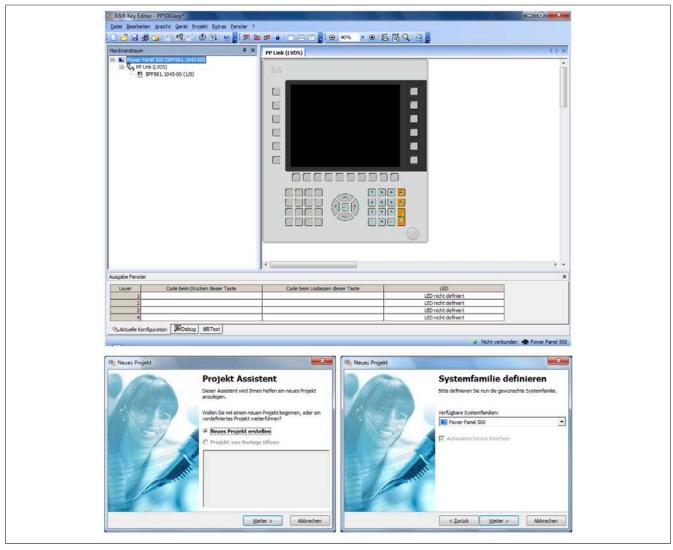


Abbildung 163: B&R Key Editor Screenshots Version 3.30 (Symbolfoto)

Features:

- Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)
- · Tastenkombinationen (CTRL+C, SHIFT+DEL, etc.) auf einer Taste
- Spezielle Funktion der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
- LEDs Funktionen zuweisen (HDD Zugriff, Power, etc.)
- 4-fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
- Parametrierung der Panel Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel 900 Geräte bei Automation PCs und Panel PCs.

Unterstützt werden folgende Systeme (Version 3.30):

- · Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- · Automation Panel 800
- Automation Panel 830

Software • B&R Key Editor

- Automation Panel 900
- IPC2000, IPC2001, IPC2002
- IPC5000, IPC5600
- IPC5000C, IPC5600C
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- Panel PC 300
- · Panel PC 700
- Panel PC 800
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500

Eine detaillierte Anleitung zum Parametrieren von Tasten und LEDs ist in der Online Hilfe des B&R Key Editors zu finden. Der B&R Key Editor kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Weiters ist dieser auf der B&R HMI Treiber- und Utilities- DVD (Best. Nr. 5SWH-MI.0000-00) zu finden.

Kapitel 5 • Normen und Zulassungen

1 Richtlinien und Erklärungen

1.1 CE- Kennzeichnung



Alle für die gültigen Richtlinien harmonisierten EN-Normen werden für B&R Produkte erfüllt

1.2 EMV-Richtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007 Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und

Prüfungen

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestig-

keit für Industriebereich

EN 61000-6-4:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen; Fachgrund-

norm Störaussendung für Industriebereich

1.3 Niederspannungsrichtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007 Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und

Prüfungen

EN 60204-1:2006 + Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemei-

A1:2009 ne Anforderungen

2 Zulassungen

Gefahr!

Ein Gesamtgerät kann nur eine Zulassung erhalten, wenn ALLE darin verbauten und angeschlossenen Einzelkomponenten die entspechende(n) Zulassungen besitzen. Wird eine Einzelkomponente verwendet, welche KEINE entsprechende Zulassung besitzt, so enthält auch das Gesamtgerät KEINE Zulassung.

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, ÖVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverlässigkeit unserer Produkte im Industriebereich. Sofern nicht anders angegeben liegen folgende Zulassungen vor:

2.1 UL Zulassung



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equiment" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL508 - 17th Edition Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 142-M1987

2.2 Zulassungen für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

2.2.1 UL Haz. Loc. Zulassung



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equiment for Use in Hazardous Loactions" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard ANSI/ISA 12.12.01:2011 Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 213-M1987

Ind. Cont. Eq. for Haz.Locs. Cl. I, Div. 2, Groups ABCD Listed 2P61

2.2.2 ATEX Zulassung



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle geprüft und für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.

II 3D Ex tc IIIA T85°C Dc IP20 Tamb: 0°C to 55°C FTZU 11 E 0001U

2.2.3 Anforderungen zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Geräte des Systems Automation PC 810 sind für den Einsatz in der oben beschriebenen Umgebung oder an nicht explosionsgefährdeten Orten geeignet. Die Verdrahtung muss gemäß den nationalen Vorschriften und den Anforderungen der Behörde ausgeführt werden. Geräte müssen in geeigneten Schutzgehäusen eingebaut werden und die Endmontage muss von der zuständigen lokalen Behörde abgenommen werden. Zusatzausrüstung muss für den Einsatzort geeignet sein.

Explosionsgeschützte Geräte sind bestimmungsgemäß einzusetzen und dürfen nur von unterwiesenen Fachkräften gemäß dieser Anleitung und dem zugehörigen Manual betrieben werden. Ein anderer Betrieb gefährdet die Sicherheit und Funktion der Geräte und der angeschlossenen Systeme. Die Verantwortung für das Einhalten der gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, sowie Normen liegt beim Betreiber.

Montage und Installation

Geräte des Systems Automation PC 810 sind gemäß dem Anwenderhandbuch zu montieren. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sind die spezifizierten Freiräume einzuhalten. Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 55°C. Bei Verwendung eines Prozessor Boards Kat. Nr. 5PC800.BM45-xxx ist ein Lüfterkit zu verwenden. Das Anzugsdrehmoment für Versorgungsklemmen beträgt 0,5 Nm. Kabel müssen für eine Oberflächentemperatur von 75°C geeignet sein. Geräte müssen bis zum Abschluss der Installationsarbeiten spannungsfrei sein. Geräte sind innerhalb eines Potenzialausgleichssystems einzusetzen und an den Potenzialausgleich anzuschließen. ATEX: Geräte sind in Schutzgehäuse einzubauen, die den Mindestschutzgrad IP54 nach EN 60529 und die Schutzart "tc" gemäß EN 60079-31 aufweisen.

Wartung

Staubablagerungen sind regelmäßig zu entfernen.

Störung und Demontage

Geräte sind außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen. Defekte Geräte sind von unterwiesenen Fachkräften auszutauschen.

Die Batterie (Renata CR2477N) oder Sicherungen nicht unter Spannung oder nur in ungefährlichen Bereichen trennen!

Gefahr!

Explosionsgefahr - Der Austausch von Komponenten kann die Eignung für Class I, Division 2 beeinträchtigen!

Explosionsgefahr - Steckverbindungen nicht unter Spannung oder nur in ungefährlichen Bereichen trennen!

Warnung!

Es dürfen nur nichtfunkende USB-Geräte gemäß Bedienungsanleitung verwendet werden!

Konformitätsprüfung und Zertifizierung

Die mit "Ex" gekennzeichneten Geräte entsprechen den Richtlinien 2004/108/EG und 94/9/EWG, sowie den harmonisierten Normen EN 61131-2:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, cl. 5.3 EN 60079-0:2009, cl. 6.1.2 EN 60079-31:2009.

Die mit "c-UL-us" gekennzeichneten Geräte entsprechen den Normen CSA Std C22.2 No. 213-M1987, CSA Std C22.2 No. 142-M1987, UL Std 508 - 17th Edition, ANSI/ISA 12.12.01:2011.

Produktdokumentation im Detail

Weitere Informationen zu Produkten können der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> oder den Anwenderhandbüchern entnommen werden.

2.3 GL Zulassung (Germanischer Lloyd)



Einige der B&R Produkte sind durch den Germanischen Lloyd geprüft und für den Maritime-Bereich zugelassen. Die GL Zertifikate (Baumusterprüfungen) werden in der Regel bei der Schiffsabnahme anderer Klassifizierungsgesellschaften akzeptiert.

Germanischer Llyod (GL) nach Standard GL 2003 (Kategorie C EMC 1)

Die Kategorie C betrifft Geräte, die vor Wettereinflüssen geschützt sind. EMC 1 beschreibt die Leitungs- und Strahlungsemissionsbegrenzungen für Geräte, die auf der Brücke eines Schiffs installiert sind.

Information:

HDD und SSD bzw. CD/DVD Laufwerke dürfen nur für Service Zwecke verwendet werden.

Für den Einsatz im Maritime-Bereich ist der Netzfilter 5AC804.MFLT-00 in der Versorgungsleitung zwingend erforderlich. Informationen dazu sind auf Seite Anschluss an das Endgerät zu finden.

Folgende Tabelle listet auf, ab welcher Revision die Einzelkomponenten eine GL- Zulassung besitzen.

Bestellnummer	Beschreibung	GL ab Rev.
5PC810.SX01-00	APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	G0
5PC810.SX02-00	APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	G0
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	D0
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	D0
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	D0
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	D0
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	E0
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	D0
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	D0
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	D0
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	D0
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	D0
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	D0
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	D0
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	D0
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	E0
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0.5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	D0
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	D0
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	D0
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.	D0
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.	D0
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	D0
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	C0
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	D0
5AC801.HDDI-99	APC810 Slide-in compact HDD Kit	D0
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	D0
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	E0
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	C0
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	C0
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	A0
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	D0
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	D0
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	D0
5AC804.MFLT-00	Netzfilter	D0
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	D0
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	D0
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	E0

Tabelle 253: Revision der Einzelkomponenten mit GL- Zulassung

Bestellnummer	Beschreibung	GL ab Rev.
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	F0
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	E0
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	E0
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	D0
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	C0
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.	C0

Tabelle 253: Revision der Einzelkomponenten mit GL- Zulassung

Zertifikat Nr. 11 858 - 10 HH



Abbildung 164: GL Zertifikat Nr. 11 858 – 10 HH

Kapitel 6 • Zubehör

Nachfolgendes Zubehör ist von B&R in Zusammenhang mit dem verwendeten Gerät funktionsgeprüft und kann mit diesem betrieben werden. Hierbei ist jedoch auf mögliche Einschränkungen hinsichtlich des Betriebs mit anderen Einzelkomponenten als Gesamtgerät zu achten. Für den Betrieb des Gesamtgerätes gilt, dass sämtliche Einzelspezifikationen der Komponenten einzuhalten sind.

Alle Komponenten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, wurden intensiven System- und Kompatibilitätstests unterzogen und sind entsprechend freigegeben. Für nicht freigegegebenes Zubehör kann B&R keine Funktionsgarantie übernehmen.

1 Ersatz CMOS Batterien

1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000

1.1.1 Allgemeines

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten und der Echtzeituhr (RTC) benötigt.

Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und muss bei nicht ausreichender Batteriekapazität, Status "Bad", ausgetauscht werden.

1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as "partly regulated". Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	SER NATA
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	

Tabelle 254: 0AC201.91. 4A0006.00-000 - Bestelldaten

1.1.3 Technische Daten

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000
Allgemeines		
Lagerzeit	max. 3 Jahre bei 30°C	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Kapazität	950 mAh	
Selbstentladung	<1% pro Jahr (bei 23°C)	
Spannungsbereich	3V	

Tabelle 255: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

Zubehör • Ersatz CMOS Batterien

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Lagerung	-20 bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	0 bis 95%	
Lagerung	0 bis 95%	
Transport	0 bis	95%

Tabelle 255: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

2 Spannungsversorgungsstecker

2.1 0TB103.9x

2.1.1 Allgemeines

Die einreihige 3-polige Feldklemme TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.

2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	A
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	The state of the s
OTB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 256: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten

2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0TB103.9	0TB103.91	
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE		Ja	
cULus		Ja	
GL		Ja	
Feldklemme			
Anmerkung	Vibrationsschutz durch Schraubflansch Nenndaten nach UL		
Anzahl der Pole	3 (female)		
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	Ausführung als Federzugklemme 2)	
Kabelart	Nur Kupferdrähte (ke	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	
Kontaktabstand	5,08 mm		
Anschlussquerschnitt			
AWG-Leiter	AWG 26 bis 14	AWG 26 bis 12	
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,20 bis 1,50 mm ²		
eindrähtig	0,20 bis 2,50 mm ²		
feindrähtig	0,20 bis 1,50 mm ²	0,20 bis 2,50 mm ²	
mit Aderendhülse	0,20 bis 1,50 mm ²		
Anzugsmoment	0,4 Nm	-	
Elektrische Eigenschaften			
Nennspannung	300 V		
Nennstrom 1)	10 A / Kontakt		
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ		

Tabelle 257: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

- 1) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!
- Die Feldklemme in Federzugausführung ist nicht anreihbar.

3 Ersatz Lüfterfilter

3.1 Allgemeines

Information:

Die Lüfterfilter stellen ein Verschleißteil dar und müssen in einem angemessenen Zeitabstand kontrolliert werden, ob noch genügend Luftdurchlass für die Kühlung gewährleistet ist. Ein Austausch bzw. die Reinigung des Luftfilters ist dann sinngemäß.

3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC801.FA01-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX01-00; 5 Stk.	
5AC801.FA02-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk.	
5AC801.FA03-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk.	
5AC801.FA05-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX05-00; 5 Stk.	

Tabelle 258: 5AC801.FA01-00, 5AC801.FA02-00, 5AC801.FA03-00, 5AC801.FA05-00 - Bestelldaten

4 DVI - Monitor Adapter

4.1 5AC900.1000-00

4.2 Allgemeines

Mit diesem Adapter ist es möglich, an der DVI-I Schnittstelle einen Standard-Monitor anzuschließen.

4.3 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Sonstiges	
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.	

Tabelle 259: 5AC900.1000-00 - Bestelldaten

5 CompactFlash Karten

5.1 Allgemeines

CompactFlash Karten sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund der Robustheit gegenüber Umwelt-(Temperatur) und Umgebungseinflüssen (Schock, Vibration, etc...) bieten CompactFlash Karten optimale Werte für den Einsatz als Speichermedium in Industrieumgebung.

5.2 Grundlagen

CompactFlash Karten, welche für den Einsatz in der Industrieautomation geeignet sind, müssen eine besonders hohe Zuverlässigkeit haben. Um diese erreichen zu können sind folgende Punkte sehr wichtig:

- · Verwendete Flashtechnologie
- Effizienter Algorithmus zur Maximierung der Lebenszeit
- Gute Mechanismen zur Erkennung und Behebung von Fehlern des Flash Speichers

5.2.1 Flashtechnologie

Aktuell sind CompactFlash Karten mit MLC (Multi Level Cell) und SLC (Single Level Cell) Flashbausteinen erhältlich

SLC Flashes haben eine um Faktor 10 höhere garantierte Lebenszeit als MLC Flashes, wodurch für den industriellen Einsatz nur CompactFlash Karten mit SLC Flashbausteinen zum Einsatz kommen.

5.2.2 Wear Leveling

Unter Wear Leveling versteht man einen Algorithmus, welcher zur Maximierung der Lebenszeit einer Compact-Flash eingesetzt werden kann. Zwischen folgenden Algorithmen wird unterschieden:

- Kein Wear Leveling
- · Dynamic Wear Leveling
- · Static Wear Leveling

Der grundlegende Gedanke von Wear Leveling ist, dass Daten über einen breiten Bereich an Blöcken bzw. Zellen auf dem Datenträger verteilt werden, damit nicht immer die gleichen Bereiche gelöscht und neu programmiert werden müssen.

Kein Wear Leveling

Erste CompactFlash Karten hatten keinen Algorithmus implementiert welcher zur Maximierung der Lebenszeit beitrug. Die Lebenszeit der CompactFlash war hier einzig und allein durch die garantierte Lebenszeit der Flashblöcke definiert.

Dynamic Wear Leveling

Dynamisches Wear Leveling bietet die Möglichkeit beim Schreiben auf ein File, noch nicht benutzte Flashblöcke für die Verteilung zu verwenden.

Wenn der Datenträger schon zu 80% mit Files voll ist, können nur 20% für das Wear Leveling verwendet werden. Die Lebensdauer der CompactFlash hängt hier also ursächlich von nicht benutzten Flashblöcken ab.

Static Wear Leveling

Statisches Wear Leveling überwacht zusätzlich, welche Daten nur selten verändert werden. Diese werden dann vom Controller von Zeit zu Zeit in Blöcke verschoben, welche schon häufig programmiert wurden um eine weitere Abnutzung der Zellen zu vermeiden.

5.2.3 Fehlerkorrektur ECC

Bei Inaktivität oder Betrieb einer bestimmten Zelle können Bitfehler entstehen. Durch ein per Hard- oder Software implementiertes Error Correction Coding (ECC) lassen sich viele derartige Fehler erkennen und korrigieren.

5.2.4 S.M.A.R.T. -Support

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (kurz S.M.A.R.T., System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung) ist ein Industriestandard für Massenspeicher der eingeführt wurde, um wichtige Parameter zu überwachen und drohende Ausfälle frühzeitig zu erkennen. Durch die Überwachung und Speicherung von kritischen Leistungs- und Kalibrierdaten wird versucht, die Wahrscheinlichkeit von Fehlerzuständen vorherzusagen.

5.2.5 Maximale Zuverlässigkeit

CompactFlash Karten welche von B&R eingesetzt werden, erzielen durch Verwendung von SLC Flashes in Verbindung mit statischem Wear Leveling gemeinsam mit einem performanten ECC Algorithmus einen Maximalwert an Zuverlässigkeit.

5.3 5CFCRD.xxxx-06

5.3.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 339

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

5.3.2 Bestelldaten

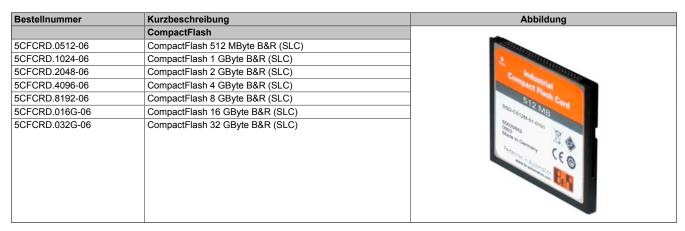


Tabelle 260: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CF-CRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten

5.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06	5CFCRD. 1024-06	5CFCRD. 2048-06	5CFCRD. 4096-06	5CFCRD. 8192-06	5CFCRD. 016G-06	5CFCRD. 032G-06
Allgemeines	0312-00	1024-00	2040-00	4030-00	0132-00	0100-00	0320-00
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte	32 GByte
Datenerhaltung			10 Jahre				
Datenverlässlichkeit		-	< 1 nichtbehebba	rer Fehler in 1014	Bit Lesezugriffen		
Lifetime Monitoring				Ja			
MTBF			> 3.000	0.000 Stunden (be	ei 25°C)		
Wartung				keine			
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4						
kontinuierliches Lesen							
typisch	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	36 MByte/s	36 MByte/s
maximal	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	34 MByte/s	34 MByte/s	37 MByte/s	37 MByte/s

Tabelle 261: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06	5CFCRD. 1024-06	5CFCRD. 2048-06	5CFCRD. 4096-06	5CFCRD. 8192-06	5CFCRD. 016G-06	5CFCRD. 032G-06	
kontinuierliches Schreiben								
typisch	15 MByte/s	15 MByte/s	15 MByte/s	14 MByte/s	14 MByte/s	28 MByte/s	28 MByte/s	
maximal	18 MByte/s	18 MByte/s	18 MByte/s	17 MByte/s	17 MByte/s	30 MByte/s	30 MByte/s	
Zertifizierungen								
CE				Ja				
cULus			1	Ja I		lo.	I	
cULus HazLoc Class 1 Division 2 ATEX Zone 22	-	-	-	-	-	Ja Ja	-	
GL	-	-	-	Ja	- 1	Ja	-	
Endurance				Ja				
garantierte Datenmenge								
garantiert 1)	50 TB	100 TB	200 TB	400 TB	800 TB	1600 TB	3200 TB	
ergibt bei 5 Jahren 1)	27,40	54,79	109,59	219,18	438,36	876,72	1753,44	
	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag	
Lösch- / Schreibzyklen								
garantiert				100.000			_	
SLC-Flash				Ja			_	
Wear Leveling				statisch				
Error Correction Coding (ECC)				Ja			_	
S.M.A.R.T. Support Unterstützung				Ja				
Hardware		DD300/400 DD50	00, PPC300, PPC	700 DDC725 DE	CRUU VBCESU /	ADC810 ADC82	 n	
Betriebssysteme		1 300/400, F130	70, 1 1 0000, FFC	700, 11 0720, FF	5500, AF C020, F	11 0010, AF 002		
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	
Windows 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	
Windows Fmbedded Standard 7	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	
32-Bit								
Windows Embedded Standard 7	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	
64-Bit								
Windows XP Professional Windows XP Embedded	Nein	Nein	Nein	Ja Ja	Ja	Ja	Ja	
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ²⁾	Ja 2)	
Windows CE 5.0				Nein			_	
Software				1		•		
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8	≥ V3.2.3.8	≥ V3.2.3.8	≥ V3.2.3.8	≥ V3.2.3.8	≥ V3.6.8.40	≥ V4.0.0.8 (Teil	
	(Teil von PVI Develop-	(Teil von PVI Develop-	(Teil von PVI Develop-	(Teil von PVI Develop-	(Teil von PVI Develop-	(Teil von PVI Develop-	von PVI Deve- lopment Setup	
	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	≥ V3.0.2.3014)	
	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V3.0.0.3020)	<u> </u>	
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20	≥ V3.21	
Umgebungsbedingungen								
Temperatur								
Betrieb				0 bis 70°C				
Lagerung				-65 bis 150°C				
Transport				-65 bis 150°C				
Luftfeuchtigkeit Betrieb								
			n	nav 85% hei 85°(-			
				nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0				
Lagerung Transport			n	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0	0			
Lagerung Transport			n	nax. 85% bei 85°0	0			
Lagerung		20 g peak, 2	n	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0		thode B103)	-	
Lagerung Transport Vibration		20 g peak, 2	n n 10 bis 2000 Hz, 4	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0	DEC JESD22, Me	thode B103)		
Lagerung Transport Vibration		01	n n 0 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 0 bis 2000 Hz, 4	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0 pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me	,		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung		20 g peak, 2	n n 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS,	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0 pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6)	thode B103)	_	
Lagerung Transport Vibration Betrieb		20 g peak, 2	n n 0 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 0 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 0 bis 2000 Hz, 4	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0 pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me	thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport		20 g peak, 2	n n 0 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 0 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 0 bis 2000 Hz, 4	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0 pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me	thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock		20 g peak, 2 20 g peak, 2	n n 20 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 20 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 20 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS,	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0 pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6)	thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport		20 g peak, 2 20 g peak, 2	n n 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS,	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0 pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6)	thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS,	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0 pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES I ms 1 mal (IEC 6	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6)	thode B103) thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, 10 bis 2000 Hz, 4 5,35 g RMS, xg peak, 0,5 ms 5 30 g, 11 xg peak, 0,5 ms 5	nax. 85% bei 85°0 nax. 85% bei 85°0 pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES I ms 1 mal (IEC 6	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6)	thode B103) thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	nax. 85% bei 85°C nax. 85% bei 85°C pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC2, Methode B ² 8-2-27) DEC2, Methode B ³ 8-2-27) DEC2, Methode B ³	thode B103) thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	nax. 85% bei 85°C nax. 85% bei 85°C pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC2, Methode B ² 8-2-27) DEC2, Methode B ³ 8-2-27) DEC2, Methode B ³	thode B103) thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	nax. 85% bei 85°C nax. 85% bei 85°C pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC2, Methode B ² 8-2-27) DEC2, Methode B ³ 8-2-27) DEC2, Methode B ³	thode B103) thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Meereshöhe		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	nax. 85% bei 85°C nax. 85% bei 85°C pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC2, Methode B ² 8-2-27) DEC2, Methode B ³ 8-2-27) DEC2, Methode B ³	thode B103) thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Meereshöhe Betrieb		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	nax. 85% bei 85°C nax. 85% bei 85°C pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC2, Methode B ² 8-2-27) DEC2, Methode B ³ 8-2-27) DEC2, Methode B ³	thode B103) thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Meereshöhe Betrieb Mechanische Eigenschaften		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	nax. 85% bei 85°C nax. 85% bei 85°C pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC2, Methode B ² 8-2-27) DEC2, Methode B ³ 8-2-27) DEC2, Methode B ³	thode B103) thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Meereshöhe Betrieb Mechanische Eigenschaften Abmessungen Breite Länge		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	max. 85% bei 85°C max. 85% bei 85°C pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 max. 4.572 m 42,8 ±0,10 mm 36,4 ±0,15 mm	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC2, Methode B ² 8-2-27) DEC2, Methode B ³ 8-2-27) DEC2, Methode B ³	thode B103) thode B103)		
Lagerung Transport Vibration Betrieb Lagerung Transport Schock Betrieb Lagerung Transport Meereshöhe Betrieb Mechanische Eigenschaften Abmessungen Breite		20 g peak, 2 20 g peak, 2 1,5 l	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	nax. 85% bei 85°C nax. 85% bei 85°C pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene pro Richtung (JEI 15 min pro Ebene mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6 mal (JEDEC JES 1 ms 1 mal (IEC 6	DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC JESD22, Me (IEC 68-2-6) DEC2, Methode B ² 8-2-27) DEC2, Methode B ³ 8-2-27) DEC2, Methode B ³	thode B103) thode B103)		

Tabelle 261: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

¹⁾ Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)

²⁾ Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

5.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

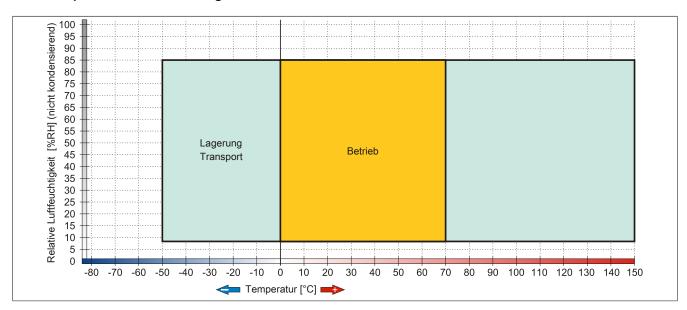


Abbildung 165: 5CFCRD.xxxx-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

5.3.5 Abmessungen

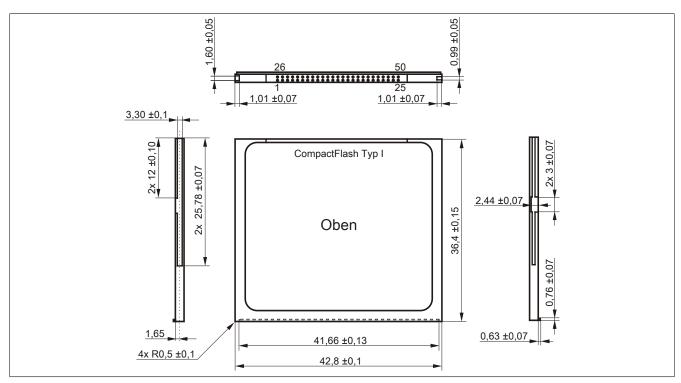


Abbildung 166: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

5.3.6 Benchmark

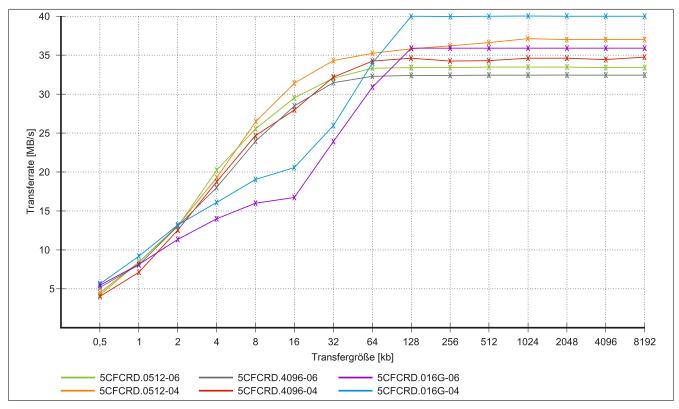


Abbildung 167: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06

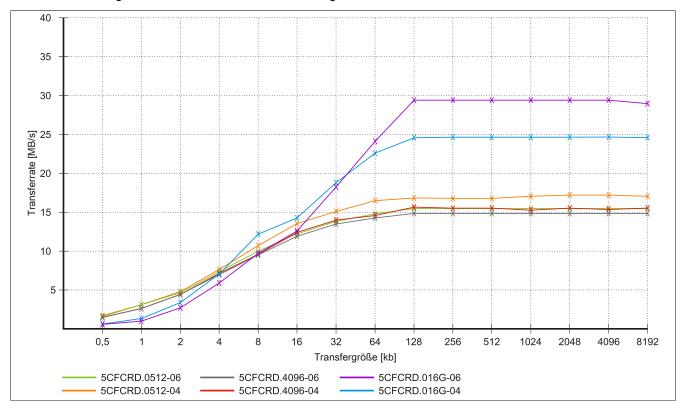


Abbildung 168: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06

5.4 5CFCRD.xxxx-04

5.4.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 339

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

5.4.2 Bestelldaten

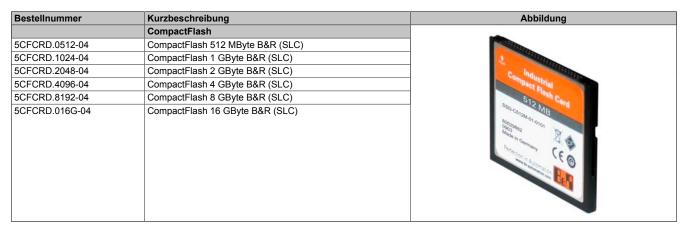


Tabelle 262: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Bestelldaten

5.4.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04	
Allgemeines							
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte	
Datenerhaltung		10 Jahre					
Datenverlässlichkeit		< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1014 Bit Lesezugriffen					
Lifetime Monitoring		Ja					
MTBF	> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)						
Wartung	keine						
unterstützte Betriebsmodi		PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4					

Tabelle 263: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04			
kontinuierliches Lesen									
typisch	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	33 MByte/s	27 MByte/s	36 MByte/s			
	(240X) 1)	(240X) 1)	(240X) 1)	(220X) 1)	(180X) 1)	(240X) 1)			
maximal	37 MByte/s	37 MByte/s	37 MByte/s	34 MByte/s	28 MByte/s	37 MByte/s			
	(260X) 1)	(260X) 1)	(260X) 1)	(226X) 1)	(186X) 1)	(247X) 1)			
kontinuierliches Schreiben						,			
typisch	17 MByte/s	17 MByte/s	17 MByte/s	16 MByte/s	15 MByte/s	18 MByte/s			
1,7 p.100.1.	(110X)	(110X)	(110X)	(106X)	(100X)	(120X)			
maximal	20 MByte/s	20 MByte/s	20 MByte/s	18 MByte/s	17 MByte/s	19 MByte/s			
maximai	(133X)	(133X)	(133X)	(120X)	(110X)	(126X)			
Zortifizionungon	(100%)	(100%)	(100%)	(120%)	(110%)	(120%)			
Zertifizierungen									
CE				а					
cULus				а					
GL			J	а					
Endurance									
garantierte Datenmenge									
garantiert ²⁾	50 TB	100 TB	200 TB	400 TB	800 TB	1600 TB			
ergibt bei 5 Jahren 2)	27,40 GByte/Tag	54,79 GByte/Tag		219,18 GByte/Tag					
	27,40 GByte/Tag	54,79 GByte/Tag	109,59 GByte/Tag	219, 16 GByte/Tag	436,36 GByte/Tag	676,72 GByte/Tag			
Lösch- / Schreibzyklen									
typisch 3)			2.000	0.000					
garantiert			100	.000					
SLC-Flash				a					
		-			,				
Wear Leveling				isch		_			
Error Correction Coding (ECC)				а					
S.M.A.R.T. Support			Ne	ein					
Unterstützung									
Hardware	PP	300/400, PP500, PP	C300 PPC700 PPC	C725 PPC800 APC	620 APC810 APC	820			
	- ''		0300,110700,110	5725, 11 0000, AI C	020, Al CO10, Al C	020			
Betriebssysteme		1			1				
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja			
Windows 7 64-Bit			Ne	ein					
Windows Embedded Standard 7	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	l Ja			
32-Bit									
Windows Embedded Standard 7	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja			
64-Bit	140111	140111	IVOIII	IVOIII	IVOIII	""			
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	lo.	lo.	lo.			
	INCIII	INCIII		Ja	Ja	Ja			
Windows XP Embedded		1	ı	a	1	T.			
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja 4)			
Windows CE 5.0			Ne	ein					
Software									
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.6.8.40 (Teil			
F VI ITALISIEL 1001	von PVI Develop-	von PVI Develop-	von PVI Develop-	von PVI Develop-	von PVI Develop-	von PVI Deve-			
					· ·				
	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	lopment Setup			
	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	≥ V3.0.0.3020)			
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20			
Umgebungsbedingungen									
Temperatur									
Betrieb	1		0 his	70°C					
Lagerung				150°C					
Transport	-	-	-05 DIS	150°C		-			
Luftfeuchtigkeit									
Betrieb			max. 85%	bei 85°C					
Lagerung			max. 85%	bei 85°C					
Transport				bei 85°C					
<u> </u>	 		11lax. 00 /	231000					
Vibration									
Betrieb		01	2000 Hz, 4 pro Richt	U (,				
			35 g RMS, 15 min p	,	•				
Lagerung		• • •	2000 Hz, 4 pro Richt	• ,					
	5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)								
Transport			2000 Hz, 4 pro Richt	•	•				
'			35 g RMS, 15 min p						
Schock			<u> </u>	,					
		4 E l	ok O E mo E mal / IFI	DEC IECDOS M-#-	ada P110\				
Betrieb		г,э кд реа	ak, 0,5 ms 5 mal (JEI		Jue DIIU)				
1			•	al (IEC 68-2-27)	. 5445				
	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)								
Lagerung									
Lagerung			•	30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Lagerung Transport			ak, 0,5 ms 5 mal (JEI	DEC JESD22, Metho	ode B110)				
			ak, 0,5 ms 5 mal (JEI	` '	ode B110)				
Transport			ak, 0,5 ms 5 mal (JEI	DEC JESD22, Metho	ode B110)				
			ak, 0,5 ms 5 mal (JEI 30 g, 11 ms 1 m	DEC JESD22, Metho	ode B110)	-			

Tabelle 263: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

Zubehör • CompactFlash Karten

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
Mechanische Eigenschaften						
Abmessungen						
Breite	42,8 ±0,10 mm					
Länge	36,4 ±0,15 mm					
Höhe			3,3 ±0,	10 mm		
Gewicht			10	g		

Tabelle 263: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

- 1) Geschwindigkeitsangaben mit 1X = 150 kByte/s. Alle Angaben beziehen sich auf die Samsung Flash Chips, CompactFlash Karte in UDMA Mode 4, Zykluszeit 30 ns in True-IDE Mode mit sequentiellem Schreiben/Lesen- Test.
- 2) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
- 3) Abhängig von der durchschnittlichen Filegröße.
- 4) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

5.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

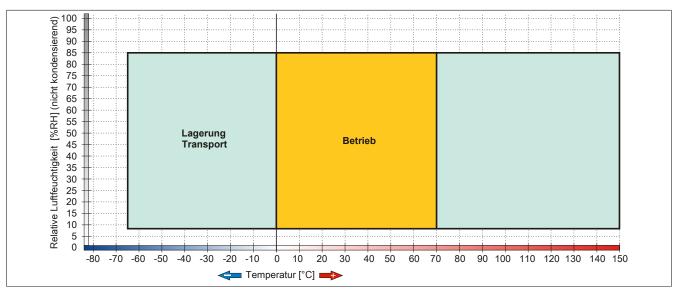


Abbildung 169: 5CFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

5.4.5 Abmessungen

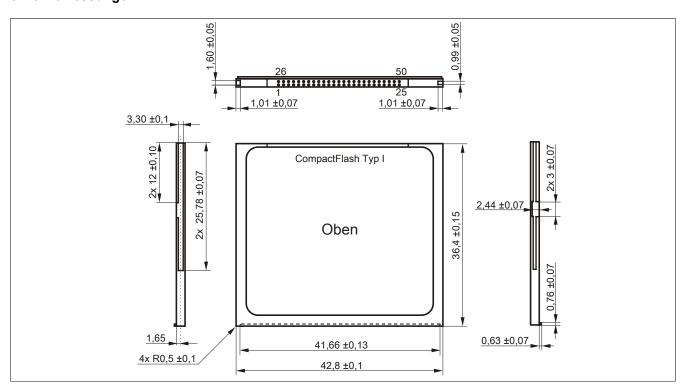


Abbildung 170: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

5.4.6 Benchmark

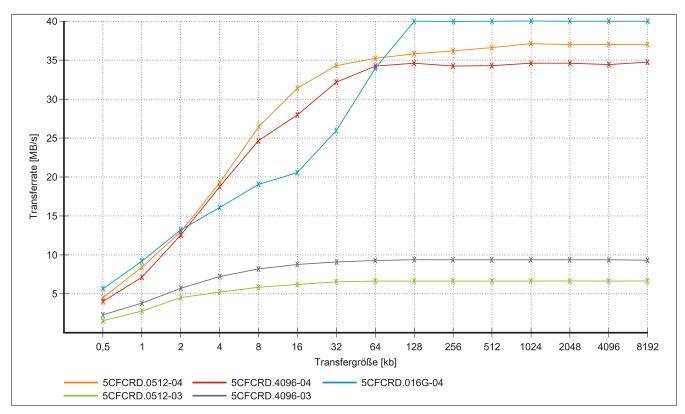


Abbildung 171: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04

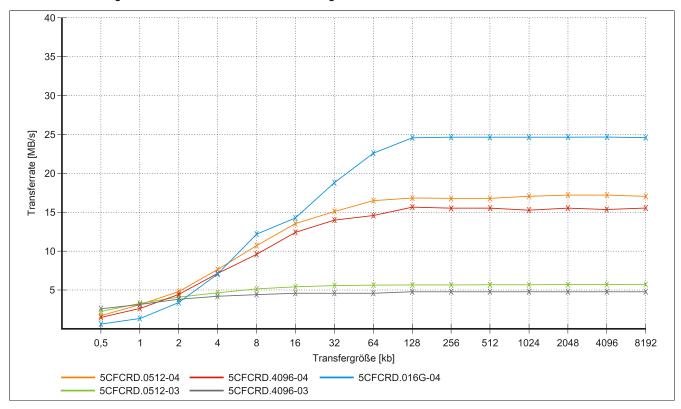


Abbildung 172: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04

5.5 5CFCRD.xxxx-03

5.5.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von Western Digital CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx- 03 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 339

Information:

Auf Windows CE 5.0 Geräten werden die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 bis zu 1GB unterstützt.

Information:

Bei den CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 hat sich lediglich der Aufkleber und die Beschreibung geändert. Die technischen Daten sind unverändert.

5.5.2 Bestelldaten

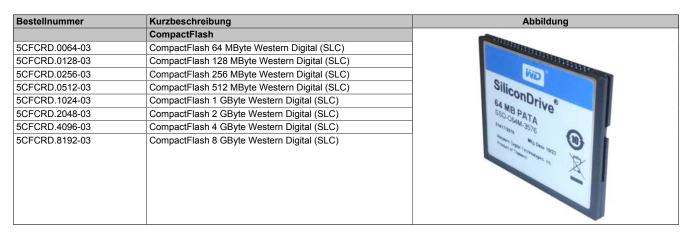


Tabelle 264: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten

5.5.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, empfiehlt B&R die Verwendung einer USV.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0064-03	5CFCRD. 0128-03	5CFCRD. 0256-03	5CFCRD. 0512-03	5CFCRD. 1024-03	5CFCRD. 2048-03	5CFCRD. 4096-03	5CFCRD. 8192-03
Allgemeines								
Kapazität	64 MByte	128 MByte	256 MByte	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre							
Datenverlässlichkeit		< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen						

Tabelle 265: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten

							•	
Produktbezeichnung	5CFCRD. 0064-03	5CFCRD. 0128-03	5CFCRD. 0256-03	5CFCRD. 0512-03	5CFCRD. 1024-03	5CFCRD. 2048-03	5CFCRD. 4096-03	5CFCRD. 8192-03
Lifetime Monitoring				J	la			
MTBF	<u> </u>			> 4.000.000 Stu	ınden (bei 25°C	;)		
Wartung				ke	ine			
unterstützte Betriebsmodi	<u> </u>		PIO	Mode 0-4, Multi	word DMA Mod	le 0-2		
kontinuierliches Lesen	l							
typisch				8 ME	Byte/s			_
kontinuierliches Schreiben	l							
typisch				6 ME	Byte/s			_
Zertifizierungen	l							
CE	I			J	la			
cULus	l				la			
GL				J	la			
Endurance								
Lösch- / Schreibzyklen	l							
typisch					00.000			_
SLC-Flash				J	la			_
Wear Leveling				stat	isch			_
Error Correction Coding (ECC)	ļ	-		J	la			_
S.M.A.R.T. Support				Ne	ein			
Unterstützung								
Hardware			,	00, PP300/400,	,	, ,	,	
	ļ	PPC8	300, Provit 2000), Provit 5000, A	APC620, APC68	80, APC810, A	PC820	_
Betriebssysteme	l							
Windows 7 32-Bit	l				ein			
Windows 7 64-Bit	l	1	1	1	ein	1		1
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit				Ne	ein			
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows XP Embedded	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja 1)
Windows CE 5.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Software	l							
PVI Transfer Tool	1		≥ V2.57 (Teil	von PVI Develo		V2.5.3.3005)		
B&R Embedded OS Installer	≥ V2.21							
Umgebungsbedingungen								
Temperatur	I							
Betrieb	0 bis 70°C							
Lagerung	1	-50 bis 100°C						
Transport	——			-50 DIS	100°C			
Luftfeuchtigkeit	l			0.1.1.050/				
Betrieb	I			8 bis 95%, nich				
Lagerung	1			8 bis 95%, nich				
Transport				8 bis 95%, nich	t kondensierend	J .		_
Vibration	l			400 : (4)	FO /- 3 O 1)			
Betrieb	I				59 m/s² 0-peak))		
Lagerung	max. 30 g (294 m/s² 0-peak)							
Transport Schock	max. 30 g (294 m/s² 0-peak)							
!	l			may 1000 a (00	210 m/s² 0 ncal	()		
Betrieb	l			max. 1000 g (98				
Lagerung Transport	max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak) max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak)							
Meereshöhe			<u> </u>	ian. 5000 g (29		N/		_
Betrieb	I			may 2	1 383 m			
				IIIax. Z	4.383 m			
Mechanische Eigenschaften								
Abmessungen	l			40.0 .0	110 mm			
Breite	l),10 mm),15 mm			
Länge Höhe	I				,15 mm ,10 mm			
Gewicht								_
OCWIOIR				11,	,4 g			

Tabelle 265: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten

1) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

5.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

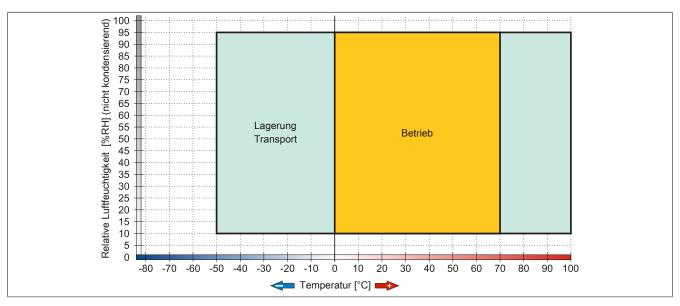


Abbildung 173: 5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

5.5.5 Abmessungen

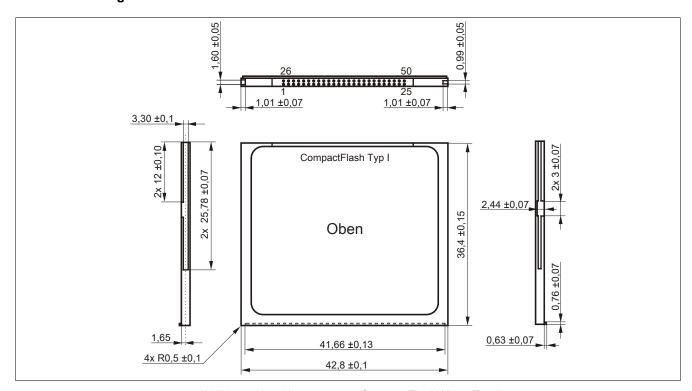


Abbildung 174: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

5.6 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Der nachfolgende Punkt ist bei Geräten mit zwei CompactFlash Slots bekannt:

• Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs zu Problemen führen. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt wird. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten älterer Technologie benötigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfür während des Hochlaufs zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwendeten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.

6 USB Media Drive

6.1 5MD900.USB2-01

6.1.1 Allgemeines

Das USB Media Drive ist eine Laufwerkskombination aus Disketten-, DVD-RW/CD-RW- Laufwerk, CompactFlash Slot und rück- und frontseitigem USB Anschluss. Es wird an den USB Anschluss des B&R Industrie PCs angeschlossen.

- Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugerät (Hutschienenwinkel)
- · Integriertes USB Diskettenlaufwerk
- Integriertes DVD-RW/CD-RW Laufwerk
- · Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug fähig)
- Integrierter USB 2.0 Anschluss (bis zu 480 MBit High Speed)
- · Versorgung, +24 VDC rückseitig
- USB/B 2.0 Anschluss rückseitig
- · optionale Frontklappe

6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MD900.USB2-01	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	Note that
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Sonstiges	
5SWUTI.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.	
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.	

Tabelle 266: 5MD900.USB2-01 - Bestelldaten

6.1.3 Schnittstellen

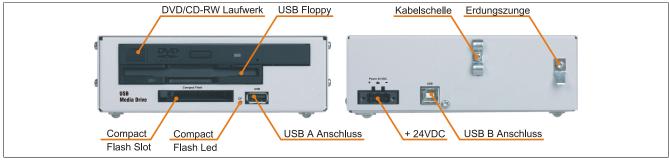


Abbildung 175: 5MD900.USB2-01 - Schnittstellen

6.1.4 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

-	
Produktbezeichnung	5MD900.USB2-01
Allgemeines	
max. Kabellänge	5 m (ohne Hub)
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Schnittstellen	
CompactFlash Slot 1	
Тур	Typ I
Anschluss	IDE/ATAPI
Activity LED	signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte
USB	
Тур	USB 2.0
Ausführung	Typ A frontseitig
or .	Typ B rückseitig
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	8 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5090 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 48 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
	CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
	Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video
	DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
Leadless	DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	IDE (ATAPI)
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	130 ms (24x)
DVD	130 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	10 bis 24x
CD-RW	10 bis 24x
DVD+R	3,3 - 8x
DVD+R (Double Layer)	2,4 - 4x
DVD+RW	3,3 - 8x
DVD-R	2 - 6x
DVD-R (Double Layer)	2 - 4x
DVD-RAM	3 - 5x
DVD-RW	2 - 6x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Diskettenlaufwerk	2100 at 0100, moromontal, 0101 white, objectival, mail 00001011
Datentransferrate	250 kBit/s (720 KByte) bzw. 500 kBit/s (1.25 MByte und 1.44 MByte)
	` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Diskettenmedien	High Density (2HD) oder Normal Density (2DD) 3.5" Disketten
Kapazität	720 kByte / 1.25 MByte / 1.44 MByte (formatiert)
MTBF	30.000 POH (Power on Hours)
Rotationsgeschwindigkeit	bis zu 360 rpm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%

Tabelle 267: 5MD900.USB2-01 - Technische Daten

Zubehör • USB Media Drive

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-01
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65 frontseitig (nur mit optionaler Frontklappe), IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 1)	
Betrieb	5 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20 bis 80%
Lagerung	5 bis 90%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,3 g (2,9 m/s² 0-peak)
Lagerung	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Transport	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Schock	
Betrieb	5 g, 11 ms
Lagerung	60 g, 11 ms
Transport	60 g, 11 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	156 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	ca. 1100 g (ohne Frontklappe)

Tabelle 267: 5MD900.USB2-01 - Technische Daten

1) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.

6.1.5 Abmessungen

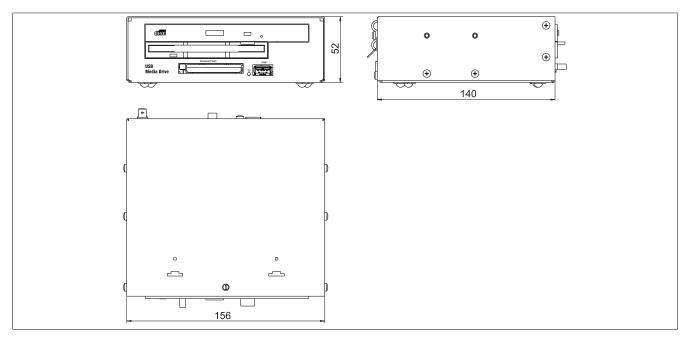


Abbildung 176: 5MD900.USB2-01 - Abmessungen

6.1.6 Abmessungen mit Frontklappe

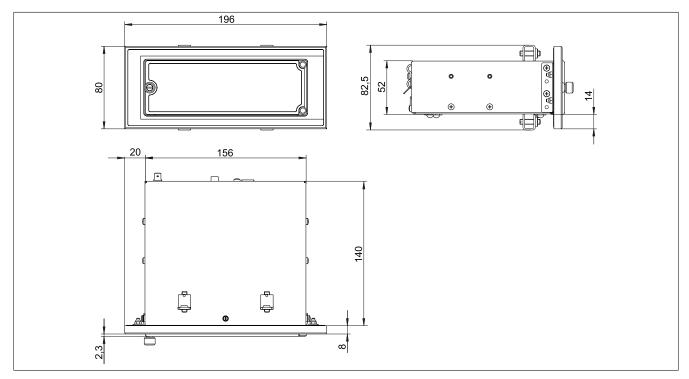


Abbildung 177: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

6.1.7 Einbau in Wanddurchbrüche

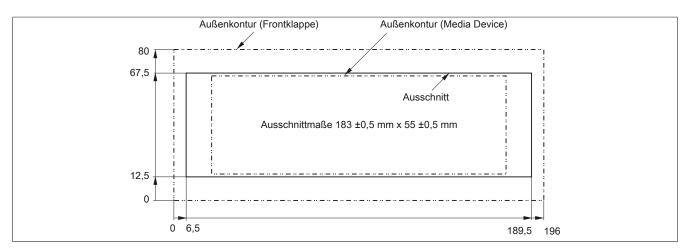


Abbildung 178: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

6.1.8 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	USB Media Drive Gesamtgerät
2	Hutschienenwinkel

Tabelle 268: 5MD900.USB2-01 - Lieferumfang

6.1.9 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl für den Tischbetrieb (aufgeklebte Gummifüße) als auch für den Betrieb als Einbaugerät (2 Hutschienenwinkel werden beigepackt) geeignet.

Einbaulagen

Aufgrund der beschränkten Einbaulage bei den verwendeten Komponenten (Floppy, DVDCDRW Laufwerk) darf das USB Media Drive Laufwerk nur wie folgt abgebildet montiert und betrieben werden.

Zubehör • USB Media Drive

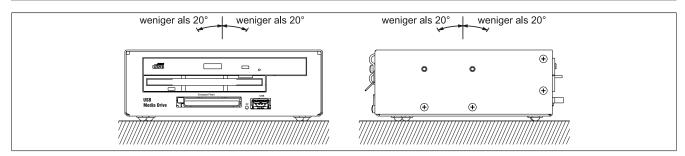


Abbildung 179: 5MD900.USB2-01 - Einbaulage

6.2 5MD900.USB2-02

6.2.1 Allgemeines

Das USB Media Drive besitzt ein DVD-R/RW DVD+R/RW- Laufwerk, einen CompactFlash Slot sowie einen rückund frontseitigen USB Anschluss. Es wird an den USB Anschluss des B&R Industrie PCs angeschlossen.

- Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugerät (Hutschienenwinkel)
- Integriertes DVD-R/RW DVD+R/RW Laufwerk
- Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug f\u00e4hig)
- Integrierter USB 2.0 Anschluss
- · Versorgung, +24 VDC rückseitig
- · USB 2.0 Anschluss rückseitig
- · optionale Frontklappe

6.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Sonstiges	
5SWUTI.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.	
_	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	

Tabelle 269: 5MD900.USB2-02 - Bestelldaten

6.2.3 Schnittstellen

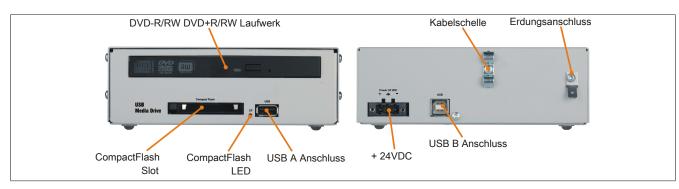


Abbildung 180: 5MD900.USB2-02 - Schnittstellen

6.2.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Allgemeines	
max. Kabellänge	5 m (ohne Hub)
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Schnittstellen	
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
Anschluss	IDE/ATAPI
Activity LED	signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte

Tabelle 270: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
USB	01HD300.00D2-02
Тур	USB 2.0
Ausführung	Typ A frontseitig
Austuriung	Typ B rückseitig
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA
CD / DVD Laufwerk	IIIdx. 300 IIIA
	2 MPuto
Datenpufferkapazität	2 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5090 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
	CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
	Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video
	DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
	DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	IDE (ATAPI)
Hochlaufzeit	IDE (ATALI)
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff) max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	max. 13 Sekunden (von 0 fpm auf Lesezugnin)
	tun 140 mg (24u)
CD DVD	typ. 140 ms (24x)
	typ. 150 ms (8x)
Lesbare Medien	00/00 001/40
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	10 bis 24x
CD-RW	10 bis 24x
DVD+R	3,3 bis 8x
DVD+R (Double Layer)	2,4 bis 4x
DVD+RW	3,3 bis 8x
DVD-R	2 bis 6x
DVD-R (Double Layer)	2 bis 4x
DVD-RAM	3 bis 5x
DVD-RW	2 bis 6x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65 frontseitig (nur mit optionaler Frontklappe), IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur 1)	
Betrieb	5 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20 bis 80%
Lagerung	5 bis 90%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,3 g (2,9 m/s² 0-peak)
Lagerung	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Transport	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Schock	10 bis 100 Hz. 2 y (13,0 His 0-peak)
Betrieb	5 a 11 ms
	5 g, 11 ms 60 g, 11 ms
Lagerung Transport	=
·	60 g, 11 ms
Meereshöhe	may 2000
Betrieb	max. 3000 m

Tabelle 270: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	156 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	ca. 1100 g (ohne Frontklappe)

Tabelle 270: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.

6.2.5 Abmessungen

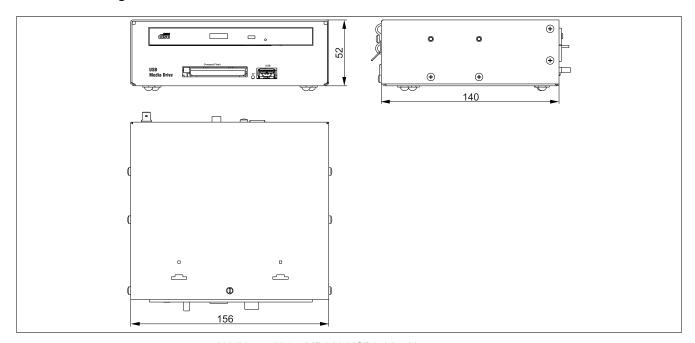


Abbildung 181: 5MD900.USB2-02 - Abmessungen

6.2.6 Abmessungen mit Frontklappe

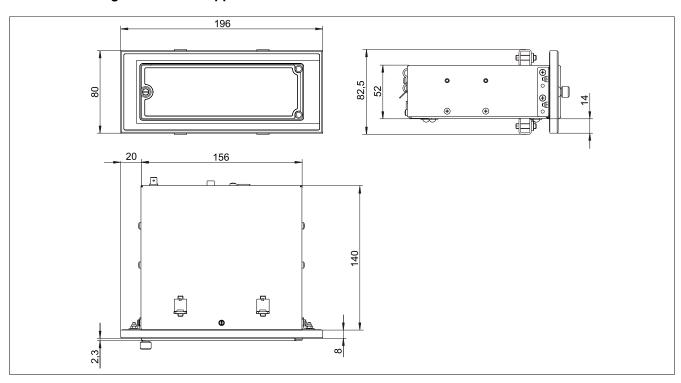


Abbildung 182: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

6.2.7 Einbau in Wanddurchbrüche

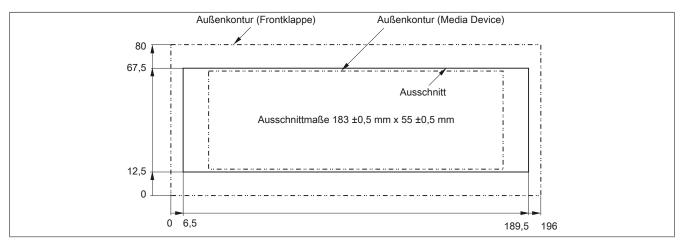


Abbildung 183: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

6.2.8 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	USB Media Drive Gesamtgerät
2	Hutschienenwinkel

Tabelle 271: 5MD900.USB2-02 - Lieferumfang

6.2.9 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl für den Tischbetrieb (aufgeklebte Gummifüße) als auch für den Betrieb als Einbaugerät (2 Hutschienenwinkel werden beigepackt) geeignet.

Einbaulagen

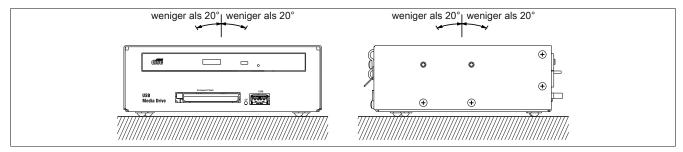


Abbildung 184: 5MD900.USB2-02 - Einbaulage

6.3 5A5003.03

6.3.1 Allgemeines

Diese Frontklappe kann optional an der Vorderseite des USB Media Drive Laufwerks (Best.Nr. 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 bzw. 5MD900.USB2-02) zum Schutz der Schnittstellen montiert werden.

6.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02	
	und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00,	
	5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.	

Tabelle 272: 5A5003.03 - Bestelldaten

6.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5A5003.03
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Front	
Dekorfolie	
Farbe heller Hintergrund	ähnlich Pantone 427CV
Abmessungen	
Breite	196 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	8 mm

Tabelle 273: 5A5003.03 - Technische Daten

6.3.4 Abmessungen

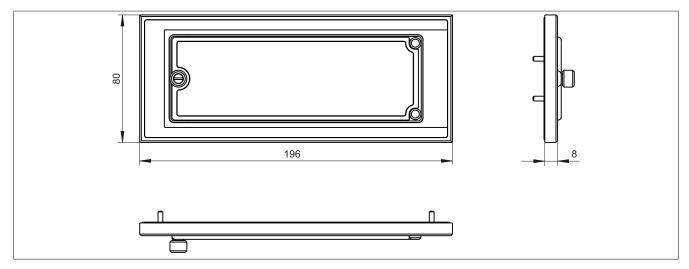


Abbildung 185: 5A5003.03 - Abmessungen

6.3.5 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Frontklappe 5A5003.03 für das USB Media Drive
4	M3 Sicherungsmutter
4	Haube Halteklammer

Tabelle 274: 5A5003.03 - Lieferumfang

6.3.6 Montage

Die Frontklappe wird mittels den 2 Hutschienenwinkel (beigepackt beim USB Media Drive) und den 4 M3 Sicherungsmuttern befestigt. Mit den 4 beiliegenden Halteklammern kann das Gesamtgerät (USB Media Drive + Frontklappe) z.B. in einer Schaltschranktür montiert werden.

Zubehör • USB Media Drive

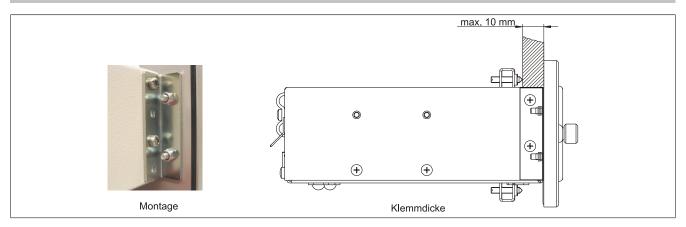


Abbildung 186: Frontklappenmontage und Klemmdicke

Einbau in Wanddurchbrüche

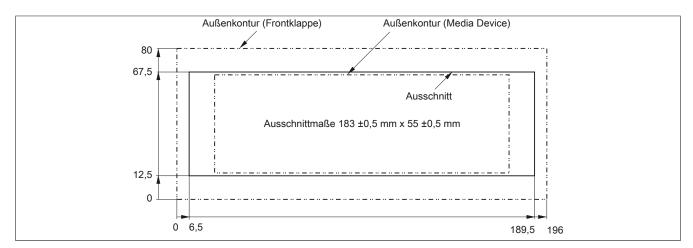


Abbildung 187: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

7 USB Memory Sticks

7.1 5MMUSB.2048-00

7.1.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können. Es kommen USB Memory Sticks des Speicherspezialisten SanDisk zum Einsatz.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein "fdisk/mbr" auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.

7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-00	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte	Cruzer micro

Tabelle 275: 5MMUSB.2048-00 - Bestelldaten

7.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-00
Allgemeines	
Datenerhaltung	10 Jahre
LEDs	1 LED (grün) 1)
MTBF	100.000 Stunden (bei 25°C)
Тур	USB 1.1, USB 2.0
Wartung	keine
Zertifizierungen	
CE	Ja
Schnittstellen	
USB	
Тур	USB 1.1, USB 2.0
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
sequentielles Lesen	max. 8,7 MByte/s
sequentielles Schreiben	max. 1,7 MByte/s
Unterstützung	
Betriebssysteme	
Windows XP Professional	Ja
Windows XP Embedded	Ja
Windows ME	Ja
Windows 2000	Ja
Windows CE 5.0	Ja
Windows CE 4.2	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Stromaufnahme	650 μA Schlafmodus, 150 mA Lesen/Schreiben

Tabelle 276: 5MMUSB.2048-00 - Technische Daten

Zubehör • USB Memory Sticks

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	10 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 90%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 90%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Lagerung	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Transport	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Schock	
Betrieb	max. 40 g (392 m/s ² 0-peak) und 11 ms Dauer
Lagerung	max. 80 g (784 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer
Transport	max. 80 g (784 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3048 m
Lagerung	max. 12192 m
Transport	max. 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	19 mm
Länge	52,2 mm
Höhe	7,9 mm

Tabelle 276: 5MMUSB.2048-00 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

7.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

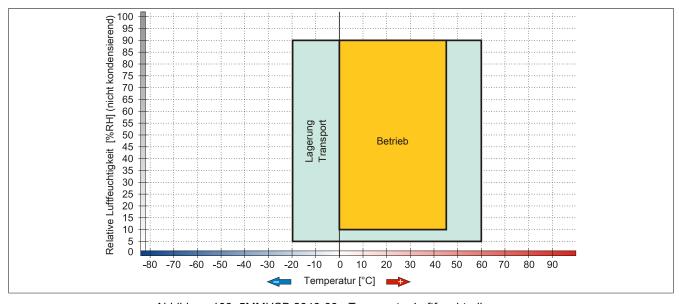


Abbildung 188: 5MMUSB.2048-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

7.2 5MMUSB.2048-01

7.2.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein "fdisk / mbr" auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.
- USB 1.1, USB 2.0
- · Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
- · Hohe Datenerhaltung
- Umgebungstemperatur Betrieb: 0 bis 70°C

7.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung	
	USB Zubehör		
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R		
		Perfection in Automation www.br-automation.com	

Tabelle 277: 5MMUSB.2048-01 - Bestelldaten

7.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01		
Allgemeines			
Datenerhaltung	> 10 Jahre		
LEDs	1 LED (grün) 1)		
MTBF	> 3.000.000 Stunden		
Тур	USB 1.1, USB 2.0		
Wartung	keine		
Zertifizierungen			
CE	Ja		
Schnittstellen			
USB			
Тур	USB 1.1, USB 2.0		
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle		
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)		
sequentielles Lesen	max. 31 MByte/s		
sequentielles Schreiben	max. 30 MByte/s		
Unterstützung			
Betriebssysteme			
Windows 7	Ja		
Windows XP Professional	Ja		
Windows XP Embedded	Ja		
Windows ME	Ja		
Windows 2000	Ja		
Windows CE 5.0	Ja		
Windows CE 4.2	Ja		
Elektrische Eigenschaften			
Stromaufnahme	max. 500 μA Schlafmodus, max. 120 mA Lesen/Schreiben		

Tabelle 278: 5MMUSB.2048-01 - Technische Daten

Zubehör • USB Memory Sticks

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis 70°C		
Lagerung	-50 bis 100°C		
Transport	-50 bis 100°C		
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	85%, nicht kondensierend		
Lagerung	85%, nicht kondensierend		
Transport	85%, nicht kondensierend		
Vibration			
Betrieb	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)		
Lagerung	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)		
Transport	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)		
Schock			
Betrieb	max. 1500 g (peak)		
Lagerung	max. 1500 g (peak)		
Transport	max. 1500 g (peak)		
Meereshöhe			
Betrieb	max. 3048 m		
Lagerung	max. 12192 m		
Transport	max. 12192 m		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Breite	17,97 mm		
Länge	67,85 mm		
Höhe	8,35 mm		

Tabelle 278: 5MMUSB.2048-01 - Technische Daten

7.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

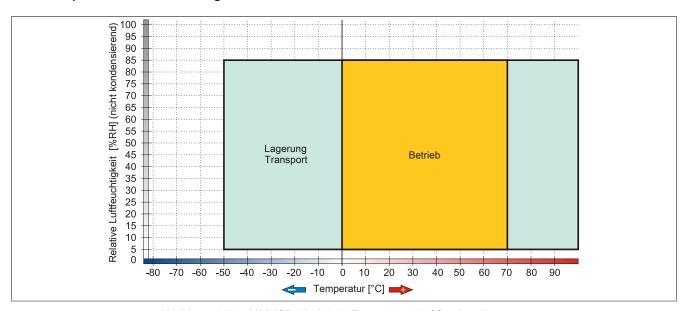


Abbildung 189: 5MMUSB.2048-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

¹⁾ Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

8 HMI Drivers & Utilities DVD

8.1 5SWHMI.0000-00

8.1.1 Allgemeines

Diese DVD beinhaltet Treiber, Utilities, Softwareupgrades und Anwenderhandbücher für B&R Panel System Produkte (siehe B&R Homepage www.br-automation.com - Bereich Industrie PCs bzw. Visualisieren und Bedienen).

Der Inhalt der DVD ist zum Zeitpunkt der Erstellung mit denen unter dem Downloadbereich auf der B&R Homepage (unter Service - "Produktbezogene Downloads") befindlichen Dateien ident.

8.1.2 Bestelldaten

Kurzbeschreibung	Abbildung
Sonstiges	
HMI Drivers & Utilities DVD	HMI Drivers & Utilities DVD
	Sonstiges

Tabelle 279: 5SWHMI.0000-00 - Bestelldaten

8.1.3 Inhalt (V2.10)

BIOS Upgrades für die Produkte

- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 815E und 855GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board X855GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 945GME N270 BIOS
- Automation PC 680
- Automation PC 810 / Automation PC 820 / Panel PC 800 B945GME BIOS
- Automation PC 810 / Panel PC 800 945GME N270 CPU Board BIOS
- Automation PC 810 / Panel PC 800 GM45 CPU Board BIOS
- Provit 2000 Produktfamilie IPC2000/2001/2002
- Provit 5000 Produktfamilie IPC5000/5600/5000C/5600C
- Power Panel 100 BIOS Geräte
- Mobile Panel 100 BIOS Geräte
- Power Panel 100 / Mobile Panel 100 User Boot Logo
- Power Panel 100 / Mobile Panel 100 REMHOST Utility
- · Power Panel 300/400 BIOS Geräte
- Power Panel 300/400 BIOS User Boot Logo
- Panel PC 310

Treiber für die Geräte

- · Automation Device Interface (ADI)
- Audio
- Chipset
- CD-ROM
- LS120
- Grafik
- Netzwerk

Zubehör • HMI Drivers & Utilities DVD

- PCI / SATA RAID Controller
- Touch Screen
- Touch Pad
- · Schnittstellenkarte

Firmware Upgrades

- Automation PC 620 / Panel PC 700 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Automation PC 810 (MTCX, SDLR, SDLT)
- · Automation PC 820 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Mobile Panel 100 (SMCX)
- Panel PC 300 (MTCX)
- Power Panel 100 (aPCI)
- Power Panel 300/400 (aPCI)
- Power Panel 300/400 (MTCX)
- Panel PC 800 (MTCX, SDLR, SDLT)
- USV Firmware

Utilities / Tools

- · B&R Embedded OS Installer
- · Windows CE Tools
- · User Boot Logo Konvertierungsprogramm
- · SATA RAID Installations Utility
- Automation Device Interface (ADI)
- CompactFlash Lebensdauerrechner (Silicon Systems)
- Miscellaneous
- MTC Utilities
- Key Editor
- · MTC & Mkey Utilities
- Mkey Utilities
- USV Konfigurationsoftware
- ICU ISA Konfiguration
- · Intel PCI NIC Boot ROM
- Diagnoseprogramme

Windows

- · Windows CE 6.0
- · Windows CE 5.0
- Windows CE 4.2
- Windows CE 4.1
- Windows CE Tools
- · Windows Embedded Standard 2009
- Thin Client
- · Windows NT Embedded
- · Windows XP Embedded
- VNC Viewer

MCAD Vorlagen für

- Industrie PCs
- · Visualisieren und Bedienen Geräte
- Einschubstreifenvordrucke
- Kundenspezifische Designs

ECAD Vorlagen für

- Industrie PCs
- · Automation PCs
- Automation Panel 900
- Panels (Power Panel)

Dokumentationen für

- · Automation PC 620
- Automation PC 680
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation Panel 800
- Automation Panel 900
- Panel PC 310
- Panel PC 700
- Panel PC 725
- Panel PC 800
- Power Panel 15/21/35/41
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- · Mobile Panel Anschlussbox
- Provit 2000
- Provit 3030
- Provit 4000
- Provit 5000
- Provit Benchmark
- · Provit Mkey
- Windows CE 5.0 Hilfe
- · Windows CE 6.0 Hilfe
- · Windows NT Embedded Applikation Guide
- · Windows XP Embedded Applikation Guide
- · Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Implementierungsanleitungen
- B&R Hilscher Feldbus Karten (CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET)

Service Tools

- Acrobat Reader 5.0.5 (Freeware in Deutsch, Englisch und Französisch)
- Power Archiver 6.0 (Freeware in Deutsch, Englisch und Französisch)
- Internet Explorer 5.0 (Deutsch und Englisch)
- Internet Explorer 6.0 (Deutsch und Englisch)

9 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Der B&R Industrie PC sorgt mit der optionalen integrierten USV dafür, dass das PC System auch nach einem Spannungsausfall Schreibvorgänge zu Ende führen kann. Erkennt die USV einen Spannungsausfall wird unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb umgeschaltet. Alle laufenden Programme werden durch die USV Software korrekt beendet. Inkonsistente Daten sind damit ausgeschlossen (funktioniert nur wenn die USV bereits konfiguriert wurde und der Treiber aktiviert ist).

Information:

- Das Panel / der Monitor wird von der USV nicht gepuffert und fällt somit bei einem Stromausfall aus.
- Genauere Informationen zur Unterbrechungsfreien Stromversorgung k\u00f6nnen im USV-Anwenderhandbuch (der externen USV) nachgelesen werden. Dieses kann von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Durch die Integration der Ladeschaltung in das Gehäuse des B&R Industrie PC, reduziert sich die Installation auf das Anschließen des Verbindungskabels zur Batterieeinheit die neben dem PC montiert wird.

Bei der Konstruktion der Batterieeinheit wurde auf die Wartungsfreundlichkeit besonderer Wert gelegt. Die Batterien sind frontseitig optimal zugänglich und im Servicefall in wenigen Augenblicken getauscht.

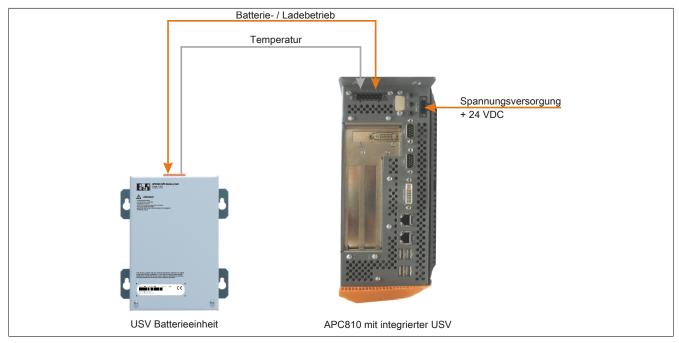


Abbildung 190: USV Prinzip

9.1 Features

- Wartungsfreie Akkus mit langer Lebensdauer
- · Kommunikation über integrierte Schnittstelle
- Temperatursensor
- Treibersoftware
- Tiefentladeschutz

9.2 Was wird benötigt

- · Eine passende Systemeinheit.
- Add-on USV Modul 5AC600.UPSI-00
- Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00
- USV Verbindungskabel 0,5 Meter (5CAUPS.0005-00) oder 3 Meter (5CAUPS.0030-00)
- Parametrierung der B&R USV mittels ADI Control Center.

9.3 5AC600.UPSI-00

9.3.1 Allgemeines

Das Add-on USV Modul kann leicht bei einer geeigneten Systemeinheit (benötigte Revision siehe Abschnitt 9.2 "Was wird benötigt" auf Seite 358) integriert werden.

9.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	MARKET
5AC600.UPSI-00 USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.		5 (23333)
	Erforderliches Zubehör	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	

Tabelle 280: 5AC600.UPSI-00 - Bestelldaten

9.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC600.UPSI-00	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
GL	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Leistungsaufnahme	max. 7,5 Watt	
Netzausfallüberbrückung	max. 20 min bei 150 W Last	
Tiefentladeschutz	Ja, bei 10 V der Batterieeinheit	
kurzschlussfest	Nein	
Ladekenndaten Batterie		
Ladestrom	max. 0,5 A	
Umschaltschwelle		
Batteriebetrieb	13 V	
Netzbetrieb	15 V	

Tabelle 281: 5AC600.UPSI-00 - Technische Daten

9.3.4 Montage

Die Montage erfolgt mit dem mitgeliefertem Montagematerial. Weitere Informationen zur Montage sind im Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" zu finden.

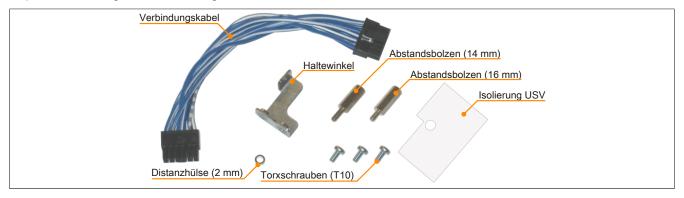


Abbildung 191: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial

9.4 5AC600.UPSB-00

9.4.1 Allgemeines

Die Batterieeinheit stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) erneuert werden.

9.4.2 Bestelldaten

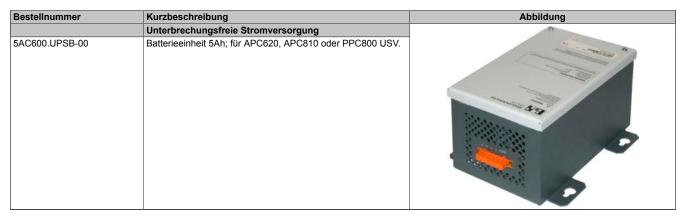


Tabelle 282: 5AC600.UPSB-00 - Bestelldaten

9.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC600.UPSB-00	
Revision	D0	E0
Allgemeines		
Batterie		
Тур	Enersys Cyclon 12 V 5 Ah (6 Stk. in Serie geschaltet)	
Lebensdauer	10 Jahre 1)	
Ausführung	Single Cell	
Temperatursensor	NTC Wid	derstand
Wartungsintervall bei Lagerung	alle 6 Monate 1 mal laden	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
GL	Ja	
Ladedauer bei Low Battery	typ. 15 Stunden	
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	12 V	
Batteriestrom	max. 8 A	
Kapazität	5 Ah	
Sicherung 2)	nein 3)	ja
Tiefentladespannung	10 V	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Ladebetrieb	-30 bis 60°C	
Betrieb	-40 bis 80°C	
Lagerung	-65 bis 80°C	
Transport	-65 bis 80°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 3000 m	

Tabelle 283: 5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten

Zubehör • Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Produktbezeichnung	5AC600.UPSB-00
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	104 mm ⁴⁾
Länge	170,5 mm
Höhe	87,5 mm
Gewicht	ca. 3200 g

Tabelle 283: 5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten

- 1) bei 25°C (bis 80% Batteriekapazität)
- 2) 25 A Sicherung. Ersatzsicherungen können bei Bedarf separat nachbestellt werden.
- 3) Bei Revisionen bis einschließlich D0 kann die Sicherung nachträglich montiert werden. Mehr dazu im APC810 und PPC800 Anwenderhandbuch, Kapitel "Wartung / Instandhaltung".
- 4) Abmessung ohne Montagelaschen.

9.4.4 Temperatur Lebensdauerdiagramm bis 20% Batteriekapazität

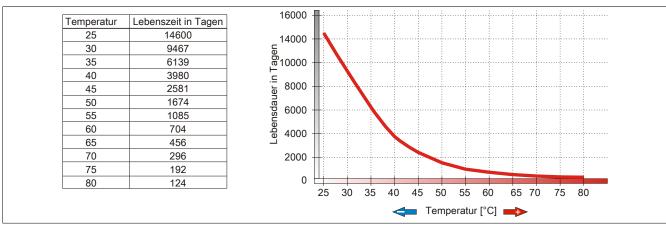


Abbildung 192: Temperatur Lebensdauerdiagramm

9.4.5 Tiefentladezyklen

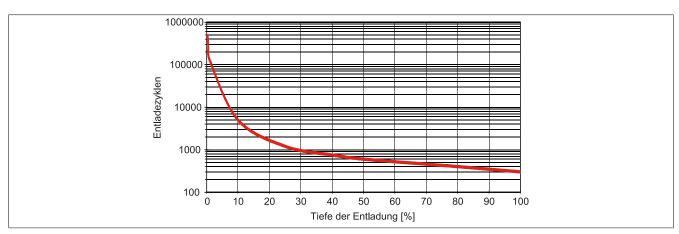


Abbildung 193: Tiefentladezyklen

9.4.6 Abmessungen

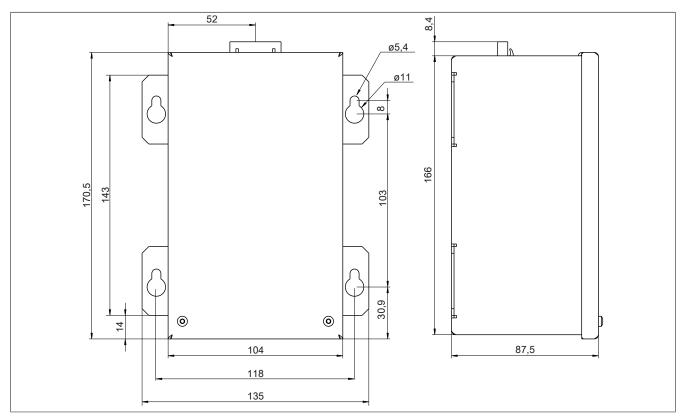


Abbildung 194: 5PC600.UPSB-00 - Abmessungen

9.4.7 Bohrschablone

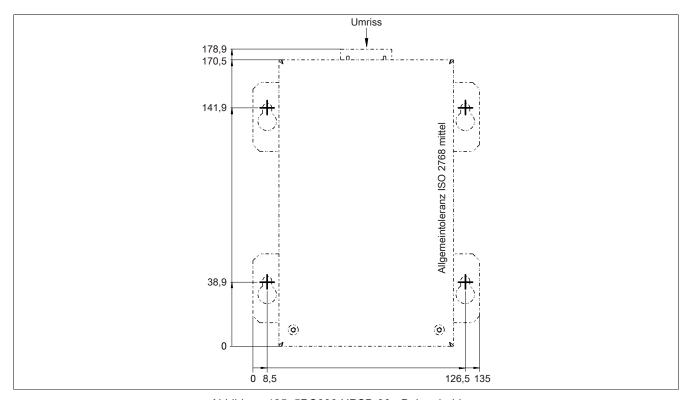


Abbildung 195: 5PC600.UPSB-00 - Bohrschablone

9.4.8 Montagevorschriften

Auf Grund der speziellen Bauweise dieser Akkumulatoren können diese in jeder beliebigen Lage betrieben so wie auch gelagert werden.

9.5 5CAUPS.00xx-00

9.5.1 Allgemeines

Das USV Verbindungskabel stellt die Verbindung zwischen dem Add-on USV Modul 5AC600.UPSI-00 und der Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 her. Es ist in den Längen 0,5 m und 3 m erhältlich.

9.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	

Tabelle 284: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Bestelldaten

9.5.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CAUPS.0005-00	5CAUPS.0030-00	
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE		Ja	
cULus		Ja	
GL		Ja	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt		mm² (AWG 20)	
		mm ² (AWG 13)	
Leiterwiderstand		m² max. 39 Ω/km	
	bei 2,5 mm	n ² max. 7,98 Ω/km	
Außenmantel			
Material		Kunststoff auf PVC Basis	
Farbe	fenstergrau	(ähnlich RAL 7040)	
Steckverbindung			
Тур	Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss 6-poli	g / Buchsenleiste Zugbügel-Schraubanschluss 6-polig	
Elektrische Eigenschaften			
Betriebsspannung	ma	ax. 300 V	
Betriebsspitzenspannung	typ. 12 VD	OC / max. 15 VDC	
Prüfspannung			
Ader/Ader		1500 V	
Strombelastbarkeit	10 /	10 A bei 20°C	
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
bewegt	-5	bis 80°C	
ruhend	-30) bis 80°C	
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	0,5 m	3 m	
Durchmesser	8,5 n	nm ±0,2 mm	
Biegeradius			
bewegt	10x Leitu	ngsdurchmesser	
feste Verlegung	5x Leitur	ngsdurchmesser	
Gewicht	ca. 100 g	ca. 470 g	

Tabelle 285: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Technische Daten

9.6 5AC600.UPSF-00

9.6.1 Allgemeines

Das USV Sicherungs Kit dient zur Nachrüstung einer Sicherung für die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00.

Eine Montageanleitung des Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00 findet sich unter "Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit" auf Seite 416.

Information:

Das USV Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00 wird nur für Batterieeinheiten bis einschließlich Revision D0 benötigt. Ab Revision E0 ist bereits eine 25 A Sicherung auf der Steckerpaltine der Batterieeinheit integriert.

9.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSF-00	USV Sicherungs Kit für Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 bis Revision D0.	2

Tabelle 286: 5AC600.UPSF-00 - Bestelldaten

9.7 5AC600.UPSF-01

9.7.1 Allgemeines

Diese 25 A Sicherungen dienen als Ersatzteil für die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 ab Revision E0 sowie für das Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00.

9.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSF-01	USV Sicherung, 5 Stück	

Tabelle 287: 5AC600.UPSF-01 - Bestelldaten

10 Netzfilter

10.1 5AC804.MFLT-00

10.1.1 Allgemeines

Der Netzfilter 5AC804.MFLT-00 kann nötig sein, um die Anforderungen hinsichtlich leitungsgebundener Störaussendungen nach GL (Germanischer Lloyd) EMC1 Auflage 2003 in Versorgungsleitungen zu erfüllen.

Der Netzfilter sollte möglichst nahe am Endgerät montiert und die Versorgungsleitung vom Endgerät zum Netzfilter so kurz als möglich gehalten werden.

10.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC804.MFLT-00	Netzfilter	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY

Tabelle 288: 5AC804.MFLT-00 - Bestelldaten

10.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC804.MFLT-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Feldklemme	
Anschlussquerschnitt	
mit Aderendhülse	1,5 mm ²
flexibel	0,2 bis 1,5 mm ²
starr	0,2 bis 2,5 mm ²
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC -25% / +30%
Nennstrom	8 A
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-25 bis 65°C
Lagerung	-25 bis 65°C
Transport	-25 bis 65°C
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	verzinktes Blech
Abmessungen	
Breite	54 mm
Länge	94 mm
Tiefe	32,15 mm
Gewicht	205 g

Tabelle 289: 5AC804.MFLT-00 - Technische Daten

10.1.4 Abmessungen

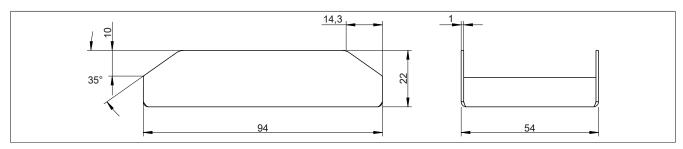


Abbildung 196: 5AC804.MFLT-00 - Abmessungen

10.1.5 Bohrschablone

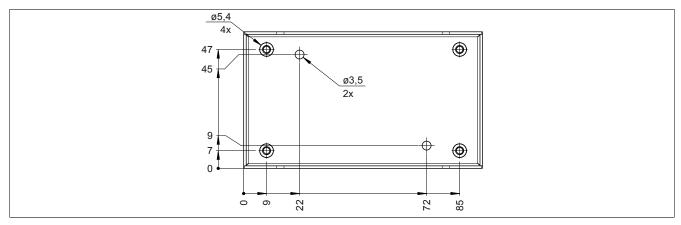


Abbildung 197: 5AC804.MFLT-00 - Bohrschablone

10.1.6 Anschluss an das Endgerät

Der Netzfilter muss zwischen der Spannungsversorgung und dem Endgerät geschaltet sein.

Folgendes muss beachtet werden:

- verdrillte und geschirmte Leitungen verwenden
- die Leitungen so kurz wie möglich halten (Spannungsversorgung Netzfilter Endgerät)
- · der Netzfilter muss auf einer metallischen lack- und ölfreien Fläche montiert werden

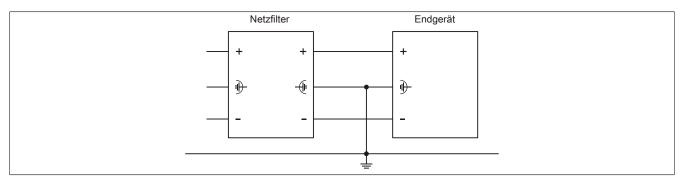


Abbildung 198: Schematisches Anschlussbeispiel

11 PCI Einsteckkarten

11.1 5ACPCI.ETH1-01

11.1.1 Allgemeines

Die universal (3,3V bzw. 5V) half size PCI Ethernet Karte verfügt über einen 10/100 MBit/s Netzwerkanschluss und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Standard 16 Bit PCI Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- · PCI Ethernet Karte
- 1 Netzwerkanschluss (10/100 MBit/s)

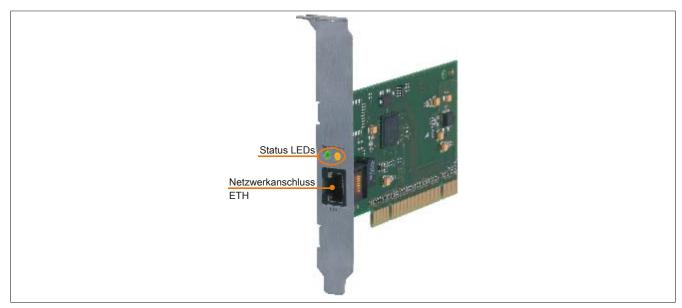


Abbildung 199: 5ACPCI.ETH1-01 - PCI Ethernet Card 10/100

11.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	

Tabelle 290: 5ACPCI.ETH1-01 - Bestelldaten

11.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH1-01
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$A58A
Diagnose	
Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja

Tabelle 291: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

Zubehör • PCI Einsteckkarten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH1-01
Schnittstellen	
Ethernet	
Anzahl	1
Controller	Intel 82551ER
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)

Tabelle 291: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

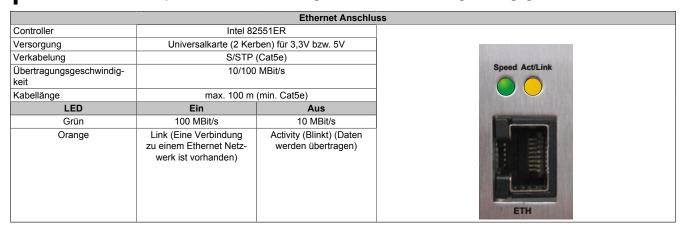


Tabelle 292: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

11.1.4 Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82551ER ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme (Windows XP Professional, Windows XP Embedded und DOS) im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

11.1.5 Abmessungen

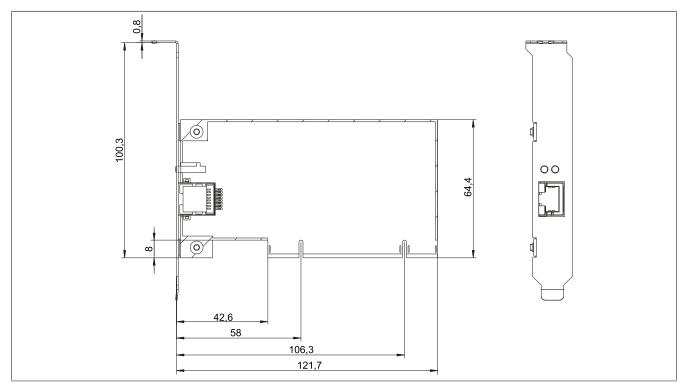


Abbildung 200: 5ACPCI.ETH1-01 - Abmessungen

11.2 5ACPCI.ETH3-01

11.2.1 Allgemeines

Die universal (3,3V bzw. 5V) half size PCI Ethernet Karte verfügt über drei 10/100 MBit/s Netzwerkanschlüsse und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Standard 16 Bit PCI Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- · PCI Ethernet Karte
- 3 Netzwerkanschlüsse (10/100 MBit/s)



Abbildung 201: 5ACPCI.ETH3-01 - PCI Ethernet Card 10/100

11.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 293: 5ACPCI.ETH3-01 - Bestelldaten

11.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH3-01
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$A58B
Diagnose	
Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja

Tabelle 294: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH3-01
Schnittstellen	
Ethernet	
Anzahl	3
Controller	Intel 82551ER
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)

Tabelle 294: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

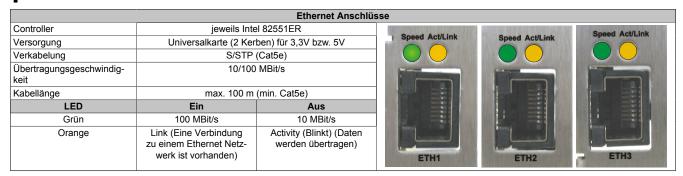


Tabelle 295: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

11.2.4 Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82551ER ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme (Windows XP Professional, Windows XP Embedded und DOS) im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

11.2.5 Abmessungen

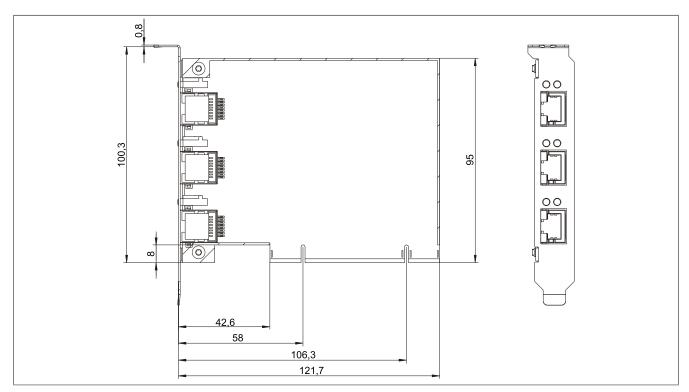


Abbildung 202: 5ACPCI.ETH3-01 - Abmessungen

12 Kabel

12.1 DVI Kabel

12.1.1 5CADVI.0xxx-00

Allgemeines

Die DVI Kabel 5CADVI.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	DVI Kabel	ARTHRIA MARTINA
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	

Tabelle 296: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CADVI.0018-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0100-00		
Allgemeines					
Zertifizierungen					
CE		Ja			
cULus		Ja			
GL		Ja			
Kabelaufbau					
Drahtquerschnitt		AWG 28			
Schirm	Ka	belpaare einzeln, sowie Kabel gesa	mt		
Gesamtschirmung	verzinnt	es Cu-Geflecht, optische Bedeckung	g > 86%		
Außenmantel					
Material		PVC			
Farbe		beige			
Bedruckung	AWM STYLE 2027	6 80°C 30V VW1 DVI DIGITAL SING	GLE LINK DER AN		
Steckverbindung					
Тур	2x DVI-D (18+1), male				
Steckzyklen		100			
Elektrische Eigenschaften					
Leiterwiderstand		max. 237 Ω/km			
Isolationswiderstand		min. 100 MΩ/km			
Mechanische Eigenschaften					
Abmessungen					
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm		
Durchmesser	max. 8,5 mm				
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)				
Gewicht	ca. 260 g	ca. 460 g	ca. 790 g		

Tabelle 297: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

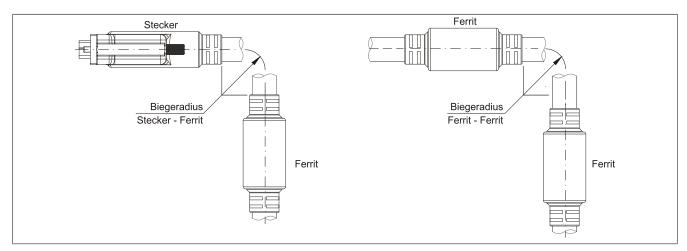


Abbildung 203: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

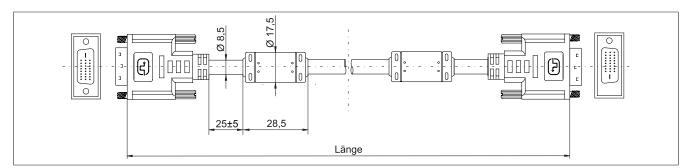


Abbildung 204: 5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

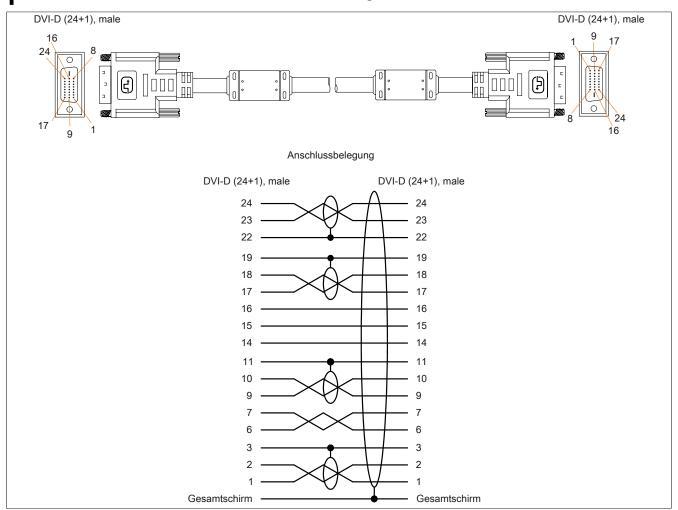


Abbildung 205: 5CADVI.0xxx-00 - Belegung

12.2 SDL Kabel

12.2.1 5CASDL.0xxx-00

Allgemeines

Die SDL Kabel 5CASDL.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert. Für eine flexible Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) ist der Einsatz der SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 erforderlich.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel	
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	

Tabelle 298: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-00	5CASDL. 0050-00	5CASDL. 0100-00	5CASDL. 0150-00	5CASDL. 0200-00	5CASDL. 0250-00	5CASDL. 0300-00
Allgemeines							
Zertifizierungen							
CE				Ja			
cULus				Ja			
GL				Ja			
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt	AWO	G 28			AWG 24		
Schirm			Kabelpaare	e einzeln, sowie K	abel gesamt		
Gesamtschirmung			verzinntes Cu-G	eflecht, optische E	Bedeckung > 85%)	
Außenmantel							
Material				PVC			
Farbe				schwarz			
Bedruckung		E74020-0	(UL) AWM STYI	LE 20176 80°C 30	OV VW-1 DVI DIG	ITAL LINK	
Steckverbindung							
Тур			2x	DVI-D (24+1), m	ale		
Steckzyklen				100			_
Kontakte				vergoldet			
mechanischer Schutz			Metallhaube	mit vercrimpter Z	Zugentlastung		
Elektrische Eigenschaften							
Leiterwiderstand							
AWG 24		-			≤ 93 Ω/km		
AWG 28	≤ 237	Ω/km			-		
Isolationswiderstand				min. 10 MΩ/km			_
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen							
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±30 mm	10 m ±50 mm	15 m ±100 mm	20 m ±100 mm	25 m ±100 mm	30 m ±100 mm
Durchmesser	typ. 8,6 ±	£0,2 mm			typ. 11 ±0,2 mm		
	max.				max. 11,5 mm		_
Biegeradius		≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)					
Beweglichkeit	bedingt f	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen / Minute)					
Gewicht	ca. 300 g	ca. 580 g	ca. 1500 g	ca. 2250 g	ca. 2880 g	ca. 4800 g	ca. 5520 g

Tabelle 299: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

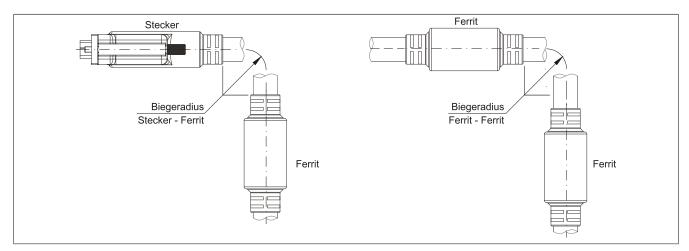


Abbildung 206: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

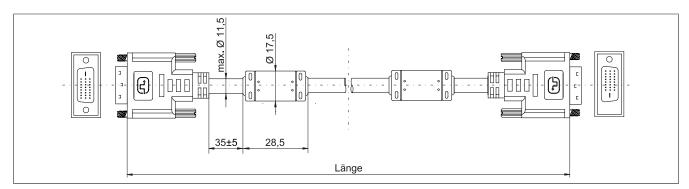


Abbildung 207: 5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

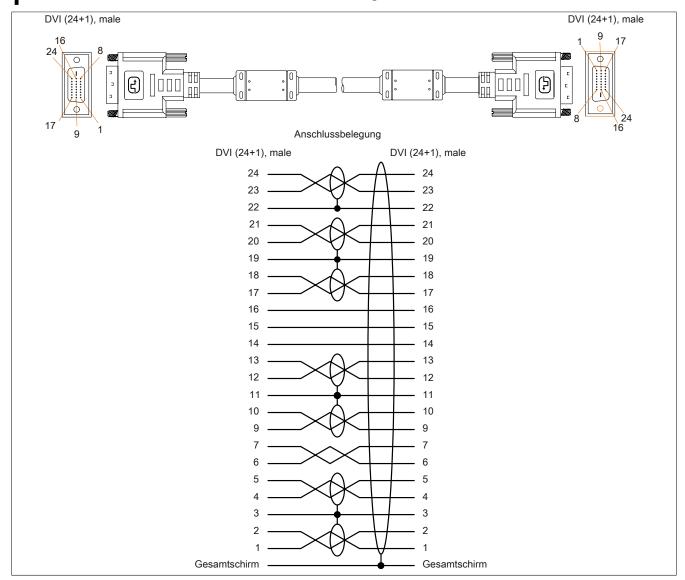


Abbildung 208: 5CASDL.0xxx-00 - Belegung

12.3 SDL Kabel mit 45° Stecker

12.3.1 5CASDL.0xxx-01

Allgemeines

Die SDL Kabel mit 45° Stecker 5CASDL.0xxx-01 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel 45° Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	

Tabelle 300: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0018-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0150-01	
Allgemeines					
Zertifizierungen					
CE		,	Ja		
cULus		•	Ja		
GL			Ja		
Kabelaufbau					
Drahtquerschnitt	AW	G 28	AW	G 24	
Schirm		Kabelpaare einzeln	, sowie Kabel gesamt		
Gesamtschirmung		verzinntes Cu-Geflecht, o	optische Bedeckung > 85%		
Außenmantel					
Material		P	VC		
Farbe		sch	iwarz		
Steckverbindung					
Тур		2x DVI-D ((24+1), male	-	
Steckzyklen		1	00		
Kontakte		verg	goldet		
mechanischer Schutz		Metallhaube mit verd	crimpter Zugentlastung		
Elektrische Eigenschaften					
Leiterwiderstand					
AWG 24		-	≤ 93	Ω/km	
AWG 28	≤ 237	΄ Ω/km		-	
Isolationswiderstand		min. 10) MΩ/km		
Mechanische Eigenschaften					
Abmessungen					
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm	10 m ±100 mm	15 m ±100 mm	
Durchmesser	max.	max. 9 mm max. 11,5 mm			
Biegeradius					
feste Verlegung		≥ 5x Kabeldurchmesser (Ste	cker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)		
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt vo	on Ferrit - Ferrit (getestet 100	Zyklen bei 5x Kabeldurchmess	er, 20 Zyklen / Minute)	
Gewicht	ca. 300 g	ca. 590 g	ca. 2800 g	ca. 2860 g	

Tabelle 301: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

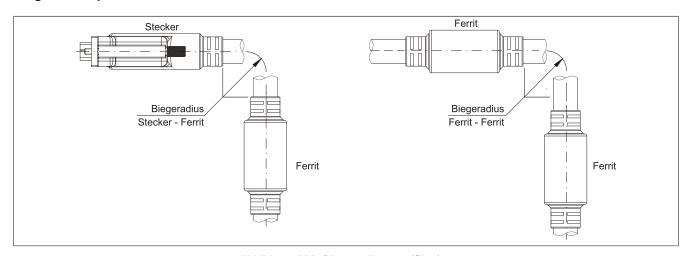


Abbildung 209: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

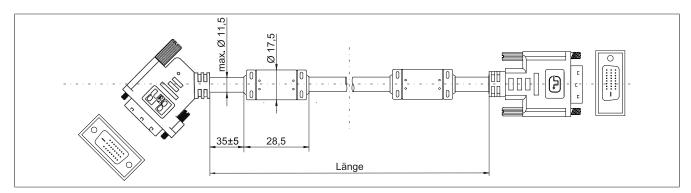


Abbildung 210: 5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

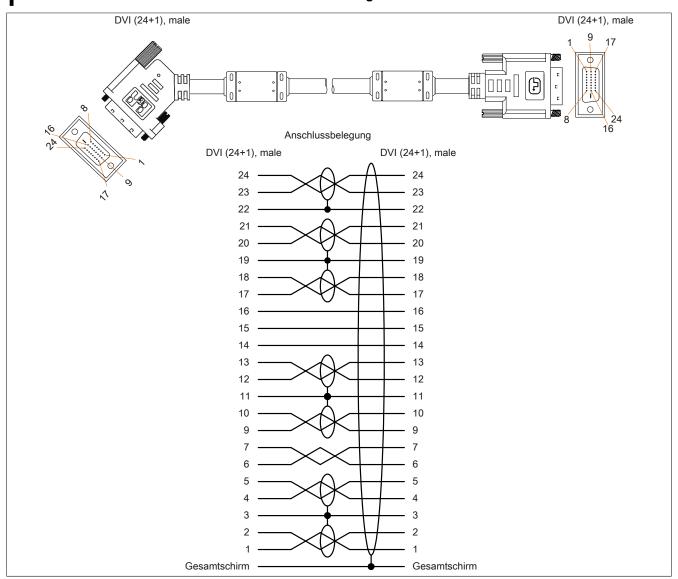


Abbildung 211: 5CASDL.0xxx-01 - Belegung

12.4 SDL Kabel flex

12.4.1 5CASDL.0xxx-03

Allgemeines

Die SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	

Tabelle 302: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03
Allgemeines							
Zertifizierungen							
CE				Ja			
cULus				Ja			
GL				Ja			
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt				NG 24 (Steuerad G 26 (DVI, USB, I			
Eigenschaften			ha	ılogen- und silikoı	nfrei		
Schirm			Kabelpaare	e einzeln, sowie K	Cabel gesamt		
Gesamtschirmung		-	alukaschierte	Folie + verzinntes	Kupfergeflecht		
Außenmantel							
Material			Spez	zial-TMPU - seide	enmatt		
Farbe				schwarz			
Bedruckung		(B&R) SDL Cable	(UL) AWM 20236	80°C 30V E 632	16	
Steckverbindung							_
Тур			2>	c DVI-D (24+1), m	nale		
Steckzyklen				min. 200			
Kontakte				vergoldet			
mechanischer Schutz			Metallhaube	mit vercrimpter 2	Zugentlastung		
Elektrische Eigenschaften							
Betriebsspannung		≤ 30 V					
Prüfspannung							
Ader/Ader				1 kV			
Ader/Schirm				0,5 kV			_
Wellenwiderstand		100 ±10 Ω					
Leiterwiderstand							
AWG 24		≤ 95 Ω/km					
AWG 26		≤ 145 Ω/km					
Isolationswiderstand		> 200 MΩ/km					
Einsatzbedingungen							
Approbation				AWM 20236 80°C			
Flammwidrigkeit			gemäß UL	758 (cable vertica	al flame test)		
Öl- und Hydrolysebeständigkeit			g	emäß VDE 0282	-10		

Tabelle 303: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.
Produktbezeichhang	0018-03	0050-03	0100-03	0150-03	0200-03	0250-03	0300-03
Umgebungsbedingungen		00000					
Temperatur							
Lagerung				-20 bis 80°C			
bewegt				-5 bis 60°C			
feste Verlegung				-20 bis 80°C			
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen							
Länge	1,8 m ±20 mm	5 m ±45 mm	10 m ±90 mm	15 m ±135 mm	20 m ±180 mm	25 m ±225 mm	30 m ±270 mm
Durchmesser				max. 12 mm			
Biegeradius							
feste Verlegung			≥ 6x Kabeldur	chmesser (von St	ecker - Ferrit)		
			≥ 10x Kabeld	urchmesser (von	Ferrit - Ferrit)		
flexible Verlegung		≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)					
Beweglichkeit	flexibel; g	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen / Stunde)			/ Stunde)		
Schleppkettendaten							
Biegewechsel	300.000						
Geschwindigkeit	4800 Zyklen/Stunde						
Biegeradius	180 mm; 15x Kabeldurchmesser						
Hub				460 mm			
Gewicht	ca. 460 g	ca. 1020 g	ca. 1940 g	ca. 2840 g	ca. 3740 g	ca. 4560 g	ca. 5590 g
Zugbelastbarkeit						,	
in Betrieb	≤ 50 N						
bei Verlegung	≤ 400 N						

Tabelle 303: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

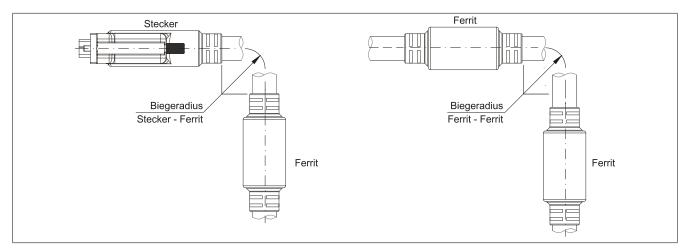


Abbildung 212: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

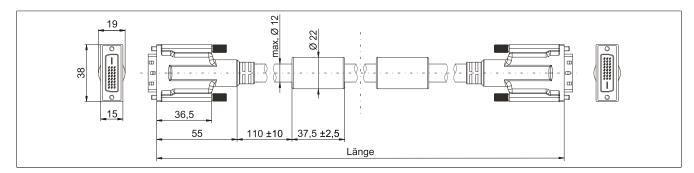


Abbildung 213: 5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen

Aufbau

Element	Belegung	Querschnitt	
	TMDS Daten 0	26 AWG	TMDS Daten 2 TMDS Daten 1
DVI	TMDS Daten 1	26 AWG	TIMBO Bateri 2
DVI	TMDS Daten 2	26 AWG	TMDS Takt TMDS Daten 0
	TMDS Takt	26 AWG	
USB	XUSB0	26 AWG	Steueradern
ОЗВ	XUSB1	26 AWG	- DDC Takt
Daten	SDL	26 AWG	- DDC Daten
	DDC Takt	24 AWG	XUSB1 -+5V
	DDC Daten	24 AWG	- Masse
Steueradern	+5 V	24 AWG	- Hot Plug Detect
	Masse	24 AWG	XUSB0 SDL
	Hot Plug Detect	24 AWG	

Tabelle 304: Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

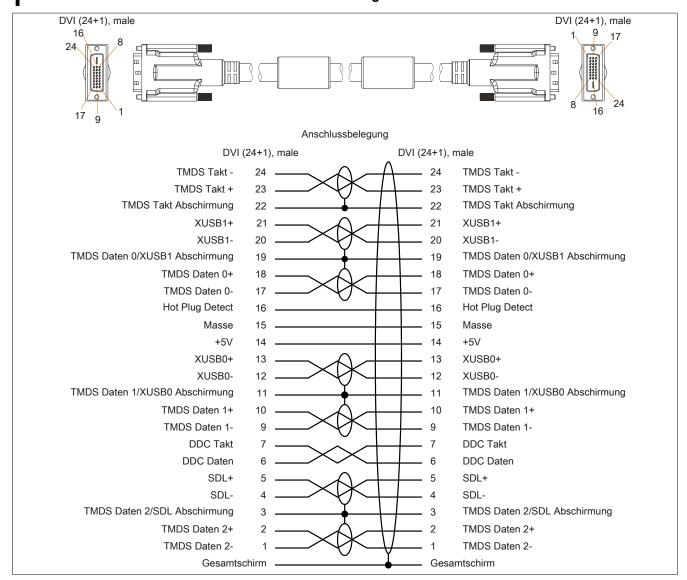


Abbildung 214: 5CASDL.0xxx-03 - Belegung

12.5 SDL Kabel flex mit Extender

12.5.1 5CASDL.0xx0-13

Allgemeines

Die SDL Kabel flex mit Extender 5CASDL.0xx0-13 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	BA
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	

Tabelle 305: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Allgemeines		·	
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus		Ja	
GL		Ja	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt		AWG 24 (Steueradern)	
		AWG 26 (DVI, USB, Daten)	
Eigenschaften		halogen- und silikonfrei	
Schirm	ŀ	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesa	mt
Gesamtschirmung	aluk	aschierte Folie + verzinntes Kupferge	flecht
Außenmantel			
Material		Spezial-TMPU - seidenmatt	
Farbe		schwarz	
Bedruckung	(B&R) \$	SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30\	/ E63216
Steckverbindung			
Тур		2x DVI-D (24+1), male	
Steckzyklen		min. 200	
Kontakte		vergoldet	
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung		
Elektrische Eigenschaften			
Betriebsspannung		≤ 30 V	
Prüfspannung			
Ader/Ader		1 kV	
Ader/Schirm		0,5 kV	
Wellenwiderstand	100 ±10 Ω		
Leiterwiderstand			
AWG 24		≤ 95 Ω/km	
AWG 26		≤ 145 Ω/km	
Isolationswiderstand	> 200 MΩ/km		
Einsatzbedingungen			
Approbation		UL AWM 20236 80°C 30V	
Flammwidrigkeit	gemäß UL758 (cable vertical flame test)		
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Lagerung		-20 bis 60°C	
bewegt	-5 bis 60°C		
feste Verlegung	-20 bis 60°C		

Tabelle 306: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

Zubehör • Kabel

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	30 m ±280 mm	40 m ±380 mm	43 m ±410 mm
Durchmesser		max. 12 mm	
Extender Box			
Breite		35 mm	
Länge		125 mm	
Höhe		18,5 mm	
Biegeradius			_
feste Verlegung	≥ 6x	≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit)	
	≥ 10	≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)	
flexible Verlegung	≥ 15	≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)	
Beweglichkeit	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (gete	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen / Stunde)	
Schleppkettendaten			
Biegewechsel		300.000	
Geschwindigkeit		4800 Zyklen/Stunde	
Biegeradius		180 mm; 15x Kabeldurchmesser	
Hub		460 mm	
Gewicht	ca. 5430 g	ca. 7200 g	ca. 7790 g
Zugbelastbarkeit			
in Betrieb		≤ 50 N	
bei Verlegung		≤ 400 N	

Tabelle 306: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

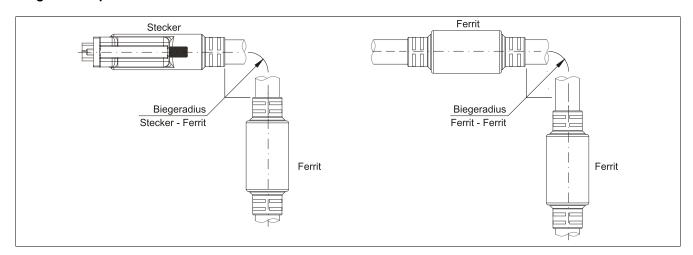


Abbildung 215: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

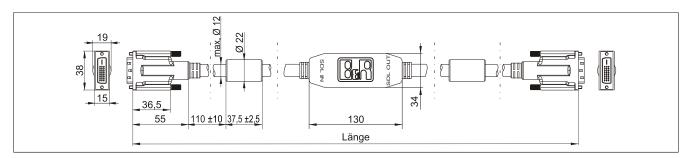


Abbildung 216: 5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

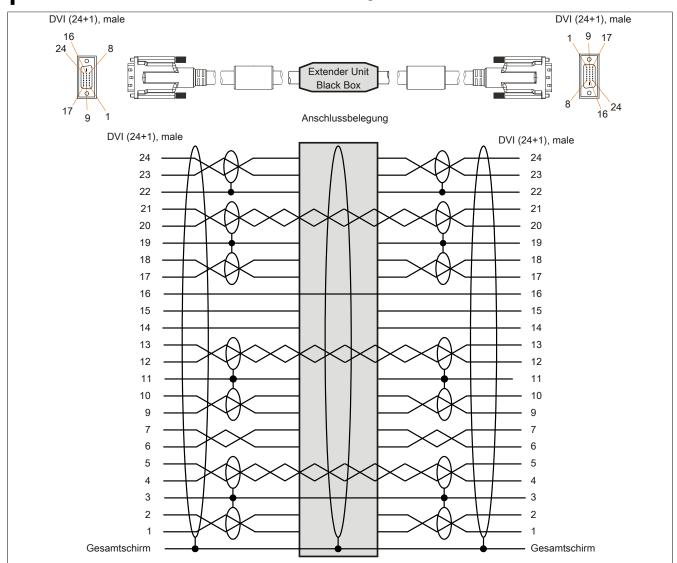


Abbildung 217: 5CASDL.0xx0-13 - Belegung

Kabelanschluss

Das SDL Kabel flex mit Extender muss in richtiger Richtung zwischen B&R Industrie PC und Automation Panel Displayeinheit angeschlossen werden. Zu diesem Zweck ist die Signalrichtung auf der Extender Unit abgebildet.

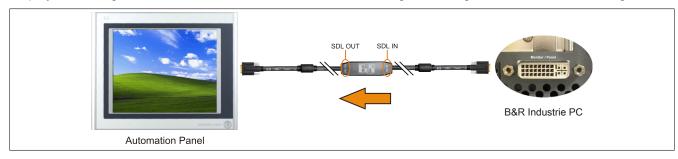


Abbildung 218: Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender

12.6 USB Kabel

12.6.1 5CAUSB.00xx-00

Allgemeines

Die USB Kabel sind für eine Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0 konzipiert.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	

Tabelle 307: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAUSB.0018-00	5CAUSB.0050-00
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	J	a
cULus	J	a
Kabelaufbau		
Drahtquerschnitt	AWG:	24, 28
Schirm	Kabel (gesamt
Außenmantel		
Farbe	bei	ige
Steckverbindung		
Тур	USB Typ A male ur	nd USB Typ B male
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm
Durchmesser	max.	5 mm
Biegeradius	min. 10	00 mm

Tabelle 308: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

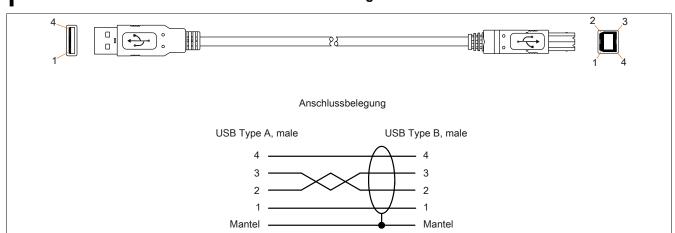


Abbildung 219: 5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel

12.7 RS232 Kabel

12.7.1 9A0014.xx

Allgemeines

Die RS232 Kabel dienen als Verlängerungskabel zwischen zwei RS232 Schnittstellen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	RS232 Kabel	
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	

Tabelle 309: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	9A0014.02	9A0014.05	9A0014.10
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE		Ja	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt		AWG 26	
Schirm		Kabel gesamt	
Außenmantel			
Farbe		beige	
Steckverbindung			
Тур	9-polige DSUB Buchse, male / female		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm
Durchmesser		max. 5 mm	
Biegeradius		min. 70 mm	

Tabelle 310: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

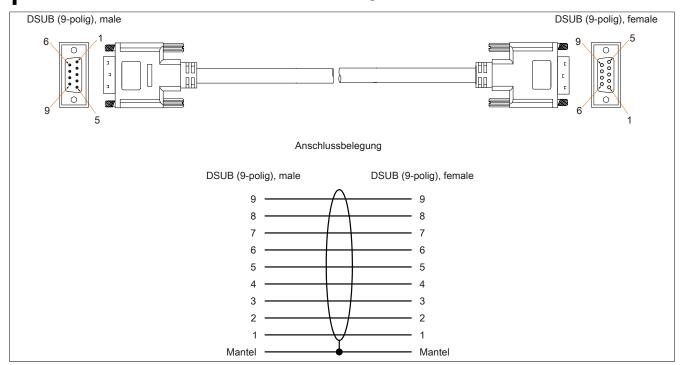


Abbildung 220: 9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel

12.8 Versorgungskabel intern

12.8.1 5CAMSC.0001-00

Allgemeines

Dieses Versorgungskabel dient zur internen Versorgung von z.B. speziellen PCI Karten. Es wird dabei an das Basisboard angesteckt.

Vorraussetzungen und Vorgangsweise siehe dazu "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 428.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5CAMSC.0001-00	Versorgungskabel intern	

Tabelle 311: 5CAMSC.0001-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAMSC.0001-00	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
Kabelaufbau		
Drahtquerschnitt	AWG 22	
Steckverbindung		
Тур	1x Disk Drive Power Stecker 4-polig male, 1x Steckergehäuse 4-polig female	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Länge	100 mm ±5 mm	
Beweglichkeit	flexibel	

Tabelle 312: 5CAMSC.0001-00 - Technische Daten

13 HDD Ersatzdiskablage

13.1 5AC801.FRAM-00

13.1.1 Allgemeines

Um eine Hard Disk so schnell wie möglich mit einer Ersatz Hard Disk wechseln zu können, gibt es die Möglichkeit ein Gehäuse am APC810 zu montieren, in dem die Erstaz HDD aufbewahrt werden kann.

Nähere Informationen zur Montage der HDD Ersatzdiskablage siehe Kapitel Wartung / Instandhaltung.



Abbildung 221: HDD Ersatzdiskablage - 5AC801.FRAM-00

13.1.2 Bestelldaten

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
8

Tabelle 313: 5AC801.FRAM-00 - Bestelldaten

13.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.FRAM-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	106 mm
Höhe	101 mm
Tiefe	18 mm

Tabelle 314: 5AC801.FRAM-00 - Technische Daten

13.1.4 Abmessungen

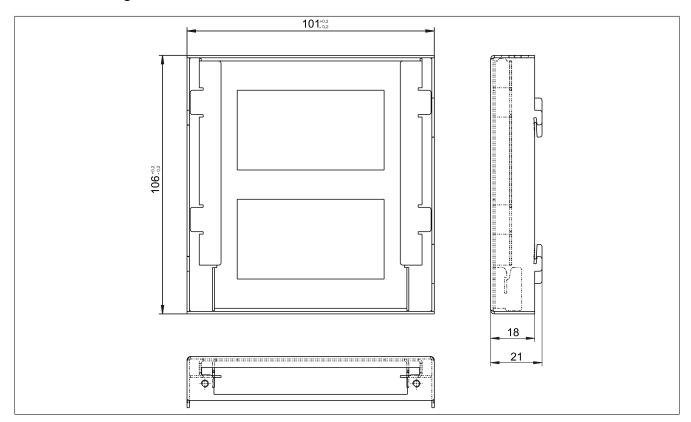


Abbildung 222: 5AC801.FRAM-00 - Abmessungen

Kapitel 7 • Wartung / Instandhaltung

In folgendem Kapitel werden jene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, die von einem qualifizierten und eingeschulten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

1 Batteriewechsel

Die Lithiumbatterie stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) und der CMOS Daten sicher.

Information:

- Das Design des Produktes gestattet das Wechseln der Batterie sowohl in spannungslosem Zustand als auch bei eingeschaltetem B&R Gerät. In manchen Ländern ist der Wechsel unter Betriebsspannung jedoch nicht erlaubt.
- Beim Wechseln der Batterie in spannungslosem Zustand bleiben vorgenommene BIOS Einstellungen erhalten (werden in einem spannungssicheren EEPROM gespeichert). Datum und Uhrzeit sind nachträglich wieder einzustellen, da diese Daten beim Wechseln verloren gehen.
- Der Batteriewechsel darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Es sind folgende Lithium Ersatzbatterien verfügbar: 4A0006.00-000 (1 Stk.) und 0AC201.91 (4 Stk.).

1.1 Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 315: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

1.2 Vorgangsweise

- Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos (Netzkabel abstecken) machen.
- Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Abdeckung des Batteriefaches entfernen und Batterie mittels Ausziehstreifen vorsichtig herausziehen.

Wartung / Instandhaltung • Batteriewechsel



Abbildung 223: Batterie entfernen

• Die Batterie darf mit der Hand nur an den Stirnseiten berührt werden. Zum Einsetzen kann auch eine isolierte Pinzette verwendet werden.

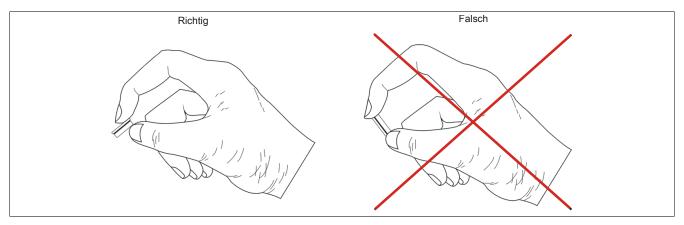


Abbildung 224: Batteriehandhabung

• Neue Batterie in richtiger Polarität einstecken.

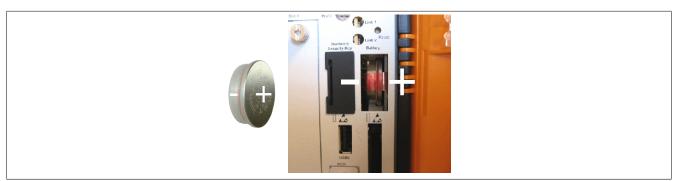


Abbildung 225: Batteriepolarität

- Beim Einstecken auf den korrekten Sitz des Ausziehstreifens achten, damit ein erneuter Tausch einfach zu bewerkstelligen ist!
- Den B&R Industrie PC wieder unter Spannung setzen Netzstecker anstecken.
- Datum und Uhrzeit im BIOS neu einstellen.

Warnung!

Bei Lithium-Batterien handelt es sich um Sondermüll! Verbrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

2 CompactFlash Tausch

Vorsicht!

Ein Tauschen der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

Das Tauschen der CompactFlash Karte ist durch Betätigung des Auswerfers (siehe Abbildung) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) schnell und sicher möglich.

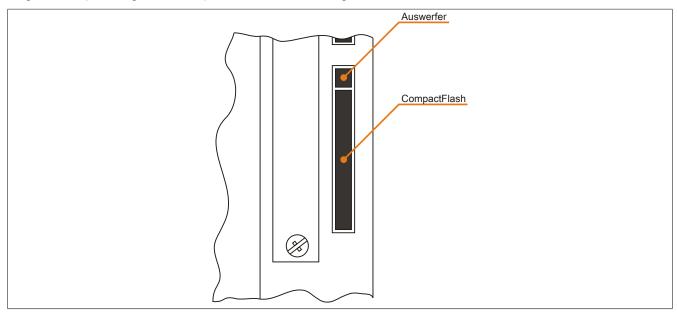


Abbildung 226: CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto)

3 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

3.1 Vorgangsweise

1. 2 Schnellverschlussschrauben der Schutzabdeckung bzw. des Slide-in compact Laufwerks lösen und entfernen.



Abbildung 227: Schnellverschlussschrauben lösen

2. Compact SATA Laufwerk einschieben und mit den Schnellverschlussschrauben befestigen.



Abbildung 228: Compact SATA Laufwerk einschieben

4 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch

Slide-in Laufwerke können bei Systemeinheiten mit 2, 3 oder 5 Card Slots eingebaut und getauscht werden.

4.1 Vorgangsweise

- 1. Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Entfernung des Slide-in Blindmodules bzw. Slide-in Laufwerks durch Lösen der 2 Schnellverschlussschrauben.



Abbildung 229: Schnellverschlussschrauben lösen

4. Slide-in Laufwerk einstecken und mit den beiden Schnellverschlussschrauben fixieren.

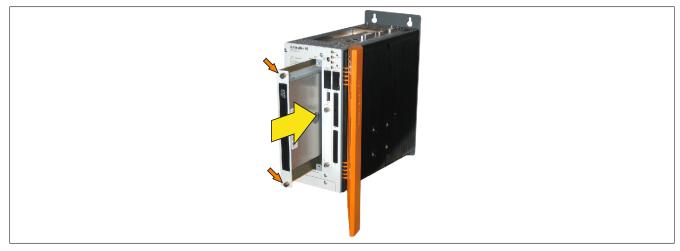


Abbildung 230: Slide-in Laufwerkseinbau

5 Slide-in compact Adapter Montage

Slide-in compact Adapter können bei Systemeinheiten mit 2, 3 oder 5 Card Slots eingebaut und getauscht werden. Mit dem Slide-in compact Adapter kann ein Slide-in compact Laufwerk (z.B. Slide-in compact HDD) in einem Slide-in Slot montiert werden.

5.1 Vorgangsweise

- 1. Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Entfernung des Slide-in Blindmodules bzw. Slide-in Laufwerks durch Lösen der 2 Schnellverschlussschrauben.



Abbildung 231: Schnellverschlussschrauben lösen

4. Silde-in compact Adapter einstecken und mit den beiden Schnellverschlussschrauben fixieren.

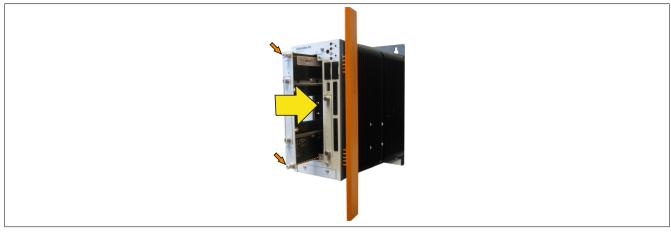


Abbildung 232: Slide-in compact Adapter Einbau

5. Nach der Montage kann ein Slide-in compact Laufwerk montiert werden.

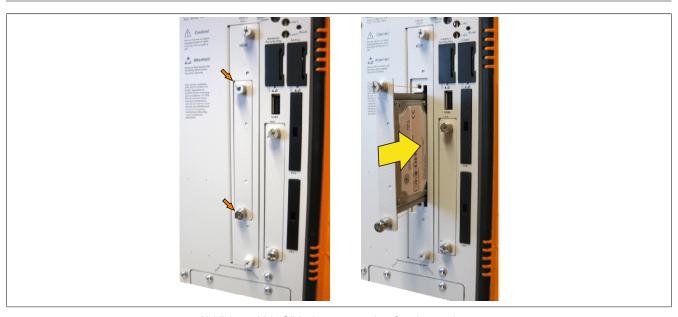


Abbildung 233: Slide-in compact Laufwerk montieren

6 Lüfter Kit Einbau / Tausch

6.1 Vorgangsweise

1. Lüfter Kit Abdeckung entfernen. Torx (T10) Schrauben lösen und Abdeckung nach vorne schieben.

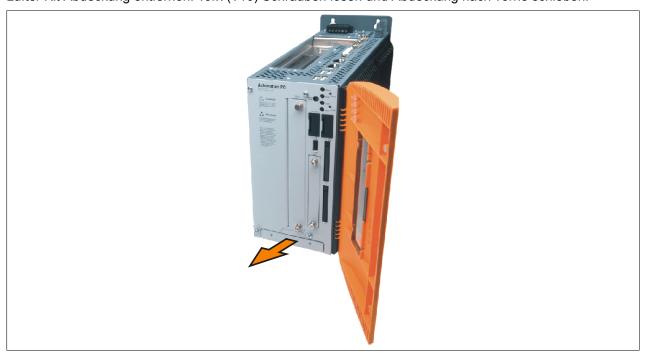


Abbildung 234: Lüfter Kit Einschub entfernen

2. Den Rahmen einlegen - Kontaktplatinenseite auf die Schleifkontakte an der Systemeinheit - und mit den Schnellverschlussschrauben befestigen.

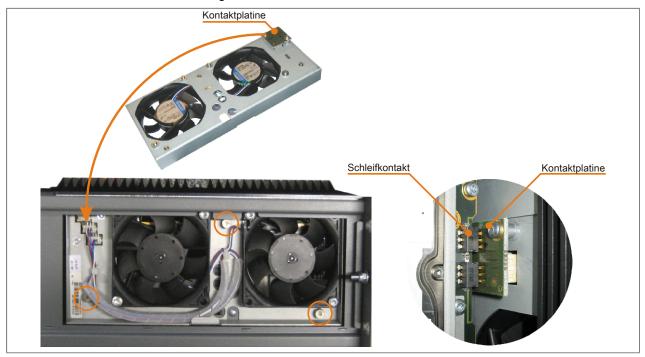


Abbildung 235: Lüfter Kit einlegen und befestigen

3. Staubfilter in die Lüfter Kit Abdeckung einlegen und mit der Filterspange fixieren.

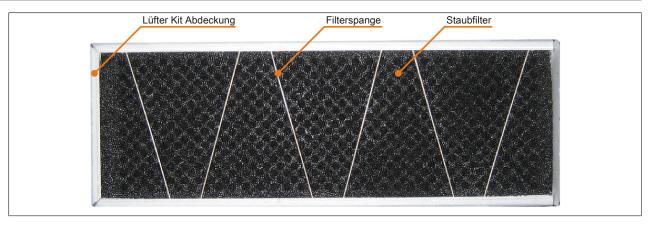


Abbildung 236: Staubfilter mit Filterspange fixieren

4. Lüfter Kit Abdeckung im Gehäuse einsetzen und mit den zuvor gelösten Torxschrauben befestigen.

Information:

Regelmäßige Kontrolle des Staubfilters je nach Einsatzgebiet und Verschmutzungsgrad. Der Einbau ist bei allen APC810 Modellen ähnlich vorzunehmen.

7 Montage des USV Moduls

Die Montage erfolgt mit dem beigelegten Montagematerial beim USV Modul.

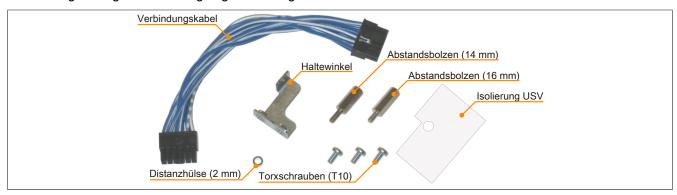


Abbildung 237: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial

Die Montage unterscheidet sich je nach Systemeinheitenvariante (1,2,3 oder 5 Card Slots) bzw. auch ob ein Addon Schnittstellenmodul (IF Option) im APC810 montiert ist.

7.1 Montage ohne montiertem Add-on Schnittstellenmodul

Je nach Systemeinheitenvariante und montiertem oder nicht montiertem Add-on Interfacemodul sind unterschiedliche Teile zu verwenden.

7.1.1 APC810 1 Card Slot

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418).
- 2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

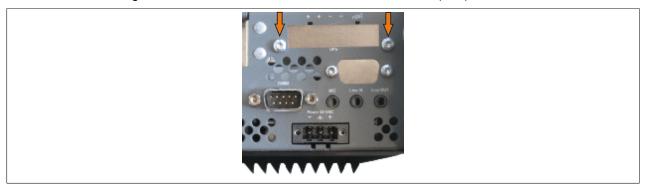


Abbildung 238: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring am Basisboard montieren (mittels Innensechskant- Schraubendreher Größe 5).

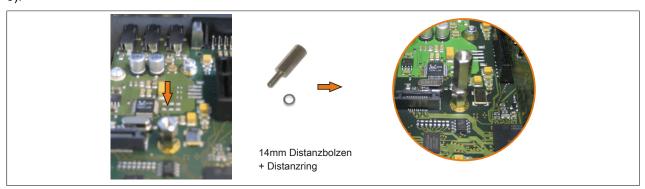


Abbildung 239: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. USV Modul mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.



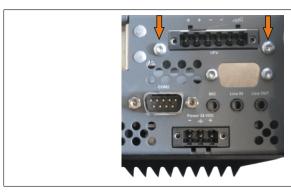




Abbildung 240: USV Modul montieren

5. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

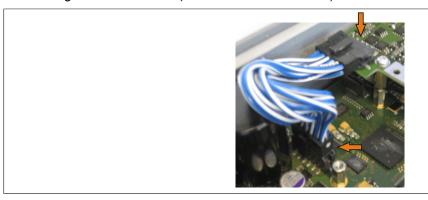


Abbildung 241: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

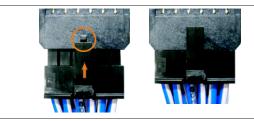


Abbildung 242: Steckerverriegelung

6. Seitendeckel montieren.

7.1.2 APC810 2 und 3 Card Slot

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418).
- 2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

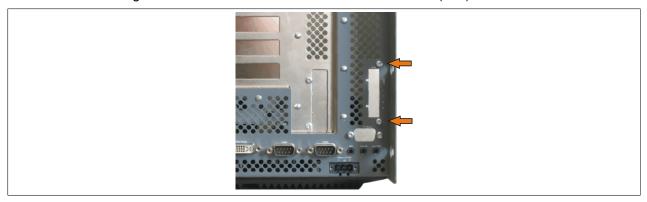


Abbildung 243: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring am Basisboard montieren (mittels Innensechskant- Schraubendreher Größe 5).

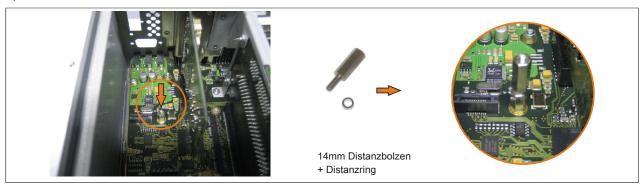


Abbildung 244: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

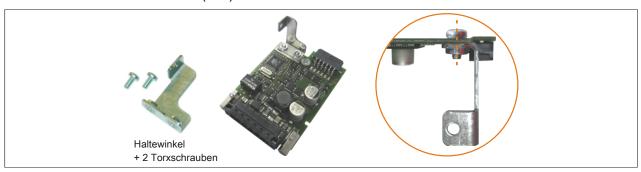


Abbildung 245: Haltewinkel montieren

5. USV Modul mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.

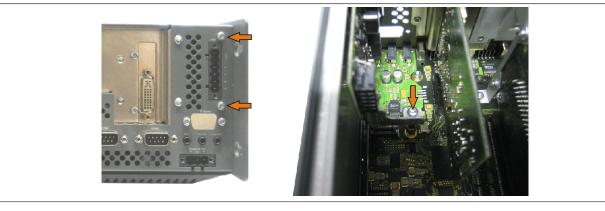


Abbildung 246: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).



Abbildung 247: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.



Abbildung 248: Steckerverriegelung

7. Seitendeckel montieren.

7.1.3 APC810 5 Card Slot

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418).
- 2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

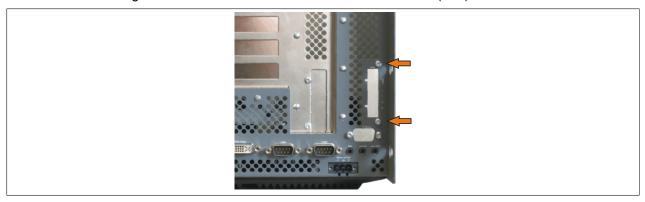


Abbildung 249: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

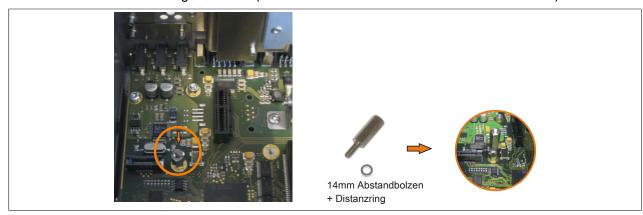


Abbildung 250: Distanzbolzen und Distanzrig montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxsschrauben (T10) am USV Modul montieren.

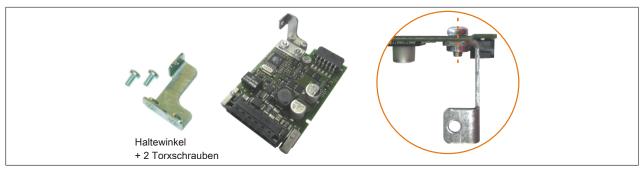


Abbildung 251: Haltewinkel montieren

5. USV Modul mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.

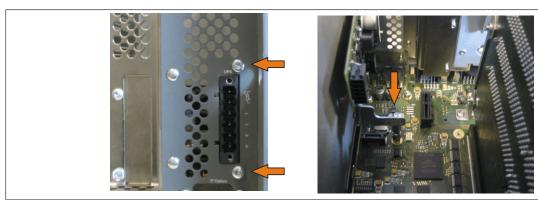


Abbildung 252: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anbringen (siehe markierte Buchsen)

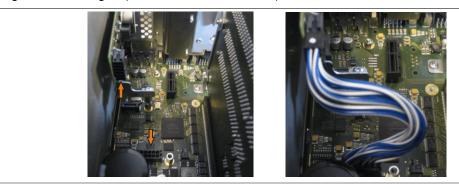


Abbildung 253: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

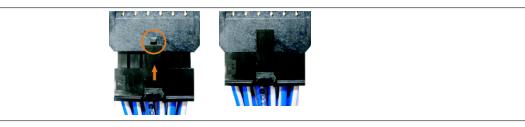


Abbildung 254: Steckerverriegelung

7. Seitendeckel montieren

7.2 Montage mit montiertem Add-on Schnittstellenmodul

7.2.1 APC810 1 Card Slot

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418).
- 2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.



Abbildung 255: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

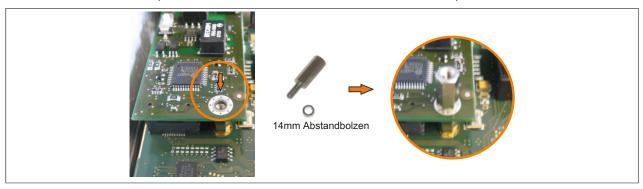


Abbildung 256: Distanzbolzen montieren

4. USV Modul mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben und eine Torxschraube aus dem Montagematerial zu verwenden.

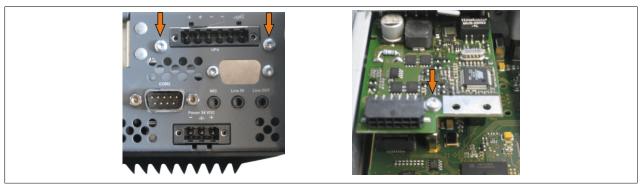


Abbildung 257: USV Modul montieren

5. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

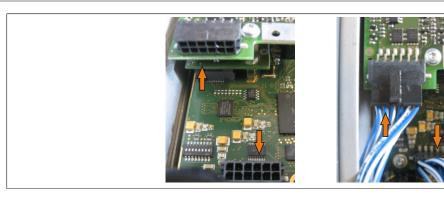


Abbildung 258: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

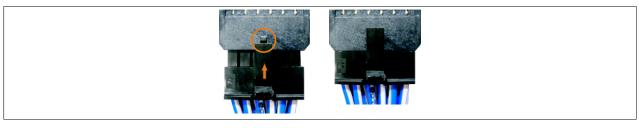


Abbildung 259: Steckerverriegelung

6. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

7.2.2 APC810 2 und 3 Card Slot

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418).
- 2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

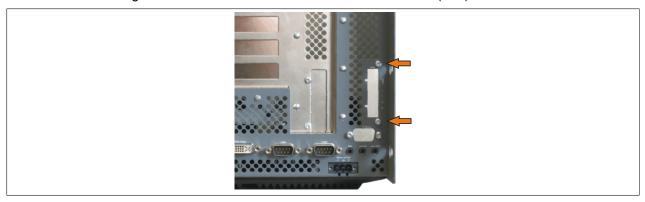


Abbildung 260: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).



Abbildung 261: Distanzbolzen montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

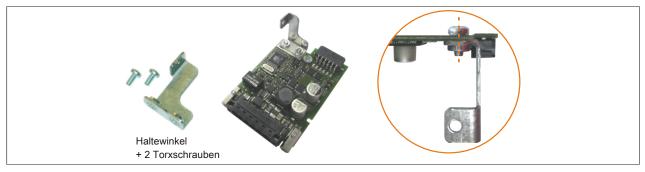


Abbildung 262: Haltewinkel montieren

5. USV Modul mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben und eine Torxschraube aus dem Montagematerial zu verwenden.

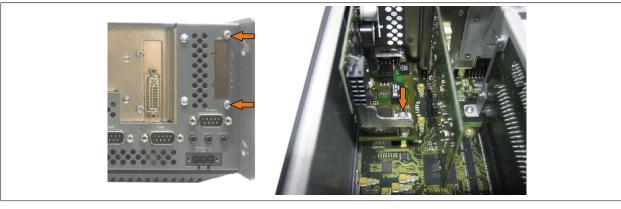


Abbildung 263: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).



Abbildung 264: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.



Abbildung 265: Steckerverriegelung

7. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

7.2.3 APC810 5 Card Slot

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418).
- 2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

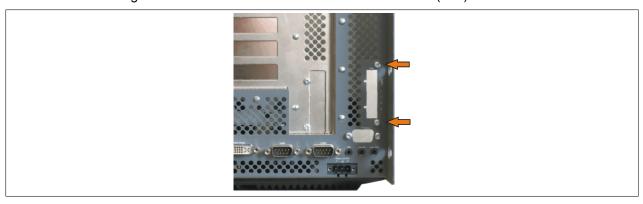


Abbildung 266: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

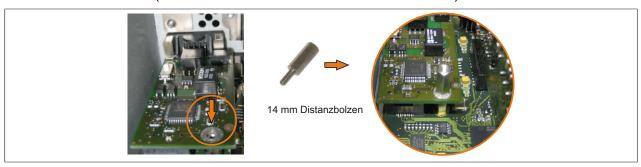


Abbildung 267: Distanzbolzen montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

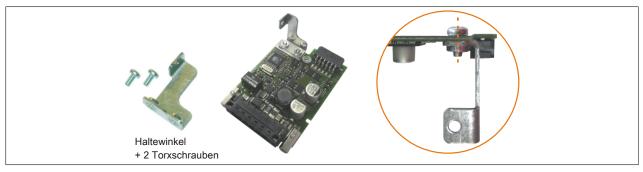


Abbildung 268: Haltewinkel montieren

5. USV Modul mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben und eine Torxschraube aus dem Montagematerial zu verwenden.

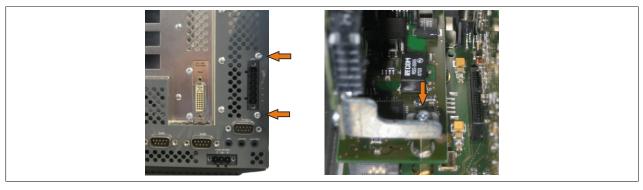


Abbildung 269: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

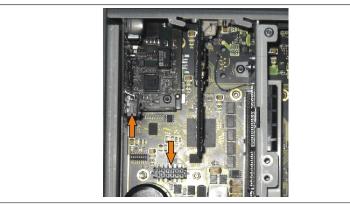




Abbildung 270: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

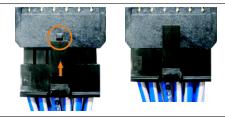


Abbildung 271: Steckerverriegelung

7. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

8 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit

Information:

Das USV Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00 wird nur für Batterieeinheiten bis einschließlich Revision D0 benötigt. Ab Revision E0 ist bereits eine 25 A Sicherung auf der Steckerpaltine der Batterieeinheit integriert.

8.1 Vorgangsweise

- 1. Die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 durch Abstecken des USV Verbindungskabel vom B&R Industrie PC trennen.
- 2. Die Abdeckung der Batterieeinheit entfernen. Dazu sind die beiden gekennzeichneten Torxschrauben (T10) zu lösen und anschließend die Abdeckung durch Schieben in Richtung des orangen Steckers abzunehmen.



Abbildung 272: Abdeckung der Batterieeinheit entfernen

3. Um die Sicherung montieren zu können muss das rote Kabel von der Batterieplatine gelöst werden.



Abbildung 273: Kabel abstecken

4. Der Stecker des Sicherungs Kit ist mit der Buchse des roten Kabels zu verbinden (1). Die Buchse des Sicherungs Kit muss an dem Stecker der Batterieplatine angeschlossen werden (2).

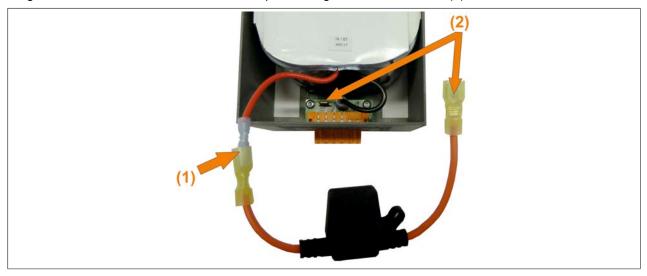


Abbildung 274: Sicherung anschließen

5. Anschließend kann die Sicherung in der Batterieeinheit verstaut werden.



Abbildung 275: Sicherung verstauen

- 6. Die Abdeckung der Batterieeinheit wieder montieren. Dazu die Zapfen der Abdeckung in die Nut der Batterieeinheit stecken und die Abdeckung mit den zu Beginn gelösten Torxschrauben befestigen.
- 7. Abschließend die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 wieder mit dem B&R Industrie PC verbinden.

9 Seitendeckeldemontage

Die Seitenabdeckung kann einfach durch lösen von Torx (T10) Schrauben entfernt werden. Je nach System variiert die Anzahl der Torxschrauben.

9.1 APC810 mit 1 Card Slot

- 1. Zuleitung zum Automation PC 810 spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Öffnen der orangen Frontabdeckung . Hinter der Abdeckung müssen die in der nachfolgenden Abbildung markierten Kombitorxschrauben (T10) gelöst werden.
- 4. Nach dem Lösen der Schrauben ist die Seitenabdeckung durch schieben nach vorne zu entfernen.



Abbildung 276: APC810 1 Card Slot Seitendeckeldemontage

9.2 APC810 mit 2 und 3 Card Slot

- 1. Zuleitung zum Automation PC 810 spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Öffnen der orangen Frontabdeckung . Hinter der Abdeckung müssen die in der nachfolgenden Abbildung markierten Kombitorxschrauben (T10) gelöst werden.
- 4. Nach dem Lösen der Schrauben ist die Seitenabdeckung durch schieben nach vorne zu entfernen.



Abbildung 277: APC810 2 Card Slot Seitendeckeldemontage

9.3 APC810 mit 5 Card Slot

- 1. Zuleitung zum Automation PC 810 spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Öffnen der orangen Frontabdeckung . Hinter der Abdeckung müssen die in der nachfolgenden Abbildung markierten Kombitorxschrauben (T10) gelöst werden.
- 4. Nach dem Lösen der Schrauben ist die Seitenabdeckung durch schieben nach vorne zu entfernen.



Abbildung 278: APC810 5 Card Slot Seitendeckeldemontage

10 AP Link Montage

10.1 Vorgangsweise

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418).
- 2. AP Link Modulabdeckung durch Lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

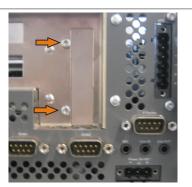


Abbildung 279: AP Link Modulabdeckung entfernen

3. Die AP Link Karte in den dafür vorgesehenen Slot stecken.

Warnung!

Beim Einstecken der AP Link Karte ist darauf zu achten, dass diese richtig in den AP Link Slot einrastet.

Die Karte nicht mit Gewalt in den Slot drücken.

4. AP Link Modul mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial sowie eine zusätzliche Torxschraube zu verwenden.





Abbildung 280: AP Link Modul montieren

5. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

11 Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1

Als Beispiel wird angenommen, dass bei einer RAID 1 Konfiguration die Secondary Hard Disk (HDD1) defekt ist. In diesem Fall ist es möglich, die defekte Hard Disk durch eine Ersatz SATA Hard Disk zu ersetzen.

Bestellnummer PCI SATA RAID Controller	Bestellnummer benötigte Ersatz SATA-HDD	Anmerkung
5ACPCI.RAIC-01	5ACPCI.RAIC-02	60 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-03	5ACPCI.RAIC-04	160 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-05	5MMHDD.0250-00	250 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-06	5MMHDD.0500-00	500 GByte Hard Disk

Tabelle 316: Übersicht benötigte Ersatz SATA-HDD für PCI SATA HDD RAID Controller

Für den Tausch der Hard Disk wird ein Torx Schraubendreher der Größe 10 benötigt.

11.1 Vorgangsweise

- 1. Zuleitung zum Gerät spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Entfernung des Seitendeckels.
- 4. Entfernung des SATA RAID Einschubes.
- 5. Lösen der richtigen 4 Befestigungsschrauben (M3x5).

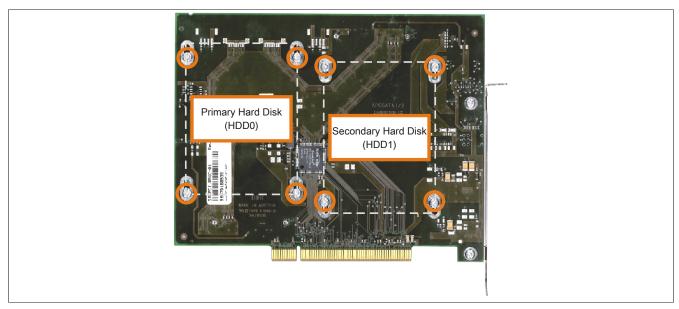


Abbildung 281: Rückseite des SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 Schraubenzuordnung

- 6. Vorderseitig die Hard Disk nach unten hin wegschieben (Abb. 282: Hard Disk Tausch linkes Bild).
- 7. Neue Hard Disk vorsichtig in die Steckverbindung (Abb. 282: Hard Disk Tausch rechtes Bild) aufstecken und dabei die Hard Disk nur an der Stirnseite, nicht an der Oberseite, berühren.

Wartung / Instandhaltung • Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1

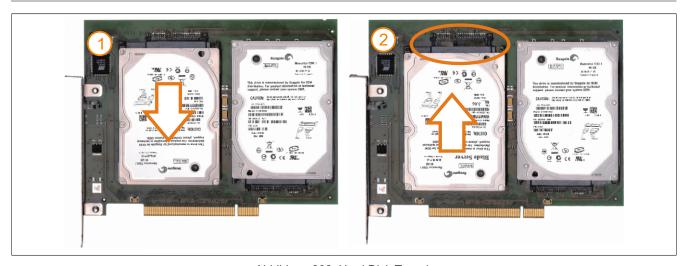


Abbildung 282: Hard Disk Tausch

- 8. Hard Disk mit den zuvor gelösten 4 Befestigungsschrauben (M3x5) wieder fixieren.
- 9. Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
- 10. Nach dem Starten des Systems wird eine Fehlermeldung durch das RAID BIOS ausgegeben "RAID1 set is in Rebuild status The rebuild will continue after boot sequence is complete".
- 11. Es kann über das SATA RAID BIOS sofort ein Rebuild durchgeführt werden, oder der Rebuild wird nach dem Hochstarten des PCs automatisch durchgeführt siehe "Rebuild Mirrored Set" auf Seite 222.

12 Montage der HDD Ersatzdiskablage

12.1 Vorgangsweise

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418).
- 2. Die Ersatz HDD in die Ersatzdiskablage einschieben und mit den Schnellverschlussschrauben befestigen.



Abbildung 283: Montage der Ersatz Hard Disk an der Ersatzdiskablage

- 3. Die HDD Ersatzdiskablage mit den dafür vorgesehnen Haken am Gehäuse des APC810 an den Lüftungsschlitzen des Seitendeckels einschieben.
- 4. Durch leichtes Umbiegen der Haken mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Kombinationszange) innen am Seitendeckel fixieren.



Abbildung 284: Montage der Ersatzdiskablage am APC810

5. Seitendeckel montieren.

13 Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz

13.1 Vorgangsweise

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe Abschnitt 9 "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418).
- 2. USV Modulabdeckung oder montierte USV durch lösen der 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

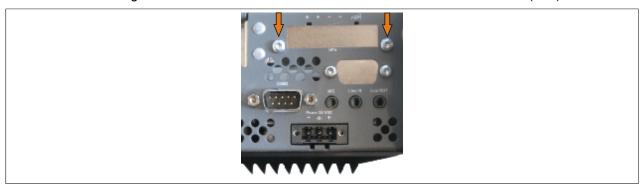


Abbildung 285: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring (sofern nicht schon von der USV montiert) am Basisboard anbringen (mittels Innensechskant-Schraubendreher Größe 5). Bei den APC810 Systemeinheiten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX03-00 ist der Distanzbolzen mit einer Länge von 14 mm zu verwenden, bei der Systemeinheit 5PC810.SX05-00 ist der Distanzbolzen mit einer Länge von 16 mm zu verwenden.

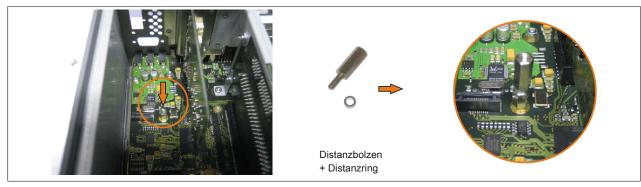


Abbildung 286: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. Ready Relais mit 2 Torxschrauben (T6) und dem Haltewinkel am Gehäuse und 1 Torxschraube (T6) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren.

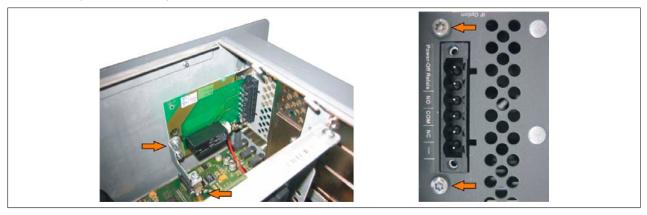


Abbildung 287: Ready Relais montieren

5. Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des internen Spannungsversorgungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

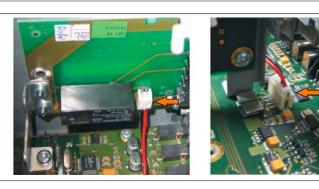


Abbildung 288: Verbindungskabel anstecken

6. Seitendeckel montieren

Anhang A

1 Maintenance Controller Extended (MTCX)

Der MTCX Controller (FPGA-Prozessor) befindet sich auf der Basisboardplatine (Bestandteil jeder Systemeinheit) des APC810 Gerätes.

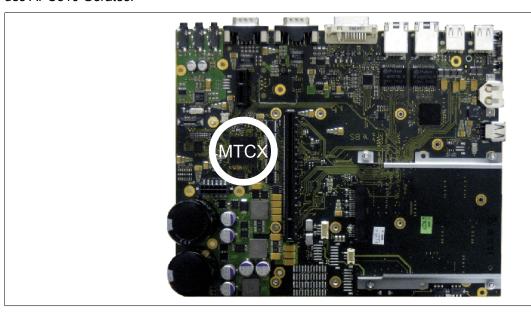


Abbildung 289: Position des MTCX Controllers

Der MTCX ist für folgende Überwachungs- und Steuerfunktionen zuständig:

- · Power On (Power OK Sequencing) und Power Fail Logik
- Watch Dog Handling (NMI und Resethandling)
- Temperaturüberwachung (I/O Bereich, Power Supply, Slide-in Laufwerk 1/2)
- Lüfterregelung
- Tasten und LED Behandlung/Koordination (Matrixtastatur von B&R Displayeinheiten)
- · Erweiterter Desktop Betrieb (Tasten, USB Weiterleitung)
- Daisy Chain Display Betrieb (Touch Screen, USB Weiterleitung)
- Panel Sperrmechanismus (konfigurierbar über B&R Control Center ADI Treiber)
- · Backlight Steuerung eines angeschlossenen B&R Displays
- Statistikdatenermittlung (Power Cycles jedes Einschalten, Power On und Lüfterstunden werden ermittelt
 jede volle Stunde wird gezählt z.B. 50 Minuten keine Erhöhung)
- SDL Datenübertragung (Display, Matrixtastatur, Touch Screen, Servicedaten, USB)
- Status LEDs (Power, HDD, Link 1, Link 2)

Die Funktionen des MTCX können per Firmwareupgrade⁷⁾ erweitert werden. Die Version kann im BIOS (Menüpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

1.1 Temperaturüberwachung Lüfterregelung

Der MTCX überwacht mit Hilfe von Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" auf Seite 38) ständig die Temperatur, in deren Abhängigkeit die Lüfter geregelt werden. Die Drehzahl ist von der gemessenen Temperatur abhängig. Die Grenzwerte sind abhängig von der verwendeten MTCX Firmware Version.

Anhang A • Maintenance Controller Extended (MTCX)

Sensorbereich	Einschalttemperatur	Max Lüfterdrehzahl bei:
CPU	65°C	81°C
Board CPU	65°C	81°C
Board I/O	60°C	76°C
Board ETH2	60°C	76°C
Board Power	60°C	76°C
Power Supply	60°C	76°C
ETH2 Controller	70°C	86°C
Slide-in 1/2	44°C	60°C

Tabelle 317: Temperaturgrenzen der Lüfterregelung (MTCX PX32 V0.06)

Ab der Einschalttemperatur wird mit minimaler Lüfterdrehzahl gestartet. Die maximale Lüfterdrehzahl wird bei Einschalttemperatur + 16°C erreicht. In diesem Bereich wird die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der Temperatur geregelt.

z.B. bei Slide-in 1/2: 44°C + 16°C = 60°C --> maximale Lüfterdrehzahl

Die Lüfter werden erst wieder ausgeschaltet, wenn die Bewertungstemperatur im Zeitraum von 4 Stunden (=Nachlaufzeit) mehr als 6°C unter der Einschalttemperatur liegt.

2 Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard

Ein Stecker auf dem Basisboard ermöglicht zur internen Versorgung von z.B. speziellen PCI Karten die Abzweigung von +5 VDC und +12 VDC.

Mit dem "5CAMSC.0001-00" auf Seite 392 kann die Spannung abgegriffen werden. Der Stecker liegt in der Nähe der Buseinheit(en) und kann an dieser mit einem Kabelbinder fixiert werden (siehe Pfeil in Abbildung). Zum Erreichen des Steckers sind der APC810 Seitendeckel (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 418) sowie eventuelle Slide-in Laufwerke und PCI Steckkarten zu entfernen.



Abbildung 290: Position Stecker für externen Verbraucher

Stecker für den externen Verbraucher			
Pin	Belegung	Leistung	4-polige Stiftleiste, male
1	+12 VDC	max. 10 Watt	
2	GND		
3	GND	max. 5 Watt	
4	+5 VDC	max. 5 Wall	

Tabelle 318: Pinbelegung Stecker am Basisboard

Anschlüsse sind über eine 1A Multifuse abgesichert.

Abbildung 1:	Konfiguration - Grundsystem	29
Abbildung 2:	Konfiguration - optionale Komponenten	
Abbildung 3:	Temperatursensorpositionen	
Abbildung 4:	Spannungsversorgung für Systemeinheiten	
Abbildung 5:	Serialnummernaufkleber Vorderseite	
Abbildung 6:	Serialnummernaufkleber Rückseite	47
Abbildung 7:	Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444	48
Abbildung 8:	5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-00 Blockschaltbild	49
Abbildung 9:	5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-01 Blockschaltbild	50
Abbildung 10:	5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-00 Blockschaltbild	
Abbildung 11:	5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-01 Blockschaltbild	
Abbildung 12:	5PC810.SX03-00 + 5PC810.BX03-00 Blockschaltbild	53
Abbildung 13:	5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-00 Blockschaltbild	
Abbildung 14:	5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-01 Blockschaltbild	55
Abbildung 15:	5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-02 Blockschaltbild	56
Abbildung 16:	Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI Karte	
Abbildung 17:	Abmessungen Standard half-size PCIe Karte	66
Abbildung 18:	Status LEDs Vorderseite	
Abbildung 19:	5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Oberseite	
Abbildung 20:	5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Vorderseite	
Abbildung 21:	5PC810.SX01-00 - Abmessungen	
Abbildung 22:	5PC810.SX01-00 - Bohrschablone	
Abbildung 23:	5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Oberseite	
Abbildung 24:	5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Vorderseite	
Abbildung 25:	5PC810.SX02-00 - Abmessungen	
Abbildung 26:	5PC810.SX02-00 - Bohrschablone	
Abbildung 27:	5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Oberseite	
Abbildung 28:	5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Vorderseite	
Abbildung 29:	5PC810.SX03-00 - Abmessungen	
Abbildung 30:	5PC810.SX03-00 - Bohrschablone	
Abbildung 31:	5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Oberseite	
Abbildung 32:	5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Vorderseite	
Abbildung 33:	5PC810.SX05-00 - Abmessungen	
Abbildung 34:	5PC810.SX05-00 - Bohrschablone	
Abbildung 35:	1 Slot Buseinheiten	
Abbildung 36:	2 Slot Buseinheiten	
Abbildung 37:	3 Slot Buseinheit	
Abbildung 38:	5 Slot Buseinheiten	
Abbildung 39:	5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 40:	5AC801.HDDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 41:	5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 42:	5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 43:	5AC801.HDDI-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.	
Abbildung 44:	5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 45:	5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen	
Abbildung 46:	5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben	
Abbildung 47:	5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.	
Abbildung 48: Abbildung 49:	5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 50:	5AC801.SSDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
~	5MMSSD.0060-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 51: Abbildung 52:	5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 53:	5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 54:	5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luttleuchtediagramm	
Abbildung 55:	5AC801.DVRS-00 - Temperatur Luttleuchtediagramm	
Abbildung 56:	PCI SATA RAID Controller	
Abbildung 57:	5ACPCI.RAIC-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
, wolldulig 31.	C. C. C. VII - Temperatur Luttedortedagramm	. 170

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 58:	5ACPCI.RAIC-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	150
Abbildung 59:	PCI SATA RAID Controller	151
Abbildung 60:	5ACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	153
Abbildung 61:	5ACPCI.RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	155
Abbildung 62:	PCI SATA RAID Controller	156
Abbildung 63:	5ACPCI.RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	158
Abbildung 64:	PCI SATA RAID Controller	159
Abbildung 65:	5ACPCI.RAIC-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	161
Abbildung 66:	5MMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 67:	5MMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 68:	5PC810.FA01-00 - Lüfter Kit	
Abbildung 69:	5PC810.FA02-00 und 5PC810.FA02-01 - Lüfter Kit	167
Abbildung 70:	5PC810.FA03-00 - Lüfter Kit	
Abbildung 71:	5PC810.FA05-00 - Lüfter Kit	
Abbildung 72:	5PC810.SX02-00 - Montagebeispiel mit der Systemeinheit	171
Abbildung 73:	Montagebeispiel mit der Systemeinheit 5PC810.SX02-00	
Abbildung 74:	5AC801.RDYR-01 - Lieferumfang	
Abbildung 75:	Schnittstellenoptionen (IF Option)	
Abbildung 76:	5AC600.CANI-00 - Abschlusswiderstand Add-on CAN Interface	
Abbildung 77:	5AC600.CANI-00 - Lieferumfang / Montagematerial	
Abbildung 78:	Add-on RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus	
Abbildung 79:	5AC600.485I-00 - Lieferumfang / Montagematerial	
Abbildung 80:	Befestigungslasche	
Abbildung 81:	Einbaulage - senkrecht	
Abbildung 82:	Einbaulage - waagrecht	
Abbildung 83:	Standardmontage - Montageabstände	
Abbildung 84:	Biegeradius Kabelanschluss	
Abbildung 85:	Erdungskonzept	
Abbildung 86:	Einstellungen für Passmark BurnIn Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD	
Abbildung 87:	Testübersicht eines APC810 2 Slot mit DVD	
Abbildung 88:	Ein Automation Panel 900 über DVI onboard (Symbolfoto)	
Abbildung 89:	Ein Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)	
Abbildung 90:	Ein Automation Panel 800 über SDL onboard (Symbolfoto)	
Abbildung 91:	Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard (Symbolfoto)	
Abbildung 92:	Vier Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)	
Abbildung 93:	Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)	
Abbildung 94:	Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)	
Abbildung 95:	Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)	
Abbildung 96:	Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)	
Abbildung 97:	Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)	
Abbildung 98:	Anschluss von USB Peripheriegeräten lokal am APC810	
Abbildung 99:	Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP900 über DVI	
Abbildung 100:	Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP800/900 über SDL	
Abbildung 101:	Einstieg in das RAID Configuration Utility	
Abbildung 102:	RAID Configuration Utility - Menü	
Abbildung 103:	RAID Configuration Utility - Menü	
Abbildung 104:	RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped	
Abbildung 105:	RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored	
Abbildung 106:	RAID Configuration Utility - Delete RAID set	
Abbildung 107:	RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set	
Abbildung 108:	RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts	
Abbildung 109:	RAID Configuration Utility - Low Level Format	
Abbildung 110:	Boot Screen	
Abbildung 111:	945GME BIOS Main Menü	
Abbildung 112:	945GME Advanced Menü	
Abbildung 113:	945GME Advanced ACPI Configuration	
Abbildung 114:	945GME Advanced PCI Configuration	

A la la !! al	OAFONE Advanced DOLIDO December Forbeiter	000
Abbildung 115:	945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion	
Abbildung 116:	945GME Advanced PCI Interrupt Routing	
Abbildung 117:	945GME Advanced PCI Express Configuration	
Abbildung 118:	945GME Advanced Graphics Configuration	
Abbildung 119:	945GME Advanced CPU Configuration	
Abbildung 120:	945GME Advanced Chipset Configuration	
Abbildung 121:	945GME Advanced I/O Interface Configuration	
Abbildung 122:	945GME Advanced Clock Configuration	
Abbildung 123:	945GME Advanced IDE Configuration	
Abbildung 124:	945GME Primary IDE Master	243
Abbildung 125:	945GME Primary IDE Slave	244
Abbildung 126:	945GME Secondary IDE Master	245
Abbildung 127:	945GME Secondary IDE Slave	246
Abbildung 128:	945GME Advanced USB Configuration	247
Abbildung 129:	945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration	
Abbildung 130:	945GME Advanced Remote Access Configuration	
Abbildung 131:	945GME Advanced CPU Board Monitor	
Abbildung 132:	945GME Advanced Baseboard/Panel Features	
Abbildung 133:	945GME Panel Control	
Abbildung 134:	945GME Baseboard Monitor	
Abbildung 135:	945GME Legacy Devices	
Abbildung 136:	945GME Boot Menü	
Abbildung 137:	945GME Security Menü	
Abbildung 138:	945GME Hard Disk Security User Password	
Abbildung 139:	945GME Hard Disk Security Oser Fassword	
•		
Abbildung 140:	945GME Power Menü	
Abbildung 141:	945GME Exit Menü.	
Abbildung 142:	PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME (COM Express) für I	
Abbildung 140.	Version ≤ 1.12	
Abbildung 143:	PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME (COM Express) für l Version ≥ 1.14 (Buseinheiten 5PC810.BX0x-0x)	
Abbildung 144:	PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards 945GME (COM Express) für l	
Abbildung 144:	Version ≥ 1.14 (Buseinheit 5PC810.BX05-02)	
Abbildung 145:	Softwareversion	
Abbildung 145:		
Abbildung 146:		. 275
Abbildung 147:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1	
Abbildung 148:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2	
Abbildung 149:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3	
Abbildung 150:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4	
Abbildung 151:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5	
Abbildung 152:	Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files	
Abbildung 153:	Erstellung einer CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files	
Abbildung 154:	ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto)	299
Abbildung 155:	ADI Control Center - SDL Equalizer Einstellung	301
Abbildung 156:	ADI Control Center - USV Einstellungen	302
Abbildung 157:	ADI Control Center - USV Monitor	303
Abbildung 158:	ADI Control Center - USV Batterieeinstellungen	304
Abbildung 159:	ADI Control Center - USV Einstellungen	305
Abbildung 160:	ADI Control Center - Erweiterte USV Einstellungen	
Abbildung 161:	ADI Development Kit Screenshots (Version 3.40)	
Abbildung 162:	ADI .NET SDK Screenshots (Version 1.80)	
Abbildung 163:	B&R Key Editor Screenshots Version 3.30 (Symbolfoto)	
Abbildung 164:	GL Zertifikat Nr. 11 858 – 10 HH	
Abbildung 165:	5CFCRD.xxxx-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten	
Abbildung 166:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I	
Abbildung 167:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06.	
~	- ATT O DISK DEHOHHAIN VA.ST VEHILEIGH LESEH " JOH OND XXXX-UH HIIL JOHOND XXXX-U).	೮೮ I
Anniidiina 168.		
Abbildung 168:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04 5CFCRD.xxxx-06	mit

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 169:	5CFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten	334
Abbildung 170:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I	.334
Abbildung 171:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04	335
Abbildung 172:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-03	mit
· ·	5CFCRD.xxxx-04	. 335
Abbildung 173:	5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten	338
Abbildung 174:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I	
Abbildung 175:	5MD900.USB2-01 - Schnittstellen	
Abbildung 176:	5MD900.USB2-01 - Abmessungen	
Abbildung 177:	Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe	
Abbildung 178:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe	
Abbildung 179:	5MD900.USB2-01 - Einbaulage	
Abbildung 180:	5MD900.USB2-02 - Schnittstellen	
Abbildung 181:	5MD900.USB2-02 - Abmessungen	
Abbildung 182:	Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe	
Abbildung 183:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe	
Abbildung 184:	5MD900.USB2-02 - Einbaulage	
Abbildung 185:	5A5003.03 - Abmessungen	
Abbildung 186:	Frontklappenmontage und Klemmdicke	
Abbildung 187:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe	
Abbildung 188:	5MMUSB.2048-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 189:	5MMUSB.2048-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	
Abbildung 190:	USV Prinzip	
Abbildung 191:	5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial	
Abbildung 192:	Temperatur Lebensdauerdiagramm	
-	Tiefentladezyklen	
Abbildung 193:	·	
Abbildung 194:	5PC600.UPSB-00 - Abmessungen	
Abbildung 195:	5PC600.UPSB-00 - Bohrschablone	
Abbildung 196:	5AC804.MFLT-00 - Abmessungen	
Abbildung 197:	5AC804.MFLT-00 - Bohrschablone	
Abbildung 198:	Schematisches Anschlussbeispiel	
Abbildung 199:	5ACPCI.ETH1-01 - PCI Ethernet Card 10/100	
Abbildung 200:	5ACPCI.ETH1-01 - Abmessungen	
Abbildung 201:	5ACPCI.ETH3-01 - PCI Ethernet Card 10/100	
Abbildung 202:	5ACPCI.ETH3-01 - Abmessungen	
Abbildung 203:	Biegeradiusspezifikation	
Abbildung 204:	5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen	
Abbildung 205:	5CADVI.0xxx-00 - Belegung	
Abbildung 206:	Biegeradiusspezifikation	
Abbildung 207:	5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen	
Abbildung 208:	5CASDL.0xxx-00 - Belegung	
Abbildung 209:	Biegeradiusspezifikation	
Abbildung 210:	5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen	
Abbildung 211:	5CASDL.0xxx-01 - Belegung	
Abbildung 212:	Biegeradiusspezifikation	
Abbildung 213:	5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen	
Abbildung 214:	5CASDL.0xxx-03 - Belegung	
Abbildung 215:	Biegeradiusspezifikation	
Abbildung 216:	5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen	
Abbildung 217:	5CASDL.0xx0-13 - Belegung	
Abbildung 218:	Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender	
Abbildung 219:	5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel	
Abbildung 220:	9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel	
Abbildung 221:	HDD Ersatzdiskablage - 5AC801.FRAM-00	
Abbildung 222:	5AC801.FRAM-00 - Abmessungen	
Abbildung 223:	Batterie entfernen	
Abbildung 224:	Batteriehandhabung	. 396

Abbildung 225:	Batteriepolarität	
Abbildung 226:	CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto)	
Abbildung 227:	Schnellverschlussschrauben lösen	
Abbildung 228:	Compact SATA Laufwerk einschieben	
Abbildung 229:	Schnellverschlussschrauben lösen	
Abbildung 230:	Slide-in Laufwerkseinbau	
Abbildung 231:	Schnellverschlussschrauben lösen	
Abbildung 232:	Slide-in compact Adapter Einbau	
Abbildung 233:	Slide-in compact Laufwerk montieren	
Abbildung 234:	Lüfter Kit Einschub entfernen	
Abbildung 235:	Lüfter Kit einlegen und befestigen	
Abbildung 236:	Staubfilter mit Filterspange fixieren	
Abbildung 237:	5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial	
Abbildung 238:	USV Modulabdeckung entfernen	
Abbildung 239:	Distanzbolzen und Distanzring montieren	
Abbildung 240:	USV Modul montieren	
Abbildung 241:	Verbindungskabel anstecken	
Abbildung 242:	Steckerverriegelung	
Abbildung 243:	USV Modulabdeckung entfernen	
Abbildung 244:	Distanzbolzen und Distanzring montieren	
Abbildung 245:	Haltewinkel montieren	
Abbildung 246:	USV Modul montieren	
Abbildung 247:	Verbindungskabel anstecken	
Abbildung 248:	Steckerverriegelung	
Abbildung 249:	USV Modulabdeckung entfernen	
Abbildung 250:	Distanzbolzen und Distanzrig montieren	
Abbildung 251:	Haltewinkel montieren	
Abbildung 252:	USV Modul montieren	
Abbildung 253:	Verbindungskabel anstecken	
Abbildung 254:	Steckerverriegelung	
Abbildung 255:	USV Modulabdeckung entfernen	
Abbildung 256:	Distanzbolzen montieren	
Abbildung 257:	USV Modul montieren	
Abbildung 258:	Verbindungskabel anstecken	
Abbildung 259:	Steckerverriegelung	
Abbildung 260:	USV Modulabdeckung entfernen	
Abbildung 261:	Distanzbolzen montieren	
Abbildung 262:	Haltewinkel montieren	
Abbildung 263:	USV Modul montieren	
Abbildung 264:	Verbindungskabel anstecken	
Abbildung 265:	Steckerverriegelung	
Abbildung 266:	USV Modulabdeckung entfernen	
Abbildung 267:	Distanzbolzen montieren	
Abbildung 268:	Haltewinkel montieren	
Abbildung 269:	USV Modul montieren	
Abbildung 270:	Verbindungskabel anstecken	
Abbildung 271:	Steckerverriegelung	
Abbildung 272:	Abdeckung der Batterieeinheit entfernen	
Abbildung 273:	Kabel abstecken	
Abbildung 274:	Sicherung anschließen	
Abbildung 275:	Sicherung verstauen	
Abbildung 276:	APC810 1 Card Slot Seitendeckeldemontage	
Abbildung 277:	APC810 2 Card Slot Seitendeckeldemontage	
Abbildung 278:	APC810 5 Card Slot Seitendeckeldemontage	
Abbildung 279:	AP Link Modulabdeckung entfernen	
Abbildung 280:	AP Link Modul montieren	
Abbildung 281:	Rückseite des SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 Schraubenzuordnung	421

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 282:	Hard Disk Tausch	422
Abbildung 283:	Montage der Ersatz Hard Disk an der Ersatzdiskablage	423
Abbildung 284:	Montage der Ersatzdiskablage am APC810	423
Abbildung 285:	USV Modulabdeckung entfernen	
Abbildung 286:	Distanzbolzen und Distanzring montieren	
Abbildung 287:	Ready Relais montieren	
Abbildung 288:	Verbindungskabel anstecken	
Abbildung 289:	Position des MTCX Controllers	
Abbildung 290:	Position Stecker für externen Verbraucher	428

Tabelle 1: Tabelle 2:	Handbuchhistorie	
Tabelle 3:	Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise	
Tabelle 4:	Nennmaßbereiche	
Tabelle 5:	Umgebungstemperatur ohne Lüfter	
Tabelle 6:	Umgebungstemperatur ohne Lüfter	
Tabelle 7:	Umgebungstemperatur ohne Lüfter	
Tabelle 8:	Umgebungstemperatur mit Lüfter	
Tabelle 9:	Umgebungstemperatur mit Lüfter	
Tabelle 10:	Temperatursensorpositionen	38
Tabelle 11:	Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten	39
Tabelle 12:	Leistungskalkulation APC 1 Slot	41
Tabelle 13:	Leistungskalkulation APC 1 Slot	42
Tabelle 14:	Leistungskalkulation APC 2 Slot	43
Tabelle 15:	Leistungskalkulation APC 2 Slot	
Tabelle 16:	Leistungskalkulation APC 3 Slot	
Tabelle 17:	Leistungskalkulation APC 5 Slot	
Tabelle 18:	Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC	
Tabelle 19:	Pinbelegung COM1	
Tabelle 20:	Pinbelegung COM2	
Tabelle 21:	Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL	
	Pinbelegung DVI Anschluss	
Tabelle 22:		
Tabelle 23:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	
Tabelle 24:	Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung	
Tabelle 25:	Ethernet Anschluss (ETH1)	
Tabelle 26:	Ethernet Anschluss (ETH2)	
Tabelle 27:	USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss	
Tabelle 28:	USB5 Anschluss	
Tabelle 29:	MIC, Line IN, Line OUT	64
Tabelle 30:	Add-on Schnittstellensteckplatz	64
Tabelle 31:	Add-on USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV)	65
Tabelle 32:	Übersicht 64-Bit Karten	66
Tabelle 33:	Daten Status LEDs	68
Tabelle 34:	CMOS Profile Schalter	68
Tabelle 35:	Power Taster	
Tabelle 36:	Reset Taster	
Tabelle 37:	Batterie	
Tabelle 38:	Bedeutung Batteriestatus	
Tabelle 39:	Hardware Security Key	
Tabelle 40:	CompactFlash Slot (CF1)	
Tabelle 41:		
	CompactFlash Slot (CF2)	
Tabelle 42:	Slide-in Slot 1	
Tabelle 43:	Slide-in Slot 2	
Tabelle 44:	Slide-in compact Slot	
Tabelle 45:	5PC810.SX01-00 - Order data	
Tabelle 46:	5PC810.SX01-00 - Technische Daten	
Tabelle 47:	5PC810.SX02-00 - Order data	
Tabelle 48:	5PC810.SX02-00 - Technische Daten	
Tabelle 49:	5PC810.SX03-00 - Order data	89
Tabelle 50:	5PC810.SX03-00 - Technische Daten	91
Tabelle 51:	5PC810.SX05-00 - Order data	96
Tabelle 52:	5PC810.SX05-00 - Technische Daten	99
Tabelle 53:	5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03	-00
	5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Bestelldaten	
Tabelle 54:	5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-01, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten	-00
Tabelle 55:	5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945	
า ฉมะแบ มม.	5PC800.B945-05 - Bestelldaten	

Tabellenverzeichnis

Tabelle 56: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC	C800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Be-
Tabelle 57: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5	
	PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 -
	AC801.HS00-02 - Bestelldaten109
Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5A	AC801.HS00-02 - Technical data109
	5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten 111
Tabelle 62: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01,	5MMDDR.2048-01 - Technische Daten111
Tabelle 63: 5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten	112
Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten	112
Tabelle 65: 5AC801.HDDI-01 - Bestelldaten	114
Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten	114
Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten	116
	116
	118
	118
	120
	122
	122
	126
	128
	162
	164

Tabelle 111:	5PC810.FA01-00 - Bestelldaten	166
Tabelle 112:	5PC810.FA01-00 - Technische Daten	166
Tabelle 113:	5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Bestelldaten	167
Tabelle 114:	5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Technische Daten	167
Tabelle 115:	5PC810.FA03-00 - Bestelldaten	
Tabelle 116:	5PC810.FA03-00 - Technische Daten	168
Tabelle 117:	5PC810.FA05-00 - Bestelldaten	169
Tabelle 118:	5PC810.FA05-00 - Technische Daten	
Tabelle 119:	5AC801.SDL0-00 - Bestelldaten	171
Tabelle 120:	5AC801.SDL0-00 - Technische Daten	171
Tabelle 121:	Pinbelegung DVI Anschluss	
Tabelle 122:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	
Tabelle 123:	5AC801.RDYR-00 - Bestelldaten	
Tabelle 124:	5AC801.RDYR-00 - Pinbelegung Ready Relais	
Tabelle 125:	5AC801.RDYR-01 - Bestelldaten	
Tabelle 126:	5AC801.RDYR-01 - Pinbelegung	174
Tabelle 127:	5AC600.CANI-00 - Bestelldaten	
Tabelle 128:	5AC600.CANI-00 - Technische Daten	
Tabelle 129:	Pinbelegung CAN	177
Tabelle 130:	Add-on CAN - I/O Adresse und IRQ	
Tabelle 131:	CAN Buslänge und Übertragungsrate	177
Tabelle 132:	CAN Kabel Anforderungen	177
Tabelle 133:	5AC600.485I-00 - Bestelldaten	179
Tabelle 134:	5AC600.485I-00 - Technische Daten	179
Tabelle 135:	Pinbelegung RS232/RS422	179
Tabelle 136:	Add-on RS232/422/485 - I/O Adresse und IRQ	179
Tabelle 137:	RS232 Buslänge und Übertragungsrate	180
Tabelle 138:	RS232 Kabel Anforderungen	180
Tabelle 139:	RS422 Buslänge und Übertragungsraten	180
Tabelle 140:	RS422 Kabel Anforderungen	180
Tabelle 141:	RS485 Buslänge und Übertragungsraten	181
Tabelle 142:	RS422 Kabel Anforderungen	181
Tabelle 143:	Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot	190
Tabelle 144:	Auswahl der Displayeinheiten	
Tabelle 145:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	192
Tabelle 146:	Linkbaugruppen	192
Tabelle 147:	Kabel für DVI Konfigurationen	193
Tabelle 148:	Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen	193
Tabelle 149:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	194
Tabelle 150:	Linkbaugruppen	194
Tabelle 151:	Kabel für SDL Konfigurationen	
Tabelle 152:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	
Tabelle 153:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	
Tabelle 154:	Kabel für SDL Konfigurationen	
Tabelle 155:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	
Tabelle 156:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	
Tabelle 157:	Linkbaugruppen	
Tabelle 158:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	
Tabelle 159:	Linkbaugruppen	
Tabelle 160:	Kabel für SDL Konfigurationen	
Tabelle 161:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	
Tabelle 162:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	
Tabelle 163:	Linkbaugruppen	
Tabelle 164:	Kabel für SDL Konfigurationen	
Tabelle 165:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	
Tabelle 166:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	
Tabelle 167:	Linkbaugruppen	206

Tabellenverzeichnis

Tabelle 168:	Kabel für SDL Konfigurationen	206
Tabelle 169:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	206
Tabelle 170:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	208
Tabelle 171:	Linkbaugruppen	208
Tabelle 172:	Kabel für SDL Konfigurationen	209
Tabelle 173:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	209
Tabelle 174:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	211
Tabelle 175:	Linkbaugruppen	212
Tabelle 176:	Kabel für SDL Konfigurationen	
Tabelle 177:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	213
Tabelle 178:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	215
Tabelle 179:	Linkbaugruppen	215
Tabelle 180:	Segmentlängen, Auflösungen und SDL Kabel	215
Tabelle 181:	BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility	219
Tabelle 182:	Biosrelevante Tasten beim POST	227
Tabelle 183:	Biosrelevante Tasten im BIOS Menü	227
Tabelle 184:	945GME Main Menü Einstellmöglichkeiten	228
Tabelle 185:	945GME Advanced Menü Einstellmöglichkeiten	229
Tabelle 186:	945GME Advanced ACPI Configuration Einstellmöglichkeiten	230
Tabelle 187:	945GME Advanced PCI Configuration Einstellmöglichkeiten	231
Tabelle 188:	945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellmöglichkeiten	232
Tabelle 189:	945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten	233
Tabelle 190:	945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten	234
Tabelle 191:	945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten	236
Tabelle 192:	945GME Advanced CPU Configuration Einstellmöglichkeiten	238
Tabelle 193:	945GME Advanced Chipset Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 194:	945GME Advanced I/O Interface Configuration Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 195:	945GME Advanced Clock Configuration Einstellmöglichkeiten	241
Tabelle 196:	945GME Advanced IDE Configuration Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 197:	945GME Primary IDE Master Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 198:	945GME Primary IDE Slave Einstellmöglichkeiten	244
Tabelle 199:	945GME Secondary IDE Master Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 200:	945GME Secondary IDE Slave Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 201:	945GME Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 202:	945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 203:	945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 204:	945GME Advanced CPU Board Monitor Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 205:	945GME Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 206:	945GME Panel Control Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 207:	945GME Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 208:	945GME Legacy Devices Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 209:	945GME Boot Menü Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 210:	945GME Security Menü Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 211:	945GME Hard Disk Security User Password	
Tabelle 212:	945GME Hard Disk Security Master Password	
Tabelle 213:	945GME Power Menü Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 214:	855GME (XTX) Exit Menü Einstellmöglichkeiten	
Tabelle 215:	Profilübersicht	
Tabelle 216:	945GME Main Profileinstellungsübersicht.	
Tabelle 217:	945GME Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 218:	945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 219:	945GME Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 220:	945GME Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 221:	945GME Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 222:	945GME Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 223:	945GME Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 224:	945GME Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsübersicht	∠04

Tabelle 225:	945GME Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 226:	945GME Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 227:	945GME Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 228:	945GME Advanced - Remote Access Configuration Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 229:	945GME Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 230:	945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 231:	945GME Main Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 232:	945GME Security Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 233:	945GME Power Profileinstellungsübersicht	
Tabelle 234:	BIOS Postcode Meldungen BIOS 945GME	
Tabelle 235:	RAM-Adressbelegung	
Tabelle 236:	I/O-Adressbelegung	
Tabelle 237:	IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode	
Tabelle 238:	IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode	
Tabelle 239:	9S0000.01-010, 9S0000.01-020 - Bestelldaten	
Tabelle 240:	Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei DVI Signalen	
Tabelle 241:	Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei RGB Signalen	
Tabelle 242:	5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL, 5SWWXP.0500-ENG WXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten	285
Tabelle 243:	5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.1200-ENG, WI7.1300-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bestelldaten	
Tabelle 244:	5SWWXP.0426-ENG - Bestelldaten	289
Tabelle 245:	Gerätefunktionen unter Windows XP Embedded mit FP2007	
Tabelle 246:	5SWWXP.0726-ENG - Bestelldaten	291
Tabelle 247:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009	291
Tabelle 248:	5SWWI7.1526-ENG, 5SWWI7.1626-ENG, 5SWWI7.1726-MUL, 5SWWI7.1826-MUL - Besten	
Tabelle 249:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7	294
Tabelle 250:	5SWWCE.0826-ENG - Bestelldaten	296
Tabelle 251:	Eigenschaften Windows CE 6.0	296
Tabelle 252:	1A4600.10, 1A4600.10-2, 1A4600.10-3, 1A4600.10-4, 1A4601.06, 1A4601.06-2 - Besten	
Tabelle 253:	Revision der Einzelkomponenten mit GL- Zulassung	318
Tabelle 254:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten	321
Tabelle 255:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten	321
Tabelle 256:	0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten	
Tabelle 257:	0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten	
Tabelle 258:	5AC801.FA01-00, 5AC801.FA02-00, 5AC801.FA03-00, 5AC801.FA05-00 - Bestelldaten	324
Tabelle 259:	5AC900.1000-00 - Bestelldaten	
Tabelle 260:	5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.81 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten	
Tabelle 261:	5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.81 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten	
Tabelle 262:	5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.81 5CFCRD.016G-04 - Bestelldaten	
Tabelle 263:	5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.81 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten	
Tabelle 264:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.10 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten	
Tabelle 265:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.10 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten	
Tabelle 266:	5MD900.USB2-01 - Bestelldaten	
Tabelle 267:	5MD900.USB2-01 - Technische Daten	
Tabelle 268:	5MD900.USB2-01 - Lieferumfang	343
Tabelle 269:	5MD900.USB2-02 - Bestelldaten	
Tabelle 270:	5MD900.USB2-02 - Technische Daten	345
Tabelle 271:	5MD900.USB2-02 - Lieferumfang	348
Tabelle 272:	5A5003.03 - Bestelldaten	349

Tabellenverzeichnis

Tabelle 273:	5A5003.03 - Technische Daten	. 349
Tabelle 274:	5A5003.03 - Lieferumfang	.349
Tabelle 275:	5MMUSB.2048-00 - Bestelldaten	.351
Tabelle 276:	5MMUSB.2048-00 - Technische Daten	. 351
Tabelle 277:	5MMUSB.2048-01 - Bestelldaten	.353
Tabelle 278:	5MMUSB.2048-01 - Technische Daten	. 353
Tabelle 279:	5SWHMI.0000-00 - Bestelldaten	.355
Tabelle 280:	5AC600.UPSI-00 - Bestelldaten	.359
Tabelle 281:	5AC600.UPSI-00 - Technische Daten	. 359
Tabelle 282:	5AC600.UPSB-00 - Bestelldaten	. 360
Tabelle 283:	5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten	
Tabelle 284:	5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Bestelldaten	. 363
Tabelle 285:	5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Technische Daten	.363
Tabelle 286:	5AC600.UPSF-00 - Bestelldaten	364
Tabelle 287:	5AC600.UPSF-01 - Bestelldaten	364
Tabelle 288:	5AC804.MFLT-00 - Bestelldaten	.365
Tabelle 289:	5AC804.MFLT-00 - Technische Daten	365
Tabelle 290:	5ACPCI.ETH1-01 - Bestelldaten	.367
Tabelle 291:	5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten	367
Tabelle 292:	5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten	368
Tabelle 293:	5ACPCI.ETH3-01 - Bestelldaten	.370
Tabelle 294:	5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten	370
Tabelle 295:	5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten	371
Tabelle 296:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten	.373
Tabelle 297:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten	373
Tabelle 298:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200	0-00,
	5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten	
Tabelle 299:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200	
	5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten	
Tabelle 300:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten	
Tabelle 301:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische ten	
Tabelle 302:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200	
	5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten	
Tabelle 303:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200	0-03,
	5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten	. 382
Tabelle 304:	Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03	
Tabelle 305:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten	.385
Tabelle 306:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten	385
Tabelle 307:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten	. 389
Tabelle 308:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten	.389
Tabelle 309:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten	.390
Tabelle 310:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten	. 390
Tabelle 311:	5CAMSC.0001-00 - Bestelldaten	. 392
Tabelle 312:	5CAMSC.0001-00 - Technische Daten	
Tabelle 313:	5AC801.FRAM-00 - Bestelldaten	.393
Tabelle 314:	5AC801.FRAM-00 - Technische Daten	393
Tabelle 315:	Bedeutung Batteriestatus	. 395
Tabelle 316:	Übersicht benötigte Ersatz SATA-HDD für PCI SATA HDD RAID Controller	.421
Tabelle 317:	Temperaturgrenzen der Lüfterregelung (MTCX PX32 V0.06)	. 427
Tabelle 318:	Pinbelegung Stecker am Basisboard	.428

0AC201.91	
0TB103.9	
0TB103.91	
1A4600.10	
1A4600.10-2	
1A4600.10-3	
1A4600.10-4	
1A4601.06	
1A4601.06-2	
4A0006.00-000	
5A5003.03	
5AC600.485I-00	
5AC600.CANI-00	
5AC600.UPSB-00	
5AC600.UPSF-00	
5AC600.UPSF-01	
5AC600.UPSI-00	
5AC801.ADAS-00	
5AC801.DVDS-005AC801.DVRS-00	
5AC801.FA01-00	
5AC801.FA02-005AC801.FA03-00	
5AC801.FA05-005AC801.FA05-00	
5AC801.FRAM-005	
5AC801.HDDI-005	
5AC801.HDDI-005AC801.HDDI-01	
5AC801.HDDI-025	
5AC801.HDDI-03	
5AC801.HDDI-03	
5AC801.HDDS-00	
5AC801.HS00-005AC801.HS00-00	
5AC801.HS00-015AC801.HS00-01	
5AC801.HS00-02	
5AC801.RDYR-00	
5AC801.RDYR-01	
5AC801.SDL0-00	
5AC801.SSDI-00	
5AC801.SSDI-01	
5AC801.SSDI-02	
5AC801.SSDI-03	
5AC804.MFLT-00	
5AC900.1000-00.	
5ACPCI.ETH1-01	
5ACPCI.ETH3-01	
5ACPCI.RAIC-01	
5ACPCI.RAIC-02	
5ACPCI.RAIC-03	
5ACPCI.RAIC-04	
5ACPCI.RAIC-05	
5ACPCI.RAIC-06	
5CADVI.0018-00	
5CADVI.0050-00	
5CADVI.0100-00	
5CAMSC.0001-00	
5CASDL.0018-00	
5CASDL.0018-01	
5CASDL.0018-03	
5CASDL.0050-00	
5CASDL.0050-01	
5CASDL.0050-03	
5CASDL.0100-00	

Bestellnummernindex

5CASDL.0100-01	
5CASDL.0100-03	382
5CASDL.0150-00	376
5CASDL.0150-01	379
5CASDL.0150-03	382
5CASDL.0200-00	376
5CASDL.0200-03	382
5CASDL.0250-00	376
5CASDL.0250-03	382
5CASDL.0300-00	376
5CASDL.0300-03	382
5CASDL.0300-13	385
5CASDL.0400-13	
5CASDL.0430-13	
5CAUPS.0005-00	
5CAUPS.0030-00	
5CAUSB.0018-00	
5CAUSB.0050-00	
5CFCRD.0064-03	
5CFCRD.0128-03	
5CFCRD.016G-04	
5CFCRD.016G-06	
5CFCRD.0256-03	
5CFCRD.032G-06	
5CFCRD.0512-03	
5CFCRD.0512-03	
5CFCRD.0512-06	
5CFCRD.1024-03	
5CFCRD.1024-04	
5CFCRD.1024-06	
5CFCRD.2048-03	
5CFCRD.2048-04	
5CFCRD.2048-06	
5CFCRD.4096-03	
5CFCRD.4096-04	
5CFCRD.4096-06	
5CFCRD.8192-03	
5CFCRD.8192-04	
5CFCRD.8192-06	
5MD900.USB2-01	
5MD900.USB2-02	
5MMDDR.0512-01	111
5MMDDR.1024-01	111
5MMDDR.2048-01	111
5MMHDD.0250-00	162
5MMHDD.0500-00	164
5MMSSD.0060-00	
5MMSSD.0060-01	
5MMSSD.0180-00	
5MMUSB.2048-00	
5MMUSB.2048-01	
5PC800.B945-00	
5PC800.B945-01	
5PC800.B945-025PC800.B945-02	
5PC800.B945-035PC800.B945-03	
5PC800.B945-045PC800.B945-04	
5PC800.B945-04	
5PC800.B945-105PC800.B945-10	
5PC800.B945-11	
5PC800.B945-12	
5PC800.B945-13	
5PC800.B945-14	106

5PC810.BX01-00	104
5PC810.BX01-01	
5PC810.BX02-00	
5PC810.BX02-01	
5PC810.BX03-00	
5PC810.BX05-00	
5PC810.BX05-01	
5PC810.BX05-02	
5PC810.FA01-00	
5PC810.FA02-00	167
5PC810.FA02-01	
5PC810.FA03-00	
5PC810.FA05-00	169
5PC810.SX01-00	75
5PC810.SX02-00	
5PC810.SX03-00	89
5PC810.SX05-00	96
5SWHMI.0000-00	355
5SWWCE.0826-ENG	296
5SWWI7.1100-ENG	287
5SWWI7.1100-GER	287
5SWWI7.1200-ENG	287
5SWWI7.1200-GER	287
5SWWI7.1300-MUL	287
5SWWI7.1400-MUL	287
5SWWI7.1526-ENG	293
5SWWI7.1626-ENG	293
5SWWI7.1726-MUL	293
5SWW17.1826-MUL	293
5SWWXP.0426-ENG	289
5SWWXP.0500-ENG	285
5SWWXP.0500-GER	285
5SWWXP.0500-MUL	285
5SWWXP.0600-ENG	285
5SWWXP.0600-GER	285
5SWWXP.0600-MUL	285
5SWWXP.0726-ENG	291
9A0014.02	390
9A0014.05	390
9A0014.10	390
9S0000.01-010	284
9S0000.01-020	284

Stichwortverzeichnis

9

945GME	106
A	
Abmessungen	
5A5003.03	349
5MD900.USB2-02	
APC810 1 Card Slot	
APC810 2 Card Slot.	
APC810 3 Card Slot	
APC810 5 Card Slot	
Standard half-size PCle Karte	
Standard half-size PCI Karte	
ACPI	
Add-on Schnittstellensteckplatz	
Add-on USV Modul	
Add-on USV Steckplatz	
ADI	
.NET SDK	
Development Kit	
SDL Equalizer Einstellung	
Allgemeintoleranz	
Anleitung Temperaturtest	
Anschluss externer Verbraucher	
Anschluss von Kabeln	185
APC810 1 Card Slot	
Abmessungen	80
Bohrschablone	81
Schnittstellen	76
Technische Daten	
APC810 2 Card Slot	
Abmessungen	87
Bohrschablone	
Schnittstellen	
Technische Daten	
APC810 3 Card Slot	0+
Abmessungen	04
Bohrschablone	
Schnittstellen	
Technische Daten	91
APC810 5 Card Slot	
Abmessungen	
Bohrschablone	
Schnittstellen	
Technische Daten	99
AP Link Montage	420
AP Link Steckplatz	65
ARemb	298
ARwin	298
ATEX Zulassung	316
Auflösung	
Auflösung DVI	
Auflösung SDL	
Auswertung Temperaturen	
Automation Runtime	
Automation Runtime Embedded	
Automation Runtime Embedded	
Automation runtime windows	290

В

B&R Automation Device Interface	299
B&R CompactFlash	332
B&R Control Center	
B&R Embedded OS Installer	
B&R Key Editor	
Batteriepolarität verkehrt	
Batteriestatusermittlung	
Batteriewechsel	
Beep Codes	
·	
Befestigungslasche	
Beispielprogramme	
Bemaßungsnorm	22
Betriebssystem	
Windows 7	
Windows CE	
Windows Embedded Standard 2009	291
Windows Embedded Standard 7	293
Windows XP Embedded	289
Windows XP Professional	285
Biegeradius	
Biegeradiusspezifikation	
BIOS 945GME	
ACPI Configuration	230
Advanced	
Baseboard/Panel Features	
Baseboard Monitor	
Boot	
Chipset Configuration	
Clock Configuration	
CPU Board Monitor	
CPU Configuration	
Exit	
Graphics Configuration	
Hard Disk Security Master Password	259
Hard Disk Security User Password	259
I/O Interface Configuration	240
IDE Configuration	241
Keyboard/Mouse Configuration	248
Legacy Devices	
Main	
Panel Control	
PCI Configuration	
PCI Express Configuration	
Power Access Configuration	
Remote Access Configuration	
Security	
USB Configuration	
BIOS Defaulteinstellungen	
BIOS Fehlersignale	
BIOS Setup Tasten	
BIOS Upgrade	
Blockschaltbild Spannungsversorgung	40
С	
Card Slot Steckplatz	66
CE- Kennzeichnung	
CMOS Profile Schalter	
COM1	
COM2	
OOIVIZ	JO, 36

Stichwortverzeichnis CompactFlash D Ε ETH1.......61 F G Н

I/O-AdressbelegungI/O-Adressbelegung	
Implementierungsanleitung	
Interrupt- Zuweisung	269
K	
Kabel	373
DVI Kabel	
SDL Kabel	
SDL Kabel flex	
SDL Kabel flex mit Extender	
SDL Kabel mit 45° Stecker	
USB Kabel	
Key Editor	
Klimakammer	
Konfiguration	. 190
Grundsystem	20
optionale Komponenten	
Kühlkörper	
Nullikolpei	109
L	
-	
Laufwerke	112
LED	68
Loopback Adapter	189
Low Battery	
Lüfter Kit.	
Lüfter Kit Einbau / Tausch	
Lüfterregelung	
Luftfeuchtigkeitsangaben	
Luftzirkulation	
M	
Maintenance Controller Extended	426
MIC, Line IN, Line OUT	
Monitor / Panel Anschluss	
Montage der UDD Freetrdiekehlere	
Montage der HDD Ersatzdiskablage	
Montage des Ready Relais /2	
Montage des USV Moduls	
Montage USV Sicherungs Kit	
MS-DOSMTCX	
W1 0/	. 420
N	
Netzfilter	
Niederspannungsrichtlinie	315
P	
Parity Error	
PCI	
PCI / PCIe	
Powerfail	
Power Taster	69

Stichwortverzeichnis

R

RAM-Adressbelegung	
Relative Luftfeuchtigkeit	
Reporterstellung	299
Reset Taster	69
Ressourcenaufteilung I/O-Adressbelegung	269
Richtlinien	
Richtlinien und Erklärungen	
RS232 Kabel	
S	
Schnittstellen	
SDL	
SDL Kabel	376
SDL Kabel flex	382
SDL Kabel flex mit Extender	385
SDL Kabel mit 45° Stecker	
Security Key	71
Seitendeckeldemontage	418
Sensor	
Serialnummernaufkleber	
Serielle Schnittstelle	58, 58
Sicherheitshinweise	
Bestimmungsgemäße Verwendung	
Betrieb	
Montage	
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	
Transport und Lagerung	
Umgebungsbedingungen	
Umweltgerechte Entsorgung	
Vorschriften und Maßnahmen	
Werkstofftrennung	
Sicherungs Kit USV	
Slide-in compact Adapter Montage	
Slide-in compact Adapter Montage	
Slide-in SlotSlide-in Slot	
Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch	
Smart Display LinkSoftwareversionen	
Spannungsversorgung	
Spannungsversorgungsstecker	
Spannunsversorgung	
Static Wear Leveling	
Status LEDs	
Störfestigkeit	
Störungsableitung	
Т	
Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk	
Temperaturangaben	
Temperaturauswertung	
Temperatursensorpositionen	
Temperaturtest	
Temperaturüberwachung	
Temperaturüberwachung Lüfterregelung	426

U

UL Haz. Loc. Zulassung	
UL Zulassung	
Umgebungstemperatur	
maximal	
maximal mit Lüfter Kit	
maximal ohne Lüfter Kit	
minimal	
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
Upgrade	
BIOS	27/
Firmware	
Upgradeinformationen	
, •	
Upgradeprobleme	
USB Kabel	
USB Media Drive	
USB Memory Stick	
USB Peripheriegeräte	
USB Schnittstellen	
User Serial ID	
USV	
Abschaltzeit der USV	307
Ändern der Abschaltzeit	306
Batterieeinstellungen aktualisieren	
Batterieeinstellungen bearbeiten	303
Batterieeinstellungen sichern	
Installation des USV Dienstes	
Low Battery Shutdown	
Over Current Shutdown	
Powerfail	
Standard Shutdown	
Statuswerte der USV anzeigen	
Systemeinstellungen der USV	
•	
USV Parametrierung	
USV Parametrierung	
USV Sicherungs Kit	
V	
Vorgehensweise Temperaturtest	187
W	
WES2009	291
WES7	
Windows 7	
Windows CE	
Windows Embedded Standard 2009	
Windows Embedded Standard 7	
Windows XP Embedded	
Windows XP Professional	
Z	
Zubehör	
Zulassungen	
ATEX	
Germanischer Lloyd	
UL	
UL Haz. Loc	
J SE E00	